创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

上海季丰电子股份有限公司

Giga Force Electronics Co., Ltd.

（上海市闵行区友东路 258-288 号 2 幢 101 室）

GIGA FORCE
季丰电子

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

（申报稿）

声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

光大证券股份有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD.

（上海市静安区新闸路 1508 号）

声明

中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者的声明

一、发行人上市的目的

公司是一家半导体领域检测服务与检测硬件产品的全功能、一站式解决方案提供商，围绕芯片设计、晶圆制造、封装等半导体全产业链企业的检测需求，提供第三方实验室检测分析服务、集成电路测试板等检测硬件产品以及量产测试服务。通过本次上市，公司将深化半导体检测领域“服务+产品”的一站式能力，强化从“0-1”阶段的检验检测业务到规模量产业务的双轮驱动模式，致力于打造全球领先的半导体一站式解决方案提供商，构建更为先进、完善的检测服务体系与检测硬件产品矩阵，助力中国半导体产业打破技术壁垒，加速关键环节的国产化替代进程，为产业链自主可控提供坚实的技术支撑与质量保障。

通过本次发行，公司将紧跟国际技术路线，持续提升在先进制程、先进封装等前沿领域的检测分析技术能力，并实现检测服务产能的稳步扩充，以满足下游客户日益增长的高端检测需求。在此基础上，公司将深挖客户全生命周期需求，推动业务从“研发验证分析”向“量产测试”有效延伸，为客户提供高可靠性芯片产品量产测试服务，着力打造公司业绩的第二增长极。同时，公司将继续深化“检测服务”与“硬件产品”的协同发展战略，以服务需求牵引产品迭代，以产品创新赋能服务升级，进一步扩大技术闭环优势，提升综合解决方案能力，构建差异化的市场竞争壁垒。通过本次发行上市，公司将全面巩固和提升在半导体检测领域的市场地位，增强核心竞争力和抗风险能力，为公司实现长期可持续高质量发展奠定坚实基础。

本次发行上市将拓宽公司融资渠道，完善人才引进与激励机制，吸引和留住高端人才，增强创新活力。同时，上市将全面提升公司品牌影响力与市场公信力，助力公司拓展优质客户资源，巩固并提升市场地位。通过上市推动公司建立更加规范、透明的现代企业治理体系，提升运营效率与抗风险能力，实现长期稳健发展，以更优异的业绩回报股东、回馈社会，更好地服务于国家半导体产业自主可控的重大战略需求。

二、发行人现代企业制度的建立健全情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的

要求，建立健全了由股东（大）会、董事会、独立董事和高级管理人员组成的治理结构。公司建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《总经理工作制度》《董事会秘书工作制度》《内部审计制度》《募集资金管理制度》等制度，并建立了战略、审计、薪酬与考核、提名等董事会下属委员会。公司股东（大）会、董事会及相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制，组织结构健全且运行良好，相关机构和人员能够依法履行职责。

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划

公司本次募集资金主要投向“浦东技术中心项目”“车规级高可靠量产测试服务建设项目”“芯片中试平台工程技术研发项目”“补充流动资金”等四个项目。本次募集资金投资项目紧密围绕公司战略目标而开展，与主营业务紧密相关，符合国家产业政策与公司发展战略。

“浦东技术中心项目”旨在进一步扩充第三方实验室检测分析业务产能，提升高端检测分析服务能力，完善公司在集成电路第三方实验室检测分析领域的区位布局，巩固公司市场地位，从而进一步提升盈利水平。“车规级高可靠量产测试服务建设项目”旨在进一步布局量产测试业务，有利于公司实现从“0-1”第三方实验室业务到规模量产业务的延伸，拓展公司的“第二增长曲线”。“芯片中试平台工程技术研发项目”有利于发行人聚焦人工智能及高性能计算等前沿领域，布局大功率、先进制程、先进封装芯片的检测分析技术。“补充流动资金”旨在补充与主营业务相关的营运资金，缓解公司营运资金压力，夯实公司发展基础。

四、发行人持续经营能力及未来发展规划

公司提供的检测服务与检测硬件产品，检测对象全面覆盖各类芯片，具备CPU、GPU、存储芯片、AI 芯片等高端芯片的检测服务能力，能够满足先进制程（最先进制程案例已覆盖 3nm 芯片）、先进封装（2.5D、3D 封装等）、成熟制程以及特色工艺的检测需求。公司围绕全国半导体产业集聚地进行区域布局，贴近关键客户，提升响应速度与服务品质。凭借全功能、一站式模式以及优秀的

技术实力与服务品质，公司已与半导体产业链内超过 3,000 家客户建立了合作关系，客户涵盖芯片设计、晶圆制造、封测等全环节，包括客户 D、中兴通讯、高通、客户 H、华虹宏力、长电科技等知名企业。报告期内，公司营业收入分别为 44,336.65 万元、58,348.29 万元、66,949.34 万元**及 37,885.76 万元，2023 至 2025 年度**营业收入复合增长率为 22.88%。依托卓越的技术服务能力、优质的客户结构、完善的区域布局，公司业务规模持续提升，持续经营能力不断增强。

未来，公司将把握中国大陆半导体行业快速发展及供应链国产化的历史机遇，坚持“技术驱动、品质为先”的经营战略。依托现有的技术积累和优质客户资源，公司将进一步完善产业链布局，深化半导体检测领域“服务+产品”的一站式能力，强化从“0-1”阶段的检验检测业务到规模量产业务的双轮驱动模式，致力于成为全球领先的半导体全功能、一站式解决方案提供商，更好地服务于国家半导体产业发展战略。

（本页无正文，为《致投资者的声明》之签章页）

董事长：

郑朝晖

上海季丰电子股份有限公司

2026年 9月 18日

发行概况

发行股票类型	**人民币普通股（A 股）**
发行股数	发行不超过 3,852.87 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于发行后公司总股本的 25%。本次发行股份全部为新股，不涉及原股东公开发售股份
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元/股
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市证券交易所和板块	深圳证券交易所创业板
发行后总股本	不超过 15,411.47 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），均为境内上市流通的股份，不涉及境外上市外资股
保荐人（主承销商）	光大证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

目 录

声明.....1

致投资者的声明.....2

一、发行人上市的目的.....2

二、发行人现代企业制度的建立健全情况.....2

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.....3

四、发行人持续经营能力及未来发展规划.....3

发行概况.....6

目 录.....7

第一节 释义.....11

一、普通术语释义.....11

二、专业术语释义.....15

第二节 概览.....18

一、重大事项提示.....18

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.....21

三、本次发行概况.....22

四、发行人主营业务经营情况.....23

五、发行人板块定位情况.....27

六、发行人主要财务数据及财务指标.....30

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息（如有）.....31

八、发行人选择的具体上市标准.....31

九、发行人公司治理特殊安排.....32

十、募集资金运用与未来发展规划.....32

十一、其他对发行人有重大影响的事项.....33

第三节 风险因素.....34

一、与发行人相关的风险.....34

二、与行业相关的风险.....38

三、其他风险.....40

第四节 发行人基本情况 42
一、发行人基本情况 42
二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况 42
三、发行人报告期内的重大资产重组情况 75
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 75
五、发行人的股权结构及内部组织结构 76
六、发行人的子公司及参股公司 78
七、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况 86
八、公司特别表决权或类似安排情况 98
九、公司协议控制架构 98
十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪或重大违法行为 98
十一、发行人股本情况 98
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 116
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 121
十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的重大协议及履行情况 121
十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况 121
十六、董事、监事、高级管理人员及其核心人员最近两年的变动情况 122
十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 123
十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 124
十九、发行人股权激励及相关安排 125
二十、发行人员工及其社会保障情况 127
第五节 业务与技术 130
一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况 130
二、发行人所处行业情况 155
三、发行人的销售情况和主要客户 204
四、发行人的采购情况和主要供应商 210

五、发行人主要固定资产和无形资产.....212
六、发行人核心技术和研发情况.....220
七、发行人环境保护情况.....235
八、发行人境外经营及境外资产情况.....237
第六节 财务会计信息与管理层分析 238
一、财务报表.....238
二、主要会计政策和会计估计.....247
三、税项.....257
四、经注册会计师鉴证的非经常性损益表.....259
五、报告期内的主要财务指标.....260
六、资产负债表日后事项、承诺及或有事项、其他重要事项.....262
七、经营成果分析.....263
八、财务状况分析.....297
九、偿债能力、流动性与持续经营能力.....328
十、资本性支出.....337
十一、发行人盈利预测情况.....337
第七节 募集资金运用与未来发展规划 338
一、募集资金运用概况.....338
二、未来发展规划.....340
第八节 公司治理与独立性 342
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.....342
二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见....342
三、发行人报告期内违法违规情况.....343
四、发行人资金占用和对外担保情况.....343
五、发行人的独立性.....343
六、同业竞争.....345
七、关联方及关联关系.....345
八、关联交易情况.....351
第九节 投资者保护 361
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排.....361

二、股利分配政策.....361
三、长期回报规划.....363
四、发行人特别表决权股份、协议控制架构或类似安排的情况.....364
第十节 其他重要事项.....365
一、重要合同.....365
二、对外担保事项.....371
三、诉讼或仲裁事项.....371
第十一节 声明.....372
一、发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明.....372
二、发行人控股股东及实际控制人声明.....373
三、保荐人（主承销商）声明.....374
四、发行人律师声明.....377
五、审计机构声明.....378
六、资产评估机构声明.....379
七、验资机构声明.....382
八、验资复核机构声明.....383
第十二节 附件.....384
一、备查文件.....384
二、查阅地址及时间.....385
三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.....385
四、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项.....388
五、股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.....404
六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.....406
七、募集资金具体运用情况.....406
八、发行人及其子公司拥有的专利.....417
九、发行人及其子公司拥有的注册商标.....425
十、发行人及其子公司拥有的计算机软件著作权.....430

第一节 释义

本招股说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

一、普通术语释义

简称	全称
公司、本公司、发行人、季丰电子	上海季丰电子股份有限公司
季丰有限、有限公司	上海季丰电子有限公司
季铭源	上海季铭源企业管理合伙企业（有限合伙）；曾用名：上海季青投资中心（有限合伙），系发行人股东
嘉善芯创	嘉善芯创壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
苏州元禾	苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
财通创新	财通创新投资有限公司，财通证券（601108.SH）子公司，系发行人股东
江山季兴	江山季兴企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
福州嘉衍	福州嘉衍创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
俱成秋实	南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
沪电股份	沪士电子股份有限公司（002463.SZ），系发行人股东
衢州绿发	衢州绿发芯测新材料产业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
尚成一号	河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
聚源信诚	聚源信诚（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
渝富益华	重庆渝富益华钧芯壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
上海季双	上海季双企业管理合伙企业（有限合伙）；曾用名：江山季佳企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
芜湖信芯	芜湖信芯股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
嘉兴君源	嘉兴君源股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
俱成秋实贰号	南京俱成秋实贰号创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
绍兴绿杉	绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
南通中皋	南通中皋君桐新兴产业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
春山锐卓	青岛春山锐卓股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
湖州创投	湖州市人才创新股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
天津合泰	天津合泰昇通国际贸易合伙企业（有限合伙），系发行人股东
衢州金藤	衢州金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名：珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
思瑞浦	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（688536.SH），系发行人股东

简称	全称
普冉股份	普冉半导体（上海）股份有限公司（688766.SH），系发行人股东
嘉兴君晋	嘉兴君晋股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
商络电子	商络电子投资（海南）有限公司，系发行人股东
成都励石	成都励石创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
上海丽平	上海丽平企业管理咨询有限公司，系发行人股东
江阴瀚联	江阴瀚联智芯股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
厦门同琅	厦门同琅接续创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
交大小苗	南通市交大未来小苗创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
共青城创丰	共青城创丰投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
畅享季	上海畅享季企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
大零号湾	上海大零号湾策源二号创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
苏州清石	苏州清石泽众创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
渝兴益华贰号	南京渝兴益华贰号创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
芜湖聚源	芜湖聚源芯达股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
新锐克胜	北京新锐克胜科技发展有限公司，系发行人股东
上海琦晖	上海琦晖企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人历史股东
上海众松	上海众松创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人历史股东
上海甚泰	上海甚泰企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人历史股东
南京金浦	南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人历史股东
上海骏晨翔	上海骏晨翔电子有限公司，系发行人历史股东
浙江季丰	浙江季丰电子科技有限公司，系发行人全资子公司
深圳季丰	深圳季丰检测技术有限公司，系发行人全资子公司
季丰精密	浙江季丰精密电子有限公司，系发行人全资子公司，曾用名：上海针台半导体科技有限公司
成都季丰	成都季丰检测技术有限公司，系发行人全资子公司
北京季峰	北京季峰检测技术有限公司，系发行人全资子公司
亦庄季峰	北京亦庄季峰检测技术有限公司，系发行人全资子公司
衢州季丰	衢州季丰检测技术有限公司，系发行人全资子公司
季丰科技	上海季丰电子科技有限公司，系发行人全资子公司
季丰计量	上海季丰计量有限公司，系发行人全资子公司
江山季丰	江山季丰电子科技有限公司，系发行人全资子公司
季丰技术	上海季丰技术有限公司，系发行人全资子公司
香港季峰	季峰（香港）电子有限公司，系发行人全资子公司

简称	全称
杭州季丰	杭州季丰电子科技有限公司，系发行人全资二级子公司
季丰物业	上海季丰物业管理有限公司，系发行人全资二级子公司
西安季丰	**上海季丰电子科技有限公司西安分公司，系发行人分公司**
普铄电子	普铄电子（上海）有限公司，系发行人参股公司
四川数智	四川省数智传感器检验检测股份有限公司，系发行人参股公司
君丰桐芯	嘉兴君丰桐芯创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人参股公司
上海元禾	上海元禾璞华未来种子创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人参股公司
物奇微	重庆物奇微电子股份有限公司
EAG 实验室	EAG Laboratories，Eurofins Scientific SE（ERF.PA）子公司
赛宝实验室	工业和信息化部电子第五研究所
中兴通讯	中兴通讯股份有限公司（000063.SZ）及其下属公司
高通	Qualcomm Incorporated（QCOM.O）及其下属公司
华虹宏力	华虹宏力半导体有限公司（688347.SH）及其下属公司
长电科技	江苏长电科技股份有限公司（600584.SH）及其下属公司
长鑫科技	长鑫科技集团股份有限公司及其下属公司
长鑫存储	长鑫存储技术有限公司，长鑫科技集团股份有限公司子公司
矽品科技	矽品科技（苏州）有限公司，矽品精密工业股份有限公司子公司
恒玄科技	恒玄科技（上海）股份有限公司（688608.SH）及其下属公司
蔚来汽车	上海蔚来汽车有限公司
禾赛科技	上海禾赛科技有限公司
翱捷科技	翱捷科技股份有限公司（688220.SH）及其下属公司
兆易创新	兆易创新科技集团股份有限公司（603986.SH）及其下属公司
紫光展锐	紫光展锐（上海）科技股份有限公司及其下属公司
豪威集团	豪威集成电路（集团）股份有限公司（603501.SH）及其下属公司
纳芯微	苏州纳芯微电子股份有限公司（688052.SH）及其下属公司
晟矽微	***上海晟矽微电子股份有限公司及其下属公司***
积塔半导体	上海积塔半导体有限公司及其下属公司
安靠科技	Amkor Technology,Inc.（AMKR.O）及其下属公司
京元电子	京元电子股份有限公司（2449.TW）
欣铨	欣铨科技股份有限公司（3264.TWO）
矽格	台湾矽格股份有限公司（6257.TW）
宜特	宜特科技股份有限公司（3289.TWO）

简称	全称
强一股份	强一半导体（苏州）股份有限公司（688809.SH）及其下属公司
华天科技	天水华天科技股份有限公司（002185.SZ）及其下属公司
甬矽电子	甬矽电子（宁波）股份有限公司（688362.SH）及其下属公司
赛默飞	Thermo Fisher Scientific Inc.（TMO.N）及其下属公司
爱德万	Advantest Corporation（6857.T）及其下属公司
日立高新	Hitachi High-Tech Corporation（日立集团子公司）及其下属公司
滨松	Hamamatsu Photonics K.K.（6965.T）及其下属公司
鸿劲精密	鸿劲精密股份有限公司（7769.TW）及其下属公司
利量电子	包括 Power Electron Trade Limited 及上海利量电子科技有限公司，均受同一实际控制人控制
闳康	闳康科技股份有限公司（3587.TWO）
苏试宜特	苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司，苏试试验（300416.SZ）的控股子公司
胜科纳米	胜科纳米（苏州）股份有限公司（688757.SH）及其下属公司
雍智科技	雍智科技股份有限公司（6683.TWO）
伟测科技	上海伟测半导体科技股份有限公司（688372.SH）
利扬芯片	广东利扬芯片测试股份有限公司（688135.SH）
广电计量	广电计量检测集团股份有限公司（002967.SZ）
华测检测	华测检测认证集团股份有限公司（300012.SZ）及其下属公司
华测蔚思博	华测蔚思博检测技术有限公司，华测检测子公司
精测	中华精测科技股份有限公司（6510.TWO）
上海市监局	上海市市场监督管理局
中国证监会	中国证券监督管理委员会
深交所	深圳证券交易所
股转系统/新三板	全国中小企业股份转让系统
光大证券、保荐机构、保荐人	光大证券股份有限公司
天健会计师	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
德恒律师	北京德恒律师事务所
中汇会计师	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
立信评估	上海立信资产评估有限公司
《公司法》	中华人民共和国公司法及其修订
《证券法》	中华人民共和国证券法及其修订
《上市规则》	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2026 年修订）
《申报及推荐暂行	《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2024

简称	全称
规定》	年修订）
报告期、最近三年及一期	2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-6 月
报告期各期末	2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末
元、万元、亿元	除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业术语释义

简称	全称
半导体	常温下导电性能介于导体（Conductor）与绝缘体（Insulator）之间的材料
IC	Integrated Circuit，即集成电路，将一定数量的电子元件（如电阻、电容、晶体管等），以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路
晶圆	Wafer，指经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路晶圆，经切割、封装等工艺后可制作成 IC 成品
FA	Failure Analysis，即失效分析，通过实验分析手段确定元器件既有的失效现象的原因及失效机理，或判断可能存在的失效情况
MA	Material Analysis，即材料分析，对样品进行材料成分及结构的分析，实现对样品的结构组织分布、元素比例构成、污染物情况等的判断
RA	Reliability Analysis，即可靠性测试，考察特定实验条件下产品的寿命特征、环境适应能力等，确定特定条件下产品的可靠性水平
CA	Chemical Analysis，即化学分析，指通过化学或物理化学方法，对材料中的元素含量、离子浓度及化合物组成进行定量检测的技术
ATE 测试	ATE 是 Automatic Test Equipment 的缩写，指利用自动测试设备对集成电路进行功能和性能验证，以确保其符合设计规格的关键质量管控环节
ESD 测试	ESD 是 Electro-Static Discharge 的缩写，也称为静电放电测试，主要用于检测产品或材料抵御静电放电干扰、防止因静电造成电子元件及电路损坏能力的测试
FT 测试	FT 是 Final Test 的缩写，也称为芯片成品测试或终测，主要是完成封装后的芯片进行各种性能指标和功能指标的测试
CP 测试	CP 是 Chip Probing 的缩写，也称为晶圆测试或中测，是对晶圆级集成电路的各种性能指标和功能指标的测试
系统级测试，SLT	SLT 是 System Level Test 的缩写，是相对于芯片级检测提出的概念，系在仿真的终端使用场景中对待测芯片进行测试
老化测试，BI	BI 是 Burn-In 的缩写，系通过提高环境温度和高电压加速老化，提前激发早期失效并剔除坏掉芯片的过程
封测、封装测试	封装指安装半导体集成电路芯片的外壳，测试指封装后对 IC 的功能、电参数进行测量以筛选出不合格的产品
电子制造服务，EMS	EMS 是 Electronic Manufacturing Services 的缩写，即电子制造服务，指向客户提供芯片封测后 PCBA 模组生产、组装与交付的制造服务
PCBA	PCBA 是 Printed Circuit Board Assembly 的缩写，即印刷电路板组装，指将电阻、电容、芯片等电子元器件通过表面贴装或插件工艺焊接到印制电路板裸板上，形成具有特定功能的成品电路板
Foundry	在集成电路行业是指专门从事晶圆制造，接受设计公司委托制造晶圆而不自行从事芯片设计的厂商

简称	全称
IDM	是 Integrated Design and Manufacture 的缩写，即垂直整合模式，该模式下企业能够独自完成芯片设计、晶圆制造、封装测试的所有环节
Fabless	无晶圆厂芯片设计公司模式，该模式下企业只从事集成电路的设计和销售，而将晶圆制造、封装、测试等环节通过委外方式进行
OSAT	是 Outsourced Semiconductor Assembly and Testing 的缩写，指专业封装测试的厂商
HTOL	High Temperature Operating Life，高温工作寿命测试，评估芯片在长期通电工作状态下的寿命和可靠性
HAST	Highly Accelerated Stress Test，高加速应力测试，评估芯片封装、材料在高温高湿环境下的耐腐蚀性和密封性
SEM	是 Scanning Electron Microscope 的缩写，即扫描电子显微镜，利用聚焦高能电子束扫描样品表面，激发二次电子等信号以生成高分辨率形貌图像。主要用于芯片表面结构观察、缺陷定位及工艺验证，是半导体失效分析和制程监控的基础工具
TEM	是 Transmission Electron Microscope 的缩写，即透射电子显微镜，将加速电子束穿透超薄样品（通常<100nm）进行成像，可提供原子级分辨率的晶体结构、缺陷及成分分析。用于先进制程中的栅极结构、界面层、掺杂分布等纳米尺度表征，是半导体材料与工艺研发的最高精度验证手段之一
FIB	是 Focused Ion Beam 的缩写，即聚焦离子束显微镜，使用镓离子束对样品进行纳米级刻蚀、沉积或切割。广泛应用于芯片电路修改、定点截面制备及 TEM 薄片样品提取，是连接表面观察与内部结构分析的关键设备
MOSFET	是 Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor 的缩写，即金属-氧化物半导体场效应晶体管，它是最常用的电压控制型开关/放大器件，是芯片、电路板里最基础的“电子开关”
FinFET	是 Fin Field-Effect Transistor 的缩写，即鳍式场效应晶体管，是一种三维立体架构的非平面 MOSFET，通过将有源导电沟道制备为垂直于硅衬底的鳍状（Fin）硅柱，栅极跨越鳍体并从上、左、右三侧包裹沟道，属于多栅极 MOS 器件
GAA	是 Gate-All-Around 的缩写，即全环绕栅极，是继 FinFET 之后、用于 3nm/2nm 及以下先进工艺的新一代三维 MOSFET 晶体管结构
CPU	是 Central Processing Unit 的缩写，即中央处理器，是计算机/电子系统的核心运算与控制单元，负责指令读取、译码、运算执行、流程控制，统筹调度整机软硬件资源，是数字系统的“大脑”
GPU	是 Graphics Processing Unit 的缩写，即图形处理器，是一种大规模并行、多核心、单指令多线程（SIMT）架构的专用处理器，最初为实时图形渲染设计，现已演进为通用高性能并行计算加速器
SoC	是 System on Chip 的缩写，即片上系统，指在单一半导体芯片内部，高度集成处理器核心、存储器、各类硬件 IP 核、接口控制器、总线架构等完整系统所需全部功能模块，实现整机系统功能单片化的集成电路
2.5D、3D 封装	是两种先进的半导体异构集成技术，它们通过在垂直方向上进行堆叠来突破单一芯片的性能极限
SIP	是 System in Package 的缩写，即系统级封装，将多个不同功能的有源芯片（裸片/ Die）、无源元件（阻容感）、MEMS /光电器件等，通过先进封装与高密度互连技术，集成于单一封装体内，形成可独立实现完整系统或子系统功能的标准组件
FPGA	是 Field Programmable Gate Array 的缩写，即现场可编程门阵列，是一种可在器件出厂后、应用现场反复配置重构硬件逻辑的半定制可编程集成电路，用户可通过硬件描述语言自定义电路拓扑与并行逻辑功能，无需流片

简称	全称
	即可实现专用数字硬件电路
QFP	是 Quad Flat Package 的缩写，即四方扁平封装，是半导体行业应用最广泛的表面贴装式塑封封装之一，芯片四周引脚向外引出、呈扁平矩形、引脚贴装在 PCB 表面，属于引线框架类传统塑封封装
WLP	是 Wafer Level Package 的缩写，即晶圆级封装，指不把晶圆切割成单颗裸片，直接在整片晶圆上完成封装、绝缘、重布线（RDL）、植球等全部封装工艺流程，最后再切割分离成单颗成品芯片的先进封装技术
QFN	是 Quad Flat No-leads 的缩写，即四方扁平无引脚封装，是一种表面贴装、无外伸引脚、四边电极、底部裸露焊盘的引线框架类塑封封装，属于主流微型化高密度封装
BGA	是 Ball Grid Array 的缩写，即球栅阵列封装，是一种底面阵列式锡球引脚的表面贴装封装；不再从芯片四周引出引脚，而是在封装底部以矩阵阵列方式排布焊锡球作为 I/O 互连端子，属于高密度、多引脚主流先进封装形态
LGA	是 Land Grid Array 的缩写，即栅格阵列无球封装，是一种底面金属触点阵列、无锡球的封装形式。封装底部只有平整金属焊盘（Land），不靠锡球焊接，而是通过主板 CPU 插座弹性针脚接触实现电气互连
CSP	是 Chip Scale Package 的缩写，即芯片级封装，封装尺寸与芯片裸片基本相当的芯片级封装统称，以极简结构、超小体积、低寄生电气特性为核心特征，广泛应用于移动终端及微型低功耗芯片
AI	是 Artificial Intelligence 的缩写，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统的一门交叉技术科学
HBM	是 High Bandwidth Memory 的缩写，即高带宽存储器，是一种基于 3D 堆叠技术、专为高性能计算场景设计的高端动态随机存取存储器，是当前 AI 大模型训练、超算及高端 GPU 的核心配套存储器件
Chiplet	又称芯粒/小芯片，是一种模块化、功能专用的小型集成电路。将传统单片 SoC 拆解为多颗功能异构、工艺优化的小芯片模块，通过先进封装与高速互连技术“积木式集成”，在单一封装内构建高性能系统的芯片架构
3D 封装/集成	是指依托 TSV 硅通孔、垂直堆叠、微凸点高密度互连等核心技术，将多颗芯片裸片或晶圆沿垂直方向层叠集成，打破传统二维平面封装限制，实现芯片空间立体化、异构化、高密度互联的先进封装与系统集成技术
I/O	是 Input/Output 的缩写，即输入/输出，芯片领域指芯片与外部电路、外设、其他芯片之间进行数据、地址、控制信号交互的接口单元，是芯片实现内部逻辑与外部系统通信的信号通路与边界端口
MEMS	是 Micro-Electro-Mechanical System 的缩写，即微机电系统，是依托半导体微纳加工工艺，在硅基晶圆上同步制造微型机械结构与微电子电路，是集感知、传动、执行、信号处理于一体的微型智能器件，属于微电子+微机械交叉融合的半导体细分领域
mil	英制长度单位，密耳，为半导体封装、基板及 PCB 领域通用英制长度单位，1 密耳等于 0.0254 毫米，常用于表征线路线宽、焊盘间距、基材厚度及封装结构尺寸
nm	纳米（nanometer），国际标准长度单位，半导体制程、芯片物理尺寸核心计量单位，代表光刻、晶体管栅极、最小线宽的先进制程水平，数值越小制程越先进、集成度越高、功耗越低

注：本招股说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项：

（一）本次发行相关主体作出的重要承诺

本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、高级管理人员以及本次发行的保荐机构及其他证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。

（二）本次发行前滚存利润的分配安排及上市后股利分配政策

1、本次发行前滚存利润的分配安排

公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润，在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东按持股比例共享。

2、本次发行后的股利分配政策

本次发行后，公司的股利分配政策请参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、股利分配政策”之“（一）发行后的股利分配政策和决策程序”。

（三）本公司特别提醒投资者关注以下风险因素

本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”中的全部内容。

1、市场竞争风险

近年来半导体产业快速发展，半导体检测与分析需求快速增加，吸引越来越多的市场参与者积极开展相关领域的投资，争夺市场份额。半导体第三方实验室

市场总体呈现市场参与者较多、集中度低的特点，除闳康、发行人、苏试宜特、胜科纳米等头部企业外，行业内还有较多聚焦本地服务的中小型民营半导体第三方实验室。在集成电路测试板领域，公司不仅面临精测、雍智科技等境外厂商的竞争，也面临境内同行业企业的竞争，整体竞争较为激烈。此外，伴随行业的高速发展，未来可能吸引更多新的进入者参与市场竞争。

随着市场竞争程度的提升，无论是第三方实验室检测分析服务还是集成电路测试板产品，均可能面临一定的单价下滑风险，进而对公司盈利能力造成不利影响。同时，未来公司如不能紧跟下游半导体产业技术发展趋势、加大研发投入、提高技术能力与服务水平、加强市场开拓力度、进一步扩大业务规模，将可能无法保持现有的市场竞争力以应对较为激烈的市场竞争，可能会出现客户流失、技术能力下滑、市场份额下降等不利情形，对持续经营产生不利影响。

2、技术泄密的风险

公司目前已在第三方实验室检测分析服务、集成电路测试板产品及量产测试服务等方面形成了一系列核心技术，该类技术系公司通过多年自主研发结合海量服务案例积累形成。公司现有的主营业务收入主要来源于利用自身核心技术提供的服务和产品销售，因此核心技术的保密对公司现有及未来的经营至关重要。

目前，公司内部已制定一系列技术保密制度，并与特定员工签署保密协议，防范技术泄密风险。但若未来公司技术出现泄密的情况，公司的竞争优势及市场地位将受到影响，进而影响公司的经营业绩及盈利水平。

3、固定资产规模较大的风险

半导体检测业务的高效开展高度依赖检测分析仪器的精准性和完备性，报告期内随着业务规模的扩大，公司固定资产规模也逐步攀升。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 58,378.45 万元、73,408.28 万元、86,757.94 万元**及 103,738.92 万元**。目前，发行人部分实验室的产能利用率仍存在一定提升空间，若未来无法通过有效导入客户等方式进一步提高产能利用率，将可能制约公司业绩的持续释放。同时，如果未来客户需求、市场竞争环境等发生不利变化导致业务发展速度低于预期，可能导致新增收入与利润无法覆盖新增资产带来的折旧摊销等成本费用，进而影响公司未来净利润水平。

4、应收账款无法收回的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 11,433.51 万元、18,069.11 万元、14,305.01 万元**及 22,093.30 万元**，占期末流动资产比例分别为 24.85%、37.06%、30.51%**及 37.98%**。随着公司业务规模的日益扩大，未来应收账款可能存在进一步增长的趋势。应收账款的按期收回对公司营运资金的健康周转至关重要。若未来下游行业或客户经营状况发生重大不利变化，将加大公司应收账款的回收风险，进而对公司的财务状况产生重大不利影响。

5、经营业绩及毛利率、净利率下降的风险

报告期内，在半导体国产化趋势深化的大环境和国家科技重大专项与产业投资基金的支持下，我国半导体产业链不断完善，国内已陆续涌现一大批优秀的芯片设计、芯片制造及封测厂商。而半导体行业技术的更新迭代促进业内厂商大规模开展研发项目，随着半导体工艺复杂度的提升、工艺节点的拓展，对失效分析、材料分析等第三方检测分析与集成电路测试板等检测硬件的需求增长。行业规模的迅速增长也带动公司**2023 年至 2025 年**经营业绩持续上升。

2026 年 1-6 月，受毛利率波动影响，公司净利润同比出现小幅下滑。如果未来公司无法持续提升技术实力、服务质量以及客户拓展能力以应对市场竞争，则可能导致公司的订单量或服务价格下降，进而面临毛利率及净利率下滑、净利润无法**持续增长**的风险。

6、量产测试及电子制造服务业务尚未盈利的风险

基于在半导体检测服务及检测硬件产品领域积累的技术能力与客户资源，公司于 2022 年拓展了量产测试业务，重点布局前景广阔、技术壁垒较高的车规级芯片量产测试市场。尽管目前已经积累了蔚来汽车、禾赛科技等优质客户，并且该业务收入在报告期内逐年增长，但由于测试厂投入较大且客户处于导入期，导致量产测试业务目前尚未实现盈利。考虑到量产测试要具备市场竞争力仍需持续进行设备投入，若未来公司的客户导入与订单获取不及预期，公司可能面临因该业务亏损而拖累整体业绩的风险。

随着终端应用对集成度与可靠性要求的不断提高，芯片设计公司正从单一芯片向模组化、系统化方向延伸。为顺应这一行业趋势，公司在原服务于内部集成

电路测试板业务而布局的表面贴装线基础之上，于 2025 年新设浙江嘉善产线规模化投入电子制造服务业务，现已取得车规级等质量体系认证。**截至 2026 年 6 月 30 日**，电子制造服务业务已投入设备原值超过 **4,800 万元**，但客户尚处于前期导入阶段，该业务目前处于亏损状态，**2026 年 1-6 月**，电子制造服务业务产生的毛利为**-871.53 万元**，预计未来一段时间内仍将对公司整体盈利水平构成压力。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况			
发行人名称	上海季丰电子股份有限公司	成立日期	2008 年 7 月 7 日
注册资本	11,558.60 万元	法定代表人	郑朝晖
注册地址	上海市闵行区友东路 258-288 号 2 幢 101 室	主要生产经营地址	上海市闵行区友东路 258-288 号 2 幢 101 室
控股股东	无	实际控制人	郑朝晖、郑琦君
行业分类	根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“M 科学研究和技术服务业”之“74 专业技术服务业”之“745 质检技术服务”之“7452 检测服务”	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司曾于 2017 年 1 月至 2021 年 3 月在股转系统挂牌
（二）本次发行的有关中介机构			
保荐人	光大证券股份有限公司	主承销商	光大证券股份有限公司
发行人律师	北京德恒律师事务所	其他承销机构	无
审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	评估机构	上海立信资产评估有限公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		无	
（三）本次发行其他有关机构			
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	收款银行	【】
其他与本次发行有关的机构		无	

三、本次发行概况

（一）本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	1.00 元		
发行股数	不超过 3,852.87 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
其中：发行新股数量	不超过 3,852.87 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不超过 15,411.47 万股		
每股发行价格	【】元/股		
发行市盈率	【】倍		
发行前每股净资产	【】元	发行前每股收益	【】元
发行后每股净资产	【】元	发行后每股收益	【】元
发行市净率	【】倍		
预测净利润（如有）			
发行方式	采取网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式		
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板 A 股股票账户的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）		
承销方式	余额包销		
拟公开发售股份股东名称	不适用		
发行费用的分摊原则	不适用		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	浦东技术中心项目		
	车规级高可靠量产测试服务建设项目		
	芯片中试平台工程技术研发项目		
	补充流动资金		
发行费用概算	保荐承销费用	【】万元	
	审计及验资费用	【】万元	
	评估费	【】万元	
	律师费用	【】万元	
	发行手续费用	【】万元	
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况（如有）			

保荐人相关子公司拟参与战略配售情况（如有）	
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则（如有）	
（二）本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	
开始询价推介日期	
刊登定价公告日期	
申购日期和缴款日期	
股票上市日期	

四、发行人主营业务经营情况

（一）发行人主要业务、主要产品与服务及其用途

公司是一家半导体领域检测服务与检测硬件产品的全功能、一站式解决方案提供商，围绕芯片设计、晶圆制造、封装等半导体全产业链企业的检测需求，提供第三方实验室检测分析服务、检测硬件产品、量产业务（量产测试及电子制造服务）、工程样品封装及其他业务。

报告期各期，公司主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第三方实验室检测分析服务	**23,002.57**	**61.60%**	42,437.31	64.02%	37,862.80	65.70%	27,760.40	63.78%
检测硬件产品	**8,561.62**	**22.93%**	15,333.34	23.13%	12,473.52	21.65%	11,437.15	26.28%
量产业务（量产测试及电子制造服务）	**3,997.05**	**10.70%**	5,720.57	8.63%	3,980.29	6.91%	3,292.01	7.56%
工程样品封装及其他	**1,779.75**	**4.77%**	2,796.46	4.22%	3,311.05	5.75%	1,036.59	2.38%
合计	**37,341.00**	**100.00%**	**66,287.68**	**100.00%**	**57,627.66**	**100.00%**	**43,526.14**	**100.00%**

公司提供的检测服务与检测硬件产品，检测对象可以全面覆盖数字、模拟、存储、功率、射频和复杂 SoC 等各类芯片，具备 CPU、GPU、存储芯片、AI 芯片等高端芯片的检测服务能力，能够满足先进制程（最先进制程案例已覆盖 3nm 芯片）、先进封装（2.5D、3D 封装等）、成熟制程以及特色工艺的检测需求。

公司在上海、北京、杭州、深圳、成都等半导体产业集聚地建立子公司，能够更好地贴近关键客户、提升响应速度与服务品质。凭借全功能、一站式模式以及优秀的技术实力与服务品质，公司已与半导体产业链内超过 3,000 家客户建立了合作关系，客户涵盖芯片设计、晶圆制造、封测等全环节，包括客户 D、中兴通讯、高通、客户 H、华虹宏力、长电科技等知名企业。

发行人主要业务、主要产品与服务及用途请参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况”。

（二）发行人主要原材料及重要供应商

第三方实验室检测分析服务板块，公司主要采购检测分析仪器、实验耗材等。其中，检测分析仪器主要为开展检测分析的专用仪器设备，包括扫描电子显微镜、透射电子显微镜、聚焦离子束显微镜、半导体芯片静电放电和闩锁效应测试系统等；试验耗材包括离子源、化学试剂、砂纸、载治具等，用于辅助完成检测分析。检测硬件产品板块，公司主要采购电子元器件，包括 PCB 板、插座、芯片、连接器、结构件、电容电阻等。量产业务板块，公司主要采购探针台、测试机、分选机等专用设备用于量产测试业务，采购印刷机、贴片机、回流焊炉等专用设备用于电子制造服务（EMS）。

报告期内，发行人的重要供应商包括爱德万、赛默飞、Micro Control Company、日立高新、滨松、鸿劲精密等。

发行人主要采购情况及重要供应商情况请参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、发行人的采购情况和主要供应商”。

（三）主要生产/服务模式

公司主要采用以客户需求为导向的订单驱动模式，以销定产。

在第三方实验室检测分析业务中，公司根据待测样品情况和客户需求设计检测分析方案，按照检测分析方案对样品进行制备、观测和分析，最终向客户提供检测分析结果或检测分析报告。

在检测硬件产品业务中，公司根据客户的需求自主研发并生产包括集成电路测试板、测试插座、检测仪器设备等在内的检测硬件产品。

在量产测试业务中，公司提供晶圆测试（CP）、芯片成品测试（FT）、系统级测试（SLT）、老化测试（BI）等服务。在电子制造服务中，公司提供 PCBA 电子模组产品的生产、组装与交付服务。

发行人主要生产模式请参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况”之“（四）主要经营模式”。

（四）销售方式和渠道及重要客户

公司的销售模式为直销模式，直接面向半导体全产业链客户提供第三方实验室检测分析服务、检测硬件产品与量产测试服务。公司以上海为总部，通过在北京、杭州、深圳、成都等半导体产业集聚地设立子公司，构建了贴近核心客户区域的服务网络，有效提升了本地化响应速度与服务质量。截至本招股说明书签署日，公司与半导体产业链内超过 3,000 家客户建立了合作关系，客户类型覆盖半导体领域全产业链，包括芯片设计、晶圆代工、封装测试企业等。

发行人销售方式和渠道及重要客户请参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况”之“（四）主要经营模式”及“三、发行人的销售情况和主要客户”。

（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

公司是业内少有的半导体检测全功能、一站式解决方案提供商，能够同时为客户提供检测服务与检测硬件方案，公司在第三方实验室检测分析、集成电路测试板、量产测试的行业竞争情况及市场地位如下：

1、第三方实验室检测分析服务

半导体第三方实验室检测分析行业的发展与半导体产业的技术演进及产能扩张紧密相关。由于半导体企业对于检测分析的时效性要求极高，第三方实验室普遍围绕主要半导体产业集聚区进行布局，呈现出一定的区域性特征。这一特点导致全球范围内第三方实验室检测分析市场格局相对分散，单体企业市场份额有限，尚未形成具有显著垄断地位的龙头企业。在中国大陆市场，主要有四类竞争参与者：外资第三方检测分析机构如闳康、EAG 实验室等在中国大陆设立的分支机构在高端客户市场占据一席之地；早期布局的国有背景机构如赛宝实验室长期服务于国家重大工程与军工项目；季丰电子、胜科纳米、华测蔚思博、苏试宜

特等本土市场化机构是市场竞争的中坚力量，在第三方实验室检测分析市场占据主导地位；数量众多的本地中小型实验室规模较小，通常在特定技术点或本地化服务上形成补充。

2024 年、2025 年，公司第三方实验室检测分析服务收入分别为 37,862.80 万元、42,437.31 万元，与闳康、胜科纳米、苏试宜特等在中国大陆的半导体检测分析收入相比，公司的第三方实验室业务收入规模居于前列，公司已成为中国大陆最主要的第三方半导体实验室之一。

2、集成电路测试板

集成电路测试板行业作为半导体检测产业链的核心硬件环节，呈现出技术密集、定制化程度高的显著特征。聚焦中国大陆市场，国内高端芯片国产化进程加速，以及终端厂商对芯片质量要求日趋严格，为本土测试板企业创造了结构性成长机遇。在高端探针卡领域，国内企业强一股份等已取得一定突破；在测试载板、老化板及系统板领域，得益于本土芯片设计、制造产能的快速扩张以及测试机产业的进步，包括季丰电子在内的一批具备定制化设计能力、快速响应服务和成本优势的本土专业厂商已崭露头角。通过深耕细分赛道（如存储、AI 芯片、射频、模拟、功率半导体），本土专业厂商与国内头部芯片设计公司、封测厂等形成紧密合作，持续提升市场份额，并在部分领域开始与国际厂商展开竞争。

集成电路测试板主要分为探针卡、测试载板、可靠性测试板、系统板四大类，公司提供的集成电路测试板以可靠性测试板为主。公司自 2019 年进入客户 D 供应链体系，目前来自该终端客户的收入占比较高。在服务客户 D 的过程中，公司经历了其系统化的质量体系验证与严格管控，形成了符合高端标准的质量管理能力，实现了“零缺陷”交付目标，整体产品品质得到显著提升。依托在这一过程中积累的技术与质量优势，公司已能够为存储、AI 等高端芯片提供集成电路测试板解决方案，并成功导入了长鑫存储、客户 I、矽品科技、恒玄科技、蔚来汽车、翱捷科技、兆易创新、思瑞浦等行业内多家知名客户。

3、量产测试业务

集成电路量产测试行业主要有两类企业：封测一体企业和独立第三方测试企业。随着封装技术投入加大、测试难度提升，封测一体厂商将主要精力和资金集

中于封装业务，越来越多地将测试业务外包给独立第三方。独立第三方测试模式发源于中国台湾，以京元电子、欣铨、矽格为代表。中国大陆起步较晚，呈现出规模小、集中度低的竞争格局，但是以伟测科技、利扬芯片为代表的内资企业近几年发展速度较快。

公司于 2022 年拓展了量产测试业务，重点布局前景广阔、技术壁垒较高的车规级芯片量产测试市场。报告期内，公司量产测试业务尚处于起步阶段。

发行人行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位请参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“二、发行人所处行业情况”。

五、发行人板块定位情况

公司是一家半导体领域检测服务与检测硬件产品的全功能、一站式解决方案提供商，围绕芯片设计、晶圆制造、封装等半导体全产业链企业的检测需求，主要提供第三方实验室检测分析服务、检测硬件产品及量产测试服务。

（一）公司符合创业板行业领域要求

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司的检测分析服务所处行业为“M 科学研究和技术服务业”之“74 专业技术服务业”之“745 质检技术服务”之“7452 检测服务”，同时，公司也属于“6560 信息技术咨询服务”行业；公司的检测硬件产品所处行业为“C 制造业”之“39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“398 电子元件及电子专用材料制造”之“3982 电子电路制造”。

根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司的检测分析服务所属行业可直接对应至“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.4 新型信息技术服务”之“国民经济行业代码 6560*信息技术咨询服务”之“测试评估认证服务”。根据《2017 年国民经济行业分类注释》，前述“测试评估认证服务”包括“软件测试、硬件测试、网络测试、信息安全测试、质量管理评估……”，公司针对半导体样品提供的检测分析实验属于“硬件测试”，顺应国家战略性新兴产业发展规划要求，可进一步提升信息技术产业核心基础硬件供给能力。公司的检测硬件产品所处行业可对应至“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

因此，公司所属行业为战略性新兴产业，不属于《申报及推荐暂行规定》第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市或禁止类行业。

（二）公司符合创业板定位相关指标要求

公司符合《申报及推荐暂行规定》第四条第二项相关指标要求，具体如下：

创业板定位相关指标	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元	是	公司高度重视研发投入，2023 年-2025 年研发投入合计 14,874.14 万元，最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元。
最近三年营业收入复合增长率不低于 25%	是	公司 2025 年营业收入为 6.69 亿元，超过 3 亿元，可不适用营业收入复合增长率要求。
最近一年营业收入达到 3 亿元的企业，不适用营业收入复合增长率要求		

（三）公司的创新、创造、创意性及其表征

1、公司深度服务集成电路产业链，符合国家集成电路产业的战略导向

公司围绕芯片设计、晶圆制造、封装测试等半导体全产业链企业在研发验证、工艺优化、可靠性评价、质量控制和量产导入等环节的检测需求，提供第三方实验室检测分析服务、量产测试服务，以及定制化集成电路测试板、测试插座、检测仪器设备等检测硬件产品。公司核心业务属于集成电路产业链关键技术攻关、工程化验证和质量可靠性保障的重要配套环节，对我国半导体产业实现技术演进、工艺进步、质量提升，进而实现自主发展有积极作用，与“十五五”时期全链条推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关的政策方向一致，符合国家发展集成电路产业的战略导向。

2、公司以独特的一站式服务模式，服务于超过 3,000 家半导体产业链客户

公司作为国内领先的半导体一站式解决方案提供商，围绕客户需求构建了半导体检测领域“服务+产品”的一站式能力。该模式实现了客户问题、检测结果、硬件适配与测试反馈的高效衔接，能够提供跨环节诊断与工程化解决方案，缩短问题定位与验证周期，提升芯片研发验证效率及产业化导入能力；同时，有助于公司持续积累工程经验、失效案例与测试数据，增强对复杂芯片研发验证及量产导入的支撑能力。同时，基于在检测分析服务及硬件产品领域积累的客户资源与技术能力，公司将业务从“0-1”延伸至规模量产阶段，形成双轮驱动模式，拓

展了公司的发展空间。

此外，公司具备软件设计及硬件开发的双重能力，通过开发定制化仪器设备为实验室赋能，使实验室形成了独特的服务能力与方案解决能力。公司的定制化仪器设备包括手动探针台、芯片软失效分析系统（SER）、射频信号源（RF-Source）及射频功率放大器（RF-PA）、阻抗测试仪（AMR）、SoC 老化测试机（H160、F370）、三维超景深显微镜、电源管理及监控系统、LIMS（实验室信息管理系统）等。

凭借全功能、一站式模式及优秀的技术实力与服务品质，公司已为半导体产业链超 3,000 家客户提供服务。

3、公司拥有较强的技术创新能力，已形成具备先进性的核心技术

发行人在失效分析、材料分析、可靠性分析及集成电路测试板等业务形成了一系列核心技术，例如先进制程逻辑单元立体结构分析方法、先进封装热失效深度定位技术、集成电路测试板设计与仿真技术等。公司技术体系覆盖样品制备、高端线路修补、失效定位、材料成分分析、集成电路测试板设计及仿真、量产老化测试等多个关键环节，能够从单点检测能力向系统级工程验证能力延伸，体现出较强的技术集成能力和工程化服务能力。发行人技术路线符合国际半导体检测分析向先进制程、先进封装和多物理场分析演进的方向。

以公司的核心技术之一先进制程逻辑单元立体结构分析技术为例，该技术主要应用于半导体检测分析领域中技术含量最高的方向之一——先进制程芯片失效分析，具备国内先进水平和较强的产业链支撑价值。该技术整合了微光电镜电信号分析手段、纳米探针探测技术、聚焦离子束精确定位制样、透射电镜原子级成像与多物理信号关联解析，构建了跨尺度形貌—成分—结构协同解析的方法体系。随着器件从平面 MOSFET 向 FinFET、GAA 等三维结构演进，芯片缺陷不再只是单点物理缺陷，而与设计、工艺、材料、应力、电性等多因素耦合相关，分析需从“找缺陷”转向“解释失效机理”。该技术所构建的跨尺度协同解析方法，恰好契合了这一深层分析需求，其应用可为先进制程芯片的良率改善提供有力支持。

4、公司知识产权丰富，检测资质和质量体系完善，具备技术自主可控能力

截至本招股说明书签署日，公司及子公司累计拥有专利 **140** 项，其中发明专利 **58** 项。公司拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的 **201** 个检测项目、检验检测机构资质认定（CMA）的 **56** 个检测项目，并获得 ISO9001 国际品质管理认证、ISO/IEC 17025 国际实验室管理体系认证、IATF16949 汽车工业质量管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证等。

（四）公司具有较强的成长性

受益于半导体产业国产化与技术进步的双重机遇，公司业务规模稳步增长，2023 年、2024 年、2025 年**及 2026 年 1-6 月**，公司营业收入分别为 44,336.65 万元、58,348.29 万元、66,949.34 万元**及 37,885.76 万元**，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 1,812.95 万元、3,836.86 万元、7,356.84 万元**及 3,405.12 万元**，整体表现出较强的成长性。

在国际贸易争端背景之下，发展半导体产业已上升至国家战略层面，随着高端芯片国产化进程加速，人工智能、汽车电子等高可靠性应用对芯片指标提出更为严苛的标准，先进制程、先进封装等半导体技术更新迭代，半导体产业链企业对第三方实验室检测分析、集成电路测试板等检测硬件产品以及量产测试服务的需求预计将保持快速增长。公司凭借全功能、一站式服务模式，优秀的检测分析服务能力、检测硬件设计能力与量产测试能力，完善的区域布点、庞大的客户基数以及优质的客户服务品质等竞争优势，有望充分受益于行业增长的红利，持续提升市场份额与经营业绩。

六、发行人主要财务数据及财务指标

公司报告期内经审计的主要会计数据和财务指标如下：

项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额（万元）	**199,767.94**	172,698.54	154,312.62	133,033.30
归属于母公司所有者权益（万元）	**93,837.82**	89,472.96	79,650.10	73,490.44
资产负债率（母公司）（%）	**50.04**	46.08	40.91	37.40
营业收入（万元）	**37,885.76**	66,949.34	58,348.29	44,336.65

项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
净利润（万元）	**4,015.83**	9,125.55	5,437.55	2,045.41
归属于母公司所有者的净利润（万元）	**4,015.83**	9,125.55	5,437.55	2,338.67
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	**3,405.12**	7,356.84	3,836.86	1,812.95
基本每股收益（元）	**0.35**	0.79	0.47	0.21
稀释每股收益（元）	**0.35**	0.79	0.47	0.21
加权平均净资产收益率（%）	**4.38**	10.80	7.10	3.53
经营活动产生的现金流量净额（万元）	**2,784.42**	27,924.06	18,171.91	19,527.00
现金分红（万元）	**-**	-	-	-
研发投入占营业收入的比例（%）	**6.68**	8.22	8.51	9.94

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息（如有）

财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日，公司经营状况良好，经营模式未发生重大变化，公司主要原材料的采购规模及采购价格、收入规模及销售价格未发生重大变化，公司客户和供应商的构成未发生重大变化，整体经营环境未发生重大不利变化。

八、发行人选择的具体上市标准

发行人选择依据《上市规则》第 2.1.2 条“（二）预计市值不低于 15 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于 4 亿元”规定的市值及财务指标申请上市。

发行人 2025 年度经审计的营业收入为 66,949.34 万元，扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润为 7,356.84 万元，公司最近一年净利润为正且营业收入不低于 4 亿元。结合发行人最近一次增资对应的估值情况以及参考公司 2025 年度经营业绩及行业平均市盈率对公司市场价值的预估结果，预计发行人发行后总市值不低于人民币 15 亿元，满足前述上市标准。

九、发行人公司治理特殊安排

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构等公司治理特殊安排。

十、募集资金运用与未来发展规划

（一）募集资金运用

公司第四届董事会第三次会议、2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》，本次发行上市募集资金将主要用于投资如下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	浦东技术中心项目	45,000.00	37,097.00
2	车规级高可靠量产测试服务建设项目	20,477.87	20,477.87
3	芯片中试平台工程技术研发项目	14,800.01	14,800.01
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		**100,277.88**	**92,374.88**

若本次发行上市募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目实际进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金。募集资金到位后，若本次发行上市实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过银行贷款等融资方式解决。

本次募集资金运用具体情况请参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

（二）未来发展规划

公司将把握国内半导体行业快速发展及供应链国产化的历史机遇，坚持“技术驱动、品质为先”的经营战略。依托现有的技术积累和优质客户资源，公司将进一步完善产业链布局，持续深化半导体检测领域“服务+产品”的一站式解决方案，并进一步强化从“0-1”的检验检测服务到大规模量产的双轮驱动模式，

致力于成为全球领先的半导体全功能、一站式解决方案提供商，更好服务于国家半导体产业发展战略。

报告期内，发行人围绕既定的发展战略，取得了良好成果，并制订了详细的未来规划。具体情况请参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”之“二、未来发展规划”。

十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股说明书签署日，不存在其他对发行人有重大影响的事项。

第三节 风险因素

投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、与发行人相关的风险

（一）客户需求波动的风险

公司是一家半导体领域检测服务与检测硬件产品的全功能、一站式解决方案提供商，围绕芯片设计、晶圆制造、封装测试等半导体全产业链企业的检测需求，提供第三方实验室检测分析服务、检测硬件产品以及量产测试服务。公司的客户群主要包括芯片设计企业、晶圆代工企业、封装测试企业等，该类客户对第三方实验室检测的需求与其自身的研发投入力度、研发项目周期、工艺升级等因素高度相关。如未来半导体行业景气度下滑，或工艺迭代进度放缓，则公司客户需求可能出现不利变动。

同时，若下游客户在资金充裕的情况下，为保障核心技术数据安全或出于自身战略布局考虑而选择自建实验室，则其对第三方检测机构的业务需求可能出现下降，导致外部采购减少，进而对公司第三方实验室业务的客户基础与市场空间产生不利影响。

（二）技术泄密的风险

公司目前已在第三方实验室检测分析服务、集成电路测试板产品及量产测试服务等方面形成了一系列核心技术，该类技术系公司通过多年自主研发结合海量服务案例积累形成。公司现有的主营业务收入主要来源于利用自身核心技术提供的服务和产品销售，因此核心技术的保密对公司现有及未来的经营至关重要。

目前，公司内部已制定一系列技术保密制度，并与特定员工签署保密协议，防范技术泄密风险。但若未来公司技术出现泄密的情况，公司的竞争优势及市场地位将受到影响，进而影响公司的经营业绩及盈利水平。

（三）检测分析仪器依赖进口的风险

半导体第三方实验室检测分析业务及量产测试业务均具有较高的技术要求、

质量要求和响应速度要求，中国大陆高端仪器及测试设备行业起步较晚，特别是半导体行业的分析仪器及测试设备对精度、解析度、稳定性、品牌知名度要求较高，导致市场基本为境外厂商垄断，造成了国内半导体第三方实验室检测分析及量产测试厂商的相关设备普遍依赖进口的现状。

公司与全球多家知名分析仪器及测试设备厂商建立了良好稳定的合作关系，但若未来国际贸易环境、出口管制政策或相关国家和地区对半导体设备出口政策发生重大不利变化，导致发行人无法正常采购相关进口设备，或现有设备所需零部件、耗材、维修维护及技术服务受到限制，且国产设备或其他替代设备无法及时满足发行人的技术及业务需求，可能导致发行人部分核心技术研发验证周期延长、新增高端检测及测试能力受限，或者现有设备维护及使用受到影响，进而对发行人的技术研发、业务拓展及经营业绩产生不利影响。

（四）经营业绩及毛利率、净利率下降的风险

报告期内，在半导体国产化趋势深化的大环境和国家科技重大专项与产业投资基金的支持下，我国半导体产业链不断完善，国内已陆续涌现一大批优秀的芯片设计、芯片制造及封测厂商。而半导体行业技术的更新迭代促进业内厂商大规模开展研发项目，随着半导体工艺复杂度的提升、工艺节点的拓展，对失效分析、材料分析等第三方检测分析与集成电路测试板等检测硬件的需求增长。行业规模的迅速增长也带动公司**2023 年至 2025 年**经营业绩持续上升。

2026 年 1-6 月，受毛利率波动影响，公司净利润同比出现小幅下滑。如果未来公司无法持续提升技术实力、服务质量以及客户拓展能力以应对市场竞争，则可能导致公司的订单量或服务价格下降，进而面临毛利率及净利率下滑、净利润无法**持续增长**的风险。

（五）固定资产规模较大的风险

半导体检测业务的高效开展高度依赖检测分析仪器的精准性和完备性，报告期内随着业务规模的扩大，公司固定资产规模也逐步攀升。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 58,378.45 万元、73,408.28 万元、86,757.94 万元**及 103,738.92 万元**。目前，发行人部分实验室的产能利用率仍存在一定提升空间，若未来无法通过有效导入客户等方式进一步提高产能利用率，将可能制约公司业

绩的持续释放。同时，如果未来客户需求、市场竞争环境等发生不利变化导致业务发展速度低于预期，可能导致新增收入与利润无法覆盖新增资产带来的折旧摊销等成本费用，进而影响公司未来净利润水平。

（六）应收账款无法收回的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 11,433.51 万元、18,069.11 万元、14,305.01 万元及 22,093.30 万元，占期末流动资产比例分别为 24.85%、37.06%、30.51%及 37.98%。随着公司业务规模的日益扩大，未来应收账款可能存在进一步增长的趋势。应收账款的按期收回对公司营运资金的健康周转至关重要。若未来下游行业或客户经营状况发生重大不利变化，将加大公司应收账款的回收风险，进而对公司的财务状况产生重大不利影响。

（七）量产测试及电子制造服务业务尚未盈利的风险

基于在半导体检测分析服务及检测硬件产品领域积累的技术能力与客户资源，公司于 2022 年拓展了量产测试业务，重点布局前景广阔、技术壁垒较高的车规级芯片量产测试市场。尽管目前已经积累了蔚来汽车、禾赛科技等优质客户，并且该业务收入在报告期内逐年增长，但由于测试厂投入较大且客户处于导入期，量产测试业务目前尚未实现盈利。考虑到量产测试要具备市场竞争力仍需持续进行设备投入，若未来公司的客户导入与订单获取不及预期，公司可能面临因该业务亏损而拖累整体业绩的风险。

随着终端应用对集成度与可靠性要求的不断提高，芯片设计公司正从单一芯片向模组化、系统化方向延伸。为顺应这一行业趋势，公司在原服务于内部集成电路测试板业务而布局的表面贴装线基础之上，于 2025 年新设浙江嘉善产线规模化投入电子制造服务业务，现已取得车规级等质量体系认证。截至 2026 年 6 月 30 日，电子制造服务业务已投入设备原值超过 4,800 万元，但客户尚处于前期导入阶段，该业务目前处于亏损状态，2026 年 1-6 月，电子制造服务业务产生的毛利为-871.53 万元，预计未来一段时间内仍将对公司整体盈利水平构成压力。

（八）质量控制和声誉风险

公司作为半导体领域第三方检测服务及检测硬件产品提供商，业务的开展高

度依赖于客户对公司中立性、保密性及产品质量的信任。

在第三方实验室业务方面，公司日常经营中涉及客户芯片设计、晶圆制造等核心环节的敏感技术信息。若公司信息安全管理出现疏漏，导致客户核心技术数据发生泄露，或在检测分析过程中未能保持客观中立的第三方立场，将直接损害公司的专业公信力，可能导致核心客户流失，并对公司行业声誉造成长期不利影响。在集成电路测试板等检测硬件产品方面，若公司产品质量管控体系运行失效，导致产品出现设计缺陷、工艺瑕疵或可靠性不达标等质量问题，可能引发客户投诉、退货甚至索赔，进而影响公司与下游客户的长期合作关系。

上述质量与声誉相关风险一旦发生，将严重削弱公司在半导体检测领域的市场信任度，对公司业务拓展、客户维系及经营业绩产生重大不利影响。

（九）专用设备维保及耗材供应与价格波动风险

报告期各期末，公司专用设备账面原值分别为 69,359.29 万元、93,573.20 万元、118,859.35 万元**及 142,590.20 万元**。公司检测分析业务高度依赖各类高精尖专用检测设备，该类仪器对运维标准、适配耗材品质要求较高，常态化的维修保养是保障设备测试精度、运行稳定性以及检测数据一致性的必要条件。

随着公司业务规模不断扩大，专用设备保有量持续增长，设备维保、专用耗材的采购规模逐年提高。现阶段部分高端仪器的维保服务、定制耗材供给稳定，如若未来市场供需环境变动引发维保、耗材售价上涨，核心供应商出现供货延迟、服务品质下降等供应风险，一方面直接抬升实验室运营成本；另一方面或将造成检测排期紧张，业务开展受到制约，最终对公司的营业收入实现、净利润水平造成不利影响。

（十）集成电路测试板原材料价格波动的风险

公司集成电路测试板生产需要采购 PCB 板、Socket 等原材料，报告期内原材料成本在集成电路测试板主营业务成本中的占比分别为 66.99%、71.41%、77.10%和 79.60%。公司集成电路测试板主要原材料受宏观经济形势、大宗商品市场价格、市场供求关系等因素影响，存在一定波动性。若上述主要原材料市场价格上涨，将影响公司集成电路测试板成本。若公司无法及时充分将价格变化的影响传导至下游客户，将影响相关产品的毛利率水平，对公司的生产经营

和盈利能力造成不利影响。

通过对集成电路测试板主要原材料价格变动对毛利率的影响进行敏感性分析估算，报告期各期，若 PCB 板采购价格上涨 10%，公司毛利率将分别下降 0.39 个百分点、0.47 个百分点、0.45 个百分点和 0.45 个百分点；若 Socket 采购价格上涨 10%，公司毛利率将分别下降 0.19 个百分点、0.08 个百分点、0.27 个百分点和 0.16 个百分点。因此，若相关原材料价格持续大幅上涨，公司存在毛利率下降的风险。

（十一）第三方实验室检测分析业务设备利用率下滑的风险

报告期内，公司持续加大检测分析设备投入以匹配下游市场需求增长，检测分析设备原值由 47,847.82 万元增长至 89,896.08 万元,产能规模相应扩张。由于半导体行业客户认证及订单导入需要一定周期，新增产能的释放往往滞后于设备投入节奏，若未来下游客户需求增长不及预期、客户导入进度延缓或行业景气度下行，公司可能面临新增产能无法及时消化、设备利用率下滑的风险。

同时，公司检测分析业务成本结构中设备折旧、场地租赁及人员薪酬等固定成本占比较高，若设备利用率出现下滑，单位检测成本将相应上升，进而对公司第三方实验室检测分析业务的毛利率及整体盈利能力产生不利影响。此外，若未来公司不能持续有效地通过优化排产调度、拓展客户群体等方式维持较高的产能利用水平，公司可能面临固定资产闲置、资产减值风险及投资回报率下降的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）宏观经济及半导体产业波动的风险

公司主营业务为半导体领域的检测服务与检测硬件产品，其下游需求与宏观经济形势、半导体产业发展状况密切相关。

半导体产业作为现代信息技术的基础，具有周期性波动的特征，受全球宏观经济、国际贸易环境、下游终端市场需求等多重因素影响。近年来，随着人工智能、物联网、汽车电子等新兴领域的快速发展，半导体市场需求持续增长，但若未来全球经济增长放缓、国际贸易争端加剧，或消费电子、工业控制等下游应用领域需求出现萎缩，可能导致半导体产业链整体进入下行周期。

公司客户主要包括芯片设计企业、晶圆代工企业、封装测试企业等，该类客户对第三方检测分析及集成电路测试板产品的需求与其自身的研发投入力度、研发项目周期、工艺升级进度等因素高度相关。若半导体行业景气度下滑，下游客户可能缩减研发预算、放缓新品推出节奏或推迟工艺升级，从而减少对第三方检测服务和检测硬件产品的采购需求。

此外，半导体产业的区域发展政策、技术迭代速度、产业链转移趋势等亦将对公司业务产生重要影响。如未来国家对半导体产业的支持力度减弱，或本土产业链发展不及预期，可能导致公司所处市场空间收窄，进而对公司经营业绩和持续发展造成不利影响。

（二）市场竞争风险

近年来半导体产业快速发展，半导体检测与分析需求快速增加，吸引越来越多的市场参与者积极开展相关领域的投资，争夺市场份额。半导体第三方实验室市场总体呈现市场参与者较多、集中度低的特点，除闳康、发行人、苏试宜特、胜科纳米等头部企业外，行业内还有较多聚焦本地服务的中小型民营半导体第三方实验室。在集成电路测试板领域，公司不仅面临精测、雍智科技等境外厂商的竞争，也面临境内同行业企业的竞争，整体竞争较为激烈。此外，伴随行业的高速发展，未来可能吸引更多新的进入者参与市场竞争。

随着市场竞争程度的提升，无论是第三方实验室检测分析服务还是集成电路测试板产品，均可能面临一定的单价下滑风险，进而对公司盈利能力造成不利影响。同时，未来公司如不能紧跟下游半导体产业技术发展趋势、加大研发投入、提高技术能力与服务水平、加强市场开拓力度、进一步扩大业务规模，将可能无法保持现有的市场竞争力以应对较为激烈的市场竞争，可能会出现客户流失、技术能力下滑、市场份额下降等不利情形，对持续经营产生不利影响。

（三）产业政策变化的风险

公司目前所从事的半导体领域检测服务与检测硬件产品，其下游需求与国家对半导体产业的整体政策导向及扶持力度密切相关。近年来，为促进本土半导体产业链的发展，国家相关部门出台了一系列鼓励政策，为公司及下游客户营造了良好的发展环境。若未来相关产业政策发生重大不利调整，或国家对半导体产业

的支持力度减弱，可能导致下游芯片设计、晶圆制造、封装测试等企业的扩产计划与研发投入放缓，从而抑制其对第三方实验检测分析及测试板等产品的采购需求。市场需求若出现萎缩或增速显著放缓，将可能对公司的经营业绩和持续发展造成不利影响。

（四）人才流失的风险

公司所从事的半导体检测业务涉及半导体、材料、机械、光学等多学科的交叉应用，具有较高的技术门槛。公司已集聚了一批拥有跨学科背景与丰富行业经验的优秀人才，保障公司业务的正常开展及持续进步。如若未来公司研发技术人员流失，或无法培养或招聘与行业技术进步所适配的人员，将对公司的经营产生不利影响。

三、其他风险

（一）募集资金投资项目风险

公司本次发行募集资金拟投资于“浦东技术中心项目”“车规级高可靠量产测试服务建设项目”“芯片中试平台工程技术研发项目”及补充流动资金。尽管本次募投项目已综合考虑了市场环境、发展趋势、成本费用等各种因素，但在项目实施管理、产能消化等各方面仍存在不可预见的风险。

1、募投项目实施过程中的风险

本次募集资金投资项目涉及场地建设、设备采购、人员招聘与培训等多个环节，项目建设周期较长，在项目实施过程中可能受到宏观经济形势变化、产业政策调整、工程建设进度等多方面因素的影响。特别是公司部分高端检测分析设备需从境外采购，若国际贸易争端加剧、进口关税政策调整或境外供应商供货周期延长，可能导致设备采购成本上升、交付延迟，进而影响募投项目的整体建设进度和投资回报。

2、募投项目产能消化不及预期及预期效益无法实现的风险

本次募投项目建成后，公司将新增第三方实验室检测服务能力、车规级芯片量产测试产能。尽管半导体检测市场需求持续增长，但若未来半导体行业景气度下行、下游客户研发投入放缓，或市场竞争加剧，公司可能面临新增产能无法及

时消化的情形。若募投项目实施后，相关服务价格出现下滑、产能未能充分消化、成本出现上升等不利变化，则存在募集资金投资项目预期效益无法实现的风险。

3、短期内净资产收益率和每股收益摊薄的风险

本次募集资金投资项目全部建成后，公司将新增大量固定资产及无形资产。项目达产后，预计每年新增折旧金额及摊销金额将有较大幅度增加。若募投项目建成后未能按预期实现效益，或市场环境发生不利变化导致项目收益不及预期，新增的折旧摊销费用将直接侵蚀公司利润，可能导致公司经营业绩出现下滑。本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的股本总数、净资产规模将在短时间内大幅增长，而募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部购建完成后才能逐步达到预期收益水平，因此，公司短期内存在净资产收益率和每股收益被摊薄的风险。

（二）股价波动的风险

二级市场股票价格不仅取决于公司经营状况，同时也受利率、汇率、通货膨胀、国内外政治经济形势及投资者心理预期等因素的影响，导致股价波动的原因较为复杂。本次股票发行后拟在创业板上市，该市场具有较高的投资风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

（三）发行失败的风险

本次发行上市相关文件须经过深圳证券交易所审核，并报送中国证监会履行注册程序。本次发行能否通过交易所的审核并取得中国证监会予以注册决定存在不确定性。本次发行结果会受到届时市场环境、投资者偏好、价值判断、市场供需等多方面因素的综合影响，若上述因素出现不利变动，本次发行存在因发行认购不足而导致发行失败的风险。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称	上海季丰电子股份有限公司
英文名称	Giga Force Electronics Co.,Ltd.
注册资本	11,558.60 万元
法定代表人	郑朝晖
成立日期	2008 年 7 月 7 日
整体变更日期	2016 年 8 月 22 日
住所	上海市闵行区友东路 258-288 号 2 幢 101 室
邮政编码	201199
电话	021-64205085
传真	021-64205085
互联网网址	giga-force.com
电子信箱	IR@giga-force.com
其他信息	负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室 负责人：邵文宗 电话号码：021-64205085
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；模具制造；模具销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
本次证券发行类型	人民币普通股（A 股）

二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况

（一）有限公司的设立情况

2008 年 6 月 25 日，张文雄、章莉签署《上海季丰电子有限公司章程》，决定成立季丰有限。季丰有限成立时注册资本为 50 万元，张文雄出资 30 万元，章莉出资 20 万元。其中张文雄名下股权系代郑朝晖持有，相关代持及解除具体情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人的设立情况

及报告期内的股本和股东变化情况”之“（四）发行人历史上的股份代持及解除情况”。

2008 年 6 月 27 日，上海华晖会计师事务所有限公司出具华会验（2008）第 426 号《验资报告》，经审验确认，截至 2008 年 6 月 25 日，季丰有限（筹）已经收到张文雄、章莉首次缴纳的注册资本（实收资本）合计 10.00 万元，其中，张文雄以货币出资 6.00 万元，章莉以货币出资 4.00 万元。

2008 年 7 月 7 日，季丰有限完成设立登记并取得上海金山工商局核发的《企业法人营业执照》。

季丰有限成立时的股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张文雄	30.00	60.00
2	章莉	20.00	40.00
合计		**50.00**	**100.00**

公司设立时的注册资本（除本次已缴纳的部分）实缴情况存在瑕疵，具体情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况”之“（六）发行人历史上的出资瑕疵情况”。

（二）股份公司的设立情况

2016 年 6 月 30 日，中汇会计师出具中汇会审[2016]3786 号《股改审计报告》，经审验，截至审计基准日 2016 年 5 月 31 日，季丰有限净资产为 18,503,026.55 元；2016 年 7 月 1 日，立信评估出具信资评报字（2016）第 2079 号《股改评估报告》，经评估截至评估基准日 2016 年 5 月 31 日，季丰有限净资产评估值为 2,089.67 万元。

2016 年 7 月 2 日，季丰有限召开股东会并作出决议，同意季丰有限整体变更为股份有限公司，并以经中汇会计师审计的截至 2016 年 5 月 31 日季丰有限净资产 18,503,026.55 元为基础进行折股（折股比例为 1.1543:1），折合至 1,603 万股股份，每股面值 1 元，其余部分计入资本公积。

2016 年 7 月 28 日，全体发起人依法共同签署了《发起人协议》；8 月 2 日，全体发起人召开了股份公司创立大会，审议通过了公司设立的相关议案。

2016 年 8 月 2 日，中汇会计师出具了中汇会验[2016]4128 号《股改验资报告》，审验截至 2016 年 5 月 31 日，季丰电子（筹）已收到全体股东拥有的季丰有限截至 2016 年 5 月 31 日止经审计的净资产 18,503,026.55 元，折合股份总数 1,603 万股，超过折股部分的净资产 2,473,026.55 元已计入资本公积。2026 年 5 月 18 日，天健会计师出具了天健验[2026]154 号《实收资本复核报告》，审验截至 2016 年 8 月 2 日，季丰电子股改时实收资本 1,603 万元已全部到位。

2016 年 8 月 22 日，上海市工商局核发了股份公司《营业执照》，核准季丰电子设立。

股份公司成立时，公司的股权结构如下：

序号	姓名/名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	季铭源	886.1084	55.28
2	陈洋森	516.8916	32.25
3	王景阳	200.0000	12.48
合计		**1,603.00**	**100.00**

（三）报告期内的股本和股东变化情况

1、2023 年 6 月，股本增资至 11,558.60 万元

2023 年 6 月 9 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会并审议通过了《关于公司增资的议案》，同意公司股本增资至 11,558.60 万元，并通过新的公司章程。

同日，尚成一号、天津合泰、普冉股份、商络电子、成都励石和上海骏晨翔分别与公司签署《股份认购协议》，约定尚成一号出资 7,038.5736 万元认购 293.2739 万股股份、天津合泰出资 2,016 万元认购 84 万股股份、普冉股份出资 1,512 万元认购 63 万股股份、商络电子出资 1,008 万元认购 42 万股股份、成都励石出资 1,008 万元认购 42 万股股份、上海骏晨翔出资 494.40 万元认购 20.60 万股股份。其中上海骏晨翔认购的股份系代张军等人持有，相关代持及解除具体情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况”之“（四）发行人历史上的股份代持及解除情况”。

2023 年 6 月 30 日，天健会计师出具天健验[2023]331 号《验资报告》，截至 2023 年 6 月 17 日，公司已收到尚成一号、天津合泰、普冉股份、商络电子、成都励石、上海骏晨翔缴纳的新增注册资本（实收股本）合计 5,448,739.00 元，计入资本公积（股本溢价）125,320,997.00 元。各出资者以货币出资 130,769,736.00 元。

2023 年 6 月 20 日，公司就本次增资事宜取得了上海市监局换发的《营业执照》。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	郑朝晖	1,787.5070	15.46
2	季铭源	930.4140	8.05
3	嘉善芯创	863.5500	7.47
4	苏州元禾	738.0000	6.38
5	郑琦君	686.0824	5.94
6	财通创新	528.0000	4.57
7	聚源信诚	420.0000	3.63
8	柴春波	408.6900	3.54
9	王笏泉	394.7400	3.42
10	福州嘉衍	375.0000	3.24
11	江山季兴	375.0000	3.24
12	俱成秋实	300.0000	2.60
13	上海琦晖	300.0000	2.60
14	沪电股份	300.0000	2.60
15	衢州绿发	300.0000	2.60
16	尚成一号	293.2739	2.54
17	渝富益华	233.3178	2.02
18	上海季双	225.0000	1.95
19	嘉兴君源	150.6078	1.30
20	陈洋森	150.0066	1.30
21	南京金浦	150.0000	1.30
22	俱成秋实贰号	150.0000	1.30
23	绍兴绿杉	150.0000	1.30

序号	姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
24	南通中皋	135.0000	1.17
25	徐莺	120.0000	1.04
26	戴梦夏	120.0000	1.04
27	春山锐卓	105.0000	0.91
28	湖州创投	93.3271	0.81
29	上海众松	93.3271	0.81
30	上海甚泰	90.0000	0.78
31	天津合泰	84.0000	0.73
32	思瑞浦	79.4100	0.69
33	江苏新潮	75.0000	0.65
34	普冉股份	63.0000	0.55
35	张群仙	60.0000	0.52
36	嘉兴君晋	48.1463	0.42
37	陈伟良	45.0000	0.39
38	商络电子	42.0000	0.36
39	成都励石	42.0000	0.36
40	上海丽平	33.6000	0.29
41	上海骏晨翔	20.6000	0.18
合计		**11,558.60**	**100.00**

2、2023 年 11 月，上海琦晖与衢州金藤股份转让

2023 年 11 月 29 日，上海琦晖与衢州金藤签署《股份转让协议》，约定上海琦晖将其所持公司 83 万股股份以 1,992 万元的价格转让给衢州金藤。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	郑朝晖	1,787.5070	15.46
2	季铭源	930.4140	8.05
3	嘉善芯创	863.5500	7.47
4	苏州元禾	738.0000	6.38
5	郑琦君	686.0824	5.94
6	财通创新	528.0000	4.57
7	聚源信诚	420.0000	3.63

序号	姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
8	柴春波	408.6900	3.54
9	王笏泉	394.7400	3.42
10	福州嘉衍	375.0000	3.24
11	江山季兴	375.0000	3.24
12	俱成秋实	300.0000	2.60
13	沪电股份	300.0000	2.60
14	衢州绿发	300.0000	2.60
15	尚成一号	293.2739	2.54
16	渝富益华	233.3178	2.02
17	上海季双	225.0000	1.95
18	上海琦晖	217.0000	1.88
19	嘉兴君源	150.6078	1.30
20	陈洋森	150.0066	1.30
21	南京金浦	150.0000	1.30
22	俱成秋实贰号	150.0000	1.30
23	绍兴绿杉	150.0000	1.30
24	南通中皋	135.0000	1.17
25	徐莺	120.0000	1.04
26	戴梦夏	120.0000	1.04
27	春山锐卓	105.0000	0.91
28	湖州创投	93.3271	0.81
29	上海众松	93.3271	0.81
30	上海甚泰	90.0000	0.78
31	天津合泰	84.0000	0.73
32	衢州金藤	83.0000	0.72
33	思瑞浦	79.4100	0.69
34	江苏新潮	75.0000	0.65
35	普冉股份	63.0000	0.55
36	张群仙	60.0000	0.52
37	嘉兴君晋	48.1463	0.42
38	陈伟良	45.0000	0.39
39	商络电子	42.0000	0.36
40	成都励石	42.0000	0.36

序号	姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
41	上海丽平	33.6000	0.29
42	上海骏晨翔	20.6000	0.18
合计		**11,558.60**	**100.00**

3、2023 年 12 月，张群仙与郑朝晖股份转让

2023 年 12 月 24 日，张群仙与郑朝晖签署《股份转让协议》，约定张群仙将其所持公司 30 万股股份以 600 万元的价格转让给郑朝晖。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	郑朝晖	1,817.5070	15.72
2	季铭源	930.4140	8.05
3	嘉善芯创	863.5500	7.47
4	苏州元禾	738.0000	6.38
5	郑琦君	686.0824	5.94
6	财通创新	528.0000	4.57
7	聚源信诚	420.0000	3.63
8	柴春波	408.6900	3.54
9	王笏泉	394.7400	3.42
10	福州嘉衍	375.0000	3.24
11	江山季兴	375.0000	3.24
12	俱成秋实	300.0000	2.60
13	沪电股份	300.0000	2.60
14	衢州绿发	300.0000	2.60
15	尚成一号	293.2739	2.54
16	渝富益华	233.3178	2.02
17	上海季双	225.0000	1.95
18	上海琦晖	217.0000	1.88
19	嘉兴君源	150.6078	1.30
20	陈洋森	150.0066	1.30
21	南京金浦	150.0000	1.30
22	俱成秋实贰号	150.0000	1.30
23	绍兴绿杉	150.0000	1.30

序号	姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
24	南通中皋	135.0000	1.17
25	徐莺	120.0000	1.04
26	戴梦夏	120.0000	1.04
27	春山锐卓	105.0000	0.91
28	湖州创投	93.3271	0.81
29	上海众松	93.3271	0.81
30	上海甚泰	90.0000	0.78
31	天津合泰	84.0000	0.73
32	衢州金藤	83.0000	0.72
33	思瑞浦	79.4100	0.69
34	江苏新潮	75.0000	0.65
35	普冉股份	63.0000	0.55
36	嘉兴君晋	48.1463	0.42
37	陈伟良	45.0000	0.39
38	商络电子	42.0000	0.36
39	成都励石	42.0000	0.36
40	上海丽平	33.6000	0.29
41	张群仙	30.0000	0.26
42	上海骏晨翔	20.6000	0.18
合计		**11,558.60**	**100.00**

4、2024 年 4 月，南京金浦、江苏新潮与谢丽股份转让

2024 年 4 月 12 日，南京金浦与谢丽签署《股份转让协议》，约定南京金浦将其所持公司 150 万股股份以 2,768 万元的价格转让给谢丽；江苏新潮与谢丽签署《股份转让协议》，约定江苏新潮将其所持公司 75 万股股份以 1,384 万元的价格转让给谢丽。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	郑朝晖	1,817.5070	15.72
2	季铭源	930.4140	8.05
3	嘉善芯创	863.5500	7.47
4	苏州元禾	738.0000	6.38

序号	姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
5	郑琦君	686.0824	5.94
6	财通创新	528.0000	4.57
7	聚源信诚	420.0000	3.63
8	柴春波	408.6900	3.54
9	王笏泉	394.7400	3.42
10	福州嘉衍	375.0000	3.24
11	江山季兴	375.0000	3.24
12	俱成秋实	300.0000	2.60
13	沪电股份	300.0000	2.60
14	衢州绿发	300.0000	2.60
15	尚成一号	293.2739	2.54
16	渝富益华	233.3178	2.02
17	上海季双	225.0000	1.95
18	谢丽	225.0000	1.95
19	上海琦晖	217.0000	1.88
20	嘉兴君源	150.6078	1.30
21	陈洋森	150.0066	1.30
22	俱成秋实贰号	150.0000	1.30
23	绍兴绿杉	150.0000	1.30
24	南通中皋	135.0000	1.17
25	徐莺	120.0000	1.04
26	戴梦夏	120.0000	1.04
27	春山锐卓	105.0000	0.91
28	湖州创投	93.3271	0.81
29	上海众松	93.3271	0.81
30	上海甚泰	90.0000	0.78
31	天津合泰	84.0000	0.73
32	衢州金藤	83.0000	0.72
33	思瑞浦	79.4100	0.69
34	普冉股份	63.0000	0.55
35	嘉兴君晋	48.1463	0.42
36	陈伟良	45.0000	0.39
37	商络电子	42.0000	0.36

序号	姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
38	成都励石	42.0000	0.36
39	上海丽平	33.6000	0.29
40	张群仙	30.0000	0.26
41	上海骏晨翔	20.6000	0.18
合计		**11,558.60**	**100.00**

5、2024 年 10 月，聚源信诚与芜湖信芯股份转让

2024 年 10 月 29 日，聚源信诚与芜湖信芯签署《股份转让协议》，约定聚源信诚将其所持公司 173.379 万股股份以 3,120.8220 万元的价格转让给芜湖信芯。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	郑朝晖	1,817.5070	15.72
2	季铭源	930.4140	8.05
3	嘉善芯创	863.5500	7.47
4	苏州元禾	738.0000	6.38
5	郑琦君	686.0824	5.94
6	财通创新	528.0000	4.57
7	柴春波	408.6900	3.54
8	王笏泉	394.7400	3.42
9	福州嘉衍	375.0000	3.24
10	江山季兴	375.0000	3.24
11	俱成秋实	300.0000	2.60
12	沪电股份	300.0000	2.60
13	衢州绿发	300.0000	2.60
14	尚成一号	293.2739	2.54
15	聚源信诚	246.6210	2.13
16	渝富益华	233.3178	2.02
17	上海季双	225.0000	1.95
18	谢丽	225.0000	1.95
19	上海琦晖	217.0000	1.88
20	芜湖信芯	173.3790	1.50
21	嘉兴君源	150.6078	1.30

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
22	陈洋森	150.0066	1.30
23	俱成秋实贰号	150.0000	1.30
24	绍兴绿杉	150.0000	1.30
25	南通中皋	135.0000	1.17
26	徐莺	120.0000	1.04
27	戴梦夏	120.0000	1.04
28	春山锐卓	105.0000	0.91
29	湖州创投	93.3271	0.81
30	上海众松	93.3271	0.81
31	上海甚泰	90.0000	0.78
32	天津合泰	84.0000	0.73
33	衢州金藤	83.0000	0.72
34	思瑞浦	79.4100	0.69
35	普冉股份	63.0000	0.55
36	嘉兴君晋	48.1463	0.42
37	陈伟良	45.0000	0.39
38	商络电子	42.0000	0.36
39	成都励石	42.0000	0.36
40	上海丽平	33.6000	0.29
41	张群仙	30.0000	0.26
42	上海骏晨翔	20.6000	0.18
合计		**11,558.60**	**100.00**

6、2024 年 11 月，陈伟良与柴春波股份转让

2024 年 11 月 1 日，陈伟良与柴春波签署《股份转让协议》，约定陈伟良所持公司 45 万股股份以 720 万元的价格转让给柴春波。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	郑朝晖	1,817.5070	15.72
2	季铭源	930.4140	8.05
3	嘉善芯创	863.5500	7.47
4	苏州元禾	738.0000	6.38

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
5	郑琦君	686.0824	5.94
6	财通创新	528.0000	4.57
7	柴春波	453.6900	3.93
8	王笏泉	394.7400	3.42
9	福州嘉衍	375.0000	3.24
10	江山季兴	375.0000	3.24
11	俱成秋实	300.0000	2.60
12	沪电股份	300.0000	2.60
13	衢州绿发	300.0000	2.60
14	尚成一号	293.2739	2.54
15	聚源信诚	246.6210	2.13
16	渝富益华	233.3178	2.02
17	上海季双	225.0000	1.95
18	谢丽	225.0000	1.95
19	上海琦晖	217.0000	1.88
20	芜湖信芯	173.3790	1.50
21	嘉兴君源	150.6078	1.30
22	陈洋森	150.0066	1.30
23	俱成秋实贰号	150.0000	1.30
24	绍兴绿杉	150.0000	1.30
25	南通中皋	135.0000	1.17
26	徐莺	120.0000	1.04
27	戴梦夏	120.0000	1.04
28	春山锐卓	105.0000	0.91
29	湖州创投	93.3271	0.81
30	上海众松	93.3271	0.81
31	上海甚泰	90.0000	0.78
32	天津合泰	84.0000	0.73
33	衢州金藤	83.0000	0.72
34	思瑞浦	79.4100	0.69
35	普冉股份	63.0000	0.55
36	嘉兴君晋	48.1463	0.42
37	商络电子	42.0000	0.36

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
38	成都励石	42.0000	0.36
39	上海丽平	33.6000	0.29
40	张群仙	30.0000	0.26
41	上海骏晨翔	20.6000	0.18
合计		**11,558.60**	**100.00**

7、2025 年 12 月-2026 年 3 月，股份转让

2025 下半年至 2026 年初，基于部分股东提出回购请求（触发部分股东与实际控制人签署的回购条款）、投资者看好公司未来发展提出投资请求、部分股东提出全部或者部分减持请求等综合背景，公司对各方相关股份交易事项进行了沟通、协调和撮合，同时由于涉及的交易方较多，该等交易在 2025 年 12 月至 2026 年 3 月期间陆续完成，具体情况如下：

（1）郑朝晖受让王笏泉 21 万股

2025 年 12 月 15 日，王笏泉与郑朝晖签订《股份转让协议书》，约定王笏泉将其代郑建生所持公司 21 万股股份以 381.36 万元的价格转让给郑朝晖；同月，王笏泉与郑建生签订《股权代持还原协议》，约定王笏泉将其代郑建生所持公司所有股份还原给郑建生，由此双方的股权代持关系解除。

（2）江阴瀚联受让上海众松、苏州元禾合计 225.8271 万股

2025 年 12 月 19 日，上海众松与江阴瀚联签订《股份转让协议书》，约定上海众松将其所持公司 93.3271 万股股份以 2,248 万元的价格转让给江阴瀚联；2026 年 1 月 15 日，苏州元禾与江阴瀚联签订《股份转让协议书》，约定苏州元禾将其所持公司 132.5 万股股份以 2,406.2 万元的价格转让给江阴瀚联。

（3）厦门同琅受让苏州元禾、尚成一号合计 163 万股

2026 年 1 月 15 日，苏州元禾与厦门同琅签订《股份转让协议书》，约定苏州元禾将其所持公司 117.5 万股股份以 2,133.8 万元的价格转让给厦门同琅；2026 年 1 月 19 日，尚成一号与厦门同琅将其签订《股份转让协议书》，约定尚成一号将其所持公司 45.5 万股股份以 1,224.9548 万元转让给厦门同琅。

（4）交大小苗受让戴梦夏、苏州元禾合计 101 万股

2025 年 12 月 31 日，戴梦夏与交大小苗签订《股份转让协议书》，约定戴梦夏将其所持公司 48.5 万股股份以 1,128.23 万元的价格转让给交大小苗；2026 年 1 月 8 日，苏州元禾与交大小苗签订《股份转让协议书》，约定苏州元禾将其所持公司 52.5 万股股份以 953.4 万元的价格转让给交大小苗。

（5）共青城创丰受让戴梦夏、衢州绿发合计 148.9762 万股

2025 年 12 月 31 日，戴梦夏与共青城创丰签订《股份转让协议书》，约定戴梦夏将其所持公司 71.5 万股股份以 1,663.26 万元的价格转让给共青城创丰；2026 年 1 月 15 日，衢州绿发与共青城创丰签订《股份转让协议书》，约定衢州绿发将其所持公司 77.4762 万股股份以 1,406.97 万元的价格转让给共青城创丰。

（6）畅享季受让衢州绿发、上海甚泰合计 147.5 万股

2026 年 1 月 15 日，衢州绿发与畅享季签订《股份转让协议书》，约定衢州绿发将其所持公司 57.5 万股股份以 1,044.2 万元的价格转让给畅享季；2026 年 1 月 26 日，上海甚泰与畅享季签订《股份转让协议书》，约定上海甚泰将其所持公司 90 万股股份以 1,634.4 万元的价格转让给畅享季。

（7）大零号湾受让衢州绿发、财通创新、尚成一号合计 147.5 万股

2026 年 1 月 15 日，衢州绿发、财通创新分别与大零号湾签订《股份转让协议书》，约定衢州绿发、财通创新将其所持公司 92 万股股份、17 万股股份分别以 1,670.72 万元、308.86 万元的价格转让给大零号湾；2026 年 1 月 19 日，尚成一号与大零号湾签订《股份转让协议书》，约定尚成一号将其所持公司 38.5 万股股份以 1,036.5001 万元的价格转让给大零号湾。

（8）苏州清石受让财通创新、上海琦晖合计 119.2 万股

2026 年 1 月 15 日，财通创新与苏州清石签订《股份转让协议书》，约定财通创新将其所持公司 70 万股股份以 1,217.78 万元的价格转让给苏州清石；2026 年 3 月 5 日，上海琦晖与苏州清石签订《股份转让协议书》，约定上海琦晖将其所持公司 49.2 万股股份以 1,185.23 万元的价格转让给苏州清石。

（9）渝兴益华贰号受让财通创新、上海琦晖合计 50.20 万股

2026 年 1 月 28 日，财通创新与渝兴益华贰号签订《股份转让协议书》，约定财通创新将其所持公司 29.5 万股股份以 535.96 万元的价格转让给渝兴益华贰号；2026 年 3 月 5 日，上海琦晖与渝兴益华贰号签订《股份转让协议书》，约定上海琦晖将其所持公司 20.7 万股股份以 498.66 万元的价格转让给渝兴益华贰号。

（10）柴春波受让财通创新、上海琦晖合计 36.6 万股

2026 年 1 月 15 日，财通创新与柴春波签订《股份转让协议书》，约定财通创新将其所持公司 21.5 万股股份以 390.6241 万元的价格转让给柴春波；2026 年 3 月 5 日，上海琦晖与柴春波签订《股份转让协议书》，约定上海琦晖将其所持公司 15.1 万股股份以 363.76 万元的价格转让给柴春波。

（11）新锐克胜受让上海琦晖 110 万股

2026 年 3 月 5 日，上海琦晖与新锐克胜签订《股份转让协议书》，约定上海琦晖将其所持公司 110 万股股份以 2,267.1 万元的价格转让给新锐克胜。

（12）曾劲涛受让上海琦晖 22 万股

2026 年 3 月 5 日，上海琦晖与曾劲涛签订《股份转让协议书》，约定上海琦晖将其所持公司 22 万股股份以 453.42 万元的价格转让给曾劲涛。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	郑朝晖	1,838.5070	15.91
2	季铭源	930.4140	8.05
3	嘉善芯创	863.5500	7.47
4	郑琦君	686.0824	5.94
5	柴春波	490.2900	4.24
6	苏州元禾	435.5000	3.77
7	财通创新	390.0000	3.37
8	江山季兴	375.0000	3.24
9	福州嘉衍	375.0000	3.24
10	郑建生	373.7400	3.23

序号	姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
11	俱成秋实	300.0000	2.60
12	沪电股份	300.0000	2.60
13	聚源信诚	246.6210	2.13
14	渝富益华	233.3178	2.02
15	江阴瀚联	225.8271	1.95
16	上海季双	225.0000	1.95
17	谢丽	225.0000	1.95
18	尚成一号	209.2739	1.81
19	芜湖信芯	173.3790	1.50
20	厦门同琅	163.0000	1.41
21	嘉兴君源	150.6078	1.30
22	陈洋森	150.0066	1.30
23	俱成秋实贰号	150.0000	1.30
24	绍兴绿杉	150.0000	1.30
25	共青城创丰	148.9762	1.29
26	畅享季	147.5000	1.28
27	大零号湾	147.5000	1.28
28	南通中皋	135.0000	1.17
29	徐莺	120.0000	1.04
30	苏州清石	119.2000	1.03
31	新锐克胜	110.0000	0.95
32	春山锐卓	105.0000	0.91
33	交大小苗	101.0000	0.87
34	湖州创投	93.3271	0.81
35	天津合泰	84.0000	0.73
36	衢州金藤	83.0000	0.72
37	思瑞浦	79.4100	0.69
38	衢州绿发	73.0238	0.63
39	普冉股份	63.0000	0.55
40	渝兴益华贰号	50.2000	0.43
41	嘉兴君晋	48.1463	0.42
42	商络电子	42.0000	0.36
43	成都励石	42.0000	0.36

序号	姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
44	上海丽平	33.6000	0.29
45	张群仙	30.0000	0.26
46	曾劲涛	22.0000	0.19
47	上海骏晨翔	20.6000	0.18
合计		**11,558.60**	**100.00**

8、2026 年 2-4 月，聚源信诚与芜湖聚源等股份转让

2026 年 2 月 2 日，聚源信诚与芜湖聚源签订《股份转让协议书》，约定聚源信诚将其所持公司 246.6210 万股股份以 5,547.5110 万元的价格转让给芜湖聚源；2026 年 3 月 15 日，上海骏晨翔与曾劲涛签订《股份转让协议书》，约定上海骏晨翔将其所持公司 16.1 万股股份以 429.226 万元的价格转让给曾劲涛；2026 年 4 月 28 日，上海骏晨翔与张军签订《股份转让协议书》，约定上海骏晨翔将其所持公司 4.5 万股股份以 119.97 万元的价格转让给张军。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	郑朝晖	1,838.5070	15.91
2	季铭源	930.4140	8.05
3	嘉善芯创	863.5500	7.47
4	郑琦君	686.0824	5.94
5	柴春波	490.2900	4.24
6	苏州元禾	435.5000	3.77
7	财通创新	390.0000	3.37
8	江山季兴	375.0000	3.24
9	福州嘉衍	375.0000	3.24
10	郑建生	373.7400	3.23
11	俱成秋实	300.0000	2.60
12	沪电股份	300.0000	2.60
13	芜湖聚源	246.6210	2.13
14	渝富益华	233.3178	2.02
15	江阴瀚联	225.8271	1.95
16	上海季双	225.0000	1.95

序号	姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
17	谢丽	225.0000	1.95
18	尚成一号	209.2739	1.81
19	芜湖信芯	173.3790	1.50
20	厦门同琅	163.0000	1.41
21	嘉兴君源	150.6078	1.30
22	陈洋森	150.0066	1.30
23	俱成秋实贰号	150.0000	1.30
24	绍兴绿杉	150.0000	1.30
25	共青城创丰	148.9762	1.29
26	畅享季	147.5000	1.28
27	大零号湾	147.5000	1.28
28	南通中皋	135.0000	1.17
29	徐莺	120.0000	1.04
30	苏州清石	119.2000	1.03
31	新锐克胜	110.0000	0.95
32	春山锐卓	105.0000	0.91
33	交大小苗	101.0000	0.87
34	湖州创投	93.3271	0.81
35	天津合泰	84.0000	0.73
36	衢州金藤	83.0000	0.72
37	思瑞浦	79.4100	0.69
38	衢州绿发	73.0238	0.63
39	普冉股份	63.0000	0.55
40	渝兴益华贰号	50.2000	0.43
41	嘉兴君晋	48.1463	0.42
42	商络电子	42.0000	0.36
43	成都励石	42.0000	0.36
44	曾劲涛	38.1000	0.33
45	上海丽平	33.6000	0.29
46	张群仙	30.0000	0.26
47	张军	4.5000	0.04
合计		**11,558.60**	**100.00**

（四）发行人历史上的股份代持及解除情况

公司历史沿革中直接股东层面及持股平台季铭源、已退出股东上海骏晨翔层面曾经存在股份代持的情况，相关代持产生的原因系两类：一类为郑朝晖、郑建生当时在其他公司任职不便显名产生了代持；另一类为被代持人为了简化工商备案操作而产生了代持。具体情况如下：

1、郑朝晖股份代持及解除情况（直接、间接层面）

期间	代持人及其身份	代持形成原因
2008.07-2015.02	张文雄：郑朝晖好友 鞠文凯：时任员工 杨玉玲：张文雄亲属	郑朝晖在其他公司任职，不便显名
	代持的形成、演变及解除过程	
	（1）2008 年 7 月，公司成立时注册资本为 50 万元，张文雄持有的 60%股权对应 30 万元注册资本系代郑朝晖持有；2009 年 8 月，公司注册资本增至 200 万元，代持的股权变更至 120 万元；2011 年 9 月，杨玉玲受让张文雄 60%股权、鞠文凯受让章莉（郑朝晖配偶）40%股权，郑朝晖与张文雄的代持关系解除； （2）2015 年 2 月，杨玉玲、鞠文凯分别将其代持的公司 60%股权、25.71%股权对应的合计 171.4286 万元注册资本转让给陈洋森，郑朝晖与杨玉玲、鞠文凯的代持关系解除；	
期间	**代持人及其身份**	**代持形成原因**
2016.05-2018.08	朱俊燕：时任员工、远亲	郑朝晖通过投资季铭源间接持有公司股份，朱俊燕当时负责公司股权事项，为简化工商备案操作产生的代持多由其执行，因此由其作为代持人。
	代持的形成、演变及解除过程	
	（3）2016 年 5 月，公司注册资本由 1,400 万元增加至 1,603 万元，季铭源认购全部新增注册资本，其中朱俊燕认购季铭源份额对应公司 113 万元注册资本系代郑朝晖持有，双方形成代持关系。2017 年 7 月公司资本公积转增后，代持的股份变更至 118.65 万股； （4）2017 年 11-12 月，季铭源向郑琦君、升导信息（张育嘉控制的企业）、泛铨电子转让股份，其中包含了上述朱俊燕代郑朝晖通过季铭源所持公司股份。2017 年 12 月郑朝晖与陈洋森已达成股份转回约定，朱俊燕通过季铭源为陈洋森代持的公司股份转变为郑朝晖所有； （5）2018 年下半年，朱俊燕离职时向王永安、陶雪芬、郑朝晖转让其代郑朝晖持有的季铭源份额，郑朝晖与朱俊燕的代持关系解除；	
期间	**代持人及其身份**	**代持形成原因**
2017.12-2018.09	李定学：员工	2017 年末陈洋森将股份转回给郑朝晖，李定学为陈洋森代持的公司股份转变为郑朝晖所有。
	代持的形成、演变及解除过程	

	（6）2017 年 12 月郑朝晖与陈洋森已达成股份转回约定，李定学通过季铭源为陈洋森代持的公司股份转变为郑朝晖所有； （7）2018 年 9 月，李定学向张文德、郑琦君、王春亮转让其代郑朝晖持有的季铭源份额，郑朝晖与李定学的代持关系解除。

2、陈洋森股份代持及解除情况（间接层面）

2015 年郑朝晖与陈洋森达成所持全部（虚拟股）股权转让约定后，公司开始通过将虚拟股股东持有的虚拟股转换为实际股权从而实现对虚拟股的规范和清理，陈洋森将所持虚拟股一部分转换为在季丰电子层面进行工商显名登记，剩余部分在季铭源层面进行工商登记，考虑到季铭源之设立系为持续进行股权激励、吸引外部投资者之目的，频繁变动均需履行较多签字等流程，为工商备案操作的便利，陈洋森所持季铭源份额由李定学、朱俊燕代持，具体情况如下：

期间	代持人及其身份	代持形成原因
2015.03-2017.12	李定学：员工	简化工商操作
	代持的形成、演变及解除过程	
	（1）2015 年 3 月，季铭源成立时出资额为 100 万元，李定学持有季铭源的部分份额对应公司 265.1428 万元注册资本系代陈洋森持有，双方形成代持关系； （2）经过季铭源一系列合伙份额转让、认购公司新增注册资本、公司资本公积转增股本，截至 2017 年 7 月，代持的股份变更至 52.5 万股； （3）2017 年 12 月，郑朝晖与陈洋森已达成股份转回约定，李定学通过季铭源为陈洋森代持的公司股份转变为郑朝晖所有，陈洋森与李定学的代持关系解除；	
期间	**代持人及其身份**	**代持形成原因**
2015.06-2017.12	朱俊燕：时任员工	朱俊燕当时负责公司股权事项，为简化工商备案操作产生的代持多由其执行，因此新增其为代持人。
	代持的形成、演变及解除过程	
	（4）2015 年 6 月，朱俊燕代陈洋森受让季铭源份额对应公司 22.9729 万元注册资本，双方形成代持关系； （5）经过季铭源一系列合伙份额转让/受让、认购公司新增注册资本、公司资本公积转增股本，截至 2017 年 7 月，代持的股份变更至 109.44 万股； （6）2017 年 11-12 月，季铭源向郑琦君、升导信息（张育嘉控制的企业）、泛铨电子转让公司股份，其中包含了朱俊燕代陈洋森通过季铭源所持公司部分股份； （7）2017 年 12 月，朱俊燕（代陈洋森）受让季铭源份额对应公司的 2.625 万股，同月郑朝晖与陈洋森已达成股份转回约定，朱俊燕通过季铭源为陈洋森代持的公司股份转变为郑朝晖所有，陈洋森与朱俊燕的代持关系解除。	

3、郑建生股份代持及解除情况（直接层面）

期间	代持人及其身份	代持形成原因
2015.03-2025.12	王景阳：郑建生好友 王笏泉：郑建生妹夫	郑建生系外籍人士，为简化工商操作委托王景阳代持，王景阳后因自身原因不便为其代持，变更代持人为王笏泉。

	代持的形成、演变及解除过程
	（1）郑建生投资 500 万元取得 200 万股虚拟股，后公司规范清理虚拟股时，郑建生所持虚拟股需转换为在公司工商登记层面的直接持股，其委托王景阳做为工商登记的公司直接股东为其代持； （2）王景阳在代持期间按照郑建生的指示减持 57.8157 万股和增持 14.4175 万股；2018 年末，郑建生委托王笏泉受让了升导信息、陈洋森、季铭源、王景阳的股份，由此郑建生和王景阳的代持关系解除，郑建生和王笏泉开始形成代持关系； （3）2025 年 12 月，王笏泉和郑建生签署《股权**代持还原**协议》，王笏泉将所持全部股份转让给郑建生，郑建生与王笏泉的代持关系解除。

4、张育嘉股份代持及解除情况（间接层面），2020 年退出持股

期间	**代持人及其身份**	**代持形成原因**
2015.03-2015.06	李定学：员工	张育嘉为中国台湾省人士，简化工商操作
	代持的形成、演变及解除过程	
	（1）2015 年 3 月，季铭源成立时出资额为 100 万元，李定学持有季铭源的部分份额对应公司 35.3025 万元注册资本系代张育嘉持有，双方形成代持关系；2015 年 6 月，李定学将此部分份额转给朱俊燕，由朱俊燕为张育嘉代持，张育嘉与李定学的代持关系解除；	
期间	**代持人及其身份**	**代持形成原因**
2015.06-2017.12	朱俊燕：时任员工	朱俊燕当时负责公司股权事项，为简化工商备案操作产生的代持多由其执行，因此变更其为代持人。
	代持的形成、演变及解除过程	
	（2）2015 年 12 月，公司注册资本由 1,200 万元增加至 1,400 万元，季铭源同比例认缴出资，朱俊燕代持的股权增至 41.1981 万元； （3）2016 年 5 月，公司注册资本由 1,400 万元增加至 1,603 万元，季铭源认购全部新增注册资本，其中朱俊燕认购季铭源份额对应公司 30 万元注册资本系代张育嘉持有；2016 年 8 月，朱俊燕（代陈洋森）向张育嘉转让季铭源份额对应公司的 55 万元注册资本；2017 年 7 月公司资本公积转增后，代持的股份变更至 132.508 万股； （4）2017 年 11-12 月，季铭源向郑琦君、升导信息（张育嘉控制的企业）、泛铨电子转让公司股份，其中包含了朱俊燕代张育嘉通过季铭源所持公司股份，张育嘉与朱俊燕的代持关系解除。	

5、王春亮股份代持及解除情况（间接层面），2019 年退出持股

期间	**代持人及其身份**	**代持形成原因**
2016.05-2018.06	朱俊燕：时任员工	简化工商操作
	代持的形成、演变及解除过程	
	（1）2016 年 5 月，公司注册资本由 1,400 万元增加至 1,603 万元，季铭源认购全部新增注册资本，其中朱俊燕认购季铭源份额对应公司 30 万元注册资本系代王春亮持有，双方形成代持关系；2017 年 7 月公司资本公积转增后，代持的股份变更至 31.5 万股； （2）2018 年 6 月，朱俊燕因离职将上述代王春亮持有的季铭源份额转给郑朝晖，由郑朝晖为王春亮代持，王春亮与朱俊燕的代持关系解除；	

期间	代持人及其身份	代持形成原因
2018.06-2018.09	郑朝晖：员工	朱俊燕从公司离职，由郑朝晖继续代持。
	代持的形成、演变及解除过程	
	（3）2018 年 9 月，郑朝晖指示李定学将其为郑朝晖代持的对应公司 31.5 万股股份转给王春亮，王春亮与郑朝晖的代持关系解除。	

6、张蕊股份代持及解除情况（间接层面），2018 年退出持股

期间	代持人及其身份	代持形成原因
2016.05-2018.06	朱俊燕：时任员工	简化工商操作
	代持的形成、演变及解除过程	
	（1）2016 年 5 月，公司注册资本由 1,400 万元增加至 1,603 万元，季铭源认购全部新增注册资本，其中朱俊燕认购季铭源份额对应公司 30 万元注册资本系代张蕊持有，双方形成代持关系。2017 年 7 月公司资本公积转增后，代持的股份增至 31.5 万股； （2）2018 年 6 月，朱俊燕因离职将上述代张蕊持有的季铭源份额转给郑朝晖，由郑朝晖为张蕊代持，张蕊与朱俊燕的代持关系解除；	
期间	代持人及其身份	代持形成原因
2018.06-2018.12	郑朝晖：员工	朱俊燕从公司离职，由郑朝晖继续代持。
	代持的形成、演变及解除过程	
	（3）2018 年 12 月，张蕊向郑朝晖转让其持有的季铭源份额，张蕊与郑朝晖的代持关系解除。	

7、李益欢股份代持及解除情况（间接层面），2017 年退出持股

期间	代持人及其身份	代持形成原因
2016.01-2017.12	朱俊燕：时任员工	简化工商操作
	代持的形成、演变及解除过程	
	（1）2016 年 1 月，朱俊燕（代陈洋森）向李益欢转让季铭源份额对应公司的 7.5 万元注册资本，其受让后由朱俊燕代其持有，双方形成代持关系； （2）2017 年 4 月，李益欢向朱俊燕（代陈洋森）转让季铭源份额对应公司的 5 万元注册资本，代持的股权减至 2.5 万元；2017 年 7 月，公司资本公积转增后，代持的股份增至 2.625 万股；2017 年 12 月，李益欢向朱俊燕（代陈洋森）转让其持有的季铭源份额，李益欢与朱俊燕的代持关系解除。	

8、庄振铭股份代持及解除情况（直接、间接层面），2019 年退出持股

期间	代持人及其身份	代持形成原因
2017.03-2017.12	朱俊燕：时任员工	庄振铭为中国台湾省人士，简化工商操作
	代持的形成、演变及解除过程	
	（1）2017 年 3 月，经张育嘉介绍，朱俊燕（代陈洋森）向庄振铭转让季铭源份额对应公司的 30 万股，其受让后由朱俊燕代其持有，双方形成代持关系。2017 年 7 月公司资本公积转增后，代持的股份增至 31.5 万股；	

	（2）2017 年 11-12 月，季铭源向郑琦君、升导信息（张育嘉控制的企业）、泛铨电子转让公司股份，其中包含了朱俊燕代庄振铭通过季铭源所持公司股份，庄振铭与朱俊燕的代持关系解除；	
期间	**代持人及其身份**	**代持形成原因**
2017.12-2018.12	升导信息、圣彦商务：时任员工张育嘉当时控制的企业	2017 年末，庄振铭将其股份转至张育嘉控制的企业名下。
	代持的形成、演变及解除过程	
	（3）2018 年 10-11 月，升导信息、圣彦商务向郑朝晖转让其代庄振铭所持公司 8.5 万股股份，并将代庄振铭持有的剩余 23 万股股份转由郑朝晖代庄振铭持有，庄振铭与升导信息、圣彦商务之间的股份代持关系解除；	
期间	**代持人及其身份**	**代持形成原因**
2018.12-2019.07	郑朝晖：员工	庄振铭为中国台湾省人士，简化工商操作。
	代持的形成、演变及解除过程	
	（4）2019 年 7 月，庄振铭向郑朝晖转让剩余 23 万股股份，庄振铭与郑朝晖的代持关系解除。	

9、陈重志股份代持及解除情况（直接层面），2019 年退出持股

期间	**代持人及其身份**	**代持形成原因**
2018.10-2019.11	升导信息、圣彦商务：时任员工张育嘉当时控制的企业	陈重志为中国台湾省人士，简化工商操作
	代持的形成、演变及解除过程	
	（1）2018 年 10 月，升导信息、圣彦商务向陈重志转让公司的 10 万股股份，其受让后由升导信息、圣彦商务代其持有； （2）2018 年 12 月，升导信息、圣彦商务按照陈重志的指示向郑朝晖转让其代陈重志持有的公司 2.5 万股股份，代持减至 7.5 万股； （3）2019 年 11 月，升导信息、圣彦商务按照陈重志的指示向郑朝晖转让剩余代陈重志持有的公司 7.5 万股股份，陈重志与升导信息、圣彦商务之间的股份代持关系解除。	

10、上海骏晨翔股份代持及解除情况（直接层面），2026 年退出持股

期间	**代持人及其身份**	**代持形成原因**
2023.6-2026.4	张军等 9 人均系上海骏晨翔工商股东或其亲友	张军等人希望通过上海骏晨翔投资公司，简化工商操作
	代持的形成、演变及解除过程	
	（1）2023 年 6 月，上海骏晨翔出资 494.40 万元认购公司 20.60 万股股份，系代张军等人持有； （2）2026 年 3 月，上海骏晨翔将其持有的公司 16.1 万股转让给曾劲涛；2026 年 4 月，上海骏晨翔将其持有的公司 4.5 万股转让给张军，此后上海骏晨翔不再持有公司股份，上海骏晨翔与张军等人股份代持关系解除。	

截至本招股说明书签署日，上述股权代持均已解除，公司股份权属清晰，不存在可能导致控制权变更的重大权属纠纷。

（五）发行人历史上的虚拟股及规范清理情况

1、虚拟股的设立背景及主要内容

公司成立初期，业务发展速度较慢、经营规模较小、员工流动性较高，为吸引核心人才、激励员工积极性及引进外部合作方，创始人决定通过设置虚拟股的方式，实现人才绑定与业务拓展。虚拟股参与主体初期以公司员工为主，后期包含少量外部合作伙伴。

创始人郑朝晖将其实际持有的季丰有限股权所对应的经济权益作为虚拟股向参与方让渡，虚拟股参与方需支付相应对价认购虚拟股权益份额，其仅享有两项核心权利：一是参与公司利润分红的权利，二是转让虚拟股并取得转让收益的权利。虚拟股东不享有《公司法》及《公司章程》约定的表决权、提案权等股东权利，不能通过所持虚拟股对公司股东会决策、日常经营管理施加任何影响；虚拟股权益独立于公司工商登记的注册资本及股权结构，与股权代持无关联，不属于法定意义上的股权代持行为。

2、虚拟股的变动情况

（1）2008 年 9 月，开始设置虚拟股，第一次虚拟股转让

2008 年 9 月，郑朝晖将其拥有的公司股权划分为 10 万股虚拟股，并将 2.00 万股作价 2.00 万元转让给蔡霞；将 1.30 万股作价 1.30 万元转让给鞠文凯；将 0.50 万股作价 0.50 万元转让给陶雪芬。

本次变动完成后，公司虚拟股权结构如下：

序号	姓名	虚拟股数（万股）	比例（%）
1	郑朝晖	6.20	62.00
2	蔡霞	2.00	20.00
3	鞠文凯	1.30	13.00
4	陶雪芬	0.50	5.00
合计		**10.00**	**100.00**

（2）2009 年 4 月，第二次虚拟股转让

2009 年 4 月，郑朝晖将其所持 1.60 万股作价 1.60 万元转让给王永安；蔡霞将其所持 2.00 万股作价 2.00 万元转让给郑朝晖后退出虚拟股。

本次变动完成后，公司虚拟股权结构如下：

序号	姓名	虚拟股数（万股）	比例（%）
1	郑朝晖	6.60	66.00
2	王永安	1.60	16.00
3	鞠文凯	1.30	13.00
4	陶雪芬	0.50	5.00
合计		**10.00**	**100.00**

（3）2010 年 4 月，第三次虚拟股转让

2010 年 4 月，王永安因离职将其所持 1.60 万股作价 2.40 万元转让给郑朝晖后退出虚拟股；郑朝晖将其所持 2.10 万股作价 3.15 万元转让给张文雄、将其所持 0.375 万股作价 0.5625 万元转让给鞠文凯。

本次变动完成后，公司虚拟股权结构如下：

序号	姓名	虚拟股数（万股）	比例（%）
1	郑朝晖	5.725	57.25
2	张文雄	2.10	21.00
3	鞠文凯	1.675	16.75
4	陶雪芬	0.50	5.00
合计		**10.00**	**100.00**

（4）2010 年 12 月，第四次虚拟股转让

2010 年 12 月，郑朝晖将其所持 0.125 万股作价 0.5 万元转让给赵卫宇。

本次变动完成后，公司虚拟股权结构如下：

序号	姓名	虚拟股数（万股）	比例（%）
1	郑朝晖	5.60	56.00
2	张文雄	2.10	21.00
3	鞠文凯	1.675	16.75
4	陶雪芬	0.50	5.00
5	赵卫宇	0.125	1.25
合计		**10.00**	**100.00**

（5）2013 年 6 月，第一次增资及第五次虚拟股转让

2013 年 6 月，公司对虚拟股总数进行了同比例扩大，将虚拟股总数由 10 万

股调整为 80 万股，该增资仅为虚拟股股本的膨胀，股东无需支付膨胀股份的对应款项。随后郑朝晖将其所持 4 万股作价 10 万元转让给王永安（王永安此时再次入职）。

本次变动完成后，公司虚拟股权结构如下：

序号	姓名	虚拟股数（万股）	比例（%）
1	郑朝晖	40.80	51.00
2	张文雄	16.80	21.00
3	鞠文凯	13.40	16.75
4	陶雪芬	4.00	5.00
5	王永安	4.00	5.00
6	赵卫宇	1.00	1.25
合计		**80.00**	**100.00**

（6）2014 年 12 月，第二次增资

2014 年 12 月，公司虚拟股总数由 80 万股增加至 84 万股，李定学以 22.6 万元认购了新增的 4 万股虚拟股。

本次变动完成后，公司虚拟股权结构如下：

序号	姓名	虚拟股数（万股）	比例（%）
1	郑朝晖	40.80	48.57
2	张文雄	16.80	20.00
3	鞠文凯	13.40	15.95
4	陶雪芬	4.00	4.76
5	王永安	4.00	4.76
6	李定学	4.00	4.76
7	赵卫宇	1.00	1.19
合计		**84.00**	**100.00**

（7）2015 年 1 月，第三、四次增资

2015 年 1 月，公司虚拟股总数由 84 万增加至 94.81 万，郑朝晖、倪春胜、张育嘉分别以 30 万元同比例认购了新增加的 10.81 万股虚拟股。同时，公司对虚拟股总数进行了同比例扩大，将虚拟股总数由 94.81 万股调整为 1,000 万股，该增资仅为虚拟股股数的膨胀，股东无需支付膨胀股份的对应款项。

本次变动完成后，公司虚拟股权结构如下：

序号	姓名	虚拟股数（万股）	比例（%）
1	郑朝晖	468.34	46.83
2	张文雄	177.20	17.72
3	鞠文凯	141.34	14.13
4	陶雪芬	42.19	4.22
5	王永安	42.19	4.22
6	李定学	42.19	4.22
7	倪春胜	38.00	3.80
8	张育嘉	38.00	3.80
9	赵卫宇	10.55	1.05
合计		**1,000.00**	**100.00**

（8）2015 年 1 月-3 月，虚拟股一系列转让及第五次增资

2015 年初，公司为引进外部投资及规范公司股权治理，开始计划对虚拟股进行规范和清理。同时，公司拟对核心骨干等人员进行一轮虚拟股股权激励。

综上，虚拟股在 2015 年 1-3 月期间发生了一系列变动，具体情况如下：

①原虚拟股股东均以 1.50 元/股的价格转出各自持股 3.2%虚拟股作为公司虚拟股激励池（郑朝晖名下）：

序号	转让方	转让虚拟股数（万股）	作价（万元）	受让方
1	郑朝晖	14.99	22.48	虚拟股激励池
2	张文雄	5.67	8.51	
3	鞠文凯	4.52	6.78	
4	陶雪芬	1.35	2.03	
5	王永安	1.35	2.03	
6	李定学	1.35	2.03	
7	倪春胜	1.22	1.82	
8	张育嘉	1.22	1.82	
9	赵卫宇	0.34	0.51	
合计		**32.00**	**48.00**	-

②由公司拟激励的新股东认购该等虚拟股，激励池中未被认购完的份额由郑朝晖等三位原虚拟股股东购回：

序号	转让方	受让方	受让虚拟股数（万股）	作价（万元）
1	虚拟股激励池	郑朝晖	10.00	15.00
2		王永安	2.00	3.00
3		李定学	4.00	6.00
4		郑增伟	5.00	7.50
5		朱俊燕	3.00	4.50
6		邱旸	2.00	3.00
7		倪梅	1.00	1.50
8		邵疆	1.00	1.50
9		张建军	1.00	1.50
10		武传贵	1.00	1.50
11		唐笑南	1.00	1.50
12		曹艳红	1.00	1.50
合计			**32.00**	**48.00**

③部分虚拟股股东退出或者减持部分份额，第六次虚拟股转让

张文雄将其所持 171.5296 万股虚拟股作价 257.2944 万元转让给郑朝晖，鞠文凯将其所持 136.8153 万股虚拟股作价 232.5860 万元转让给郑朝晖，二人退出虚拟股；赵卫宇将其所持 1.7580 万股虚拟股作价 2.637 万元转让给郑朝晖，陶雪芬将其所持 5 万股虚拟股作价 7.50 万元转让给郑朝晖，二人此时减持了部分份额；郑朝晖将其所持 40.00 万股虚拟股作价 90.00 万元转让给孟媛媛。

上述变动完成后，公司虚拟股权结构如下：

序号	姓名	虚拟股数（万股）	比例（%）
1	郑朝晖	737.70	73.77
2	李定学	44.84	4.48
3	王永安	42.84	4.28
4	孟媛媛	40.00	4.00
5	倪春胜	36.78	3.68
6	张育嘉	36.78	3.68
7	陶雪芬	35.84	3.58
8	赵卫宇	9.21	0.92
9	郑增伟	5.00	0.50
10	朱俊燕	3.00	0.30

序号	姓名	虚拟股数（万股）	比例（%）
11	邱旸	2.00	0.20
12	倪梅	1.00	0.10
13	邵疆	1.00	0.10
14	张建军	1.00	0.10
15	武传贵	1.00	0.10
16	唐笑南	1.00	0.10
17	曹艳红	1.00	0.10
合计		**1,000.00**	**100.00**

④第五次增资，虚拟股增至 1,400.00 万股

外部投资者王景阳（代郑建生）以 500 万元认购 200 万股、王仲晰以 200 万元认购 80 万股，原虚拟股股东按原持股比例以 300 万元认购 120 万股，虚拟股总数由 1,000.00 万股增加至 1,400.00 万股。

本次变动完成后，公司虚拟股权结构如下：

序号	姓名	虚拟股数（万股）	比例（%）
1	郑朝晖	826.2249	59.02
2	王景阳	200.0000	14.29
3	王仲晰	80.0000	5.71
4	李定学	50.2212	3.59
5	王永安	47.9812	3.43
6	孟媛媛	44.8000	3.20
7	倪春胜	41.1981	2.94
8	张育嘉	41.1981	2.94
9	陶雪芬	40.1412	2.87
10	赵卫宇	10.3153	0.74
11	郑增伟	5.6000	0.40
12	朱俊燕	3.3600	0.24
13	邱旸	2.2400	0.16
14	倪梅	1.1200	0.08
15	邵疆	1.1200	0.08
16	张建军	1.1200	0.08
17	武传贵	1.1200	0.08

序号	姓名	虚拟股数（万股）	比例（%）
18	唐笑南	1.1200	0.08
19	曹艳红	1.1200	0.08
合计		**1,400.00**	**100.00**

3、虚拟股的规范清理情况

2015 年郑朝晖与陈洋森达成所持全部（虚拟股）股权转让约定，公司通过将虚拟股股东持有的虚拟股转换为实际股权从而实现对虚拟股的清理：对于持股数量高于 200 万股的股东在直接层面进行工商显名登记；持股数量低于 200 万股的股东在间接（持股平台季铭源）层面进行工商显名登记。基于前述清理安排，陈洋森将所持虚拟股转换为实际股权，一部分在季丰电子层面进行工商显名登记，剩余部分在季铭源层面进行工商登记（委托李定学代持）；郑建生所持虚拟股转换为实际股权并在季丰电子层面进行工商登记（委托王景阳代持）；其余虚拟股股东所持虚拟股转换为实际股权并在季铭源层面进行工商显名登记（其中张育嘉委托李定学代持）。

当公司工商登记的注册资本增至 1,400 万元时，该注册资本金额与虚拟股股份数量一致，虚拟股股东持有的虚拟股转换为实际股权予以工商登记，虚拟股即完成了规范清理。

（1）直接持股层面虚拟股规范清理情况

2015 年 2 月，杨玉玲将其所持季丰有限 120 万元注册资本转让给陈洋森；鞠文凯将其所持季丰有限 51.4286 万元注册资本转让给陈洋森、将其所持季丰有限 28.5714 万元注册资本转让给王景阳。由此，陈洋森、王景阳（代郑建生）开始在季丰电子层面持股（此时季丰有限的注册资本为 200 万元）。通过 2015 年 5 月、2016 年 1 月两次增资后，公司的注册资本增至 1,400 万元，股权结构如下：

序号	姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	季铭源	683.1084	48.79
2	陈洋森	516.8916	36.92
3	王景阳	200.0000	14.29
合计		**1,400.00**	**100.00**

（2）间接持股（季铭源）层面虚拟股规范清理情况

①2015 年 3 月，季铭源成立时股权情况如下：

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	对应公司注册资本（万元）
1	李定学	58.6660	58.67	343.5022
2	王仲晰	11.7112	11.71	68.5714
3	王永安	7.0239	7.02	41.1264
4	孟媛媛	6.5582	6.56	38.3996
5	倪春胜	6.0310	6.03	35.3128
6	陶雪芬	5.8762	5.88	34.4064
7	赵卫宇	1.5100	1.51	8.8414
8	郑增伟	0.8198	0.82	4.8001
9	朱俊燕	0.4918	0.49	2.8796
10	邱旸	0.3279	0.33	1.9199
11	倪梅	0.1640	0.16	0.9603
12	邵疆	0.1640	0.16	0.9603
13	张建军	0.1640	0.16	0.9603
14	武传贵	0.1640	0.16	0.9603
15	唐笑南	0.1640	0.16	0.9603
16	曹艳红	0.1640	0.16	0.9603
合计		**100.00**	**100.00**	**585.5215**

②2015 年 6 月，季铭源内部财产份额转让

2015 年 6 月，李定学将其代陈洋森持有的季铭源 14,639 元财产份额转让给毛余喜、109,792 元财产份额转让给刘自力、20,868 元财产份额转让给朱俊燕（由朱俊燕继续替陈洋森代持该部分财产份额）、将其代张育嘉持有的季铭源 60,297 元财产份额转让给朱俊燕（由朱俊燕继续替张育嘉代持该部分财产份额）。

武传贵、唐笑南、赵卫宇因离职将各自持有的季铭源 1,640 元财产份额转让给陈洋森（由朱俊燕代持）；陶雪芬因资金需要减持部分份额及公司拟对毛余喜进行激励，因此陶雪芬将其持有的季铭源 43,917 元财产份额转让给毛余喜。

本次变动完成后，季铭源股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	对应公司注册资本（万元）
1	李定学	38.1064	38.11	223.1212
2	王仲晰	11.7112	11.71	68.5715
3	刘自力	10.9792	10.98	64.2856
4	朱俊燕	10.4463	10.45	61.1653
5	王永安	7.0239	7.02	41.1264
6	孟媛媛	6.5582	6.56	38.3996
7	倪春胜	6.0310	6.03	35.3128
8	毛余喜	5.8556	5.86	34.2858
9	陶雪芬	1.4845	1.48	8.6921
10	郑增伟	0.8198	0.82	4.8001
11	邱旸	0.3279	0.33	1.9199
12	倪梅	0.1640	0.16	0.9603
13	邵疆	0.1640	0.16	0.9603
14	张建军	0.1640	0.16	0.9603
15	曹艳红	0.1640	0.16	0.9603
合计		**100.00**	**100.00**	**585.5215**

③ 2015 年 12 月，季铭源涉及的虚拟股还原完毕（对应季铭源内部财产份额调整）

2015 年 12 月，公司注册资本增至 1,400 万元，季铭源的出资额相应增至 683.1084 万元。

本次变动完成后，季铭源股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	对应公司注册资本（万元）
1	李定学	38.1064	38.11	260.3079
2	王仲晰	11.7112	11.71	80.0000
3	刘自力	10.9792	10.98	75.0000
4	朱俊燕	10.4463	10.45	71.3600
5	王永安	7.0239	7.02	47.9812
6	孟媛媛	6.5582	6.56	44.8000
7	倪春胜	6.0310	6.03	41.1981
8	毛余喜	5.8556	5.86	40.0000

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	对应公司注册资本（万元）
9	陶雪芬	1.4845	1.48	10.1412
10	郑增伟	0.8198	0.82	5.6000
11	邱旸	0.3279	0.33	2.2400
12	倪梅	0.1640	0.16	1.1200
13	邵疆	0.1640	0.16	1.1200
14	张建军	0.1640	0.16	1.1200
15	曹艳红	0.1640	0.16	1.1200
合计		**100.00**	**100.00**	**683.1084**

至此，其余虚拟股股东间接持有季丰电子的股份数均已在季铭源的工商登记层面予以还原体现，其名下持有的虚拟股权均已转换为实际股权。

综上，发行人历史上曾存在的虚拟股均已规范清理完毕，公司目前股权结构真实、清晰。虽然该虚拟股的实施期间距今较长、在早期的时候存在现金交易和无协议的情况，但公司认为相关对象未来提出异议并主张个人利益的风险较低。

（六）发行人历史上的出资瑕疵情况

序号	时间	形成过程与原因	补正程序
1	2009 年 8 月	1、2009 年 8 月 21 日，季丰有限股东会同意公司注册资本增至 200 万元，新增注册资本由全体股东按比例认缴。同日股东张文雄（代郑朝晖持有）、章莉向公司汇入 190 万元（包含设立时未实缴部分与本次新增注册资本）； 2、2009 年 8 月 28 日，190 万元转回至出资账户，此次出资存在瑕疵。	1、2025 年 8 月，郑朝晖以货币形式出资 190 万元，对前述瑕疵予以补正； 2、2026 年 2 月，公司召开股东会同意关于确认股东郑朝晖补缴出资及相关事项，会议确认本次补缴完成后郑朝晖对公司的出资义务已履行完毕，不存在任何争议或潜在纠纷； 3、2026 年 5 月 18 日，天健会计师出具天健验[2026]149 号《验资报告》对相关实收资本出资到位予以确认。
2	2016 年 1 月	1、2015 年 12 月 10 日，季丰有限股东会同意公司以资本公积金转增注册资本的方式增资 200 万元，由全体股东按比例认缴。 2、由于用于增资的资本公积不符合会计准则，此次出资存在瑕疵。	1、2016 年 5 月，时任公司股东季铭源、陈洋森、王景阳以货币形式重新出资，对前述瑕疵予以补正； 2、2016 年 5 月，季丰有限召开股东会同意修改 2015 年 12 月 10 日股东会决议增加注册资本至 1,400 万元时的出资方式，增资部分以资本公积转增注册资本的方式变更为以货币方式出资。 3、2016 年 6 月 12 日，中汇会计师出具《出资情况的专项复核报告》（中汇会鉴[2016]3961 号）对相关实收资本出资到位予以确认。

序号	时间	形成过程与原因	补正程序
			4、相关情况已在公司申请新三板挂牌时出具的《公开转让说明书》等文件中进行了披露。

根据上海市信用中心出具的《企业专项信用报告》，报告期内发行人在市场监管领域等不存在违法违规行为。

针对发行人历史上存在的出资瑕疵，实际控制人已出具承诺将承担相关法律责任，具体情况请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。

综上，发行人股权演变中的股东出资瑕疵已经规范整改，注册资本已通过货币补缴方式进行充实并经股东会审议确认，未侵犯发行人及现有全体股东的权益，不存在纠纷或潜在纠纷，不会对发行人造成重大不利影响，发行人或相关股东未因瑕疵事项受到过行政处罚，不会构成本次发行的法律障碍。

三、发行人报告期内的重大资产重组情况

报告期内，发行人未有重大资产重组情况。

四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况

公司曾于 2017 年 1 月至 2021 年 3 月在股转系统挂牌。

2016 年 12 月 30 日，股转公司核发《关于同意上海季丰电子股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]9942 号），同意公司股票在股转系统挂牌并公开转让；2017 年 1 月 18 日，公司股票在股转系统挂牌公开转让。

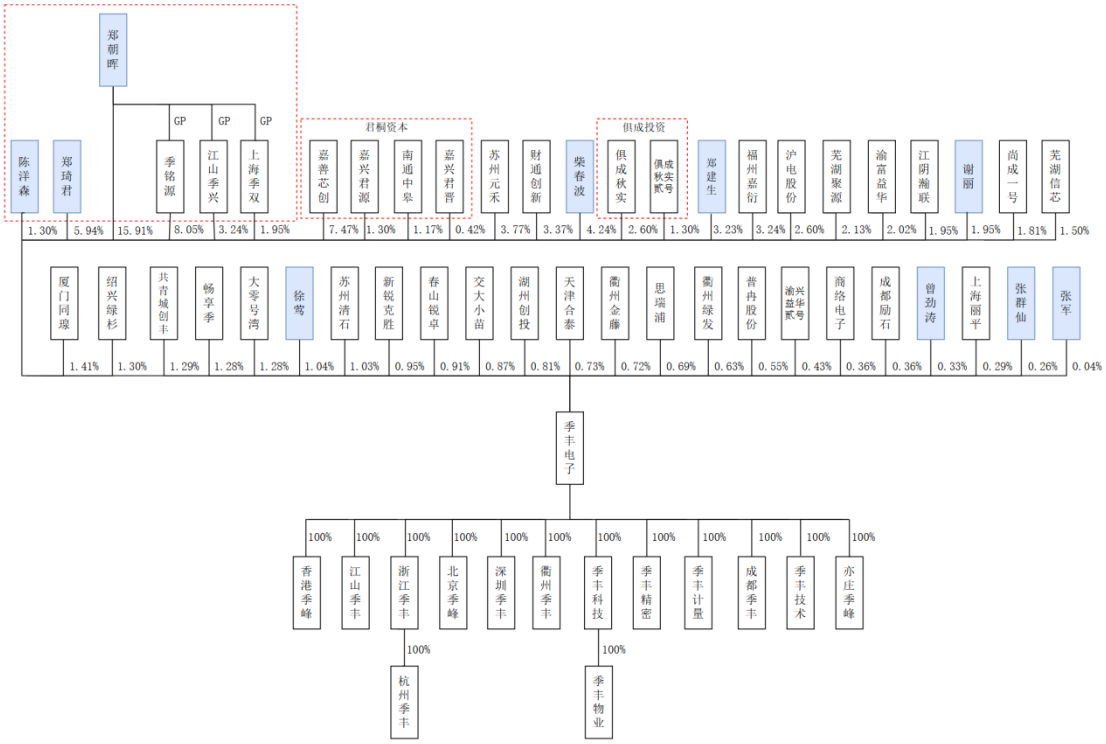
2021 年 2 月 22 日，公司召开股东大会并审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案，全体股东一致同意公司股票在股转系统摘牌。根据股转公司出具的《关于同意上海季丰电子股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2021]622 号）及《关于上海季丰电子股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转系统公告[2021]271 号），公司股票自 2021 年 3 月 17 日起终止在股转系统挂牌。

挂牌期间，公司不存在因涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关调查，被移送司法机关或追究刑事责任，或受到对公司生产经营有重大影响的行政处罚，或者被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚的情形。

五、发行人的股权结构及内部组织结构

（一）股权结构

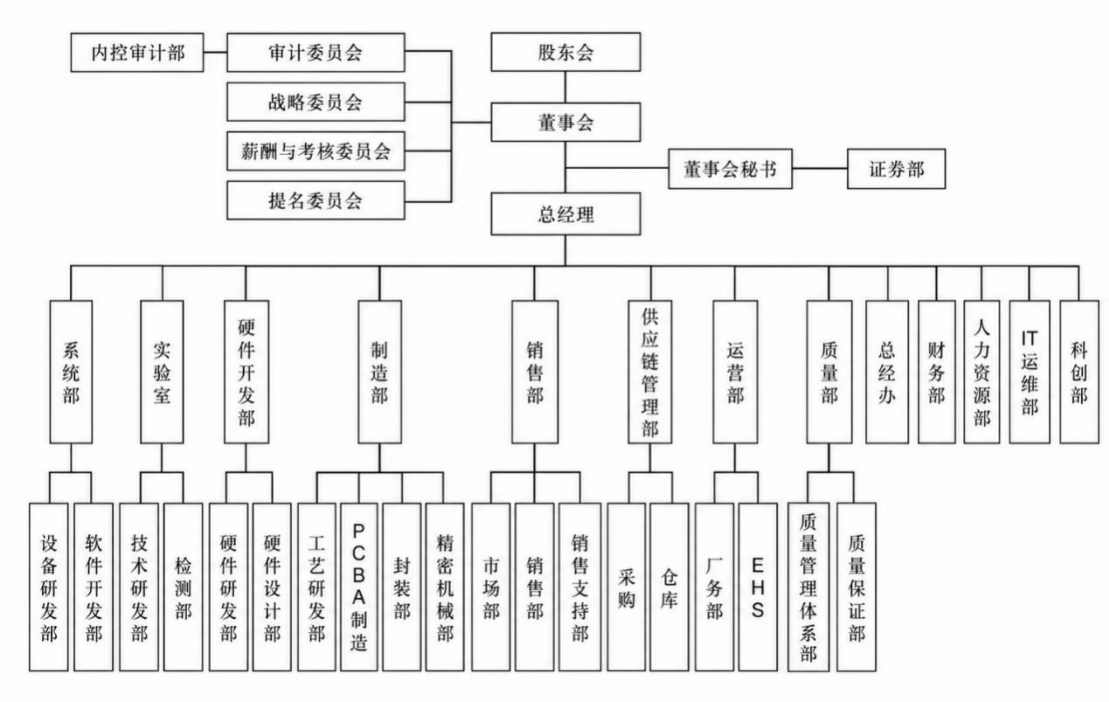
截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下表所示：



（二）组织结构

公司按照《公司法》及《公司章程》的规定，建立了较为完善的法人治理结构，设立了股东会、董事会，其中董事会设有审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。

截至本招股说明书签署日，公司内部组织结构如下图所示：



（三）发行人的主要职能单位

目前公司设有以下职能部门，其主要职责如下：

部门名称		职责
系统部	设备研发部	负责自主研发、设计及优化公司生产、检测、实验所需的专用设备与仪器系统，提升硬件能力与自动化水平。
	软件开发部	负责开发与维护公司业务系统、数据分析平台、内部管理软件及实验室信息管理系统，支持公司数字化运营。
实验室	技术研发部	负责前沿技术预研、新材料/新工艺/新方法的开发、技术路径验证，并形成核心技术专利与知识产权。
	检测部	依据国家、行业及客户标准，为客户样品或公司产品提供专业的分析、测试、可靠性验证及失效分析服务，并出具权威检测报告。
硬件开发部	硬件研发部	负责硬件产品（如探针台、测试板卡等）的底层架构设计、关键电路研发、精密部件选型与性能评估。
	硬件设计部	负责硬件产品的详细电路设计、PCB Layout、信号完整性仿真，并输出可供生产的完整设计文件。
制造部	工艺研发部	负责制定和优化生产工艺流程，解决生产中的技术难题，提升产品良率和生产效率。
	PCBA 制造	负责印刷电路板的贴片、焊接、组装及测试等全流程生产制造。
	封装部	负责芯片、模组等产品的封装设计、打样、测试及小批量生产。
	精密机械部	负责半导体相关测试设备和测试治具等各类精密机械产品的设计、生产、组装，主要包括测试插座 Socket、手动探针台等。
销售部	市场部	负责市场调研、品牌推广、营销活动策划与执行、销售线索管理、大客户关系维护及行业生态合作。
	销售部	负责开拓市场、服务客户，满足客户需求，达成销售目标。
	销售支持部	负责客户信息建档、报价管理、合同拟制及印章申请、归档全流程，同步完成 ERP 订单录入。统筹全业务线对账确认、发票开票申请及发送工

部门名称		职责
		作，以及应收账款全周期管理及回款催收职责。
质量部	质量管理体系部	负责建立、推行和维护公司整体质量管理体系、组织内审与管理评审，确保体系持续有效运行。
	质量保证部	负责从研发到交付全过程的质量控制，包括来料检验、过程巡检、成品检验、客户质量投诉处理及质量改进活动。
供应链管理部		**负责全公司采购战略、供应商管理、采购执行与供应链优化，保障物料稳定、经济、及时供应。**
运营部		**负责生产厂房、设施、动力的日常运维、安全管理及环保工作，确保生产环境稳定可靠。**
财务部		负责公司的财务管理，包括会计核算、预算管理、成本控制、税务筹划、资金管理与融资活动，为公司决策提供财务数据支持。
人力资源部		负责人力资源规划、招聘与配置、培训与发展、绩效管理、薪酬福利、员工关系与企业文化建设及行政事务。
IT 运维部		负责公司网络、服务器、业务系统及信息安全的日常运维管理，保障系统稳定运行与数据安全，为各部门提供 IT 技术支持与服务。
科创部		负责公司研发项目从概念到结项全流程的输入输出和过程管控，以及公司专利等知识产权的管理。
总经办		负责协助公司最高管理层进行战略规划、目标分解、重大事项督办、协调、重要会议与活动组织，并负责董事会日常事务。
内控审计部		负责建立健全内控与风险管理体系，开展内部审计、流程合规性审查、舞弊调查，并提出管理改进建议，保障公司资产安全与运营合规。
证券部		协助董事会行使职责，负责组织实施股权管理事务，包括投资者关系管理，股东会、董事会的管理，信息披露制度建设及对外信息管理，公司挂牌、上市等相关工作。

六、发行人的子公司及参股公司

截至本招股说明书签署日，公司拥有 14 家控股子公司、2 家参股公司，并参股 2 家合伙企业。公司设立子公司坚持聚焦主业定位，旗下各子公司均服务于主营业务，形成业务延伸与配套协同布局。

（一）子公司

1、季峰（香港）电子有限公司

成立时间	2018 年 1 月 18 日	注册资本	1 港元
注册地址	香港金钟道 89 号力宝中心一座 10 楼 1003 室	实收资本	1 港元
主要生产经营地	香港金钟道 89 号力宝中心一座 10 楼 1003 室	股权结构	公司持股 100%
经营范围	电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转移、技术咨询		
主营业务	报告期内无实际经营，目前正在申请注销。		
项目（单位：万元）	**2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月**		2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	**49.83**		71.11

净资产	**49.83**	70.68
营业收入	-	-
净利润	**-18.95**	-4.59
审计情况	经天健会计师审计	

2、江山季丰电子科技有限公司

成立时间	2019 年 3 月 29 日	注册资本	100 万元
注册地址	浙江省衢州市江山市双塔街道文教西路 15 号	实收资本	100 万元
主要生产经营地	浙江省衢州市江山市双塔街道文教西路 15 号	股权结构	公司持股 100%
经营范围	电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发、销售；电子产品、电子元器件、模具、仪器仪表、计算机硬件及辅助设备、机电设备销售；设备租赁；货物及技术进出口；电路板组件研发与测试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主营业务	集成电路板研发与设计		
项目（单位：万元）	**2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月**	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	
总资产	**1,205.93**	1,207.09	
净资产	**324.46**	138.69	
营业收入	**766.98**	1,150.94	
净利润	**181.95**	32.94	
审计情况	经天健会计师审计		

3、浙江季丰电子科技有限公司

成立时间	2021 年 1 月 25 日	注册资本	20,000 万元
注册地址	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 8 号 1 号厂房 201 室	实收资本	20,000 万元
主要生产经营地	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 8 号 1 号厂房 201 室	股权结构	公司持股 100%
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；电子元器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备销售；电子产品销售；通用设备修理；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。		
主营业务	第三方实验室检测分析业务、量产测试业务		

项目（单位：万元）	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	41,902.71	40,978.57
净资产	14,170.81	14,924.07
营业收入	5,250.67	9,306.05
净利润	-782.07	-1,199.56
审计情况	经天健会计师审计	

4、杭州季丰电子科技有限公司

成立时间	2021 年 4 月 29 日	注册资本	1,000 万元
注册地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路 560 号 1 幢 1 号楼 106 室	实收资本	1,000 万元
主要生产经营地	浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路 560 号 1 幢 1 号楼 106 室	股权结构	浙江季丰持股 100%
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。		
主营业务	第三方实验室检测分析业务		

项目（单位：万元）	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	5,364.30	5,023.35
净资产	4,649.16	4,247.48
营业收入	1,557.41	2,533.39
净利润	401.69	427.88
审计情况	经天健会计师审计	

5、北京季峰检测技术有限公司

成立时间	2021 年 9 月 29 日	注册资本	1,000 万元
注册地址	北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 3 单元 301	实收资本	1,000 万元
主要生产经营地	北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 3 单元 301	股权结构	公司持股 100%
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
主营业务	第三方实验室检测分析业务		

项目（单位：万元）	**2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月**	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	**4,560.62**	4,795.14
净资产	**756.02**	738.01
营业收入	**781.56**	1,334.28
净利润	**17.74**	206.16
审计情况	经天健会计师审计	

6、深圳季丰检测技术有限公司

成立时间	2021 年 10 月 28 日	注册资本	2,000 万元
注册地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 28 号通产新材料产业园 3 栋 1 单元 101	实收资本	2,000 万元
主要生产经营地	深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 28 号通产新材料产业园 3 栋 1 单元 101	股权结构	公司持股 100%
经营范围	一般经营项目：物联网技术服务；网络技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可经营项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主营业务	第三方实验室检测分析业务		
项目（单位：万元）	**2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月**	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	
总资产	**10,453.51**	10,548.89	
净资产	**3,864.65**	3,760.22	
营业收入	**1,845.45**	4,347.67	
净利润	**103.88**	992.94	
审计情况	经天健会计师审计		

7、衢州季丰检测技术有限公司

成立时间	2022 年 2 月 18 日	注册资本	1,000 万元
注册地址	浙江省衢州市银仓路 10 号 1 幢 2 号	实收资本	1,000 万元
主要生产经营地	浙江省衢州市银仓路 10 号 1 幢 2 号	股权结构	公司持股 100%
经营范围	许可项目：检验检测服务；安全生产检验检测；室内环境检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；环境保护监测；太阳能发电技术服务；储能技术服务；信息技术咨询服务；**劳务服务（不含劳务派遣）（除依**		

	法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	
主营业务	第三方实验室检测分析业务（新能源领域）	
项目（单位：万元）	**2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月**	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	**4,871.67**	5,100.52
净资产	**184.18**	473.10
营业收入	**536.44**	1,409.95
净利润	**-289.46**	-67.28
审计情况	经天健会计师审计	

8、上海季丰电子科技有限公司

成立时间	2022 年 2 月 21 日	注册资本	1,000 万元
注册地址	上海市闵行区友东路 258-288 号 2 幢 102 室	实收资本	1,000 万元
主要生产经营地	上海市闵行区友东路 258-288 号 2 幢 102 室	股权结构	公司持股 100%
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；普通机械设备安装服务；其他电子器件制造；半导体分立器件制造；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；专业设计服务；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主营业务	集成电路测试板生产及工程样品封装业务		
项目（单位：万元）	**2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月**	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	
总资产	**15,700.28**	12,319.94	
净资产	**1,034.71**	1,090.17	
营业收入	**8,845.60**	15,385.03	
净利润	**-62.52**	1,414.34	
审计情况	经天健会计师审计		

9、上海季丰物业管理有限公司

成立时间	2022 年 3 月 7 日	注册资本	100 万元
注册地址	上海市闵行区友东路 258-288 号 2 幢 109 室	实收资本	100 万元
主要生产经营地	上海市闵行区友东路 258-288 号 2 幢 109 室	股权结构	季丰科技持股 100%
经营范围	一般项目：物业管理；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁；住房租赁；会议及展览服务；体育赛事策划；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育用品设备出租；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；工程管理服务。（除依		

	法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
主营业务	管理公司集团物业相关事宜	
项目（单位：万元）	**2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月**	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	**508.58**	433.37
净资产	**140.81**	130.47
营业收入	**83.20**	172.86
净利润	**10.34**	31.98
审计情况	经天健会计师审计	

10、浙江季丰精密电子有限公司

成立时间	2022 年 3 月 7 日	注册资本	5,000 万元
注册地址	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 8 号 A2 幢 3 楼	实收资本	5,000 万元
主要生产经营地	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 8 号 A2 幢 3 楼	股权结构	公司持股 100%
经营范围	一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；五金产品批发；五金产品研发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；仪器仪表销售；照相机及器材销售；通信设备制造；光电子器件制造；家用电器制造；其他通用仪器制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；终端测试设备制造；终端测试设备销售；实验分析仪器销售；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；智能机器人销售；五金产品制造；模具制造；模具销售；包装材料及制品销售；普通机械设备安装服务；试验机制造；试验机销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
主营业务	电子制造服务、检测硬件生产、研发及销售		
项目（单位：万元）	**2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月**	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	
总资产	**17,715.28**	12,965.31	
净资产	**1,891.14**	2,547.87	
营业收入	**3,647.14**	4,874.12	
净利润	**-673.63**	-1,544.87	
审计情况	经天健会计师审计		

11、上海季丰计量有限公司

成立时间	2022 年 6 月 14 日	注册资本	1,000 万元
注册地址	浦东新区顾唐路 1688 号、金唐路 189 号 4 幢 A 区 1-2 层	实收资本	1,000 万元
主要生产经营地	浦东新区顾唐路 1688 号、金唐路 189 号 4 幢 A 区 1-2 层	股权结构	公司持股 100%
经营范围	一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备租赁；集成电路芯片设计及服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主营业务	计量校准服务业务、化学分析业务		
项目（单位：万元）	**2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月**		2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	**5,905.51**		5,668.16
净资产	**931.78**		947.95
营业收入	**786.71**		1,398.29
净利润	**-19.25**		-87.46
审计情况	经天健会计师审计		

12、成都季丰检测技术有限公司

成立时间	2022 年 6 月 22 日	注册资本	1,000 万元
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道集萃街 619 号天府海创园 2-2 号楼 2 层	实收资本	1,000 万元
主要生产经营地	中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道集萃街 619 号天府海创园 2-2 号楼 2 层	股权结构	公司持股 100%
经营范围	许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主营业务	第三方实验室检测分析业务		
项目（单位：万元）	**2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月**		2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	**2,816.11**		2,760.59
净资产	**1,716.54**		1,503.91

营业收入	**1,015.83**	1,898.24
净利润	**209.69**	321.87
审计情况	经天健会计师审计	

13、上海季丰技术有限公司

成立时间	2024 年 1 月 24 日	注册资本	10,000 万元
注册地址	上海市浦东新区沪南路 2218 号西楼 18 层	实收资本	10,000 万元
主要生产经营地	上海市浦东新区沪南路 2218 号西楼 18 层	股权结构	公司持股 100%
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；**货物进出口；技术进出口。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。**自主展示（特色）项目：计量技术服务。**		
主营业务	第三方实验室检测分析业务及量产测试业务		
项目（单位：万元）	**2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月**		2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	**17,405.30**		11,171.76
净资产	**9,537.28**		9,567.83
营业收入	**511.72**		863.80
净利润	**-30.56**		-365.68
审计情况	经天健会计师审计		

14、北京亦庄季峰检测技术有限公司

成立时间	2024 年 6 月 12 日	注册资本	3,000 万元
注册地址	北京市北京经济技术开发区地盛东路 1 号院 2 幢 1 层 101	实收资本	3,000 万元
主要生产经营地	北京市北京经济技术开发区地盛东路 1 号院 2 幢 1 层 101	股权结构	公司持股 100%
经营范围	许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
主营业务	第三方实验室检测分析业务		
项目（单位：万元）	**2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月**		2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	**14,684.32**		11,861.77

净资产	**9,930.80**	7,841.41
营业收入	**4,598.87**	9,014.41
净利润	**2,089.39**	3,923.26
审计情况	经天健会计师审计	

（二）参股公司

截至本招股说明书签署日，公司参股企业的简要情况如下：

单位：万元

序号	名称	主要股东	持股比例	出资金额	入股时间	控股方/执行事务合伙人	主要业务
1	普铄电子	鹿时领持股 50%；PROBELOGIC,INC 持股 30%	10%	80	2015.03	鹿时领	半导体测试探针卡的加工、组装及销售
2	君丰桐芯	卢凤仙持股 46.25%；季丰电子持股 9.25%；王坤持股 9.25%	9.25%	1,000	2021.06	上海君泺企业管理合伙企业（有限合伙）	投资与资产管理
3	四川数智	四川振兴新兴产业投资有限公司持股 30%；四川天府产投投资有限公司持股 21%；深圳市亚凯斯科技有限公司持股 16%；	13%	1,300	2024.09	四川产业振兴基金投资集团有限公司	传感器检验检测服务
4	上海元禾	上海未来启点私募投资基金合伙企业（有限合伙）持股 30%；上海闵行金融投资发展有限公司持股 14.34%；苏州元禾控股股份有限公司持股 12.30%；南通市交大未来产业投资基金中心（有限合伙）持股 10.93%	2.73%	1,000	2026.02	上海天集芯企业管理合伙企业（有限合伙）	投资与资产管理

七、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况

（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人基本情况

截至本招股说明书签署日，公司股权较分散，公司第一大股东为郑朝晖先生，其直接持有公司 1,838.5070 万股股份，占公司股份总数的 15.91%，公司不存在控股股东。

郑朝晖为公司创始人并任公司董事长、总经理，直接持有公司 15.91%股权，同时其作为季铭源、江山季兴、上海季双的执行事务合伙人控制公司 13.24%表决权；郑琦君系郑朝晖之妹，在公司任职多年，现任公司证券部总监，直接持有公司 5.94%股权。

同时，郑朝晖、郑琦君、陈洋森、李定学四人签署了《一致行动协议》及补充协议，确认自 2022 年 12 月起至公司首发上市后 36 个月，各方实际在公司的决策及经营管理的重大事项采取一致行动，陈洋森及李定学在公司股东大会和董事会会议（如均为董事会成员）中行使表决权时，应当与郑朝晖达成一致意见；如无法达成一致意见，则以郑朝晖意见为准。因此郑朝晖通过与陈洋森、李定学的一致行动关系控制公司 1.30%表决权。

综上，郑朝晖、郑琦君兄妹系公司的实际控制人，二人合计控制公司 36.38%的表决权，共同对公司股东（大）会及公司日常经营管理实施重大影响和实际控制。

1、郑朝晖

郑朝晖先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，住址为上海市浦东新区******，证件号码为 3101121973********。1998 年 3 月至 2004 年 9 月任上海贝岭（600171.SH）测试工程经理；2004 年 9 月至 2004 年 12 月，任晶晨股份（688099.SH）运营经理；2004 年 12 月至 2011 年 5 月，任创锐讯通讯技术（上海）有限公司[1]运营总监；2011 年 5 月至 2017 年 3 月，任高通企业管理（上海）有限公司工程总监；2017 年 3 月至 2018 年 3 月，任芯导科技（688230.SH）工程及质量副总经理；2018 年 3 月至今，历任公司执行董事长、董事长、总经理；现任公司董事长、总经理。

2、郑琦君

郑琦君女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，住址为上海市浦东新区******，证件号码为 3308231976********。1999 年 12 月至 2018 年 9 月，先后在江山市相关乡镇人民政府、江山市林业局任科员； 2018 年 10 月至今，历任公司董事会秘书、行政总监、总经理助理、证券部总监；现任

[1] 该公司 2011 年时被高通收购，并更名为高通企业管理（上海）有限公司。

公司证券部总监。

3、陈洋森

陈洋森先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，住址为浙江省江山市市区*******，证件号码为 3308231968*******。1987 年 8 月至 1996 年 9 月，任浙江省江山市林业局下属林业派出所所长、检查站站长；1996 年 12 月至 1998 年 7 月，任浙江省江山市林业总场场长；1997 年 9 月至今，任江山市绿业有限公司董事长；2015 年 3 月至 2018 年 12 月，历任公司执行董事、董事长。陈洋森现未担任公司职务。

4、李定学

李定学先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，住址为上海市杨浦区*******，证件号码为 5102281972*******。1995 年 7 月至 1998 年 1 月，任上海航天局第八设计部助理工程师；1998 年 1 月至 2001 年 11 月，历任德律科技股份有限公司及其子公司技术支持、销售工程师、销售经理；2001 年 12 月至 2004 年 8 月，历任蔚华科技股份有限公司及其子公司销售经理；2004 年 9 月至 2014 年 8 月，任泰瑞达（上海）有限公司销售经理；2014 年 9 月至今，历任公司财务总监、董事、副总经理；现任公司副总经理。

5、季铭源

截至本招股说明书签署日，季铭源持有公司 8.05%股份，基本情况如下：

项目	基本情况
季铭源	上海季铭源企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310115332340095W
类型	有限合伙企业
成立日期	2015 年 3 月 9 日
出资额	129.717 万元
执行事务合伙人	郑朝晖
注册地址	上海市闵行区友东路 258-288 号 1 幢 101 室
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；品牌管理；专业设计服务；企业形象策划；社会经济咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

项目	基本情况
主营业务及其与发行人主营业务的关系	持股平台，无实际经营业务，与发行人不存在同业竞争或上下游关系。

季铭源的合伙人构成及出资比例如下：

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	郑朝晖	普通合伙人	**8.5905**	**6.62**
2	刘自力	有限合伙人	20.0763	15.48
3	倪卫华	有限合伙人	17.985	13.86
4	朱勇	有限合伙人	17.009	13.11
5	王仲晰	有限合伙人	13.3842	10.32
6	高强	有限合伙人	11.2929	8.71
7	李定学	有限合伙人	9.7593	7.52
8	季春葵	有限合伙人	6.2737	4.84
9	毛余喜	有限合伙人	4.6008	3.55
10	江磊	有限合伙人	4.1826	3.22
11	张战祥	有限合伙人	3.7646	2.90
12	陶雪芬	有限合伙人	3.0672	2.36
13	郑琦君	有限合伙人	2.5095	1.93
14	王先君	有限合伙人	2.0913	1.61
15	邱旸	有限合伙人	0.6274	0.48
16	李美惠	有限合伙人	0.4182	0.32
17	邵疆	有限合伙人	0.3346	0.26
18	李广辉	有限合伙人	0.3346	0.26
19	王绍亮	有限合伙人	0.2788	0.21
20	朱明辉	有限合伙人	0.2788	0.21
21	杨亭	有限合伙人	0.2788	0.21
22	王麒	有限合伙人	0.2788	0.21
23	卢健	有限合伙人	0.2788	0.21
24	李毅峰	有限合伙人	0.2788	0.21
25	朱晨	有限合伙人	0.1394	0.11
26	范小涛	有限合伙人	0.1394	0.11
27	于超楠	有限合伙人	0.1394	0.11
28	冯恒超	有限合伙人	0.1394	0.11
29	周丽	有限合伙人	0.1394	0.11

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
30	张艳霖	有限合伙人	0.1394	0.11
31	张李鑫	有限合伙人	0.1394	0.11
32	徐石磊	有限合伙人	0.1394	0.11
33	王猛	有限合伙人	0.1394	0.11
34	刘思佳	有限合伙人	0.1394	0.11
35	李永鹏	有限合伙人	0.1394	0.11
36	姜荣	有限合伙人	0.1394	0.11
37	吴静	有限合伙人	0.0697	0.05
合计			**129.7170**	**100.00**

6、江山季兴

截至本招股说明书签署日，江山季兴持有公司 3.24%股份，基本情况如下：

项目	基本情况
名称	江山季兴企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330881MA7BN54N2L
类型	有限合伙企业
成立日期	2021 年 10 月 22 日
出资额	1,312.5 万元
执行事务合伙人	郑朝晖
注册地址	浙江省衢州市江山市双塔街道文教西路 15 号 501 室（自主申报）
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务及其与发行人主营业务的关系	持股平台，无实际经营业务，与发行人不存在同业竞争或上下游关系。

江山季兴的合伙人构成及出资比例如下：

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	郑朝晖	普通合伙人	336.00	25.60
2	邵文宗	有限合伙人	203.00	15.47
3	杨小明	有限合伙人	94.50	7.20
4	郑建忠	有限合伙人	63.00	4.80
5	肖遵保	有限合伙人	52.50	4.00
6	毛富强	有限合伙人	52.50	4.00
7	刘威龙	有限合伙人	31.50	2.40

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
8	王秀军	有限合伙人	31.50	2.40
9	黄晓江	有限合伙人	31.50	2.40
10	邱旸	有限合伙人	26.25	2.00
11	戴剑俊	有限合伙人	21.00	1.60
12	吴嘉杰	有限合伙人	21.00	1.60
13	王仁洲	有限合伙人	21.00	1.60
14	李晓龙	有限合伙人	21.00	1.60
15	周天飞	有限合伙人	21.00	1.60
16	程勇	有限合伙人	17.50	1.33
17	陈小康	有限合伙人	10.50	0.80
18	伍艳华	有限合伙人	10.50	0.80
19	郑翠华	有限合伙人	10.50	0.80
20	沈伟	有限合伙人	10.50	0.80
21	张云斌	有限合伙人	10.50	0.80
22	娄相春	有限合伙人	10.50	0.80
23	尹玉洁	有限合伙人	10.50	0.80
24	郑澳麒	有限合伙人	10.50	0.80
25	李红宇	有限合伙人	10.50	0.80
26	顾磊	有限合伙人	10.50	0.80
27	徐樊毅	有限合伙人	10.50	0.80
28	范建玉	有限合伙人	10.50	0.80
29	高枫	有限合伙人	10.50	0.80
30	李海飞	有限合伙人	10.50	0.80
31	王瑞芳	有限合伙人	10.50	0.80
32	郑轶璐	有限合伙人	10.50	0.80
33	冯中	有限合伙人	10.50	0.80
34	赵晶	有限合伙人	7.00	0.53
35	沈红萍	有限合伙人	7.00	0.53
36	陈忠	有限合伙人	7.00	0.53
37	程扬名	有限合伙人	7.00	0.53
38	眭辉	有限合伙人	7.00	0.53
39	谢蓉	有限合伙人	5.25	0.40
40	高娜娜	有限合伙人	5.25	0.40

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
41	庄由	有限合伙人	5.25	0.40
42	陶喆人	有限合伙人	5.25	0.40
43	张林君	有限合伙人	5.25	0.40
44	赵晨	有限合伙人	5.25	0.40
45	闫亮	有限合伙人	5.25	0.40
46	刘斌辉	有限合伙人	3.50	0.27
47	汪海潮	有限合伙人	3.50	0.27
48	伏思远	有限合伙人	3.50	0.27
49	庄志翔	有限合伙人	3.50	0.27
50	王伟	有限合伙人	3.50	0.27
合计			**1,312.50**	**100.00**

7、上海季双

截至本招股说明书签署日，上海季双持有公司 1.95%股份，基本情况如下：

项目	基本情况
名称	上海季双企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330881MA7BN5JG0P
类型	有限合伙企业
成立日期	2021 年 10 月 22 日
出资额	787.5 万元
执行事务合伙人	郑朝晖
注册地址	上海市浦东新区沪南路 2218 号西楼 18 层
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务及其与发行人主营业务的关系	持股平台，无实际经营业务，与发行人不存在同业竞争或上下游关系。

上海季双的合伙人构成及出资比例如下：

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	郑朝晖	普通合伙人	**32.90**	**4.18**
2	丁兆达	有限合伙人	126.00	16.00
3	庄振宏	有限合伙人	101.50	12.89
4	曹静波	有限合伙人	63.00	8.00
5	陈参参	有限合伙人	31.50	4.00

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
6	何桂港	有限合伙人	31.50	4.00
7	李占业	有限合伙人	26.25	3.33
8	邵疆	有限合伙人	21.00	2.67
9	陈胜兰	有限合伙人	21.00	2.67
10	钱焕	有限合伙人	21.00	2.67
11	魏垂亚	有限合伙人	21.00	2.67
12	顾耀	有限合伙人	14.00	1.78
13	李硕	有限合伙人	10.50	1.33
14	海淼	有限合伙人	10.50	1.33
15	周文中	有限合伙人	10.50	1.33
16	刘朝喜	有限合伙人	10.50	1.33
17	祝宇怀	有限合伙人	10.50	1.33
18	曾路俊	有限合伙人	10.50	1.33
19	毛周俊	有限合伙人	10.50	1.33
20	李广辉	有限合伙人	10.50	1.33
21	刘维	有限合伙人	10.50	1.33
22	宋晶晶	有限合伙人	10.50	1.33
23	李彤	有限合伙人	10.50	1.33
24	杨恒	有限合伙人	10.50	1.33
25	郑文杰	有限合伙人	10.50	1.33
26	蔡清	有限合伙人	10.50	1.33
27	廖淼	有限合伙人	10.50	1.33
28	李星	有限合伙人	10.50	1.33
29	黄炜锋	有限合伙人	10.50	1.33
30	卢俊安	有限合伙人	10.50	1.33
31	龚敏雪	有限合伙人	8.40	1.07
32	丁邦国	有限合伙人	7.00	0.89
33	张正昌	有限合伙人	7.00	0.89
34	刘兆山	有限合伙人	7.00	0.89
35	李娜	有限合伙人	7.00	0.89
36	李鸿	有限合伙人	7.00	0.89
37	彭赛	有限合伙人	7.00	0.89
38	何梦雅	有限合伙人	7.00	0.89

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
39	王庆兵	有限合伙人	5.25	0.67
40	卞国荣	有限合伙人	5.25	0.67
41	张启	有限合伙人	5.25	0.67
42	胡斌	有限合伙人	5.25	0.67
43	陶颖龚	有限合伙人	5.25	0.67
44	肖亮	有限合伙人	4.20	0.53
合计			**787.50**	**100.00**

（二）其他持有公司 5%以上股份的主要股东基本情况

名称	持股比例（%）	关联关系
嘉善芯创	7.47	均为上海君桐股权投资管理有限公司控制的私募基金，合计持有公司 5%以上股份
嘉兴君源	1.30	
南通中皋	1.17	
嘉兴君晋	0.42	

1、嘉善芯创

项目	基本情况
企业名称	嘉善芯创壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2020 年 5 月 13 日
认缴出资额	100,000 万元
执行事务合伙人	上海君桐股权投资管理有限公司
注册地及主要生产经营地	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇复兴大道 16 号 2 幢 113 室
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务及其与发行人主营业务的关系	股权投资，与发行人不存在同业竞争或上下游关系。

截至本招股说明书签署日，嘉善芯创的合伙人构成及出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海君桐股权投资管理有限公司	普通合伙人	10,000.00	10.00
2	嘉善县金融投资有限公司	有限合伙人	90,000.00	90.00
合计			**100,000.00**	**100.00**

嘉善芯创为在中国证券投资基金业协会完成备案的私募股权投资基金，基金

编号为 SLC358，备案日期为 2020 年 6 月 1 日。嘉善芯创的基金管理人上海君桐股权投资管理有限公司系在中国证券投资基金业协会登记的私募投资基金管理人，登记编号为 P1021028，登记日期为 2015 年 8 月 20 日。

2、嘉兴君源

项目	基本情况
企业名称	嘉兴君源股权投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2022 年 8 月 1 日
认缴出资额	3,400 万元
执行事务合伙人	上海君泺企业管理合伙企业（有限合伙）
注册地及主要生产经营地	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 187 室-55（自主申报）
经营范围	一般项目：股权投资；实业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务及其与发行人主营业务的关系	股权投资，与发行人不存在同业竞争或上下游关系。

截至本招股说明书签署日，嘉兴君源的合伙人构成及出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海君泺企业管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	100.00	2.94
2	盐城东投科技创新投资管理有限公司	有限合伙人	2,000.00	58.82
3	嘉兴晋同智产股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	29.41
4	朱翠平	有限合伙人	300.00	8.82
合计			**3,400.00**	**100.00**

嘉兴君源为在中国证券投资基金业协会完成备案的私募股权投资基金，基金编号为 SXT264，备案日期为 2022 年 11 月 22 日。嘉兴君源的基金管理人上海君桐股权投资管理有限公司系在中国证券投资基金业协会登记的私募投资基金管理人，登记编号为 P1021028，登记日期为 2015 年 8 月 20 日。

3、南通中皋

项目	基本情况
企业名称	南通中皋君桐新兴产业投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业

项目	基本情况
成立日期	2021 年 11 月 15 日
认缴出资额	10,000 万元
执行事务合伙人	上海君泺企业管理合伙企业（有限合伙）
注册地及主要生产经营地	如皋市城南街道幸福河西路 9 号 15 幢
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务及其与发行人主营业务的关系	股权投资，与发行人不存在同业竞争或上下游关系。

截至本招股说明书签署日，南通中皋的合伙人构成及出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海君泺企业管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	100.00	1.00
2	如皋市科创投资集团有限公司	有限合伙人	9,900.00	99.00
合计			**10,000.00**	**100.00**

南通中皋为在中国证券投资基金业协会完成备案的私募股权投资基金，基金编号为 STG672，备案日期为 2021 年 11 月 29 日。南通中皋的基金管理人上海君桐股权投资管理有限公司系在中国证券投资基金业协会登记的私募投资基金管理人，登记编号为 P1021028，登记日期为 2015 年 8 月 20 日。

4、嘉兴君晋

项目	基本情况
企业名称	嘉兴君晋股权投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2021 年 8 月 5 日
认缴出资额	11,650 万元
执行事务合伙人	上海君桐股权投资管理有限公司
注册地及主要生产经营地	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 173 室-55
经营范围	一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主营业务及其与发行人主营业务的关系	股权投资，与发行人不存在同业竞争或上下游关系。

截至本招股说明书签署日，嘉兴君晋的合伙人构成及出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海君桐股权投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.86
2	共青城永昌盛贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	42.92
3	山西晋阳常茂股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,000.00	34.33
4	光彩芯辰（浙江）科技有限公司	有限合伙人	1,000.00	8.58
5	上海君禺商务信息咨询有限公司	有限合伙人	900.00	7.73
6	张大磊	有限合伙人	550.00	4.72
7	深圳晋阳股权投资管理有限公司	有限合伙人	100.00	0.86
合计			**11,650.00**	**100.00**

嘉兴君晋为在中国证券投资基金业协会完成备案的私募股权投资基金，基金编号为 SSJ179，备案日期为 2021 年 11 月 25 日。嘉兴君晋的基金管理人上海君桐股权投资管理有限公司系在中国证券投资基金业协会登记的私募投资基金管理人，登记编号为 P1021028，登记日期为 2015 年 8 月 20 日。

（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业

公司实际控制人郑朝晖、郑琦君控制的其他企业为季铭源、江山季兴、上海季双、上海琦晖。

季铭源、江山季兴、上海季双的具体情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人基本情况”；上海琦晖曾持有公司的股份，但在 2026 年 3 月已经全部转出，截至本招股说明书签署日，上海琦晖的基本情况如下：

项目	基本情况
名称	上海琦晖企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310112MAC1HHBQ16
类型	有限合伙企业
成立日期	2022 年 10 月 24 日
出资额	300 万元
执行事务合伙人	郑朝晖

项目	基本情况
注册地址	上海市闵行区莘松路 380 号 5、6 楼
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	持股平台，无实际经营业务

上海琦晖的合伙人构成及出资比例如下：

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	郑朝晖	219.65	73.22	普通合伙人
2	郑琦君	80.35	26.78	有限合伙人
合计		**300.00**	**100.00**	-

（四）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份的质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在控股股东，公司实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况。

八、公司特别表决权或类似安排情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权或类似安排情况。

九、公司协议控制架构

截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构。

十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪或重大违法行为

报告期内，公司不存在控股股东，公司实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

十一、发行人股本情况

（一）本次发行前后公司股本情况

本次发行前，公司总股本 11,558.60 万股。本次拟发行新股 3,852.87 万股，

不涉及原股东公开发售股份。本次发行的股份不低于发行后公司总股本的 25%。本次发行股份前后股本变动情况如下：

序号	姓名/名称	发行前		发行后	
		持股数（万股）	持股比例（%）	持股数（万股）	持股比例（%）
1	郑朝晖	1,838.5070	15.91	1,838.5070	11.93
2	季铭源	930.4140	8.05	930.4140	6.04
3	嘉善芯创	863.5500	7.47	863.5500	5.60
4	郑琦君	686.0824	5.94	686.0824	4.45
5	柴春波	490.2900	4.24	490.2900	3.18
6	苏州元禾	435.5000	3.77	435.5000	2.83
7	财通创新	390.0000	3.37	390.0000	2.53
8	江山季兴	375.0000	3.24	375.0000	2.43
9	福州嘉衍	375.0000	3.24	375.0000	2.43
10	郑建生	373.7400	3.23	373.7400	2.43
11	俱成秋实	300.0000	2.60	300.0000	1.95
12	沪电股份	300.0000	2.60	300.0000	1.95
13	芜湖聚源	246.6210	2.13	246.6210	1.60
14	渝富益华	233.3178	2.02	233.3178	1.51
15	江阴瀚联	225.8271	1.95	225.8271	1.47
16	上海季双	225.0000	1.95	225.0000	1.46
17	谢丽	225.0000	1.95	225.0000	1.46
18	尚成一号	209.2739	1.81	209.2739	1.36
19	芜湖信芯	173.3790	1.50	173.3790	1.13
20	厦门同瑔	163.0000	1.41	163.0000	1.06
21	嘉兴君源	150.6078	1.30	150.6078	0.98
22	陈洋森	150.0066	1.30	150.0066	0.97
23	俱成秋实贰号	150.0000	1.30	150.0000	0.97
24	绍兴绿杉	150.0000	1.30	150.0000	0.97
25	共青城创丰	148.9762	1.29	148.9762	0.97
26	畅享季	147.5000	1.28	147.5000	0.96
27	大零号湾	147.5000	1.28	147.5000	0.96
28	南通中皋	135.0000	1.17	135.0000	0.88
29	徐莺	120.0000	1.04	120.0000	0.78

序号	姓名/名称	发行前		发行后	
		持股数（万股）	持股比例（%）	持股数（万股）	持股比例（%）
30	苏州清石	119.2000	1.03	119.2000	0.77
31	新锐克胜	110.0000	0.95	110.0000	0.71
32	春山锐卓	105.0000	0.91	105.0000	0.68
33	交大小苗	101.0000	0.87	101.0000	0.66
34	湖州创投	93.3271	0.81	93.3271	0.61
35	天津合泰	84.0000	0.73	84.0000	0.55
36	衢州金藤	83.0000	0.72	83.0000	0.54
37	思瑞浦	79.4100	0.69	79.4100	0.52
38	衢州绿发	73.0238	0.63	73.0238	0.47
39	普冉股份	63.0000	0.55	63.0000	0.41
40	渝兴益华贰号	50.2000	0.43	50.2000	0.33
41	嘉兴君晋	48.1463	0.42	48.1463	0.31
42	商络电子	42.0000	0.36	42.0000	0.27
43	成都励石	42.0000	0.36	42.0000	0.27
44	曾劲涛	38.1000	0.33	38.1000	0.25
45	上海丽平	33.6000	0.29	33.6000	0.22
46	张群仙	30.0000	0.26	30.0000	0.19
47	张军	4.5000	0.04	4.5000	0.03
48	本次发行股份	/	/	3,852.8667	25.00
合计		**11,558.60**	**100.00**	**15,411.4667**	**100.00**

（二）本次发行前公司前十名股东持股情况

截至本招股说明书签署日，公司股本总数为 11,558.60 万股，其中前 10 名股东情况如下表所示：

序号	姓名/名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	郑朝晖	1,838.5070	15.91
2	季铭源	930.4140	8.05
3	嘉善芯创	863.5500	7.47
4	郑琦君	686.0824	5.94
5	柴春波	490.2900	4.24
6	苏州元禾	435.5000	3.77

序号	姓名/名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
7	财通创新	390.0000	3.37
8	江山季兴	375.0000	3.24
9	福州嘉衍	375.0000	3.24
10	郑建生	373.7400	3.23
合计		**6,758.0834**	**58.47**

（三）本次发行前公司前十名自然人股东及其在公司担任的职务

序号	姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	担任职务
1	郑朝晖	1,838.5070	15.91	董事长、总经理
2	郑琦君	686.0824	5.94	证券部总监
3	柴春波	490.2900	4.24	未在公司任职
4	郑建生	373.7400	3.23	未在公司任职
5	谢丽	225.0000	1.95	未在公司任职
6	陈洋森	150.0066	1.30	未在公司任职
7	徐莺	120.0000	1.04	未在公司任职
8	曾劲涛	38.1000	0.33	未在公司任职
9	张群仙	30.0000	0.26	未在公司任职
10	张军	4.5000	0.04	未在公司任职
合计		**3,956.2260**	**34.23**	-

（四）发行人股本中涉及国有股份或外资股份的情况

截至本招股说明书签署日，财通创新持有发行人 390 万股股份，持股比例为 3.37%。根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会令第 36 号）的规定，财通创新属于“不符合本办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业”，证券账户应标注为“CS”。根据财通创新出具的《财通创新关于国有股东标识问题的说明》，财通创新的证券账户已经在中国证券登记结算有限责任公司标注为“CS”。

截至本招股说明书签署日，郑建生持有发行人 373.74 万股股份，持股比例为 3.23%，其持股情况符合《中华人民共和国外商投资法》的相关规定。

除上述情况外，公司股本中不涉及国有股份或外资股份的情况。

（五）最近一年发行人新增股东的持股数量及相关情况

1、新增股东持股数量

序号	姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	取得方式
1	芜湖聚源	246.6210	2.13	受让
2	江阴瀚联	225.8271	1.95	受让
3	厦门同琅	163.0000	1.41	受让
4	共青城创丰	148.9762	1.29	受让
5	畅享季	147.5000	1.28	受让
6	大零号湾	147.5000	1.28	受让
7	苏州清石	119.2000	1.03	受让
8	新锐克胜	110.0000	0.95	受让
9	交大小苗	101.0000	0.87	受让
10	渝兴益华贰号	50.2000	0.43	受让
11	曾劲涛	38.1000	0.33	受让
12	张军	4.5000	0.04	受让

2、新增股东基本情况

（1）芜湖聚源

项目	基本情况
企业名称	芜湖聚源芯达股权投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2025 年 5 月 8 日
认缴出资额	100,200 万元
执行事务合伙人	信达资本管理有限公司 苏州聚源炘芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
注册地及主要生产经营地	安徽省芜湖市镜湖区范罗山街道长江中路 92 号雨耕山文化创意产业园内思楼 3F 309-76（一址多照）
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主营业务	股权投资

截至本招股说明书签署日，其合伙人构成及出资比例如下：

序号	名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	信达资本管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.10
2	苏州聚源炘芯企业管理咨	普通合伙人	100.00	0.10

序号	名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
	询合伙企业（有限合伙）			
3	中国信达资产管理股份有限公司	有限合伙人	90,000.00	89.82
4	中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司	有限合伙人	10,000.00	9.98
合计			**100,200.00**	**100.00**

（2）江阴瀚联

项目	基本情况
企业名称	江阴瀚联智芯股权投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2021 年 11 月 30 日
认缴出资额	67,676.7677 万元
执行事务合伙人	江阴联融企业服务合伙企业（有限合伙）（委派代表：宁旻）
注册地及主要生产经营地	江阴市中山南路 79 号 B 座三楼 313 室
经营范围	一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	股权投资

截至本招股说明书签署日，其合伙人构成及出资比例如下：

序号	名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	江阴联融企业服务合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	676.77	1.00
2	江阴市政府投资基金(有限合伙）	有限合伙人	20,000.00	29.55
3	上海富瀚微电子股份有限公司	有限合伙人	13,000.00	19.21
4	中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）	有限合伙人	12,000.00	17.73
5	北京联博企慧企业管理有限公司	有限合伙人	10,000.00	14.78
6	深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）	有限合伙人	7,000.00	10.34
7	无锡产发创业投资中心(有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	7.39
合计			**67,676.7677**	**100.00**

（3）厦门同琅

项目	基本情况
企业名称	厦门同琅接续创业投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2025 年 12 月 4 日
认缴出资额	5,010 万元
执行事务合伙人	上海北科创星际私募基金管理合伙企业（有限合伙）
注册地及主要生产经营地	厦门市同安区云谷路 36 号 502 室之五十二单元
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主营业务	股权投资

截至本招股说明书签署日，厦门同琅的合伙人构成及出资比例如下：

序号	名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海北科创星际私募基金管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	10.00	0.20
2	苏州博琅昕曜创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,500.00	49.90
3	嘉兴联琅接力创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,500.00	49.90
合计			**5,010.00**	**100.00**

（4）共青城创丰

项目	基本情况
企业名称	共青城创丰投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2025 年 12 月 23 日
认缴出资额	3,071.23 万元
执行事务合伙人	上海惟颐**企业**管理有限公司（委派代表：黄淼）
注册地及主要生产经营地	江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	股权投资

截至本招股说明书签署日，其合伙人构成及出资比例如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海惟颐投资管理有限公	普通合伙人	1.00	0.03

	司			
2	无锡滨湖南钢星博创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,945.23	95.90
3	贝壳股权投资（常州）有限公司	有限合伙人	105.00	3.42
4	黄睿	有限合伙人	20.00	0.65
合计			**3,071.23**	**100.00**

（5）畅享季

项目	基本情况
企业名称	上海畅享季企业管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2025 年 11 月 5 日
认缴出资额	2,678.6 万元
执行事务合伙人	邱旸
注册地及主要生产经营地	上海市浦东新区沪南路 2218 号西楼 18 层
经营范围	一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：企业管理咨询。
主营业务	股权投资

截至本招股说明书签署日，其合伙人构成及出资比例如下：

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	邱旸	普通合伙人	217.92	8.14
2	郑澳麒	有限合伙人	263.32	9.83
3	彭赛	有限合伙人	118.04	4.41
4	顾耀	有限合伙人	118.04	4.41
5	丁兆达	有限合伙人	99.88	3.73
6	杨小明	有限合伙人	90.80	3.39
7	邵文宗	有限合伙人	90.80	3.39
8	冯中	有限合伙人	90.80	3.39
9	王先君	有限合伙人	90.80	3.39
10	王秀军	有限合伙人	72.64	2.71
11	倪卫华	有限合伙人	54.48	2.03
12	朱勇	有限合伙人	54.48	2.03
13	毛富强	有限合伙人	54.48	2.03

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
14	张战祥	有限合伙人	54.48	2.03
15	陈参参	有限合伙人	54.48	2.03
16	周文中	有限合伙人	54.48	2.03
17	赵晶	有限合伙人	54.48	2.03
18	程勇	有限合伙人	54.48	2.03
19	宋扬	有限合伙人	54.48	2.03
20	李鸿	有限合伙人	54.48	2.03
21	董立超	有限合伙人	54.48	2.03
22	仁益敏	有限合伙人	54.48	2.03
23	李美惠	有限合伙人	54.48	2.03
24	贾菊	有限合伙人	54.48	2.03
25	石宏良	有限合伙人	54.48	2.03
26	顾磊	有限合伙人	45.40	1.69
27	沈红萍	有限合伙人	36.32	1.36
28	李占业	有限合伙人	36.32	1.36
29	刘锦沛	有限合伙人	36.32	1.36
30	吴晗宇	有限合伙人	36.32	1.36
31	刘浩	有限合伙人	36.32	1.36
32	黄国建	有限合伙人	36.32	1.36
33	肖亮	有限合伙人	36.32	1.36
34	李星	有限合伙人	27.24	1.02
35	廖淼	有限合伙人	27.24	1.02
36	毛余喜	有限合伙人	18.16	0.68
37	眭辉	有限合伙人	18.16	0.68
38	张林君	有限合伙人	18.16	0.68
39	钱焕	有限合伙人	18.16	0.68
40	高峰	有限合伙人	18.16	0.68
41	李娜	有限合伙人	18.16	0.68
42	王绍亮	有限合伙人	18.16	0.68
43	张正昌	有限合伙人	18.16	0.68
44	朱晨	有限合伙人	18.16	0.68
45	张昊淼	有限合伙人	18.16	0.68
46	赵苗羽	有限合伙人	18.16	0.68

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
47	刘祥	有限合伙人	18.16	0.68
48	刘华凯	有限合伙人	18.16	0.68
49	陆燕	有限合伙人	18.16	0.68
合计			**2,678.60**	**100.00**

（6）大零号湾

项目	基本情况
企业名称	上海大零号湾策源二号创业投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2025 年 1 月 22 日
认缴出资额	30,100 万元
执行事务合伙人	上海大零号湾私募基金管理有限公司（委派代表：马伟明）
注册地及主要生产经营地	上海市闵行区剑川路 940 号 B 幢 3 层
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	股权投资

截至本招股说明书签署日，其合伙人构成及出资比例如下：

序号	名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海大零号湾私募基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.33
2	上海闵行金融投资发展有限公司	有限合伙人	20,000.00	66.45
3	上海浦尚实业有限公司	有限合伙人	1,000.00	3.32
4	上海马桥实业发展有限公司	有限合伙人	1,000.00	3.32
5	**上海虹桥镇商务发展有限公司**	有限合伙人	1,000.00	3.32
6	上海颛溪企业管理有限公司	有限合伙人	1,000.00	3.32
7	上海吴泾科技园管理发展有限公司	有限合伙人	1,000.00	3.32
8	上海莘驰资产经营有限公司	有限合伙人	1,000.00	3.32
9	上海梅陇经济发展有限公司	有限合伙人	1,000.00	3.32
10	上海七宝蒲溪建设发展有限公司	有限合伙人	1,000.00	3.32
11	上海华漕前湾科技发展有限公司	有限合伙人	1,000.00	3.32

序号	名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
12	上海市莘庄工业区投资管理有限公司	有限合伙人	1,000.00	3.32
合计			**30,100.00**	**100.00**

（7）苏州清石

项目	基本情况
企业名称	苏州清石泽众创业投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2025 年 11 月 14 日
认缴出资额	2,466 万元
执行事务合伙人	清石资产管理（上海）有限公司（委派代表：田雨）
注册地及主要生产经营地	苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）迎宾大道 333 号苏州湾东方创投基地 29 号楼
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	股权投资

截至本招股说明书签署日，其合伙人构成及出资比例如下：

序号	名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	清石资产管理（上海）有限公司	普通合伙人	66.00	2.68
2	苏州清石恒沣创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	40.55
3	南通清石嘉丽创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	700.00	28.39
4	苏州清石博源股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	700.00	28.39
合计			**2,466.00**	**100.00**

（8）新锐克胜

项目	基本情况
企业名称	北京新锐克胜科技发展有限公司
类型	有限责任公司
成立日期	2005 年 4 月 27 日
注册资本	503.6 万元
法定代表人	王萍
注册地及主要生产经营地	北京市北京经济技术开发区**荣京东街 3 号 1 幢 27 层 1 单元 2513**

项目	基本情况
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；半导体器件专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；软件开发；普通机械设备安装服务；机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；**劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务	泛半导体（半导体、显示面板等）领域备件销售和系统性服务

截至本招股说明书签署日，其股权结构情况如下：

序号	姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王萍	352.52	70.00
2	北京新方舟企业管理中心（有限合伙）	151.08	30.00
合计		**503.60**	**100.00**

（9）交大小苗

项目	基本情况
企业名称	南通市交大未来小苗创业投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2023 年 6 月 25 日
认缴出资额	25,000 万元
执行事务合伙人	上海小苗朗程投资管理有限公司（委派代表：梁剑明）
注册地及主要生产经营地	江苏省南通市开发区崇州大道 60 号紫琅科技城 6 号楼 12 层
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	股权投资

截至本招股说明书签署日，其合伙人构成及出资比例如下：

序号	姓名/名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海小苗朗程投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.40
2	上海紫竹高新小苗创业投资有限公司	有限合伙人	4,900.00	19.60
3	南通市交大未来产业投资基金中心（有限合伙）	有限合伙人	4,000.00	16.00
4	上海柏甯企业管理有限公司	有限合伙人	4,000.00	16.00
5	启东经开厚望产业投资基金合伙企业	有限合伙人	2,000.00	8.00

序号	姓名/名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
	（有限合伙）			
6	湖州南浔浔合股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,000.00	8.00
7	嘉兴南湖容迈创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,000.00	8.00
8	李彧	有限合伙人	1,200.00	4.80
9	天创商汇（海南）投资有限公司	有限合伙人	1,000.00	4.00
10	周韵	有限合伙人	1,000.00	4.00
11	上海尚理投资有限公司	有限合伙人	1,000.00	4.00
12	上海马达投资有限公司	有限合伙人	500.00	2.00
13	黄凯	有限合伙人	500.00	2.00
14	华锦洲	有限合伙人	300.00	1.20
15	上海利港企业管理有限公司	有限合伙人	300.00	1.20
16	杨海忠	有限合伙人	200.00	0.80
合计			**25,000.00**	**100.00**

（10）渝兴益华贰号

项目	基本情况
企业名称	南京渝兴益华贰号创业投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2025 年 12 月 12 日
认缴出资额	1,565 万元
执行事务合伙人	南京江北益华私募基金管理有限公司
注册地及主要生产经营地	江苏省南京市江北新区浦滨路 211 号基因大厦 B 座 2306-2 室
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	股权投资

截至本招股说明书签署日，其合伙人构成及出资比例如下：

序号	姓名/名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	南京江北益华私募基金管理有限公司	普通合伙人	15.00	0.96
2	广安金财投融资（集团）有限责任公司	有限合伙人	1,500.00	95.85
3	韩梅	有限合伙人	50.00	3.19
合计			**1,565.00**	**100.00**

（11）曾劲涛

姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	住址	证件号码	在发行人处任职情况
曾劲涛	中国	是	上海市浦东新区******	3101121978********	未在公司任职

（12）张军

姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	住址	证件号码	在发行人处任职情况
张军	中国	否	上海市松江区******	6541251980********	未在公司任职

3、入股原因、价格及定价依据

序号	姓名/名称	入股原因	单价（元）	定价依据
1	江阴瀚联	看好公司的未来发展，对公司的行业前景及经营有信心	20.61	投资者看好半导体行业及发行人的发展前景，参考公司所处行业、经营发展情况、市盈率等因素后协商确定。
2	厦门同璟		20.61	
3	共青城创丰		20.61	
4	畅享季		18.16	
5	大零号湾		20.45	
6	苏州清石		20.61	
7	新锐克胜		20.61	
8	交大小苗		20.61	
9	渝兴益华贰号		20.61	
10	曾劲涛		20.61/26.66	
11	芜湖聚源		22.49	
12	张军		26.66	

4、新增股东的关联关系、股份代持情况

公司最近一年新增股东芜湖聚源的执行事务合伙人之一与芜湖信芯的执行事务合伙人均为信达资本管理有限公司；新增股东渝兴益华贰号执行事务合伙人与渝富益华的执行事务合伙人之一均为南京江北益华私募基金管理有限公司。

除上述情况外，公司最近一年新增股东与其他股东、公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员不存在关联关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。

公司最近一年新增股东所持公司股份不存在股份代持情形。

5、新增股东持有股份的锁定期安排是否符合相关规定

最近一年新增股东均已根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》等规定出具了股份锁定承诺，新增股东持有股份的锁定期安排符合相关规定，具体承诺情况请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。

（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

1、股东郑朝晖与郑琦君为亲兄妹关系；股东陈洋森系郑朝晖、郑琦君母亲的弟弟；

2、股东徐莺系股东柴春波的舅妈；

3、股东郑建生系郑朝晖、郑琦君外婆的弟弟的儿子；

4、股东季铭源、江山季兴、上海季双的执行事务合伙人均为郑朝晖；郑朝晖与郑琦君、陈洋森、李定学签署了《一致行动协议》及补充协议；因此陈洋森、李定学、季铭源、江山季兴、上海季双为郑朝晖、郑琦君的一致行动人；

5、股东嘉善芯创、嘉兴君晋的执行事务合伙人均为上海君桐股权投资管理有限公司；股东嘉兴君源、南通中皋的执行事务合伙人均为上海君泺企业管理合伙企业（有限合伙），上海君泺企业管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人系上海君桐股权投资管理有限公司；

6、股东俱成秋实、俱成秋实贰号的执行事务合伙人均为南京俱成股权投资管理有限公司；

7、股东芜湖聚源的执行事务合伙人之一及芜湖信芯的执行事务合伙人均为信达资本管理有限公司；

8、股东渝富益华的执行事务合伙人之一及渝兴益华贰号执行事务合伙人均为南京江北益华私募基金管理有限公司。

上述股东持股比例情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、发行人股本情况”之“（一）本次发行前后公司股本情况”。

（七）公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营的影响

本次发行股份全部为新股，不涉及股东公开发售股份的情形。

（八）私募基金备案情况

截至本招股说明书签署日，发行人机构股东中共有 23 名为私募基金股东，其所履行的私募投资基金管理人登记及基金备案的情况如下：

序号	名称	基金编号	私募基金管理人	管理人登记编号
1	嘉善芯创壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	SLC358	上海君桐股权投资管理有限公司	P1021028
2	嘉兴君源股权投资合伙企业（有限合伙）	SXT264	上海君桐股权投资管理有限公司	P1021028
3	南通中皋君桐新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	STG672	上海君桐股权投资管理有限公司	P1021028
4	嘉兴君晋股权投资合伙企业（有限合伙）	SSJ179	上海君桐股权投资管理有限公司	P1021028
5	苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）	SNU333	元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司	P1071690
6	南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	SGE506	南京俱成股权投资管理有限公司	P1069480
7	南京俱成秋实贰号创业投资合伙企业（有限合伙）	SNC449	南京俱成股权投资管理有限公司	P1069480
8	芜湖聚源芯达股权投资合伙企业（有限合伙）	SAYS53	信达资本管理有限公司	P1000639
9	芜湖信芯股权投资合伙企业（有限合伙）	SAPH77	信达资本管理有限公司	P1000639
10	福州嘉衍创业投资合伙企业（有限合伙）	SLH803	北京沃衍资本管理中心（有限合伙）	P1008585
11	衢州绿发芯测新材料产业投资合伙企业（有限合伙）	STU595	衢州绿发金创股权投资管理有限公司	P1064692
12	河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）	SZQ592	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）	P1002076
13	重庆渝富益华钧芯壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	STJ381	重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司	P1004104
14	绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）	ST3198	上海建信创科股权投资管理有限公司	P1060937
15	青岛春山锐卓股权投资合伙企业（有限合伙）	STG198	春山浦江（上海）投资管理有限公司	P1005974
16	南京渝兴益华贰号创业投资合伙企业（有限合伙）	SBPC76	南京江北益华私募基金管理有限公司	P1072312
17	湖州市人才创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	SNH167	湖州市创新创业投资有限公司	P1071133
18	衢州金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	SNP133	上海常春藤投资控股有限公司	P1004090

序号	名称	基金编号	私募基金管理人	管理人登记编号
19	成都励石创业投资合伙企业（有限合伙）	SB1172	北京励石投资管理有限公司	P1071072
20	厦门同璟接续创业投资合伙企业（有限合伙）	SBNQ90	上海北科创星际私募基金管理合伙企业（有限合伙）	P1074258
21	江阴瀚联智芯股权投资合伙企业（有限合伙）	STT352	北京联融志道资产管理有限公司	P1023850
22	南通市交大未来小苗创业投资合伙企业（有限合伙）	SB7426	上海小苗朗程投资管理有限公司	P1063500
23	上海大零号湾策源二号创业投资合伙企业（有限合伙）	SATX37	上海大零号湾私募基金管理有限公司	P1074869

（九）公司股东中战略投资者持股情况

本次发行前，公司不存在战略投资者持股的情况。

（十）对赌协议的情况

公司历史沿革中存在公司和主要股东等相关主体与部分投资人约定对赌及股东特殊权利条款或安排的情况。截至本招股说明书签署日，相关对赌及股东特殊权利条款或安排已全部解除并确认自始无效，且不得因任何情形再行恢复效力，具体情况如下：

序号	签订情况	签订时间	曾约定的主要特殊权利条款	目前状态
1	财通创新、嘉善芯创、俱成秋实分别与公司主要股东陈洋森、郑朝晖、郑琦君、李定学、季铭源签署《投资者权利协议书》	2020.9	股份限售、共同出售权、反稀释保护权、上市对赌涉及的回购权、优先清算权、优先跟投权、业绩承诺涉及的回购权等	2023 年 12 月，各方签订了《相关股东特殊权利条款之解除协议》，相关特殊投资条款已全部解除，自始无效且不可恢复
2	苏州元禾、聚源信诚、沪电股份分别与公司主要股东陈洋森、郑朝晖、郑琦君、李定学、季铭源签署《投资者权利协议书》	2021.4	股份限售、共同出售权、反稀释保护权、上市对赌涉及的回购权、优先清算权、优先跟投权、业绩承诺涉及的回购权等	2023 年 9 月聚源信诚、2023 年 12 月苏州元禾、沪电股份，各方签订了《相关股东特殊权利条款之解除协议》，相关特殊投资条款已全部解除，自始无效且不可恢复
3	衢州绿发、福州嘉衍、绍兴绿杉、俱成秋实贰号、南京金浦、江苏新潮与公司主要股东陈洋森、郑朝晖、郑琦君、李定学签署《投资者权利协议书》	2021.12	股份限售、共同出售权、反稀释保护权、上市对赌涉及的回购权、分红权、优先清算权等	2026 年 2 月衢州绿发、2023 年 12 月福州嘉衍、绍兴绿杉、俱成秋实贰号，各方签订了《相关股东特殊权利条款之解除协议》，相关特殊投资条款已全部解除，自始无效且不可恢复。2024 年 4 月，南京金浦和江苏新潮将所持全部股份

序号	签订情况	签订时间	曾约定的主要特殊权利条款	目前状态
				转出（同时受让股东不再享有该等权利），因此所有特殊投资条款均在该时点失效。
	衢州绿发与郑朝晖、郑琦君、陈洋森、李定学签署《补充协议》	2022.1	上市对赌涉及的回购权	2022 年 12 月，衢州绿发与上海琦晖签署《股份转让协议》，约定衢州绿发以 4,200.6667 万元将其持有的公司 300 万股转让给上海琦晖。因此回购义务已完成，原协议条款均已解除。
4	戴梦夏与公司主要股东陈洋森、郑朝晖、郑琦君、李定学签署《投资者权利协议书》	2022.10	共同出售权、反稀释保护权、上市对赌涉及的回购权、分红权、优先清算权等	2023 年 9 月，双方签订了《相关股东特殊权利条款之解除协议》，相关特殊投资条款已全部解除，自始无效且不可恢复
	戴梦夏与郑朝晖、郑琦君签署《补充协议》	2022.12	优先清算权、最惠国等	
5	南通中皋与郑朝晖签署《补充协议》	2022.2	上市对赌涉及的回购权	2025 年 12 月，双方签订了《相关股东特殊权利条款之解除协议》，相关特殊投资条款已全部解除，自始无效且不可恢复
6	湖州创投、嘉兴君源、渝富益华、上海众松与公司主要股东陈洋森、郑朝晖、郑琦君、李定学签署《投资者权利协议书》	2022.12	共同出售权、反稀释保护权、上市对赌涉及的回购权、分红权、优先清算权等	2026 年 3 月渝富益华、2026 年 2 月湖州创投、2025 年 12 月嘉兴君源分别签订了《相关股东特殊权利条款之解除协议》，相关特殊投资条款已全部解除，自始无效且不可恢复。2025 年 12 月，郑朝晖、郑琦君指定第三方已回购上海众松的全部股份，原协议所有条款均已解除。
	湖州创投、嘉兴君源、渝富益华、上海众松与郑朝晖、郑琦君签署《补充协议》	2022.12	优先清算权、最惠国等	
7	尚成一号、天津合泰、普冉股份、商络电子、成都励石、上海骏晨翔与公司主要股东陈洋森、郑朝晖、郑琦君、李定学签署《投资者权利协议书》	2023.6	共同出售权、反稀释保护权、上市对赌涉及的回购权、分红权、优先清算权等	2026 年 3 月尚成一号、2023 年 8 月天津合泰、普冉股份、上海骏晨翔、2023 年 9 月成都励石、2023 年 12 月商络电子分别签订了《相关股东特殊权利条款之解除协议》，相关特殊投资条款已全部解除，自始无效且不可恢复。
	尚成一号、天津合泰、普冉股份、商络电子、成都励石、上海骏晨翔与郑朝晖签署《补充协议》	2023.6	优先清算权、最惠国等	

综上，截至本招股说明书签署日，相关对赌及股东特殊权利条款或安排已全

部解除并确认自始无效，且不得因任何情形再行恢复效力，符合《监管规则适用指引——发行类第 4 号》规定的相关要求。

十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况

（一）董事会成员

截至本招股说明书签署日，公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名，现任董事基本情况如下：

序号	姓名	职务	提名人	任职期间
1	郑朝晖	董事长、总经理	董事会	2025 年 9 月 30 日至 2028 年 9 月 30 日
2	倪卫华	董事、副总经理	董事会	2025 年 9 月 30 日至 2028 年 9 月 30 日
3	杨小明	董事	董事会	2025 年 9 月 30 日至 2028 年 9 月 30 日
4	毛余喜	职工董事	职工代表大会	2025 年 9 月 30 日至 2028 年 9 月 30 日
5	陶卫	董事	董事会	2025 年 9 月 30 日至 2028 年 9 月 30 日
6	张绍敏	董事	董事会	2025 年 9 月 30 日至 2028 年 9 月 30 日
7	杨勤法	独立董事	董事会	2025 年 9 月 30 日至 2028 年 9 月 30 日
8	王泽霞	独立董事	董事会	2025 年 9 月 30 日至 2028 年 9 月 30 日
9	何卫锋	独立董事	董事会	2025 年 9 月 30 日至 2028 年 9 月 30 日

公司董事简历如下：

1、郑朝晖先生的简历请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人基本情况”。

2、倪卫华先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2002 年 4 月，历任上海博达数据通信有限公司硬件工程师、经理；2002 年 4 月至 2006 年 5 月，任智邦大陆科技有限公司技术经理；2006 年 5 月至 2011 年 5 月，任创锐讯通讯技术（上海）有限公司主任经理；2011 年 5 月至 2020 年 5 月，任高通企业管理（上海）有限公司首席工程师；2020 年 5 月至今，任公司董事兼副总经理。

3、杨小明先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001 年 12 月至 2003 年 8 月，任哈尔滨郎泰克环保科技有限公司上海分公司机械设计工程师；2003 年 9 月至 2006 年 9 月，任上海连信商贸有限公司设

计经理；2006 年 10 月至 2008 年 6 月，任上海慧济普环保科技有限公司设计经理；2008 年 7 月至 2011 年 6 月，任上海宏岸港口机械有限公司主任设计师；2011 年 7 月至 2022 年 2 月，任青岛海西重机有限责任公司上海分公司专家；2022 年 2 月至今，任公司机械设计首席工程师、董事。

4、毛余喜先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 7 月至 1998 年 1 月，历任上海新江机器厂铸锻分厂技术质量科工程师、副科长；1998 年 1 月至 2015 年 3 月，历任上海美维电子有限公司产品工程部工程师、主管；2015 年 4 月至今，历任公司资深经理、运营总监；2016 年 8 月至 2025 年 9 月，任公司监事；2025 年 9 月至今，任公司职工董事。

5、陶卫女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003 年 4 月至 2018 年 12 月，历任上海交通大学电子信息与电气工程学院讲师、副教授；2018 年 12 月至今，任上海交通大学自动化与感知学院研究员；2025 年 9 月至今，任公司董事。

6、张绍敏女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年 9 月至 2021 年 10 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级经理；2021 年 10 月至今，任上海君桐股权投资管理有限公司风控部财务风控经理；2025 年 9 月至今，任公司董事。

7、杨勤法先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989 年 9 月至 1999 年 7 月，任浙江时代银鹰律师事务所主任；2003 年 6 月至 2012 年 5 月，任上海国巨律师事务所兼职律师；2012 年 6 月至 2019 年 12 月，任北京大成（上海）律师事务所兼职律师；2019 年 12 月至今，任上海市浩信律师事务所兼职律师；2002 年 7 月至今，任华东政法大学经济法学院副教授、房地产政策法律研究所所长、投资与建设法治研究院副院长；2023 年 4 月至今任公司独立董事。

8、王泽霞女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988 年 4 月至今，历任杭州电子科技大学教师、财经学院副院长、财经学院院长、会计学院院长，现任杭州电子科技大学信息工程学院特聘教授；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

9、何卫锋先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2005 年 5 月至 2006 年 8 月，任香港科技大学电子与计算机工程系博士后研究员；2006 年 9 月至今，历任上海交通大学电子信息与电气工程学院讲师、副研究员、教授；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

（二）监事会成员

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定，2025 年 9 月 30 日，公司召开临时股东大会调整内部监督机构，由董事会审计委员会承接原监事会的法定职权，公司自此不再设置监事会。截至监事会取消前，公司监事会由毛余喜、陶雪芬、尹琦组成。

（三）高级管理人员

截至本招股说明书签署日，公司现任高级管理人员 6 名，基本情况如下表：

序号	姓名	职务	任职期间
1	郑朝晖	董事长、总经理	2025 年 9 月 30 日至 2028 年 9 月 30 日
2	倪卫华	董事、副总经理	2025 年 9 月 30 日至 2028 年 9 月 30 日
3	朱勇	副总经理	2025 年 9 月 30 日至 2028 年 9 月 30 日
4	李定学	副总经理	2025 年 9 月 30 日至 2028 年 9 月 30 日
5	庄振宏	副总经理	2025 年 9 月 30 日至 2028 年 9 月 30 日
6	邵文宗	董事会秘书、财务总监	2025 年 9 月 30 日至 2028 年 9 月 30 日
		副总经理	2026 年 2 月 26 日至 2028 年 9 月 30 日

郑朝晖先生、李定学先生的简历情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人基本情况”。倪卫华先生的简历情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。

其他公司高级管理人员简历情况如下：

1、朱勇先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 7 月，任仁宝电子科技（昆山）有限公司硬件团队主管；2004 年 9 月至 2008 年 6 月，任智邦大陆科技有限公司课长；2008 年 6 月至 2011 年 5

月，任创锐讯通讯技术（上海）有限公司芯片测试部门高级工程师；2011 年 5 月至 2019 年 5 月，任高通企业管理（上海）有限公司芯片测试部门高级经理；2019 年 5 月至今，历任公司董事、CTO 兼副总经理；现任公司副总经理。

2、庄振宏先生，1969 年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998 年 7 月至 2000 年 4 月，任利汎科技股份有限公司研发工程师；2000 年 5 月至 2010 年 4 月，历任美商飞昱科技股份有限公司台湾分公司售后服务工程师、销售经理；2010 年 5 月至 2021 年 2 月，任飞雅贸易（上海）有限公司销售总监；2021 年 2 月至 2023 年 4 月，任赛默飞世尔电子技术研发（上海）有限公司销售总监；2023 年 7 月至今，任公司副总经理。

3、邵文宗先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 10 月至 2016 年 4 月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2016 年 5 月至 2018 年 8 月，任光大证券股份有限公司投行部高级经理；2018 年 10 月至 2021 年 2 月，任百姓网股份有限公司财务部高级经理；2021 年 3 月至今，任公司财务总监；2022 年 9 月至今，任公司董事会秘书；2026 年 2 月至今，任公司副总经理。

（四）其他核心人员

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员为郑朝晖、倪卫华、朱勇。

郑朝晖先生简历情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人基本情况”。

倪卫华先生简历情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。

朱勇先生简历情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（三）高级管理人员”。

（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况（在发行人及其子公司的任职除外）如下：

姓名	在发行人担任职务	其他任职单位	职务	任职单位与发行人关系
郑朝晖	董事长兼总经理	上海季双	执行事务合伙人	发行人股东
		上海琦晖	执行事务合伙人	发行人实际控制人控制的企业
		江山季兴	执行事务合伙人	发行人股东
		季铭源	执行事务合伙人	发行人股东
倪卫华	董事、副总经理	四川数智	董事	发行人参股公司
张绍敏	董事	广芯电子技术（上海）股份有限公司	董事	发行人关联方
		杭州中欣晶圆半导体股份有限公司	董事	发行人关联方
陶卫	**董事**	**苏州明微科技有限公司**	**经理**	**发行人关联方**
杨勤法	独立董事	上海东方证券资产管理有限公司	独立董事	无关联关系
		江苏纽泰格科技集团股份有限公司	独立董事	无关联关系
		物奇微	独立董事	无关联关系
		上海超导科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
		上海市浩信律师事务所	兼职律师	无关联关系
王泽霞	独立董事	杭州明泽云软件有限公司	董事长兼总经理	发行人关联方
		灿芯半导体（上海）股份有限公司	独立董事	无关联关系
		浙江临安农村商业银行股份有限公司	独立董事	无关联关系
		中国会计学会高等工科院校分会	副会长	无关联关系
何卫锋	独立董事	上海为旌科技有限公司	技术顾问	无关联关系
李定学	副总经理	普铄电子	董事	发行人参股公司

（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员相互间不存在亲属关系。

十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及其他核心人员最近三年不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的重大协议及履行情况

除独立董事以外，公司与其内部董事、高级管理人员及其他核心人员分别签署了《劳动合同》和《保密协议》。公司与独立董事签订了《独立董事聘任协议书》。截至本招股说明书签署日，上述合同、协议履行正常，不存在违约情形。

公司董事、高级管理人员和其他核心人员作出的重要承诺具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。

十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况

（一）直接持股情况

截至本招股说明书签署日，董事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务或亲属关系	持股数（万股）	持股比例（%）
1	郑朝晖	董事长、总经理	1,838.51	15.91
2	郑琦君	证券部总监，郑朝晖之妹	686.08	5.94

（二）间接持股情况

截至本招股说明书签署日，董事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属间接持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务或亲属关系	间接持股方式	持股数（万股）	持股比例（%）
1	郑朝晖	董事长、总经理	通过季铭源、江山季兴、上海季双间接持股	167.02	1.44
2	倪卫华	董事、副总经理	通过季铭源、上海畅享季间接持股	132.00	1.14
3	杨小明	董事	通过江山季兴、上海畅享季间接持股	32.00	0.28
4	毛余喜	职工董事	通过季铭源、上海畅享季间接持股	34.00	0.29
5	朱勇	副总经理	通过季铭源、上海畅享季间接持股	125.00	1.08
6	李定学	副总经理	通过季铭源间接持股	70.00	0.61
7	庄振宏	副总经理	通过上海季双间接持股	29.00	0.25
8	邵文宗	副总经理、董事会秘书、财务总监	通过江山季兴、上海畅享季间接持股	63.00	0.55
9	郑琦君	证券部总监、郑朝晖之妹	通过季铭源间接持股	18.00	0.16

（三）股份质押、冻结或发生诉讼纠纷情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属所持有的公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

十六、董事、监事、高级管理人员及其核心人员最近两年的变动情况

（一）董事的变动情况

公司董事最近两年内的变动情况如下：

序号	变动时间	变动情况
1	2024 年 1 月	原董事祁耀亮因个人原因离任，选举杨小明担任公司董事
2	2025 年 9 月	董事会任期届满，原董事闻威、周子学、高强离任，选举陶卫、张绍敏担任公司董事
3	2025 年 9 月	召开职工代表大会选举毛余喜担任公司职工董事

除上述变动外，最近两年公司董事人选未发生其他变化。

（二）监事的变动情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定，2025 年 9 月 30 日，公司召开临时股东大会调整内部监督机构，由董事会审计委员会承接原监事会的法定职权，不设监事会或者监事。截至监事会取消前，

公司监事会由毛余喜、陶雪芬、尹琦组成。

（三）高级管理人员的变动情况

公司高级管理人员最近两年内的变动情况如下：

序号	变动时间	变动情况
1	2025 年 9 月	原副总经理高强因个人原因离任

（四）其他核心人员的变动情况

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员最近两年未发生变动。

十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

截至本招股说明书签署日，除发行人及其子公司以外，公司董事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况如下表所示：

姓名	职务	对外投资企业名称	持股比例（%）	主营业务
郑朝晖	董事长、总经理	季铭源	6.62	公司持股平台
		江山季兴	25.60	公司持股平台
		上海季双	4.18	公司持股平台
		上海琦晖	73.22	股权投资
		景宁鼎精企业管理咨询中心（有限合伙）	12.98	企业管理服务
		上海纯芯私募基金管理有限公司	9.00	股权投资
		上海谋胜投资管理有限公司	2.46	股权投资
		上海洛子峰企业管理中心（有限合伙）	7.25	企业管理服务
		嘉兴君杉股权投资合伙企业（有限合伙）	14.05	股权投资
		嘉兴君茸创业投资合伙企业（有限合伙）	5.27	股权投资
倪卫华	董事、副总经理	季铭源	13.86	公司持股平台
		畅享季	2.03	公司持股平台
杨小明	董事	江山季兴	7.20	公司持股平台
		畅享季	3.39	公司持股平台
毛余喜	职工董事	季铭源	3.55	公司持股平台
		畅享季	0.68	公司持股平台
陶卫	董事	苏州明微科技有限公司	40.00	软件和信息技术

姓名	职务	对外投资企业名称	持股比例（%）	主营业务
				服务
王泽霞	独立董事	杭州明泽云软件有限公司	50.00	应用软件开发、云计算技术服务
朱勇	副总经理	季铭源	13.11	公司持股平台
		畅享季	2.03	公司持股平台
李定学	副总经理	季铭源	7.52	公司持股平台
庄振宏	副总经理	上海季双	12.89	公司持股平台
邵文宗	副总经理、董事会秘书、财务总监	江山季兴	15.47	公司持股平台
		畅享季	3.39	公司持股平台

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他与公司及公司业务相关的对外投资情况。上述对外投资与公司不存在利益冲突。

十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况

（一）薪酬组成、确定依据、所履行的程序

截至本招股说明书签署日，在本公司任职的董事、监事（已取消）、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、奖金和福利津贴等组成，相关薪酬系根据公司相关薪酬标准和制度确定；独立董事在公司领取固定津贴。

公司董事的薪酬政策与方案由薪酬与考核委员会制定，须报经董事会同意、提交股东会审议通过后方可实施；公司总经理及其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。发行人董事、监事会取消前在任的监事和高级管理人员的薪酬及考核方案均按照《公司章程》等公司治理制度履行了相应的审议程序。

（二）薪酬总额及占比

报告期内，公司时任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬总额（含独立董事领取的津贴）及占公司各期利润总额的比例如下表所示：

年度	薪酬总额（万元）	利润总额（万元）	占利润总额的比例
2026 年 1-6 月	**280.35**	**4,763.65**	**5.89%**
2025 年度	728.24	9,746.70	7.47%
2024 年度	775.88	6,359.72	12.20%

年度	薪酬总额（万元）	利润总额（万元）	占利润总额的比例
2023 年度	631.28	2,760.76	22.87%

（三）最近一年从发行人及其关联企业领取收入情况

公司时任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年在本公司及其关联企业领取薪酬的情况如下表所示：

序号	姓名	公司职务	2025 年度税前薪酬（万元）
1	郑朝晖	董事长、总经理	70.97
2	倪卫华	董事、副总经理	91.42
3	杨小明	董事	50.13
4	毛余喜	职工董事；前任监事会主席，于 2025 年 9 月离任	53.04
5	陶卫	董事	\
6	张绍敏	董事	\
7	杨勤法	独立董事	12.00
8	王泽霞	独立董事	12.00
9	何卫锋	独立董事	12.00
10	高强	前任董事，于 2025 年 9 月离任	40.60
11	周子学	前任董事，于 2025 年 9 月离任	37.50
12	闻威	前任董事，于 2025 年 9 月离任	\
13	尹琦	前任监事，于 2025 年 9 月离任	\
14	陶雪芬	前任职工代表监事，于 2025 年 9 月离任	32.72
15	朱勇	副总经理	70.77
16	李定学	副总经理	52.51
17	庄振宏	副总经理	123.28
18	邵文宗	副总经理、董事会秘书、财务总监	69.30

十九、发行人股权激励及相关安排

为增强员工归属感与团队凝聚力，实现员工利益与公司未来利益的一致性，公司制定并实施了股权激励计划，激励对象涵盖公司及其全资子公司的优秀管理人员、研发与技术骨干、业务骨干及其他公司认定的核心员工。

公司股权激励计划通过持股平台上海季双、江山季兴及季铭源间接持股方式

实施，相关股权激励方案明确约定授予数量、行权条件、份额流转等核心条款，严格遵循相关法律法规及公司规章制度要求，履行了董事会、股东（大）会审议程序，决策流程合法合规。

公司股权激励方案条款主要规定和实施影响情况如下：

（一）股权激励方案对于股权内部流转、退出、管理的规定

项目	主要内容
服务期安排	激励对象应自合伙企业财产份额授予之日起与公司维持期限 5 年的劳动关系。
退出限制	激励对象所持财产份额，自财产份额授予之日起未满 60 个月或公司尚未完成首次公开发行并上市的，根据《员工持股办法》的规定予以转让/退出，不得对外转让；自财产份额授予之日起满 60 个月且公司已经完成首次公开发行并上市的，经执行事务合伙人的书面同意后，方可对外转让。
份额流转	在承诺服务期内，如激励对象与公司解除、终止劳动关系/员工身份关系的，其应当退出合伙企业，并应向参与股权激励计划的其他员工或者执行事务合伙人指定的其他符合《员工持股办法》规定条件的员工，按照《员工持股办法》或员工合伙企业的合伙协议的约定，转让全部出资财产份额。
强制除名退出的情形	若激励对象出现以下情形时，其须主动将名下财产份额全部转给普通合伙人或其指定的受让人，否则公司、持股平台、普通合伙人均有权将其从持股平台中强制除名退出： 1、激励对象违反公司规章制度、员工持股办法、劳动/劳务合同、合伙协议承诺函等文件的规定/约定，公司可与其解除、终止劳动关系的； 2、激励对象与公司解除、终止劳动关系的； 3、除取得公司同意之外，激励对象连续 180 日无法到岗工作的； 4、激励对象所持有的持股平台的财产份额被司法机关查封冻结或持股平台被责令协助执行的情形； 5、激励对象发生法律、法规规定不得持有持股平台财产份额的情形； 6、损害公司利益等持股平台合伙协议约定的情形。

（二）股权激励对公司的影响及上市后的行权安排

上述股权激励对公司经营状况的影响主要为有助于公司吸引和留住优秀人才，调动员工积极性，提升团队凝聚力和企业竞争力，为公司持续、稳定发展提供重要保障。上述股权激励实施完毕前后，公司实际控制人未发生变化，对公司财务状况、控制权未产生重大影响。上述股权激励计划不存在未行权的情况，不涉及上市后的行权安排。

（三）股份支付处理情况

公司已按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，对于公司员工持股平台入股价格低于同期公允价格的部分，确认了股份支付费用，并在合伙协议约定的五年服务期内进行分摊。报告期内，公司股权激励对应的股份支付各期

摊销的金额分别为 639.99 万元、720.97 万元、508.97 万元和 **351.18 万元**。

二十、发行人员工及其社会保障情况

（一）员工情况

1、员工人数及变化情况

单位：人

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
员工总数	**1,253**	1,117	958	864

2、员工专业结构

单位：人

专业结构	人数	占员工总数比例（%）
生产人员	**885**	**70.63**
研发人员	**140**	**11.17**
管理人员	**147**	**11.73**
销售人员	**81**	**6.46**
合计	**1,253**	**100.00**

3、员工受教育程度

单位：人

教育程度	人数	占员工总数比例（%）
博士	**6**	**0.48**
硕士	**41**	**3.27**
本科	**560**	**44.69**
大专及以下	**646**	**51.56**
合计	**1,253**	**100.00**

4、员工年龄分布

单位：人

年龄分布	人数	占员工总数比例（%）
21 岁以下	**9**	**0.72**
21-30 岁	**744**	**59.38**
31-40 岁	**371**	**29.61**
41-50 岁	**113**	**9.02**

年龄分布	人数	占员工总数比例（%）
50 岁及以上	**16**	**1.28**
合计	**1,253**	**100.00**

（二）公司执行社会保障制度、住房公积金、医疗制度等的情况

公司实行劳动合同制。公司与员工按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定签订了《劳动合同》，并为员工提供了必要的社会保障计划，根据国家及地方的有关规定，公司为员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，并为员工缴纳了住房公积金。

报告期各期末，公司及其子公司在册员工人数分别为 864 人、958 人、1,117 人**和 1,253 人**，公司缴纳社会保险及住房公积金的员工人数如下：

1、社会保险缴纳情况

项目		2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
员工总人数（人）		**1,253**	1,117	958	864
已缴纳人数（人）		**1,203**	1,099	947	854
未缴纳人数（人）		**50**	18	11	10
差异原因	港澳台籍员工	**5**	7	5	4
	新入职未能在签订劳动合同当月缴纳	**43**	9	5	6
	退休返聘	**2**	2	1	0

2、住房公积金缴纳情况

项目		2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
员工总人数（人）		**1,253**	1,117	958	864
已缴纳人数（人）		**1,203**	1,100	947	854
未缴纳人数（人）		**50**	17	11	10
差异原因	港澳台籍员工	**5**	7	5	4
	新入职未能在签订劳动合同当月缴纳	**43**	8	5	6
	退休返聘	**2**	2	1	0

报告期各期末，公司未缴纳社会保险和住房公积金人数较少，少数未缴纳的

具体情况及形成原因为：1）退休返聘无需缴纳；2）新入职错过当月缴纳时间、前单位未停保；3）部分港澳台籍员工自愿放弃缴纳。

根据公司及子公司所在地监管机构提供的《市场主体专用信用报告》证明，公司及子公司不存在因违反社会保险相关法律、法规被处罚的情形；公司及子公司不存在因违反住房公积金相关法律、法规被处罚的情形。

（三）公司实际控制人承诺

为充分保障公司首次公开发行股票并上市后中小股东的利益，公司实际控制人郑朝晖、郑琦君已出具承诺，承诺的具体内容请参见本招股说明书“第十二节附件”之“四、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。

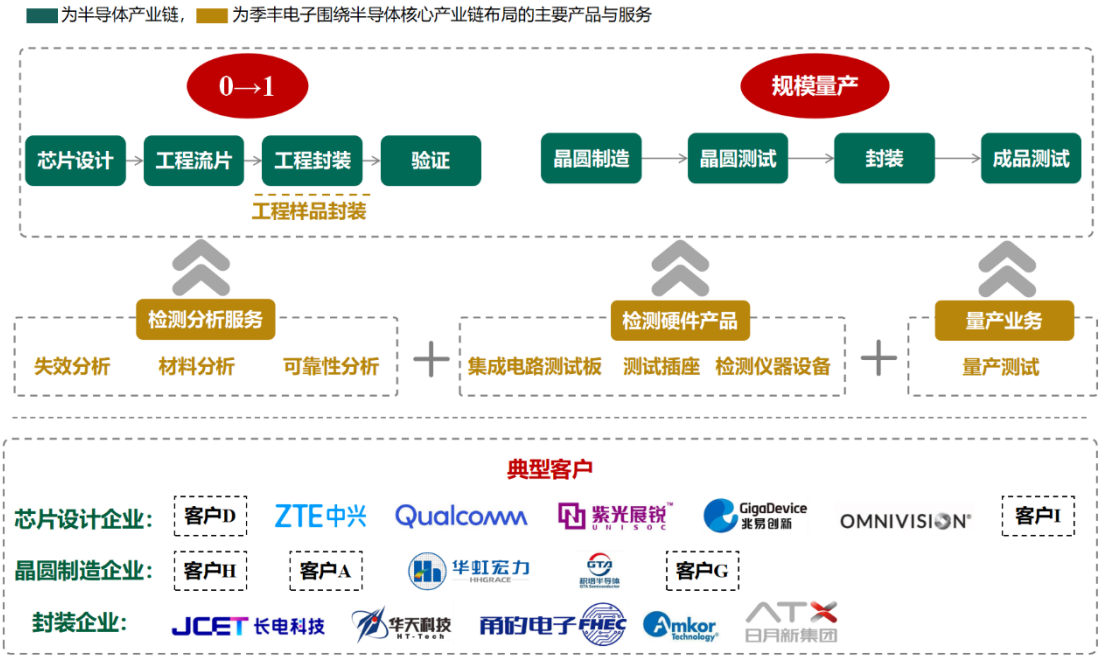
第五节 业务与技术

一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况

（一）主营业务基本情况

公司是一家半导体领域检测服务与检测硬件产品的全功能、一站式解决方案提供商，围绕芯片设计、晶圆制造、封装等半导体全产业链企业的检测需求，提供第三方实验室检测分析服务、集成电路测试板等检测硬件产品以及量产测试服务。以集成电路为主要代表的半导体行业，其研发和量产制造是高度复杂精密、技术迭代快速、投资成本巨大的综合性工程。半导体检测贯穿从研发、制造到系统化应用的全流程，在芯片“0 到 1”和“规模量产”的过程中发挥着关键作用，且涉及半导体、材料、机械、光学等多学科的交叉应用，具有较高的技术门槛，属于半导体产业中不可或缺的重要组成部分，也是国家政策认可和鼓励的半导体产业链环节之一。

芯片的“0-1”阶段通常包括设计、工程流片、工程封装、验证四大环节，半导体检测主要发生在验证环节，包含测试和分析。测试，即以定制化集成电路测试板等硬件为载体，经不同类型的测试机对芯片进行可靠性等测试；分析，即通过失效分析、材料分析等实验室服务对失效样品进行缺陷定位与故障分析，实现问题判定。规模量产阶段通常包括晶圆制造、量产封装、量产测试三大环节。量产测试，包括晶圆测试与成品测试；质量监控贯穿于规模量产阶段的三大环节，是指通过可靠性测试、失效分析等手段进一步保证量产芯片的质量。公司能够为客户提供上述两个阶段的全功能、一站式半导体检测服务，既能提供失效分析、材料分析、可靠性测试等第三方实验室检测分析及定制化检测硬件产品，又能提供量产测试服务，帮助客户快速定位问题及验证、提高芯片研发效率、缩短研发周期、优化工艺良率、降低开发成本，为各类芯片从设计、工程验证再到量产的全生命周期提供高可靠性保障。



公司提供的检测服务与检测硬件产品，检测对象可以全面覆盖数字、模拟、存储、功率、射频和复杂 SoC 等各类芯片，具备 CPU、GPU、存储芯片、AI 芯片等高端芯片的检测服务能力，能够满足先进制程（最先进制程案例已覆盖 3nm 芯片）、先进封装（2.5D、3D 封装等）、成熟制程以及特色工艺的检测需求。公司在上海、北京、杭州、深圳、成都等半导体产业集聚地建立子公司，能够更好地贴近关键客户、提升响应速度与服务品质。凭借全功能、一站式模式以及优秀的技术实力与服务品质，公司已与半导体产业链内超过 3,000 家客户建立了合作关系，客户涵盖芯片设计、晶圆制造、封测等全环节，包括客户 D、中兴通讯、高通、客户 H、华虹宏力、长电科技等知名企业。

公司集聚了一批拥有跨学科背景与丰富行业经验的优秀人才，积累了对各种芯片类型进行测试、对各类失效情况进行检测分析的海量案例，在第三方实验室检测分析、集成电路测试板设计与仿真、量产测试等方面形成了一系列核心技术。截至本招股说明书签署日，公司及其子公司拥有 **140** 项专利，其中发明专利 **58** 项。公司拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的 **201** 个检测项目、检验检测机构资质认定（CMA）的 **56** 个检测项目，并获得 ISO9001 国际品质管理认证、ISO/IEC 17025 国际实验室管理体系认证、IATF16949 汽车工业质量管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证等。公司获评为工信部国家级重点“小巨人”企业、国家先进制造业集群（车规级芯片工程化测试服务平台）、

“中国芯”优秀支撑服务企业、上海市科技小巨人优秀企业、上海市服务型制造示范平台、上海市专精特新中小企业、优秀专家工作站等。

（二）主要产品或服务的基本情况

1、主要产品及服务概况

公司主要产品及服务可分为第三方实验室检测分析服务、检测硬件产品、量产业务、工程样品封装及其他等，具体如下：

服务/产品名称		服务内容/具体产品
第三方实验室检测分析服务	失效分析	• 指通过实验分析手段确定元器件既有失效现象的原因及失效机理，或判断可能存在的失效情况； • 公司提供的失效分析检测实验手段主要包括非破坏性分析、电性检测分析、高阶线路修补、样品制备、微观形貌表征等，主要解决芯片设计、研发、测试以及应用阶段的失效问题
	材料分析	• 指通过实验分析手段对样品进行材料成分及结构的分析，实现对样品的结构组织分布、元素比例构成、污染物情况等的深入分析判断； • 公司提供的材料分析检测实验手段主要包括 FIB 双束聚焦离子束分析测试服务、高解析度 TEM 测试服务和痕量化学分析服务，公司擅长先进芯片样品的截面和平面分析，包含形貌观察、尺寸量测、元素分析及晶体学结构解析，能够获取适合纳米尺度结构的形貌表征，适用于硅、砷化镓、碳化硅、氮化镓等多种半导体材料分析
	可靠性测试	• 指考察特定实验条件下产品的寿命特征、环境适应能力等，通过调节温度、湿度、压力、电压等方式评估产品在规定的寿命期间、预期的使用、运输或储存等环境下，能否保持功能可靠； • 公司提供的可靠性测试服务包括工艺可靠性认证、封装级可靠性认证、产品级可靠性认证、板级可靠性认证、新能源可靠性认证，测试覆盖范围为行业领先
检测硬件产品	集成电路测试板（含测试插座）	• 是一种用于测试半导体器件功能、可靠性的电路板或模块，从芯片设计到批量生产过程中涉及的可靠性测试、晶圆测试和芯片成品测试均需要定制化设计测试板； • 公司从事高端客制化测试板设计，在测试板方面形成了较强的技术实力，涵盖测试载板、老化板、系统板等产品，具备从原理图到仿真、版图、元器件选型等一站式设计能力； • 同时，公司还为客户提供自主研发生产的测试插座，主要作为工程测试或量产测试过程中的配套治具
	检测仪器设备	• 公司基于长期以来的技术积累，为更好满足客户个性化的检测需求，公司可为客户提供自主研发仪器设备，如手动探针台、SoC 可靠性测试机、存储芯片可靠性测试机、三维超景深显微镜等
量产业务	高可靠性芯片量产测试服务	• 量产测试服务是在芯片规模量产阶段，提供晶圆测试（CP）、成品测试（FT）、系统级测试（SLT）、老化测试（BI）等服务； • 公司于 2022 年布局高可靠性芯片量产测试业务，主要为车规级芯片提供量产测试服务

服务/产品名称		服务内容/具体产品
	电子制造服务	• 电子制造服务（EMS）是面向客户提供的芯片封测后 PCBA 模组生产、组装与交付的制造服务
工程样品封装		• 是指在芯片研发验证阶段，为工程批晶圆提供的快速、小批量、低成本的封装解决方案，目的是在最短时间内把裸芯片加工成可用于电气测试、功能验证及失效分析的工程样品； • 公司于 2019 年开始布局工程样品封装业务，可以提供从晶圆磨划、固晶键合、塑封陶封的一站式服务

2、主要产品及服务介绍

（1）第三方实验室检测分析服务

公司提供的第三方实验室检测分析服务包括失效分析、材料分析（含化学分析）、可靠性测试等。

①失效分析

失效分析旨在通过实验分析手段探究芯片等样品的失效原因，或判断潜在失效问题。失效分析不仅涵盖对已失效样品的诊断分析，也包括检查是否存在潜在失效问题以评估及保障产品在工艺与材料层面的稳定性。失效分析贯穿客户产品的调研、研发、试产到量产全生命周期，为客户设计方案优化、工艺参数调优、产线良率提升及质量问题溯源等提供关键决策支持。

在实际项目中，公司根据客户需求与样品特性定制分析方案，技术人员通常需要结合对样品生产工艺和失效现象的初步推断，并综合运用电性、结构、材料、理化等多方面技术进行失效根因溯源及失效模型的推演，以提供合适的检测分析方案，并综合运用多项技术进行交叉验证。在制定分析方案后，公司遵循“现象——机理——原因”的递进逻辑判定失效原因，首先进行非破坏性分析，包括外观检测、X 射线无损检测分析、超声波无损检测分析等；然后，进行电性分析，包括电流-电压特性测试、热点定位等；公司还会根据客户需求和案例复杂程度，综合运用材料分析及化学分析相关检测项目以进一步探究失效原因（参见本节“2、/（2）/①/B.材料分析”）。最终，向客户提供检测分析结果或检测分析报告，提出失效原因及改进建议。

公司目前提供的失效分析检测实验手段包括非破坏性分析、电性分析、样品制备、微观形貌表征等，具体如下：

A.非破坏性分析

非破坏性分析（Non-Destructive Testing，NDT）是指在不损害被检测对象的使用性能、不伤害被检测对象内部组织的前提下，利用材料内部结构异常或缺陷引起的热、声、光、电、磁等反应的变化，对检测件内部及表面的结构、性质、状态及缺陷的类型、数量、形状、位置、尺寸进行检查和测试的方法。公司结合样品失效情况和检测目的，采取相应的检测项目，通过检测程序调节参数，从而对样品失效部位进行初步定位。公司可提供的典型检测项目如下：

序号	检测项目	检测内容
1	超高精度无损外观检测	利用立体显微镜、金相显微镜等对检测样品的外观、表面进行观察和超高精度的测量，从而寻找失效部位和相关物证
2	超声波无损检测分析	利用超声波能透入金属材料的深处的特性和在界面边缘发生反射的特点，在荧光屏上形成脉冲波形，根据这些脉冲波形来判断缺陷位置和大小
3	X 射线无损检测分析	利用不同材料厚度或密度对 X 光吸收和透过率的不同的原理来成像，可用于检测样品内部缺陷、通孔内部缺陷、异物和裂纹等

B.电性分析

电性分析（Electrical Failure Analysis，EFA）是针对电学性能的失效分析，包括电性测量和电性失效定位分析。电性测量主要利用半导体测量采样设备对检测样品进行电性能测量和分析，确定被测电路的电参数是否异常，从而确定失效模式。在电性测量的基础上，进一步通过热成像、光子成像、激光成像等方式对检测样品的短路、漏电缺陷、电异常等进行精准定位。公司可提供的典型检测项目如下：

序号	检测项目	检测内容
1	电测量	通过特定检测设备检测元器件的电流值、电压值、阻抗值等参数，计算分析元器件的各项参数及性能
2	红外热成像显微检测	通过非接触热成像的方式快速获取元器件表面温度分布数据，根据算法快速定位失效点，可用于电路短路、缺陷检测等
3	微光显微检测	通过侦测电子-空穴复合所激发出的光子与热载流子寻找样品亮点、热点从而检测出样品所产生的漏电、短路、失效点等缺陷
4	高分辨率激光束电阻异常检测	利用激光作用于半导体产生的热效应和光生载流子效应导致半导体电阻发生变化的原理，对样品失效点进行高分辨率观测和定位
5	纳米级探针检测	通过若干纳米探针（Nano Prober）构成的探针基座，与外界电性测试机链接，形成一套完整的测量系统，可实现纳米级晶体管电性测试及故障定位

C.样品制备

样品制备指通过对原始样品的针对性处理，使其特定部位或结构能够满足后续高精度检测设备的观测与分析条件，是进行芯片设计验证与底层缺陷分析的必

要手段，包括研磨（Polish）、开封（Decap）、去层（Delayer）、聚焦离子束制样（FIB 制样，Focused Ion Beam）等步骤。

由于客户送检的失效样品通常已被塑封料、金属布线层等不透明或不导电材料覆盖，直接观察内部结构及缺陷较为困难，公司需要通过研磨、开封、去层、FIB 制样等手段进行样品制备，实现对芯片内部纵剖面、焊点界面、金属布线等关键部位的暴露，为后续的形貌观测、材料分析等检测步骤创造条件。由于失效样品通常数量较少且不可复现，因此对制样准确性要求较高，稍有不慎则可能引入新的人为缺陷，造成失效分析结果的失真，甚至导致失效信息的丢失。因此，样品制备的质量直接影响了失效定位的准确性与分析结果的可靠性。公司依托丰富的案例经验与技术研发，已掌握一系列样品制备工艺，能够有效控制制样风险。公司可提供的样品制备服务如下：

序号	具体服务	具体内容
1	研磨（Polish）	通过机械研磨、离子束研磨（Ion Milling）和精密抛光，获得芯片内部结构的横截面或纵截面，以暴露目标观察点（如芯片与基板的键合点、金属布线层间结构），为后续扫描电镜等微观观察提供平整、清晰、无损伤的截面。其技术关键在于避免不同材料在研磨过程中产生边缘破损或材料拖尾，确保截面形貌真实反映器件内部状态。结合离子束研磨等最终处理，可进一步消除表面微划痕，获得更为清晰的截面细节。
2	开封（Decap）	通过物理、化学或激光技术去除集成电路外部封装材料，暴露内部晶圆、键合线及焊盘结构。该环节需确保内部功能单元不受损伤，针对金线、铜线、镀钯铜线、银线等不同键合材料以及超小尺寸封装，公司采用差异化开封策略。
3	去层（Delayer）	采用反应离子刻蚀（RIE）等技术，逐层剥离芯片表面的介质与金属布线，实现下层电路的结构缺陷观测或电性探测，是一种更为精密的微区处理技术。通过等离子体轰击选择性去除氧化物（Oxide）、氮化物（Nitride）、聚酰亚胺（Polyimide）及硅（Si）等材料；对于高阶芯片及背照式（BSI）图像传感器等复杂结构，通过精确控制每一层的去除终点并结合物理研磨，避免过刻蚀对下层结构造成破坏。
4	聚焦离子束制样（FIB 制样）	依托双束电镜（Dual-Beam FIB）及等离子体聚焦离子束（Plasma FIB）设备，可对待测芯片开展高精度定点切割与精准制样；在离子束精确定位制样的同时，同步通过扫描电镜实时观测，可即时确认故障形貌特征，精准研判故障成因与失效机理，同时可为透射电镜表征分析提供标准待测样品。
5	高端线路修补（Circuit repair）	采用 Centrios FIB 专用设备（赛默飞旗下高端聚焦离子束专用设备）搭配 GDS（Graphic Design System，GDSII 芯片版图数据格式）自动导航定位软件，针对存在设计缺陷的芯片样品开展线路修补，重构并实现合规正确的设计逻辑；可全面适配铝制程、铜制程样品的电路改版修复。 本服务可助力芯片设计公司快速迭代优化设计方案、完成全新电路逻辑验证，大幅缩短研发迭代周期，同时规避因设计失误产生

序号	具体服务	具体内容
		的光罩（Mask）改版成本，有效节约研发时间与项目投入。

D.微观形貌表征

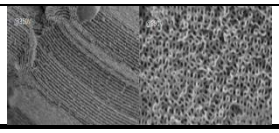
在完成样品制备后，公司会综合运用扫描电子显微镜形貌分析、透射电子显微镜形貌分析、聚焦离子束分析等多种检测手段，在微米乃至纳米尺度上对样品的内部结构、元素分布及污染物构成进行深入解析，进一步判别样品内部的缺陷。

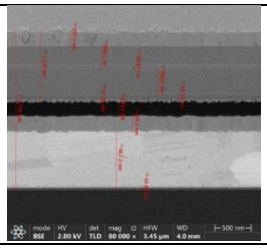
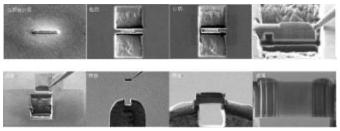
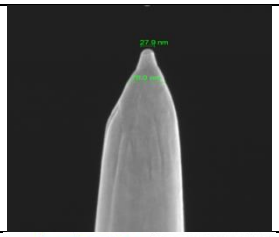
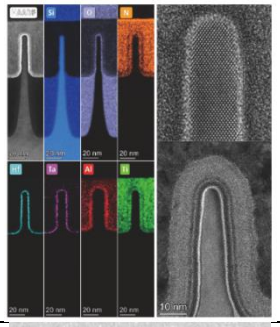
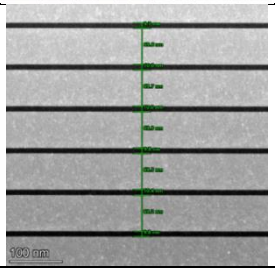
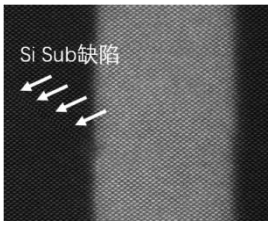
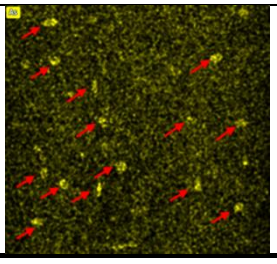
②材料分析

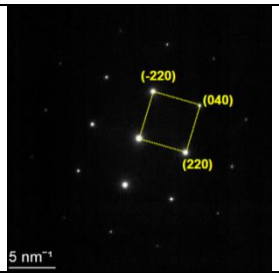
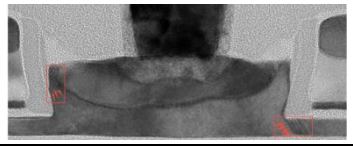
材料分析指通过实验分析手段对样品进行材料结构、成分及理化特性的分析，实现对样品的结构组织分布、元素比例构成、污染物等情况的深入分析判断。材料分析业务主要面向晶圆制造厂，一方面在其进行新工艺开发或产线验证过程中，验证产线中晶圆样品的内部结构及性能，以提供关键数据支持、实现缺陷判定，从而确定改进方向以提升良率；另一方面，在产线运行的日常质量监控中，亦有可能需要对质量的一致性进行破坏性物理分析。同时，在失效分析中，也会根据客户需求和案例复杂程度，综合运用材料分析及化学分析相关检测项目以进一步探究失效原因。

公司提供的材料分析检测实验手段主要提供聚焦离子束（FIB）双束系统分析测试服务、高分辨率透射电子显微镜（TEM）测试服务和化学分析服务。FIB 双束系统具备定点切割、截面制备与纳米级成像能力，适用于芯片内部结构的定点分析与缺陷定位；高分辨率 TEM 则可实现对材料原子级结构的直观观测，应用于晶格缺陷、界面态与材料相变等深层分析；化学分析通过构建高灵敏度痕量分析等手段，为客户提供精准的成分检测与杂质监控服务。公司擅长先进芯片样品的截面和平面分析，包含形貌观察、尺寸量测、元素分析及晶体学结构解析，能够获取适合纳米尺度结构的形貌表征，适用于硅、砷化镓、碳化硅、氮化镓等多种半导体材料分析。

具体检测项目及功能如下表所示：

类别	项目	具体介绍	功能展示
FIB 双束系统	表面成像	在极低加速电压下实现亚纳米性能的表征，从而显示极表面细致的信息。	

类别	项目	具体介绍	功能展示
分析测试服务	聚焦离子束加工及成像	利用透射电镜将离子束精确地聚焦在材料或器件的特定微区进行截面或平面切割，再用电子束对所切截面或平面进行成像；同时，通过对加工过程的实时监测，可实现边加工边观察，防止错过缺陷位置。	
	透射电子显微镜样品制备	透射电镜样品尺寸较小，检测前需利用高精度离子束进行定点切割，精准地控制样品厚度与样品质量，可以弥补扫描电镜在分辨率不足情况下的分析需求。	
	微纳米尺寸加工	通过各种微纳米器件或结构的加工和制备，获得高精度和高一致性的器件，如 APT 样品、AFM 探针、光学结构阵列器件等。	
高解析度 TEM 测试服务	形貌观察	透射电子显微技术拥有亚原子级别的分辨率，适合纳米尺度结构的形貌表征。公司可提供非球差透射电子显微镜系统测试服务和聚光镜球差校正透射电子显微镜系统测试服务，后者的最优扫描透射成像分辨率能达到 0.078nm，有效适配半导体器件的形貌观察。	
	尺寸量测	尺寸量测是半导体制造过程中工艺监测所需的最基本需求。通过准确地理解客户需求、识别器件结构，对得到的数据进行甄别，准确、客观地反馈测量结果。	
	高分辨成像	主要用于反应样品内部晶格的周期性规律。材料不同的结晶性质会影响材料的物理特性，针对半导体器件设计需要，不同功能区的材料需要设计成不同的结晶状态，如单晶、非晶或多晶状态等。同时，高分辨成像作为纳米级样品结构表征的有效技术手段，适用于半导体器件的微纳结构分析	
	（微量）元素分析	透射电子显微技术可有效适应微量元素分析。由于透射电子显微技术相关样品的厚度较薄，显著提高了能谱分析的空间分辨率，便于在半导体器件工艺监测或失效分析时，找到异常本源。	

类别	项目	具体介绍	功能展示
	衍射分析	透射电子显微技术区别于聚焦离子束和扫描电子显微镜双束系统的另一大优势是其具有衍射分析能力，即可以通过倾转晶带轴，使入射电子束平行于特定的晶面入射。	
	晶体缺陷分析	晶格缺陷是半导体制造过程中不可避免的现象，透射电镜测试服务可以表征纳米尺寸内的晶体缺陷，比如 SiGe 工艺中的位错观察等。	
化学分析	痕量金属杂质分析	公司化学分析实验室配备电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）、离子色谱仪（IC）、气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）等先进设备，痕量金属杂质分析可对半导体生产过程中使用的超纯水（UPW）、氢氟酸（HF）等数十种电子级化学品进行检测，金属杂质分析灵敏度可达 ppt（万亿分之一）级别。	
	晶圆表面金属污染检测	晶圆表面金属污染检测分析灵敏度可达 5×10^{8} atoms/cm²量级，能够有效识别影响器件良率的表面污染物。	

③可靠性测试

芯片可靠性测试通过调节温度、湿度、压力、电压等方式模拟高温、低温、高湿等复杂环境，以增强或加速器件潜在的故障暴露，评估产品在规定的寿命期间、预期的使用、运输或储存等环境下，能否保持功能可靠。可靠性测试在芯片设计阶段即识别并解决前述问题，对于芯片研发成功至关重要。

公司提供的可靠性测试服务包括工艺可靠性测试、封装级可靠性测试、产品级可靠性测试、板级可靠性测试、新能源可靠性测试，具体如下：

序号	可靠性测试	测试项目	检测场景与功能
1	工艺可靠性测试	氧化层完整性测试	主要为评估氧化层的可靠性，系破坏性测试，包括扫描电压电流和经时击穿两种方式
		热载流子注入测试	主要利用注入热载流子的方式推导器件使用寿命，广泛应用于小尺寸器件及大规模集成电路中
		负偏压不稳定性测试	主要为评估验证器件在高温环境下抗负偏压的性能和寿命
		阈值电压稳定性测试	基于 MOSFET 器件的阈值电压退化现象，用于检测 MOSFET 器件的可靠性

序号	可靠性测试	测试项目	检测场景与功能
		电迁移测试	主要通过施加温度和电流的方式，检测金属导线中的热载流子和电阻，用于判断器件失效的发生
		应力迁移测试	通过将芯片放置于特定温度下以特定时间，检测和评估芯片应力迁移的可接受程度
		其他测试项目	主要为未包含在检测标准的测试，包括针对客户开发新工艺，新器件或者新产品定制化的测试项目等
2	封装可靠性测试	预处理（Precon, PC）	通过模拟芯片贴到测试载板的过程，检测芯片内的潮气，以及在瞬间高温的情况下是否会出现分层、失效等
		温湿度偏压寿命试验（THB）	基于定制化温湿度测试板和测试插座，主要用于检测芯片对湿气的抵抗性以及芯片封装的气密性
		高加速应力试验（B-HAST/U-HAST）	通过施加偏压（Bias）或不施加偏压（Unbiased）的高温高湿环境，用于检测芯片对湿气的抵抗性以及芯片封装的气密性
		高低温循环试验（TCT）	通过调节芯片测试温度条件以及循环测试次数等方式检测芯片封装材料的膨胀系数，以评估其封装效果
		高温蒸煮试验（PCT）	主要通过不加电的方式，用于检测芯片对湿气的抵抗性以及芯片封装的气密性
		高温储存试验（HTSL）	主要通过不加电的方式，用于检测芯片存储年限以及界面金属共化物的生长情况
		功率温度循环试验（PTC）	在施加功率的条件下进行温度循环测试，评估功率器件在电热耦合应力下的可靠性
		低温储存试验（LTSL）	评估芯片在低温储存环境下（如-55℃）的长期可靠性
3	产品可靠性测试	高温工作寿命测试（HTOL）	评估元器件在高温环境下的耐久性和寿命
		低温工作寿命测试（LTOL）	常用于发现由热载流子效应等引起的特定失效模式，或验证存储器、亚微米尺寸器件在低温环境下的功能稳定性
		早夭寿命失效率测试（ELFR）	基于产品失效率的“浴盆曲线”理论，通过加速应力筛选出早期失效品，评估产品在早期使用阶段的失效率
		软失效测试（SER）	通过辐射等手段测试芯片发生软错误的概率，评估其在航空航天、军事、车载等高可靠性应用场景下的抗辐射能力及数据完整性
		存储类芯片非易失性测试（EDR）	对非易失性存储器进行反复擦写循环（如 10,000 次）后进行高低温实验和 ATE 测试，评估其数据保持特性、耐久性及在复杂环境下的读写稳定性

序号	可靠性测试	测试项目	检测场景与功能
		模拟人体接触集成电路时产生的静电放电（HBM）	模拟人体接触器件时产生的静电冲击，以评估电子器件抗静电放电能力
		模拟半导体电子器件在生产或运输中积累静电后接触导体时的快速放电测试（CDM）	模拟电子器件在生产或运输中积累静电后接触导体时的快速放电现象，以评估电子器件抗静电放能力
		闩锁效应测试（Latch-up）	评估集成电路在过电压、过电流或温度异常时触发低阻抗寄生结构导致器件锁死的可靠性测试
		传输线脉测试（TLP）	通过纳秒级方波脉冲获取器件 I-V 曲线，可量化二次击穿电流（It2）、触发电压（VT1）等动态参数
		超快传输线脉测试（VF-TLP）	针对先进工艺节点 ESD 防护设计的超快传输线脉冲测试，通过纳秒级方波脉冲（脉宽可低至 1.25ns）精确获取器件的动态 I-V 曲线，能有效表征二次击穿电流（It2）、触发电压（VT1）等关键参数，相比传统 TLP，其优势在于更短的上升沿（<1ns）和更快的脉冲速度，可模拟高频静电瞬变场景，尤其适用于 FinFET、GAA 等先进制程芯片的 ESD 失效机理分析
4	板级可靠性	温循测试（BLTC）	模拟产品全生命周期高低温交替环境变化，评估整体互连结构长期耐温变疲劳寿命
		跌落测试（BLDT）	模拟终端整机意外掉落、搬运磕碰、装配撞击、手持设备自由跌落等瞬时冲击工况。考核 PCB 焊点、芯片封装、补强结构的抗瞬时冲击能力
		三/四点弯曲测试（3/4-Point Bend）	模拟整机装配锁螺丝受力、壳体挤压、主板安装形变、局部静态弯折、结构组装带来的恒定弯曲应力。三点弯较四点弯应力集中，有剪切应力影响，四点弯应力均匀，无剪切干扰，更接近真实装配模拟
		振动测试（VFV）	模拟车载颠簸震动、工业设备长期运转振动、运输全程颠簸、户外设备环境共振、机械结构持续抖动。验证 PCBA 长期动态抗振动疲劳能力
		循环弯曲测试（Cycling-Bend）	模拟整机反复按压、插拔形变、手持弯折、机身反复扭曲、柔性/薄款产品日常反复形变使用场景。考核长期反复形变下的互连耐久寿命
		球形弯曲测试（Spherical bend）	模拟整机多点受力、整机扭曲形变、大面积主板整体受压、壳体全域挤压、复杂三维装配形变。覆盖多角度、多方向复合拉扯与弯折，考核大尺寸 BGA、大面积 PCB 整板互连可靠性，暴露边角、

序号	可靠性测试	测试项目	检测场景与功能
			区域化隐性开裂问题
5	新能源可靠性测试	组件标准化性能测试	主要包括最大功率与标准性能测试、温度特性测试、热斑耐久性评估、环境应力可靠性测试、机械强度与载荷测试、材料与粘接可靠性测试、光致衰减及电学稳定性等，验证组件质量及安全性
		组件差异化性能测试	包括盐雾腐蚀测试、氨腐蚀测试、沙尘测试、防火测试等，验证组件在沿海、养殖场、荒漠、屋顶等特殊环境下的稳定性
		组件户外实证	气候适应性实证、产品对比实证、系统应用实证、特定应力研究等，评估户外实际发电性能，分析性能衰减与失效模式，校准预测模型与验证加速老化等

（2）检测硬件产品

公司起步于半导体测试及可靠性认证所需的中高端集成电路测试板业务，经过了近二十年的技术沉淀，可为客户提供集成电路测试板、测试插座、检测仪器设备等检测硬件产品。

①集成电路测试板

集成电路测试板，是一种用于测试半导体器件性能、可靠性的电路板或模块，从芯片设计到量产过程中涉及的可靠性测试、晶圆测试和芯片成品测试均需要定制化设计测试板，在半导体制造和测试过程中起到了关键作用。

随着芯片功能和设计复杂性的日益提升，集成电路测试板亦面临着测试覆盖率、信号完整性、测试时长、可靠性和耐用性等挑战。公司集成电路测试板具有高层数、低信号耗损、大电流属性和高机械精度等优势，主要体现如下：

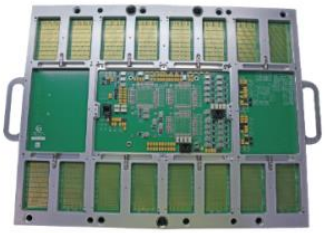
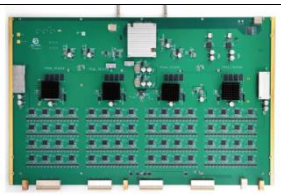
高层数：公司提供的高层数测试板能够在一个相对较小的物理空间内容纳更多的测试电路，从而提高测试的效率和覆盖范围。

低信号耗损：公司通过采用低耗损的材料、优化电路布局和抑制信号干扰等方式实现低信号耗损，能够为客户提供准确的、可靠的测试结果。

大电流属性和高机械精度：公司提供的测试板支持更高的电流传输速率，能够适配大电流特性，确保测试过程中的电流供应稳定，避免因电流不足或不稳定而影响测试结果。同时，减少信号损耗和干扰，以及测试过程中的停顿和错误。

公司配备两条特色产线可直接服务于公司测试板产品的制造，分别针对大尺寸厚板与高精度芯片（如系统级封装）贴装需求，专注于芯片测试板卡及小批量高端 PCBA 的精密贴装。

公司在测试板方面形成了较强的技术实力，可为各类芯片定制化设计提供测试载板、老化板、系统板、测试插座等产品，具体情况如下：

产品名称	具体介绍	产品图示
测试载板（ATE FT Load Board）	测试载板是芯片成品测试（FT）的核心接口设备，主要用于封装后集成电路的性能验证与良率筛选。其通过连接自动测试设备与被测芯片，实现对电源负载、高速信号完整性及开短路等电学参数的综合检测，确保芯片功能符合设计规范要求。在工作过程中，被测芯片通过载板上的专用测试插座与测试机台建立电气连接，由测试机向芯片输入特定信号并采集反馈数据，载板则负责传输高频信号和稳定电源，并保障信号完整性。	
老化板（Burn-in Board）	老化板专用于芯片可靠性验证，通过模拟高温、高电压、高负载等严苛工作环境，加速芯片潜在缺陷的暴露。其主要支持老化测试、高温工作寿命测试（HTOL）与高加速应力测试（HAST）等关键评估项目。在测试中，芯片通过插座与老化板连接，整体置入高温测试机箱中持续运行。为满足长期高温环境下的稳定性要求，老化板在材料选择（如耐高温板材）、元件布局及散热设计方面均需采用特殊方案。	
系统板	系统板主要用于芯片设计前期的功能验证与硬件原型开发，在流片前为客户提供可编程、可重构的硬件环境，支持设计调试与性能评估。	
测试插座（Socket）	测试插座是连接芯片与测试板的精密接口装置，其通过弹性探针或接触结构建立稳定电气连接，实现测试信号传输与电源加载，确保芯片引脚与测试主板间的信号完整性。该产品支持芯片的快速插拔与更换，避免重复焊接带来的损伤，显著提升测试效率并降低研发与生产成本。公司产品线涵盖 ATE 测试座、老化测试座及多种封装形式的定制化解决方案。	

②检测仪器设备

基于长期以来的技术积累，为更好满足客户个性化的检测需求，公司为客户提供手动探针台、SoC 可靠性测试机、存储芯片可靠性测试机、三维超景深显微

镜等仪器设备。

产品名称	具体介绍	产品图示
手动探针台	手动探针台是为晶圆、芯片及微型元器件提供电性能参数分析的精密平台，广泛应用于研发验证、失效分析及小批量测试场景。其通过微米级精度的位移控制系统与探针组件，将外部测试仪器连接至测试点。公司具备手动探针台核心部件的自主研发与制造能力，包括探针台、针座、针杆及温控样品台（Chuck）等，可针对客户需求提供定制化设计，目前已交付数百台设备。	
SoC 可靠性测试机	该设备是公司自主研发的新一代数字老化测试设备，专为芯片的高温工作寿命测试（HTOL）和量产老化测试场景设计，具备 184 个双向 I/O 通道、20MHz 测试频率，支持室温至 150℃的独立温区控制，已应用于车规、高性能计算等对可靠性要求较为严苛的领域。	
存储芯片可靠性测试机	该设备是公司自主研发的面向 FLASH、SRAM 等存储芯片的专业老化测试设备，支持-40℃至 150℃的独立温区控制，可实现高效能热管理，显著降低能耗。该设备提供主流封装测试公板，支持自动化 Pattern 生成与量产场景下的统一数据管理，并创新集成片上失效芯片定位功能，可精准输出包含错误 Cycle、地址位、数据位等参数的失效分析报告，有效提升客户在高端芯片可靠性验证与故障溯源环节的效率和精度。	
三维超景深显微镜	该设备具备 20 至 2000 倍光学放大能力，支持自动对焦、镜头切换、2D/3D 图像拼接及真彩色三维重构功能，可实现对复杂几何结构微器件的三维立体观测与定量测量。该设备通过超景深合成技术辅助实验室解决传统显微镜在立体样品观测中的焦平面模糊问题，可清晰呈现芯片焊点、通孔、侧壁等微观结构的形貌与缺陷。	

（3）量产业务

①量产测试服务

公司的量产测试业务主要包括晶圆测试（Chip Probing，简称 CP）、成品测试（Final Test，简称 FT）、系统级测试（System Level Test，简称 SLT）以及老化测试（Burn In，简称 BI）。量产测试业务依托自动化测试设备、老化测试机、数字化管理系统以及覆盖宽温区的测试环境，主要服务于高可靠性芯片（如车规

级芯片）的测试需求。其中，系统级测试与老化测试是针对高可靠性芯片设计的测试模块，季丰电子在这两项测试上具备差异化的技术能力与方案优势，形成了区别于竞争对手的核心竞争力。

A.晶圆测试

晶圆测试指通过探针台和测试机的配合使用，对晶圆上的裸芯片进行功能和电参数测试，主要在晶圆制造后、芯片切割封装前进行，以筛选出不良品，避免后续封装成本浪费。公司晶圆测试能力覆盖 6 英寸至 12 英寸晶圆，支持最薄 200 微米的超薄晶圆及凸点工艺测试。针对车规芯片的高可靠性要求，公司提供-55℃至+200℃的三温测试条件。

B.成品测试

成品测试指通过分选机和测试机的配合使用，对封装完成后的芯片进行功能和电参数测试，主要在封装完成后进行，以确保产品达到设计规格和质量标准。公司在此环节提供-60℃至+175℃的三温成品测试等服务，公司能力覆盖 QFP、QFN、BGA、LGA、CSP 等主流封装类型，并集成制造执行系统（MES）实现测试数据实时监控与可追溯分析。

C.系统级测试

系统级测试系在仿真的终端使用场景中对待测芯片进行测试。系统级测试通常采用一块模拟终端使用场景的系统板（System Board），板上包含待测芯片运行所需的供电、时钟、存储及外围接口等，由外部测试主机控制整个测试流程的执行。因芯片系统级测试为模拟真实终端使用场景的功能测试，被广泛应用于车规生产测试流程中；同时，由于芯片系统级测试的特殊性，通常会在芯片系统级测试后添加功能和电参数测试，以保证通过芯片系统级测试良品的整体质量。

D.老化测试

老化测试系通过提高环境温度和高电压加速老化，提前激发早期失效并剔除存在潜在缺陷的芯片的过程。老化测试的核心是不能显著影响芯片的使用寿命，测试时长因芯片类型而异，典型的老化测试时间为 8 至 12 小时。在老化测试后，需要执行功能和电参数测试来筛选出失效样品。该测试是芯片成品测试中成本最高的环节，通常在拥有高质量、高稳定性要求的车规级芯片测试中执行。

②电子制造服务（EMS）

随着终端应用对集成度与可靠性要求的不断提高，芯片设计公司正从单一芯片向模组化、系统化方向延伸，对系统级模组业务及与之配套的高端模组制造设备能力的需求日益增长。公司依托在第三方实验室领域积累的深厚的分析和验证能力，基于原有为制造集成电路测试板所储备的技术能力及团队，于 2025 年开始规模化投入电子制造服务（EMS）业务。公司现已配备 6 条专业产线，包括 2 条车规电子线、2 条高速贴装线、2 条 SIP（系统级封装）线，具备万级洁净环境、行业领先的制造及检验设备、严谨标准的工艺流程，并通过了 IATF16949 车规质量管理体系、ISO13485 医疗器械质量管理体系、ISO14001 环境管理体系及 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。公司可为芯片设计公司及系统厂商提供专业的车规级、医疗级及 SIP 系统级组装服务。

目前，该业务仍处于建设初期及客户导入阶段。

（4）工程样品封装及其他

此外，公司围绕客户需求布局了工程样品封装、实验室建设等其他业务。

①工程样品封装

工程样品封装业务是指在芯片研发验证阶段，为工程批晶圆提供的快速、小批量、低成本的封装解决方案，目的是在最短时间内把裸芯片加工成可用于电气测试、功能验证及失效分析的工程样品。

公司于 2019 年开始布局工程样品封装业务，可以支持塑封、陶瓷管壳封装及板级封装（Circuit On Board，简称 COB）等多种工艺类型，提供晶圆减薄、划片到固晶、键合、塑封、激光刻标、管脚整形、自动化光学检测等封装全流程。该工程样品封装业务可将传统需 2-3 周的封装周期缩短至最短 24 小时内完成，并提供失效分析所需的样品制备、芯片重组（Re-bonding）等配套服务，显著优化了客户在芯片功能测试、可靠性认证、失效分析阶段的时效性，与公司第三方实验室服务形成深度协同。

②实验室建设

公司在半导体检测分析服务领域积累了深厚的实验室建设与运营经验，目前

已建成多个专业类型的第三方实验室，并在全国范围内具备一定影响力。因此，客户委托公司提供实验室布局规划、设备选型配置、实验室管理系统开发及实验室后续运营等服务内容。

（三）营业收入构成

报告期内，公司主营业务收入具体构成情况如下：

单位：万元

类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第三方实验室检测分析服务	23,002.57	61.60%	42,437.31	64.02%	37,862.80	65.70%	27,760.40	63.78%
检测硬件产品	8,561.62	22.93%	15,333.34	23.13%	12,473.52	21.65%	11,437.15	26.28%
量产业务（量产测试及电子制造服务）	3,997.05	10.70%	5,720.57	8.63%	3,980.29	6.91%	3,292.01	7.56%
工程样品封装及其他	1,779.75	4.77%	2,796.46	4.22%	3,311.05	5.75%	1,036.59	2.38%
合计	37,341.00	100.00%	66,287.68	100.00%	57,627.66	100.00%	43,526.14	100.00%

（四）主要经营模式

1、盈利模式

公司围绕芯片设计、晶圆制造、封装测试等半导体全产业链企业的检测需求，提供第三方实验室检测分析服务、检测硬件产品、量产业务、工程样品封装及其他业务，盈利模式分别如下：

（1）第三方实验室检测分析服务

公司向芯片设计企业、晶圆制造厂、封装厂等半导体全产业链客户提供失效分析、材料分析、可靠性测试等第三方实验室服务，服务环节包括客户送样、方案制定、样品制备、上机观测、数据分析、报告出具等，以此获取收入及利润。

（2）检测硬件产品

公司从事集成电路测试板的研发、设计、制造与销售，主要通过直接向客户销售 ATE 测试板、可靠性测试板、系统板等实现收入和利润；同时，公司自主研发的测试插座，以与测试板配套销售为主、单独销售为辅。另外，公司自主研发手动探针台、可靠性测试机等检测仪器设备并对外销售。

（3）量产业务

在规模量产阶段，公司为客户提供量产测试和电子制造服务，其中量产测试包括晶圆测试、成品测试、系统级测试及老化测试等，电子制造服务包括芯片封测后 PCBA 模组的生产、组装与交付。

（4）工程样品封装及其他

公司向客户提供工程样品封装服务及实验室建设业务。

2、采购模式

第三方实验室检测分析服务板块，公司主要采购检测分析仪器、实验耗材等。其中，检测分析仪器主要为开展检测分析的专用仪器设备，包括扫描电子显微镜、透射电子显微镜、聚焦离子束显微镜、半导体芯片静电放电和闩锁效应测试系统等；试验耗材包括离子源、化学试剂、砂纸、载治具等，用于辅助完成检测分析。同时，在出现临时性设备检测产能紧缺或面对少量超出自身检测能力范围的检测项目时，公司会委托第三方检测服务机构完成部分检测项目。

检测硬件产品板块，公司主要采购电子元器件，包括 PCB 裸板、芯片、连接器、结构件、电容电阻等。

量产业务板块，公司主要采购探针台、测试机、分选机等专用设备用于量产测试业务，采购印刷机、贴片机、回流焊炉等专用设备用于电子制造服务（EMS 业务）。

公司已建立规范完善的采购管理机制，制定了《采购管理制度》等内部规范，对采购流程、供应商管理实施管控。在采购执行流程方面，业务部门提交需求申请，明确物品规格、技术指标及使用用途。对于设备等固定资产采购，采购执行过程中需匹配年初制定的采购预算条目，如果是预算外采购，需事先审批，经批准后先增加预算再执行采购。采购部在受理需求后，依据公司供应商准入标准开展资质审核，审核内容包括企业资质、质量体系、实地考察情况等，综合评估质量、价格、交期与服务等因素后确定合作供应商，与供应商签订采购合同，并视情况附加保密、质量及廉洁协议。合同审批实行分级授权机制，依据采购类别与金额设置相应审批权限，确保权责清晰、风险可控。采购物资到货后，由需求部门进行质量评估及验收确认，其中固定资产需填写《收货单》《验收单》，办理

固定资产验收审批及登记，验收合格后依据合同约定及审批流程办理入库及付款结算。

3、生产/服务模式

公司主要采用以客户需求为导向的订单驱动模式，以销定产。

在第三方实验室检测分析业务中，公司根据待测样品情况和客户需求设计检测分析方案，按照检测分析方案对样品进行制备、观测和分析，最终向客户提供检测分析结果或检测分析报告。

检测硬件产品板块，主要包括集成电路测试板业务、测试插座、检测仪器设备业务。在集成电路测试板业务中，公司专注于集成电路测试板的研发、设计，并将测试板设计方案发送至制板供应商，制板供应商完成 PCB 裸板的生产后交付给公司，公司贴片安装辅材后出售。在测试插座业务中，公司自 2024 年开始自行设计和生产测试插座。在检测仪器设备业务中，探针台、可靠性测试机等检测仪器设备由公司自主研发和生产。

在量产测试业务中，公司根据客户订单及自身产能情况安排，提供晶圆测试（CP）、成品测试（FT）、系统级测试（SLT）、老化测试（BI）等服务。在电子制造服务中，公司根据客户订单，提供 PCBA 模组生产、组装与交付的服务。

其他业务板块，工程样品封装由公司自有产线完成。

公司制定了多维度的生产管理制度和标准化的作业流程，并根据达成情况和不同客户需求进行持续优化升级，同时依托上海、北京、杭州、深圳、成都等地实验室多点布局模式，确保公司检测分析服务和检测硬件产品交付的质量和时效性。

4、营销及管理模式

公司的销售模式为直销模式，直接面向半导体全产业链客户提供检测分析服务与检测硬件产品。公司以上海为总部，通过在北京、杭州、深圳、成都等半导体产业集聚地设立子公司，构建了贴近核心客户区域的服务网络，有效提升了本地化响应速度与服务质量。凭借在半导体检测领域积累的技术实力与项目经验，公司能够深度理解并快速响应客户在研发、验证及量产等环节的差异化检测需求。

公司已组建一支兼具专业技术背景与市场开拓能力的销售团队，通过直接洽谈、客户引荐、会议论坛、网络宣传、举办体育活动等多种渠道开拓并维护客户关系，目前已为超过 3,000 家客户提供服务。在内部管理方面，公司建立了规范的销售内控制度和销售人员激励政策，对客户信息档案实施动态跟踪，并依据内部服务收费标准、项目复杂度、客户资信状况及合作历史等因素，与客户协商确定价格并实施差异化的信用政策，从而在保障服务品质与客户满意度的同时，有效控制运营风险。

5、研发模式

公司以自主研发为主，坚持以市场需求与技术前沿为导向，持续开展研发活动，并根据《研发项目管理制度》等内部制度进行研发流程管理。

公司的研发需求主要来源于三个维度：一方面，紧密跟随半导体产业链的技术演进，针对先进制程、先进封装及新材料应用带来的检测挑战进行前瞻性技术布局；另一方面，深度响应客户在研发与量产中遇到的实际问题，特别是在失效分析、可靠性测试及特定应用场景（如车规芯片）认证中提出的具体需求；此外，依托深厚的测试技术积淀，公司大力开展高端检测设备的自主研发，不仅精准解决市场前沿定制化的复杂测试需求，并逐渐推广转换成通用设备，更致力于打破核心设备外部依赖。

在研发活动的开展方式上，公司以自主研发为核心，建有专业实验室并配备了相应设备及团队。同时，公司高度重视与产业界及学术界的协同创新，例如与上海交通大学合作研发，并与产业链企业建立联合实验室共同开展功率半导体等领域的技术攻关，以实现资源共享和优势互补。

公司的研发团队由电子、材料、化学、机械、软件等跨学科专业人才组成。团队核心成员普遍拥有在芯片设计、晶圆工艺、封装、测试等集成电路行业知名企业的任职经历，积累了丰富的工程实践经验，能够针对复杂问题提出切实可行的解决方案。

研发活动所产生的成果，主要体现在检测方法与服务方案的创新、定制化的硬件与仪器设备以及相关知识产权积累三个层面。公司不仅致力于改进和创造新的检测分析方案，也自主研发相关的测试板及检测仪器。这些研发成果最终通过

申请专利等形式进行保护，并成功应用于对外提供的技术服务与硬件产品中，实现了有效的成果转化。

公司研发活动可分为立项、开展与结项阶段。在立项阶段，各事业部基于前期调研情况及行业技术动向，组建项目团队，提交立项申请及《研发项目立项书》，经审批通过后正式立项；在项目开展阶段，研发项目负责人根据立项审批情况，具体开展研发活动；在结项阶段，研发项目负责人提交结项申请及《研发项目结项书》，对项目执行情况进行总结、对比项目技术目标与完成情况，经公司内部审批后项目正式结项。

6、经营模式的形成原因、影响因素及变动趋势

公司目前采用的经营模式，与公司所处的行业特征、公司在行业中的竞争地位、企业自身的发展阶段、公司的产品结构及产品的上下游市场相关。影响公司经营模式的关键因素包括客户的性质及经营需求、产品技术水平、供应商供给等。

公司主要经营模式及影响的关键因素在报告期内保持稳定，无重大变化，预计未来也不会发生重大变化。

（五）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

公司成立于 2008 年，起步于系统级测试及可靠性认证所需的中高端集成电路测试板业务。2014 年，公司开始尝试切入第三方实验室检测分析业务。2018 年，公司紧抓国内半导体产业发展机遇，全面切入第三方实验室检测分析业务，并开始向半导体领域检测硬件方案与检测分析服务的全功能、一站式解决方案提供商转型。2021 年开始，公司在北京、深圳、杭州、成都等地区设立子公司进行区域扩张，公司业务规模快速增长。2022 年，公司开始拓展量产测试业务。2025 年，公司拓展电子制造服务（EMS）业务。公司发展历程的关键节点如下：

重要时间节点	事件
2008 年	季丰电子成立，从中高端集成电路测试板业务起步
2014 年	初步切入可靠性测试、失效分析、材料分析等业务
2018 年	全面切入第三方实验室检测分析业务，新增 ATE 测试（利用自动测试设备对芯片进行测试）业务
2019 年	增加快速封装、仪器设备及系统软件的研发业务，开始向检测硬件方案与检测分析服务的全功能、一站式解决方案提供商转型
2021 年	在浙江嘉兴、浙江杭州、北京、深圳设立子公司进行区域扩张，公司营业收入首次破亿

重要时间节点	事件
2022 年	新增衢州季丰拓展新能源检测业务，在成都区域扩张，新增量产测试业务
2024 年	新设上海季丰技术、北京亦庄季峰，并拓展测试插座的研发及生产业务
2025 年	新设 EMS 事业部，并进一步加大量产业务板块的资源投入

（六）发行人主要业务经营情况和核心技术产业化情况

公司自设立以来深耕半导体检测领域，在第三方实验室检测分析、集成电路测试板设计与仿真、量产测试业务等方面形成了一系列核心技术。公司核心技术均围绕检测服务与检测硬件产品产业化，促使公司经营规模稳步增长。目前公司核心技术已经完全实现产业化，报告期内，公司核心技术形成的收入及占主营业务收入的比例具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
核心技术形成的收入	**34,349.54**	62,203.90	53,135.99	41,230.39
主营业务收入	**37,341.00**	66,287.68	57,627.66	43,526.14
占比	**92.01%**	**93.84%**	**92.21%**	**94.73%**

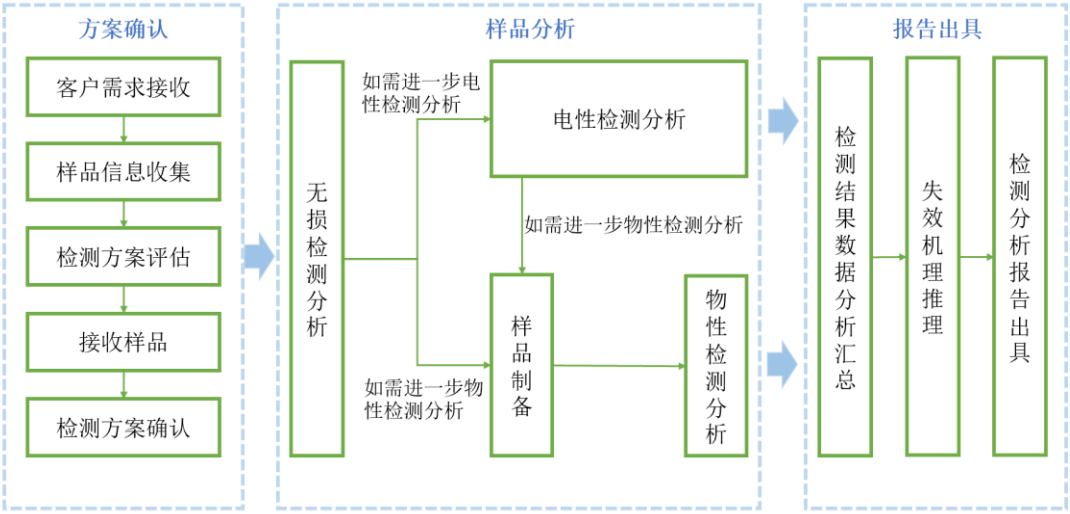
如上表所示，报告期内，公司始终围绕核心技术开展主营业务，核心技术开展生产经营所产生的收入占公司主营业务收入的比例均超过 90%，非核心技术收入主要为电子制造服务、工程样品封装及其他产生的收入，占比较小。

（七）主要产品或服务的工艺流程

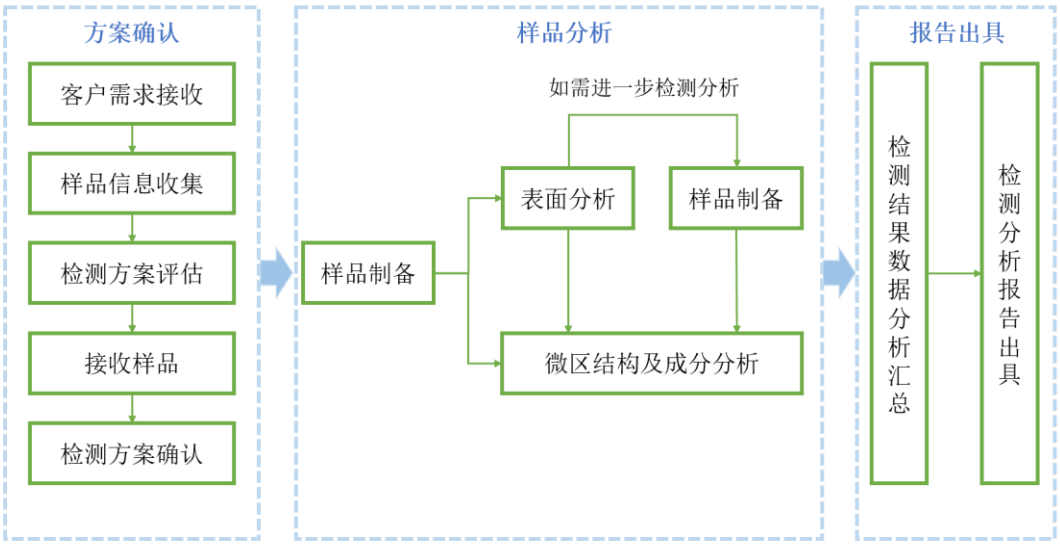
公司产品及服务的主要工艺流程如下图所示：

1、第三方实验室服务工艺流程

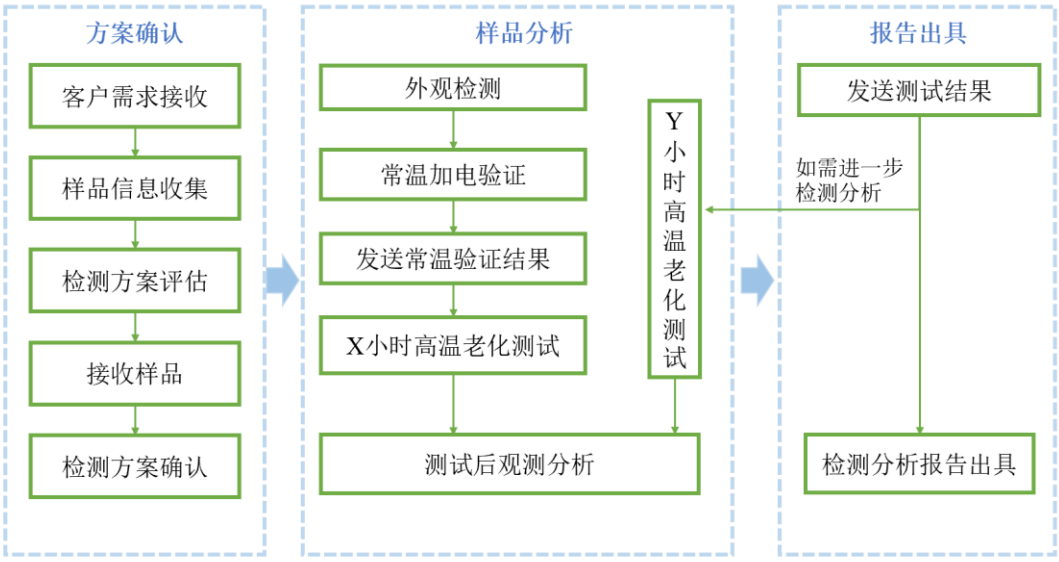
（1）失效分析（FA）



（2）材料分析（MA）

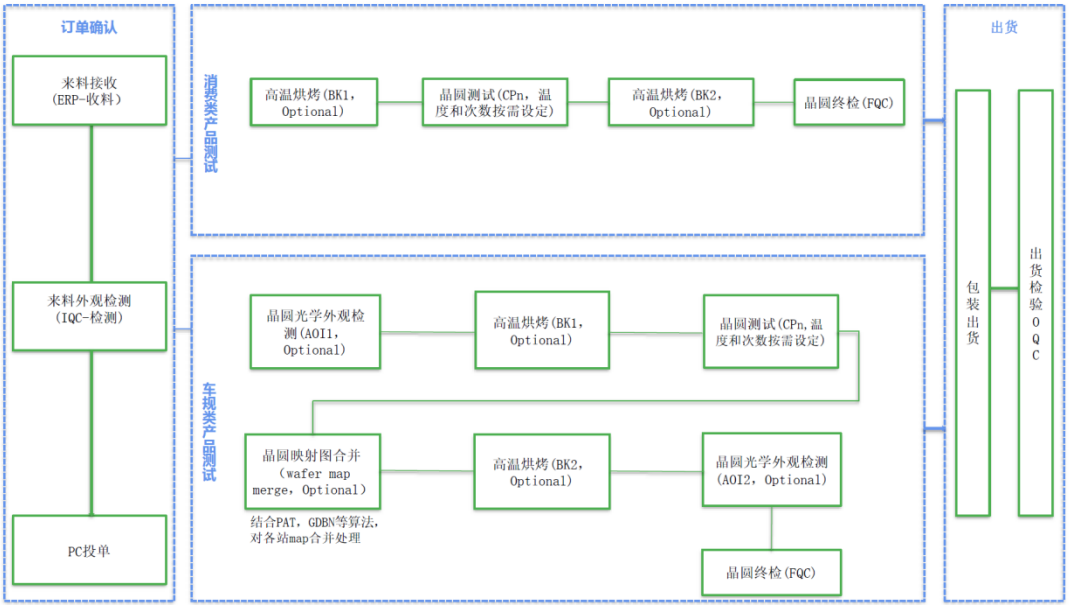


（3）可靠性测试（RA）

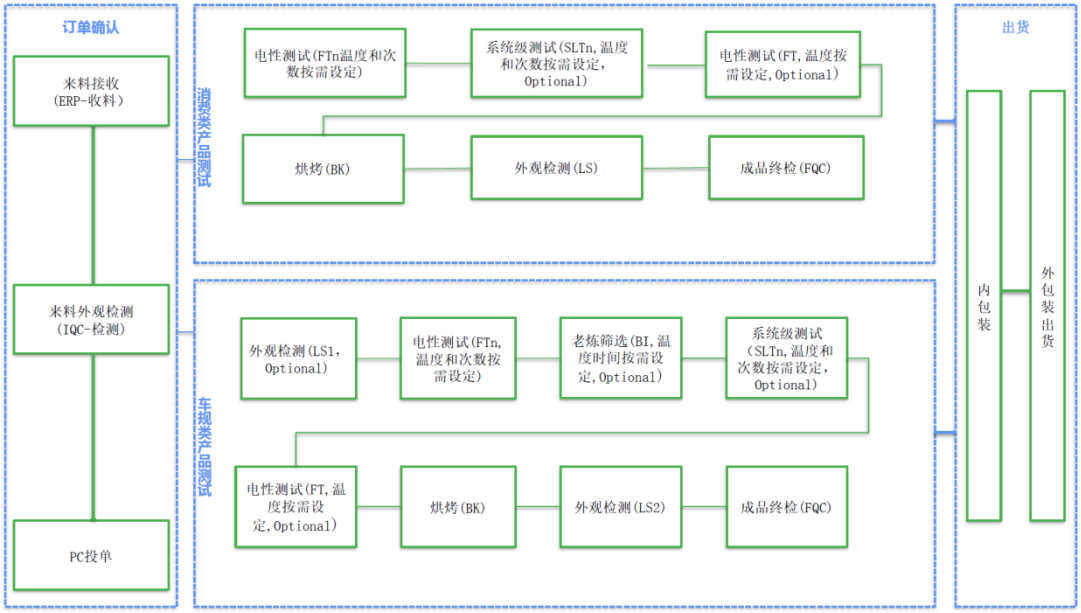


2、高可靠性芯片量产测试服务工艺流程

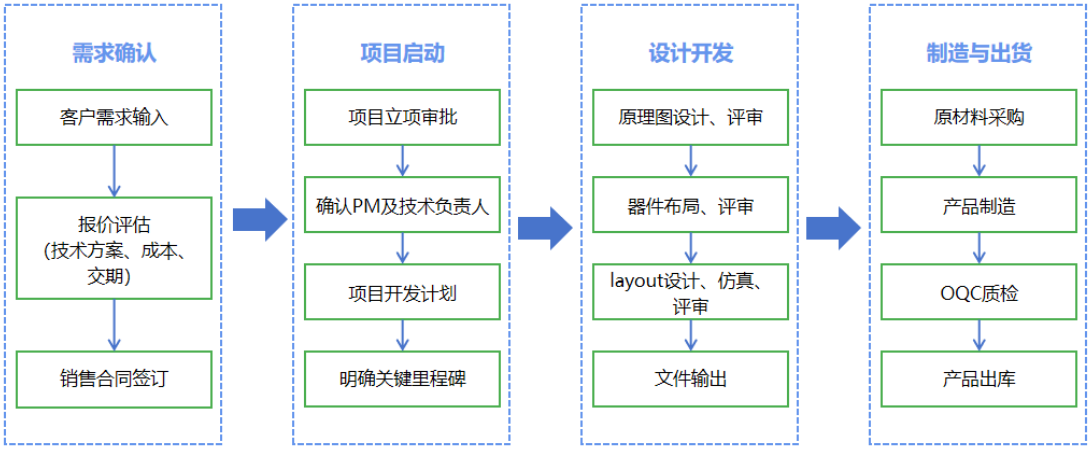
（1）晶圆测试



（2）成品测试



3、集成电路测试板工艺流程



（八）具有代表性的业务指标变动情况及原因

发行人所属行业代表性业务指标为主营业务收入、主营业务毛利率和净利润，具体情况请参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“七、经营成果分析”。

（九）发行人符合产业政策和国家经济发展战略的情况

公司围绕芯片设计、晶圆制造、封装测试等半导体全产业链企业在研发验证、工艺优化、可靠性评价、质量控制和量产导入等环节的检测需求，提供第三方实验室检测分析服务、检测硬件产品以及量产测试服务。公司主要服务集成电路产业链，公司核心业务属于集成电路产业链关键技术攻关、工程化验证和质量可靠性保障的重要配套环节，对我国半导体产业实现技术演进、工艺进步、质量提升，

进而实现自主发展有积极作用。

根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司核心业务均属于战略性新兴产业。其中第三方实验室检测分析服务对应“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.4 新型信息技术服务”之“国民经济行业代码 6560*信息技术咨询服务”之“测试评估认证服务”；检测硬件产品对应“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，集成电路相关的“先进封装与测试”“集成电路装备及关键零部件”属于鼓励发展类条目。

从国家战略布局来看，集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性、先导性产业。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出，加强原始创新和关键核心技术攻关，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。同时，提出推动科技创新和产业创新深度融合，布局建设概念验证、中试验证平台，加大应用场景建设和开放力度。公司业务与“十五五”时期全链条推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关的政策方向一致，公司符合国家产业政策和经济发展战略。

二、发行人所处行业情况

（一）所属行业及确定所属行业的依据

公司是一家半导体领域检测服务与检测硬件产品的全功能、一站式解决方案提供商，向半导体产业链企业提供第三方实验室检测分析服务、集成电路测试板等检测硬件产品，以及量产测试服务。

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司的第三方实验室检测分析服务所处行业为“M 科学研究和技术服务业”之“74 专业技术服务业”之“745 质检技术服务”之“7452 检测服务”，同时，公司也属于“6560 信息技术咨询服务”行业。公司的检测硬件产品所处行业为“C 制造业”之“39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“398 电子元件及电子专用材料制造”

之“3982 电子电路制造”。公司的量产测试服务所处行业为“C 制造业”之“C3973 集成电路制造”。

根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司的第三方实验室检测分析服务所属行业对应“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3-4 新型信息技术服务”之“国民经济行业代码 6560*信息技术咨询服务”之“测试评估认证服务”。根据《2017 年国民经济行业分类注释》，前述“测试评估认证服务”包括“软件测试、硬件测试、网络测试、信息安全测试、质量管理评估……”，公司针对半导体样品提供的检测分析实验属于“硬件测试”，顺应国家战略性新兴产业发展规划要求，可进一步提升信息技术产业核心基础硬件供给能力。公司的检测硬件产品所处行业对应“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2-1 新型电子元器件及设备制造”。公司的量产测试服务所处行业对应“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造”。

（二）行业的主管部门、监管体制、行业主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	工业和信息化部	主要负责工业行业和信息化产业的监督管理，针对集成电路产业负责制订行业的产业政策、产业规划，组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业的发展方向进行宏观调控。
2	国家市场监督管理总局	主要负责市场综合监督管理，统一登记市场主体并建立信息公示和共享机制，组织市场监管综合执法工作，承担反垄断统一执法，规范和维护市场秩序，组织实施质量强国战略，负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。
3	国家质量监督检验检疫总局（AQSIQ）	国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的直属机构。下设认监委（CNCA）和标准委（SAC），职责分别为统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作和统一管理全国标准化工作。
4	国家认证认可监督管理委员会（CNCA）	国务院决定组建并授权，履行行政管理职能，统一管理、监督和综合协调全国范围内的认证认可工作的主管机构，其主要职责包括管理相关校准、检测、检验实验室技术能力的评审和资格认定工作。
5	中国合格评定国家认可委员会（CNAS）	为国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检验机构等相关机构的认可工作。主要职责包括建立并运行合格评定机构国家认可体系，制定并发布认可工作的规则、准则、指南等规范性文件，对境内外提出申请的合格评定机构开展能力评价等。

序号	行业主管单位	监管内容
6	中国半导体行业协会（CSIA）	行业自律组织，在工信部的指导和管理下，主要负责制定行业发展战略、发展规划、产业政策及市场研究，向会员单位和政府有关部门提供行业引导和咨询服务，代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见等。

2、行业的主要法律法规及政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》	-	-	2025.10	加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。 推动科技创新和产业创新深度融合，布局建设概念验证、中试验证平台，加大应用场景建设和开放力度。
2	《上海市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	-	-	2026.2	强化工业服务业对产业转型升级的支持赋能作用，提升工业设计、产业互联网、检验检测认证、智能运维等服务能级，探索共享制造、柔性制造等新模式，持续提高服务型制造竞争力。 协同促进制造业数智化转型，提升工业设计、检验检测、认证认可等生产性服务业服务辐射功能。
3	《上海市促进检验检测认证行业高质量发展行动方案（2025—2027年）》	沪市监认检〔2025〕83号	上海市市场监督管理局	2025.3	明确集成电路检测技术突破与平台建设，在汽车、集成电路、新能源、电气装备、建设工程、仪器仪表等细分领域，靶向培育一批领军企业；加快建设国家汽车芯片质检中心，推动自主芯片质量提升和装车应用；支持开展人工智能识别感知芯片、车规级芯片、传感器芯片、高密度集成电路封装技术等新产品、新工艺检测技术研究。
4	《市场监管总局办公厅关于深入实施检验检测促进产业优化升级行动的通知》	市监检测发〔2024〕54号	国家市场监督管理总局	2024.7	聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、集成电路、人工智能等战略性新兴产业，同时兼顾传统产业改造升级，探索建立检验检测“揭榜挂帅”创新机制，鼓励检验检测机构与高校、科研院所、产业链上下游企业共同组建创新联合体，开展检

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
					验检测关键共性技术和仪器设备协同攻关，破解“卡脖子”难题，推动科技创新和产业创新深度融合，加快创新成果转化落地。
5	《关于印发贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025 年）的通知》	国市监标技发〔2024〕30 号	国家市场监督管理总局	2024.3	在集成电路、半导体材料、生物技术、种质资源、特种橡胶，以及人工智能、智能网联汽车、北斗规模应用等关键领域集中攻关，加快研制一批重要技术标准。推动检验测试方法、检验设备、标准样品等自主创新、协同配套。围绕新兴领域和优势领域，参与国际标准验证，为中外标准体系兼容和互认提供有力支撑。推动标准与计量、认证认可、检验检测等质量基础设施要素一体化发展。
6	《制造业可靠性提升实施意见》	工信部联科〔2023〕77 号	工信部、教育部、科技部等五部门	2023.6	提出围绕制造强国、质量强国建设要求，全面推进新型工业化，提升产业链供应链韧性和安全水平，强化可靠性技术攻关，提高试验验证能力，为实现制造业高质量发展打下坚实质量基础；提出实施基础产品可靠性“筑基”工程，在电子行业领域，加强材料分析、破坏性物理分析、可靠性试验分析、板级可靠性测试、失效分析等分析评价技术研发和标准体系建设，推动在相关行业中的应用。
7	《关于开展 2023 年工业和信息化质量提升与品牌建设工作的通知》	工信厅科函〔2023〕152 号	工信部办公厅	2023.6	集聚产业技术基础要素资源，提升计量、标准、检验检测、试验验证等支撑能力，面向产品全生命周期、创新链全环节、产业链全链条提供“一站式”服务；聚焦机械、电子、汽车等重点行业，支持专业机构加强加速试验、可靠性仿真等应用基础理论和应用技术研究，完善可靠性技术服务能力；推动基础电子、能源电子、汽车芯片等领域重点产品质量与可靠性水平提升，加快汽车芯片检测服务平台建设。
8	《质量强国建设纲要》	中发〔2022〕17 号	国务院	2023.2	提出推进质量强国建设，全面提高我国质量总体水平，推动质量基础设施更加现代高效，要求增加优质服务供给，提高生产服务

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
					专业化水平，提升工业设计、检验检测、知识产权、质量咨询等科技服务水平，推动产业链与创新链、价值链精准对接、深度融合；提出加快质量技术创新应用，推进质量设计、试验检测、可靠性工程等先进质量技术的研发应用；提出构建高水平质量基础设施，深化检验检测机构市场化改革，开展先进质量标准、检验检测方法、高端计量仪器、检验检测设备设施的研制验证。
9	《“十四五”认证认可检验检测发展规划》	国市监认证发〔2022〕69 号	国家市场监督管理总局	2022.7	围绕“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”发展要求，加快构建统一管理、共同实施、权威公信、通用互认的认证认可检验检测体系，全面提升认证认可检验检测服务供给水平，推动质量变革、动力变革、效率变革，促进质量提升和产业升级，助推经济社会高质量发展。
10	《市场监管总局关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》	国市监检测发〔2021〕55 号	国家市场监督管理总局	2021.9	推进检验检测机构市场化发展，坚持把创新作为驱动检验检测发展的第一动力，完善检验检测创新体系，加强共性技术平台建设，提升自主创新能力，推动行业向专业化和价值链高端延伸，围绕先进制造业发展积极打造一批共性技术服务平台。
11	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	-	全国人大	2021.3	健全产业基础支撑体系，建设生产应用示范平台和标准计量、认证认可、检验检测、试验验证等产业技术基础公共服务平台；培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。
12	《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》	发改产业〔2021〕372 号	国家发改委等 13 个部门	2021.3	明确提出要加快检验检测认证服务业市场化、国际化、专业化、集约化、规范化改革和发展，提高服务水平和公信力，推动提升制造业产品和服务质量。
13	《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政	国发〔2020〕8 号	国务院	2020.7	提出集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，从财税、投融资、IPO、

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
	策的通知》				研究开发、进出口等多角度对半导体产业的发展提供政策支持，并明确提出对国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业实施税收优惠政策。
14	《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》	工信部联政法〔2020〕101 号	工信部等十五部门	2020.7	提出推动服务型制造创新发展，鼓励发展面向制造业全过程的专业化检验检测认证服务提供商，加强检验检测认证服务机构的资质管理和能力建设，提升检验检测认证服务能力，鼓励有条件的认证机构创新认证服务模式，为制造企业提供全过程的质量提升服务。

3、报告期初以来新制定或修订以及预期近期出台的法律法规及行业政策对发行人的具体影响

报告期初以来，国家通过制定和出台《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（简称“十五五规划”）等一系列国家及地方相关政策，大力鼓励半导体产业升级发展，推动检验检测等科技服务创新变革。当前和今后一段时期，我国半导体产业正处于重要的战略机遇期和攻坚期。报告期初以来新制定或修订的相关法律法规及行业政策，为半导体检测行业的健康发展提供了良好的制度与政策保障，对半导体检测分析服务、检测硬件产品及量产测试服务的质量提升和产业升级提供了强有力的指导，同时也为公司的经营发展提供了法律保障与政策支持，为公司经营创造了稳定的市场预期与发展机遇。

（三）行业发展概况、行业特点、行业壁垒、机遇及风险、未来趋势等

1、半导体检测行业概况

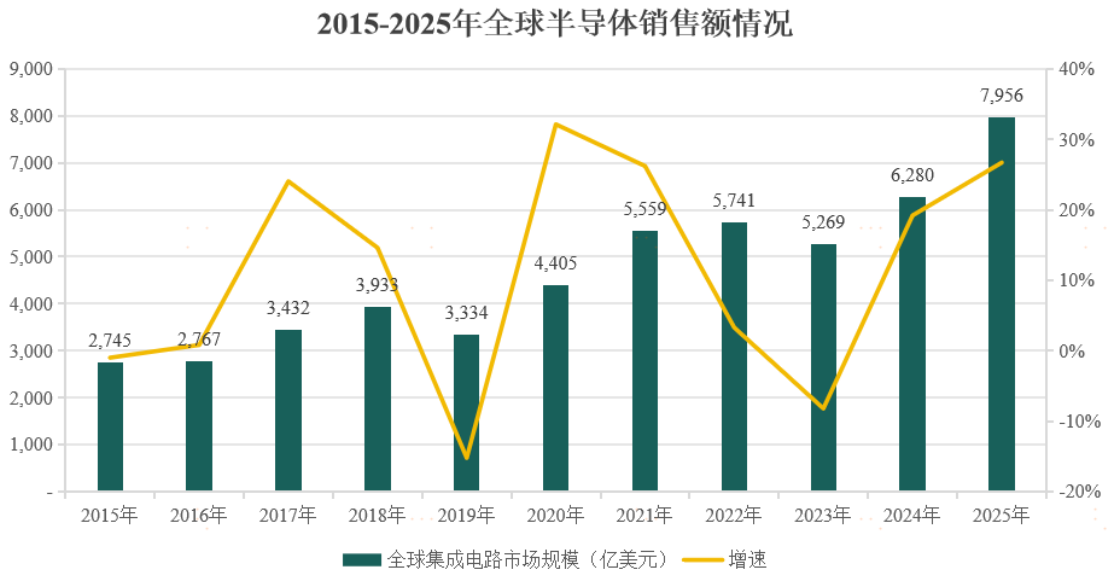
（1）半导体产业发展情况

半导体产业是一个涵盖范围极广的战略性基础产业集群，通常按照产业链划分为三大核心领域：上游为支撑产业，包括半导体材料（如硅片、光刻胶、电子特气）和半导体设备（如光刻机、刻蚀机、检测设备）；中游为核心制造产业，主要涉及芯片的设计、制造、封测三大环节，产品类型包括集成电路（如逻辑芯片、存储器、微处理器）、分立器件（如二极管、晶体管）、光电子器件（如激

光器、传感器）以及功率器件；下游则为应用端，广泛渗透于通信、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、航空航天等各个领域。其中，集成电路是整个半导体产业的核心，占据了 80%以上的市场份额。

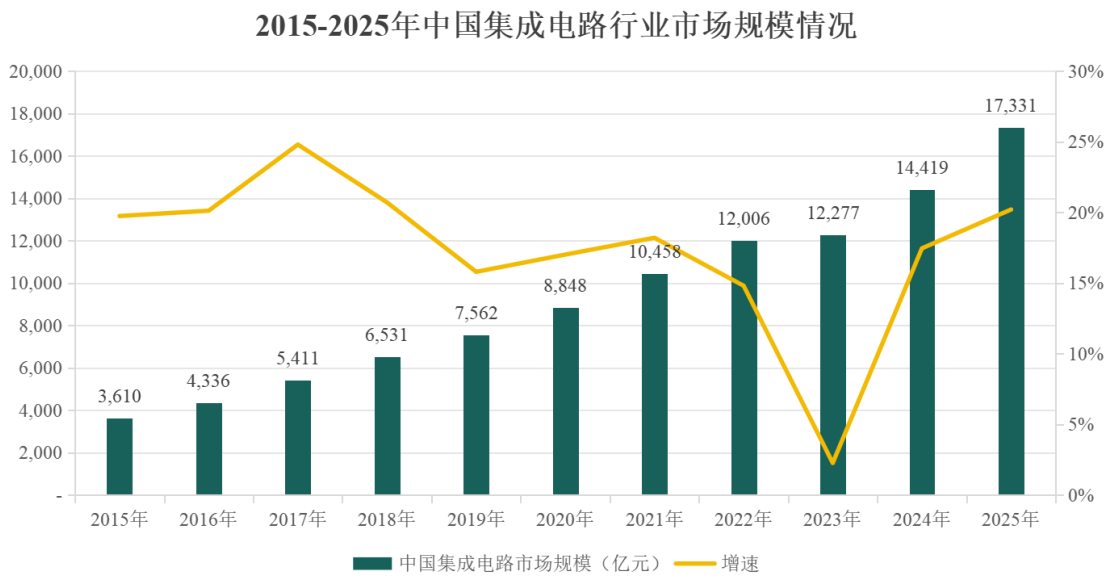
集成电路（Integrated Circuit，IC，又称芯片）产业是现代工业的“数字粮食”，其发展水平直接决定了一个国家电子信息产业的自主性与竞争力。作为将晶体管、电阻、电容等电子元器件微缩集成于半导体晶片上的高技术产业，它构成了所有数字系统的物理基石。其下游应用已从传统的计算机、通信和消费电子，深度扩展并驱动了人工智能、5G/6G 通信、新能源汽车、物联网、云计算及工业自动化等几乎所有新兴科技领域。下游应用的快速演进（如智能手机的普及、AI 大模型的兴起）不断对芯片算力、能效和集成度提出更高要求，从而与集成电路的技术进步形成双向驱动与相互促进的紧密循环。因此，该产业的景气周期与创新活力，与全球科技创新的步伐紧密交织，呈现明显的需求驱动特征。

近年来，全球半导体产业在技术、需求与资本的共同驱动下实现增长，但也经历了显著的周期性波动。2020-2021 年，宏观环境变化催生的远程办公需求与供应链“缺芯潮”共同推动了市场的超常繁荣和规模扩张。然而，2022 年起高通胀、消费电子需求崩塌与行业库存高企引发深度调整。进入 2023-2024 年，市场呈现结构性分化：传统消费电子芯片持续低迷，但以 AI 算力芯片和汽车半导体为代表的高端需求逆势增长，成为市场筑底复苏的关键支撑。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2025 年，全球半导体销售额为 7,956 亿美元，同比增长 26.7%，逻辑器件和存储器件对整体市场扩张的贡献最大，这主要得益于数据中心、人工智能加速器和先进计算系统对高性能芯片的需求。根据 WSTS 预测，2026 年全球半导体销售额预计将继续增长，并有望突破 1 万亿美元大关。



数据来源：WSTS

中国大陆作为全球最大的集成电路消费市场，其产业地位已从过去的“全球工厂”演变为驱动技术创新与供应链重构的关键力量。根据中国半导体行业协会统计，中国大陆集成电路行业市场规模从 2015 年的 3,610 亿元增长至 **2025 年的 17,331 亿元，年复合增长率达 16.99%**。2020 年后，行业在外部压力和内生需求的双重作用下加速转型：一方面，全球“缺芯潮”与地缘政治博弈使供应链安全成为国家战略议题，直接推动了以成熟制程和特色工艺为主的国产替代进程，国内晶圆厂、设备材料企业迎来发展窗口期；另一方面，国内新能源车、光伏、AI 算力等新兴产业的爆发，催生了结构性市场需求，使国产芯片在功率半导体、存储、部分算力芯片等领域实现了突破性进展。当前行业虽面临周期性调整与高端技术封锁的挑战，但“内需拉动+自主创新”的双引擎正驱动中国集成电路产业从规模扩张向高质量发展转型。



数据来源：中国半导体行业协会

（2）半导体检测行业简要介绍

半导体检测是贯穿集成电路研发、制造、封装、应用全生命周期的质量控制与可靠性保障体系。其核心任务既涵盖研发阶段的工程批验证、设计调试与工艺开发支持，又包括生产过程中的缺陷识别与良率管控。这一体系通过一系列精密的技术手段，全面验证芯片的物理特性、电学功能和长期可靠性，是确保产品从“0-1”研发验证到规模量产全流程的关键支撑。

半导体检测行业在产业链中扮演着“技术赋能者”与“质量守护者”的双重角色。一方面，通过为研发阶段提供精确的测量数据、失效分析报告和可靠性评估，加速技术迭代和新产品上市；另一方面，通过严格的缺陷监控和产品筛选，直接决定最终产品的良率与成本。这种贯穿全流程的特性，决定了检测行业的发展与半导体产业的技术演进、下游客户的研发活动与生产活动深度伴生，其技术难度、市场需求和投资规模都与半导体产业发展情况紧密相关。

根据应用阶段和目的，半导体检测主要可分为三类：前道量测与检测、量产测试以及实验室检测分析，具体如下表：

项目	前道量测与检测	实验室检测分析	量产测试
应用环节	晶圆加工制造环节	半导体产业链各环节，包括研发阶段与量产阶段	晶圆制造完成后
检测对象	工艺过程中的晶圆	各类型样品：包括工艺过程中或完成的晶圆、封装完成前或后的芯片、模组、终端产品或	晶圆测试：加工完成后的晶圆；成品测试：封装完成后的芯片

项目	前道量测与检测	实验室检测分析	量产测试
		材料、售后客退品等	
检测方式	对晶圆制造过程中每一步工艺过程的质量进行量测或者检查，包括测量薄膜厚度、关键尺寸、检查晶圆图案缺陷等，以保证工艺符合预设的指标，防止出现偏差和缺陷的不合格晶圆进入下一道工艺流程	主要针对失效样品进行缺陷定位与故障分析，帮助客户实现问题判定，加速产品研发与工艺升级，提高产品良率，进一步提升生产效率。该类半导体检测分析通常需结合物理、化学、结构、材料等多学科知识，运用包括物性分析、电性分析、表面分析、化学分析等在内的多类型检测分析技术	晶圆测试主要针对加工后的晶圆进行电性测试，在划片封装前将不合格的裸片剔除，减少芯片封装成本；成品测试主要针对封装后的芯片进行功能测试，保证产品出厂的合格率。该类型检测同样可应用于芯片设计阶段流片后产品的有效性验证
检测主体	通常由晶圆制造厂商自行购置设备进行检测	通常由企业自有实验室检测分析或委托第三方测试分析	委托第三方测试为主，已形成一批专业从事第三方测试的企业

公司在半导体检测领域深耕，核心业务包括第三方实验室检测分析、集成电路测试板等检测硬件产品，以及量产测试服务。其中，第三方实验室检测分析形成了从前端研发支持到后端质量保障的技术服务能力；集成电路测试板作为关键的检测硬件接口，其作用贯穿于研发验证与量产测试全过程；量产测试服务则为芯片规模化生产提供高效可靠的测试保障。公司通过半导体检测领域“服务+产品”模式，实现了业务从研发验证环节到规模量产环节的全覆盖。

2、第三方实验室检测分析行业

（1）第三方实验室检测分析行业概况、所属产业链情况

①第三方实验室检测分析行业概况

半导体第三方实验室检测分析是行业精细化分工的产物。早期半导体产业主要由 IDM 模式主导，企业自行完成设计、制造、封装测试及分析验证。随着产业演进，逐渐分离出 Fabless、Foundry 和 OSAT 专业环节。为进一步提升效率与专业性，芯片设计公司、晶圆制造企业及其他参与者开始将部分检测、分析、验证等需求外包，或将其作为内部实验室的补充。这主要是因为自建和维护涵盖所有尖端分析设备的实验室成本极高，且技术迭代迅速；同时，第三方机构能提供跨工艺平台的中立数据、更快的服务周期，并汇聚了多领域专家经验。因此，专注于提供独立、中立检测分析服务的第三方实验室成为了半导体产业链中不可或缺的技术支持环节。

在中国大陆，半导体第三方实验室行业是伴随本土产业链的成熟而逐步发展起来的。早期的高端市场需求主要由国际领先检测机构（如 SGS、Eurofins、闳康、宜特等）以及部分国家级、国有科研院所的检测平台来满足，本土商业化的第三方检测能力相对薄弱。随着国内半导体产业在政策扶持下进入高速发展期，尤其是设计公司数量激增和制造产能大幅扩张，对本地化、快速响应、成本可控的检测分析需求变得极为迫切。在此背景下，一批本土第三方实验室（如季丰电子、胜科纳米等）逐渐兴起，从最初提供基础的失效分析、可靠性测试，逐步发展到能够覆盖材料表征、工艺监控、可靠性认证、芯片拆解与逆向分析等全流程服务。近年来，在供应链安全、国产化替代与技术创新的双重驱动下，该行业正朝着更专业化、规模化、平台化的方向加速发展，已成为支撑中国半导体产业实现自主可控与质量提升的重要技术基石。

②业务分类及在半导体产业链各环节的作用

半导体第三方实验室检测分析主要针对晶圆、芯片等高度复杂精密的样品，进行可靠性认证、缺陷定位与故障分析，帮助客户快速定位问题及验证、提高芯片研发效率、优化工艺良率、降低开发成本、缩短研发周期，为各类芯片从设计、工程验证再到量产的全生命周期提供高可靠性保障。第三方实验室检测分析可以分为失效分析、材料分析、可靠性测试及其他，各自市场规模占比分别约为 35%、20%、35%及 10%，主要业务分类及其在半导体产业链各环节的作用如下表：

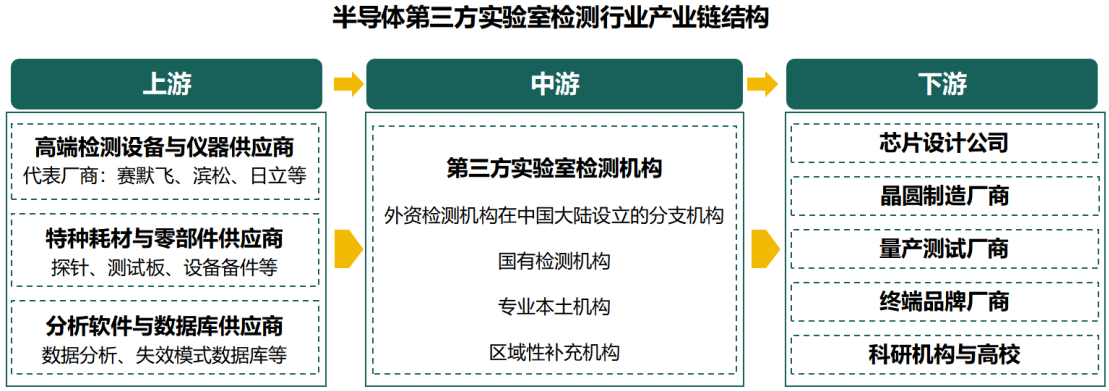
产品分类	定义	细分应用场景	客户主要送检样品形态	具体功能或作用
失效分析	主要指通过实验分析手段确定元器件既有的失效现象的原因及失效机理，或判断可能存在的失效情况	芯片设计	晶圆、芯片	新产品研发过程中，针对失效样品进行失效分析，优化设计工艺，保证新产品的可靠性水平；判断质量问题产生的环节，优化产品生产良率
		晶圆制造	晶圆	对产线进行质量监控，针对失效样品明确失效原因，进行电路验证，进一步提升产线良率
		设备厂商	晶圆	新设备研发过程中，针对设备生产的失效样品进行失效分析，优化设备生产工艺
		封装测试	晶圆、芯片	新工艺开发或产线验证过程中，针对失效样品进行分析，明确失效原因，改善封装工艺，优化选材、结构设计等，验证封装产线运行情况；量产过程中失效样品的分析，提升封装可靠性水平
		模组及终端应	芯片、模组	新产品研发过程中，针对失效样品进行失效分析，优化设计及生产工艺；针对

产品分类	定义	细分应用场景	客户主要送检样品形态	具体功能或作用
		用		量产过程中的质量问题进行失效分析，实现产品质量监控，提高产品的安全性与可靠性；针对售后客退不良品进行失效分析，明确失效原因，提高产品质量
		科研机构	芯片、模组	对科研过程中不符合预期的失效样品进行分析，明确失效原因，加速科研项目进程
材料分析	主要指通过实验分析手段对样品进行材料成分及结构的分析，实现对样品的结构组织分布、元素比例构成、污染物情况等的深入分析判断。	晶圆制造	晶圆	新工艺开发或产线验证过程中，验证产线中晶圆样品的内部结构及性能，确认工艺开发调试状态
		设备厂商	晶圆	新设备研发过程中，需要对试生产的晶圆样品进行内部结构及性能进行评估，确认设备是否达到设计参数要求
		材料厂商	各种形态的材料样品（包括衬底材料、化学试剂、固态胶等）	新产品研发过程中，针对样品进行材料元素、成分等分析，优化产品性能，未来在第三代半导体、大硅片、光刻胶等领域需求较广
可靠性测试	通过调节温度、湿度、压力、电压等方式模拟高温、低温、高湿等复杂环境，以增强或加速器件潜在的故障暴露，评估产品在规定的寿命期间、预期的使用、运输或储存等环境下的失效机制	芯片设计	芯片	产品设计可靠性验证，包括高温工作寿命测试、低温工作寿命测试、早夭寿命失效率测试、软失效率测试等
		晶圆制造	晶圆、芯片	晶圆制造工艺的可靠性验证，包括电迁移（EM）、经时介电层击穿（TDDB）、热载流子注入效应（HCI）、负偏压温度不稳定性（NBTI）、高温工作寿命试验（HTOL）、软错误率（SER）等
		封装测试	芯片	包括预处理（PC）、MSL 测试、温湿度偏压寿命试验、高加速应力试验、高低温循环试验、高温蒸煮试验、高温储存试验等

④第三方实验室检测分析产业链情况

半导体第三方实验室检测分析行业的产业链上游为行业的技术基础，由高端检测设备与仪器供应商（如赛默飞、滨松、日立高新、蔡司）、特种耗材与零部件供应商以及分析软件与数据库供应商构成，为核心检测分析能力提供必要的硬件、耗材与数据等支持。中游是行业的核心服务提供者，呈现多元主体格局，既包括外资检测机构在中国大陆的分支机构、国有检测机构，也包括专业本土机构与区域性补充机构，共同为下游客户提供关键的分析与认证服务。下游覆盖了半导体产业的全链条需求方，包括芯片设计公司、晶圆制造厂商、量产测试厂商、终端品牌厂商以及科研机构与高校，其研发验证、工艺监控、质量保障及前沿研究等需求直接驱动了整个检测分析行业的技术迭代与市场发展。整体产业链以

“技术服务”为核心，上游赋能、中游转化、下游驱动，共同支撑着半导体产业的创新与可靠运行。



（2）所属细分行业技术水平及特点

半导体第三方实验室既可作为独立的技术服务平台承担关键检测分析任务，又能与厂内自建实验室形成有效互补，其核心技术水平与特点主要体现在三个方面：

①专业性：设备与人员专业，具备系统性跨学科特点

第三方实验室融合物理、化学、材料、电子等多学科技术，覆盖从材料表征、失效分析到可靠性验证的全流程检测分析体系。其配备三维 X 射线成像设备（3D X-Ray）、扫描电子显微镜（SEM）、电容式扫描显微镜（SCM）、双束聚焦离子束显微镜（FIB）、透射电子显微镜（TEM）等专业设备，技术团队具备跨芯片设计、制造、封装等环节的系统性分析能力，能够有效诊断涉及多环节的复杂技术问题，突破了厂内实验室通常局限于自身工艺环节的局限。

②经济性：专业资源集约化，提供高性价比服务

面对高端检测设备投入大、技术迭代快的行业特点，第三方实验室通过专业化运营实现设备与人才资源的集约利用。这不仅降低了客户在设备购置、维护及人才培育上的成本，更通过规模化检测分析能力为客户提供了应对研发波动、紧急需求的灵活解决方案，提升了行业的资源使用效率。

③综合性：经验数据积累深厚，支持技术持续优化

基于长期服务多元客户积累的丰富案例库，第三方实验室形成了涵盖多工艺节点、多产品类型的失效模式数据库与解决方案知识体系。这种超越单一企业经

验的技术积累，使其能够为客户的工艺改进、良率提升和可靠性设计提供更具参考价值的优化建议。

④独立性：立场客观独立，促进供应链协同质量提升

由于独立于任何单一制造环节，第三方实验室在分析跨供应链质量问题时能够保持客观中立。这使其在复杂失效溯源、责任界定与工艺改进中，成为连接设计、制造、封装各方的可信技术桥梁，与客户内部实验室共同构建更完整的产业质量保障体系。

（3）进入本行业主要壁垒

①技术壁垒

第三方实验室检测分析机构的技术核心在于对各类检测分析技术的系统掌握与综合运用。随着半导体产业链的不断完善以及制程节点的持续演进，特别是近年来汽车电子、工业控制、数据中心等下游领域对芯片可靠性、安全性、一致性提出更高要求，检测分析机构在技术深度与广度方面也面临着更高要求；同时，先进封装、异构集成、第三代半导体材料的广泛应用，也推动了三维结构分析、界面特性分析、应力与热管理相关的测试技术不断迭代。

一家完善的第三方检测分析机构通常需要综合掌握失效分析、材料分析、化学分析、可靠性测试在内的一整套技术体系。上述技术不仅要求具备单一设备的操作能力，更重要的是对检测原理、工艺流程、样品制备方法、测试参数设定、数据判读和失效机理建模的系统把握，并能够结合客户工艺特点形成有针对性的整体解决方案。行业内领先的第三方检测分析机构通常基于长期服务国内外头部客户所积累的大量检测分析案例，不断在失效机理研究、工艺缺陷数据库建设、测试方法优化与标准化方面形成技术沉淀，建立起适配不同工艺节点、不同材料体系、不同应用场景的一整套技术流程。这类隐性技术资产具有累积性、专用性，新进入者即使购置类似检测设备，短期内亦难以复制既有机构在检测分析方案设计能力、复杂问题诊断能力以及综合技术服务能力方面的优势。

②人才壁垒

实验室检测分析方案对工程师在微电子、材料、理化、结构力学等方面的跨学科理解运用能力要求较高。高水平工程师不仅需要熟练掌握 SEM、TEM、FIB

等复杂设备的操作，还需理解芯片结构与工艺流程，能够结合具体应用场景进行方案设计和结果判断。目前国内半导体检测分析方面的高端复合型人才总体供给不足，需要在大量实际项目中积累经验并接受系统化内部培训，人才培养周期较长。新进入企业在短期内难以形成稳定、完整的技术团队，难以及时响应客户的复杂需求，人才获取和培养成为制约其进入行业和扩张业务的重要因素。

③客户认证壁垒

第三方实验室检测分析行业的客户包括芯片设计企业、晶圆厂、封测厂及终端厂商等，对检测分析机构的保密管理、服务质量、交付稳定性和持续服务能力要求较高。新检测分析机构通常需通过客户严格的供应商认证流程，包括资质审查、现场审核、试样比对等。由于更换检测分析服务提供商会增加工艺调整成本和质量控制风险，客户一般不愿频繁更换，而是倾向于与已通过认证的机构长期合作。既有机构在质量体系、技术能力和项目协同方面的稳定表现，进一步加深了客户黏性。新进入者即便具备一定硬件条件，也往往需要较长时间逐步积累案例和信誉，对其进入形成较明显的客户认证壁垒。

④资质认证壁垒

由于检测分析结果将对下游客户的研发试制、产品性能、生产效率等产生重要影响，市场普遍要求第三方实验室具备相应资质。行业内具有代表性的资质包括 CNAS 实验室认可、CMA 资质认定，以及国外客户普遍认可的 ISO/IEC 17025 国际实验室管理体系认证等，其对实验室的检测分析技术能力和覆盖面、管理体系、人员资质、设备配置均提出较高要求，需通过文件评审、现场评审和能力验证等程序，从而对新进入者形成一定的资质认证壁垒。

⑤资金壁垒

针对半导体产业的第三方实验室检测分析业务对资本规模和资金实力有较高要求。检测分析专用仪器设备种类繁多，高端设备单台价格可能高达数百万美元，且实验室对洁净度、抗静电要求较高，前期建设投入较大。随着对检测分辨率、灵敏度和自动化程度要求持续提升，行业需要密集资本投入促进检测设备更新换代。同时，检测分析机构还需持续进行检测方法开发、失效机理研究、信息化建设等，相关研发投入金额较大、周期较长。上述因素决定了行业具有一定的

资金壁垒，资金规模不足的企业难以在短期内形成完善的设备体系和研发能力。

（4）行业发展态势

①半导体产业升级与需求多元化驱动行业规模持续扩张

A.国内半导体产业快速发展，检测分析需求总量与结构双升

半导体第三方实验室检测分析市场空间与国内半导体产业规模同步增长。根据集微咨询统计，2025 年中国大陆半导体第三方实验室检测分析市场规模将达到约 125.5 亿元，预计到 2027 年有望达到 181.5 亿元，年复合增长率为 20.3%。市场规模增长主要受三方面因素驱动：其一，国产化进程加速推动产业链完善，芯片设计企业数量持续增加，研发迭代过程中产生的检测分析需求持续放量，同时国内检测分析机构凭借本地化响应能力与供应链安全优势，逐步承接原由国际头部企业主导的中高端订单；其二，汽车电子、工业控制、人工智能等高可靠性应用对芯片寿命、失效阈值提出更严苛标准，推动检测项目扩项、案件周期延长及检测成本提升；其三，先进制程、先进封装及第三代半导体材料的普及，增加了检测分析的复杂性和必要性，例如，车规芯片需满足 AEC-Q 系列认证要求，先进封装需进行三维结构分析，第三代半导体则依赖位错密度等材料级表征。

B.芯片复杂度与先进制程升级，检测分析环节前置化与高频化

随着芯片制程向 28nm 以下先进节点推进，以及 Chiplet、3D 封装等技术应用，传统的“封装后终测”模式已无法满足良率管控需求，检测分析环节逐步向制造流程前端延伸。晶圆制造阶段需通过光学检测（AOI）、电子束检测（EBI）实时监控光刻缺陷，封装前需对裸芯片进行功能筛选（KGD 测试），先进封装后需开展系统级测试（SLT）。检测分析环节的前置化与高频化，也带动了检测分析服务频次及单价的提高。

C.精细化分工趋势深化，第三方检测分析机构获认可

半导体产业日益精细化、专业化的分工模式，推动更多企业将非核心的检测分析环节外包。中小型芯片设计公司出于成本控制和效率优化考虑，倾向于与第三方检测分析机构合作，自身专注核心研发环节；大型晶圆厂则通过外包部分复杂检测分析项目以补充内部产能缺口。第三方检测分析机构以服务质量、检测效率获得客户更多认可和信赖，具备技术优势与成本优势，在半导体产业精细化分

工的发展趋势下，获得越来越多行业主流企业的认可。

②第三方实验室检测分析行业技术发展趋势

A.向更高分辨率与多信息融合的分析能力发展

为满足半导体先进工艺与先进材料的检测要求，检测分析技术朝着能够观察更细微结构并能同时获取多种信息的方向演进。例如，在物性分析方面，先进的显微镜技术已可实现接近原子尺度的观测，有助于识别材料内部的极细微缺陷；在化学分析方面，飞行时间二次离子质谱等新技术手段能够更精确地测定材料界面的元素分布。同时，将多种分析技术联合使用，同步获取形貌、成分及晶体结构数据，正成为提升分析效率的重要方式。

B.向更严苛的可靠性及实际使用环境模拟测试深化

针对汽车、工业等领域对芯片寿命和稳定性的高要求，芯片检测分析方案在向更长的测试时间、更复杂的模拟环境发展。例如，高加速应力测试（HALT）等方法能够将温度、压力、振动等多种环境应力组合施加于芯片，从而在较短时间内综合评估其长期使用的可靠性；失效分析也不仅限于观察失效现象，而是通过特殊技术观察材料在受力过程中的变化，深入探究导致失效的物理机理。

C.向与客户深度协同及提供综合解决方案转变

检测分析机构角色从单纯的服务执行者向深度的技术合作伙伴转型。在芯片设计初期，检测分析机构即扮演辅助研发的角色，为客户规划更高效、经济的检测分析方案。部分检测机构已构建起“检测-分析-解决方案”的服务模式，即在完成检测分析后，还能基于发现的问题为客户提供工艺改进的具体建议，帮助客户提升良率。

D.向智能化与自动化方向演进

面对日益增长的检测分析需求，智能化技术被广泛应用于检测分析流程的各个环节。自动化系统能够显著提升设备利用率和检测效率；机器学习算法则能辅助对晶圆表面缺陷进行自动识别与分类，加快分析速度；数字孪生技术可以对检测过程进行模拟优化，有助于减少样品损耗；模块化的设计理念也使得检测分析方案能更灵活、快速地响应不同客户的定制需求。

E.向数据安全与隐私保护能力强化演进

随着检测数据价值的提升，数据安全已成为检测分析机构的核心竞争力之一。头部机构建立加密数据传输系统，对采集、存储、传输环节全程加密；涉密项目通常会采取物理隔离的专用工作区域、严格的权限管理等一系列措施，以确保客户信息安全。

（5）面临机遇与风险

①行业发展面临的机遇

A.国家政策为行业带来良好发展机遇

国家层面相继出台的《集成电路产业发展促进条例》及《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等系列政策，不仅提出大力推动集成电路等产业创新发展，还鼓励建立集成电路检测分析和认证机构，为企业提供检测分析和认证服务，促进集成电路产业的健康发展。

半导体第三方实验室检测分析作为产业链中不可或缺的技术服务环节，通过提供覆盖研发、制造、封装全流程的专业检测分析，直接支撑技术攻关的验证与优化，是保障产业链协同创新与质量提升的重要基础设施。

B.新兴应用与技术演进共同拓宽检测分析市场空间

一方面，人工智能、高性能计算、汽车电子等新兴应用的快速发展，成为驱动全球半导体市场增长的重要引擎。这些领域对芯片的算力、能效及可靠性提出极致要求，显著扩大了从设计验证到量产质量管控过程中对专业检测分析服务的需求规模。

另一方面，半导体技术自身正持续向先进制程、先进封装、第三代半导体等方向演进，推动芯片结构日益复杂、工艺节点不断微缩。这不仅要求检测技术向纳米级、原子级精度提升，更催生了针对异质集成、新材料、新架构的定制化、多维度分析需求。

在这一背景下，第三方检测分析实验室面临重要发展机遇：市场规模的扩大为行业带来持续增长空间，技术复杂度的提升则创造了更多高附加值的专业服务需求。第三方实验室通过积累跨工艺、跨产品的检测分析经验，能够为半导体企

业提供从材料分析到可靠性验证的全流程技术支持，成为产业链中重要的专业服务环节。

C.半导体产业向中国大陆转移与高端芯片及设备的国产化进程加快

随着国际贸易争端加剧与部分国家的技术封锁，中国大陆半导体产业加速构建自主可控供应链，推动产业链本土化完善并逐步降低对外依赖。随着全球半导体产业链进一步向中国大陆集聚，我国半导体产业在制造、封测等环节持续深化的同时，也加速向芯片设计与核心技术领域拓展，推动产业结构向更高附加值环节升级。在这一过程中，供应链安全与自主可控成为产业发展的重要导向，对半导体检测分析服务提出了更专业化、系统化的需求。高端芯片及设备的研发与量产需要更精密的检测分析技术支持，而产业链各环节也日益依赖于能够提供全链条分析、快速响应和本地化服务的专业检测分析机构。第三方实验室检测分析凭借其跨环节的技术整合能力与规模化服务优势，正成为支撑产业链协同发展、提升整体质量与安全水平的重要力量，行业面临持续发展的市场机遇。

D.专业化分工深化凸显第三方服务价值

半导体行业是高度分工的产业，第三方实验室检测分析机构通过集中投入高端设备、组建专业团队，构建起规模化、系统化的检测分析能力，为芯片设计公司、晶圆制造厂等下游企业提供涵盖研发验证、工艺监控与质量认证的全流程服务。这不仅使企业能将检测分析等非核心环节外包以聚焦于技术研发与生产优化，有效降低其设备与人力成本，也通过跨客户、多场景积累的丰富经验帮助客户缩短研发周期、提升良率。在产业分工持续深化的趋势下，第三方检测分析服务已成为企业自建实验室的重要补充，共同推动半导体产业向更高效、更高质量的方向发展，市场空间也将随之持续扩大。

②行业发展面临的风险

A.市场竞争风险

在下游半导体设计、制造及封测等环节投资不断增加的背景下，进入第三方实验室检测分析市场的主体明显增多。一方面，原有从事材料检测、化学分析等业务的第三方机构加大设备投入和人员配置，向集成电路及相关领域延伸；另一方面，部分综合性检测机构以及新设立的专业实验室亦将半导体检测分析作为重

点布局方向。

随着各类主体加速进入，行业整体供给能力有所提升，但在客户资源、项目定价、交付周期等方面的竞争趋于激烈。对于尚处于成长阶段的检测分析机构，如果在技术能力积累、质量管理体系建设、行业口碑等方面形成的差异化优势不够突出，可能面临盈利空间被压缩、优质客户获取难度加大等风险。

B.高端技术人才供给风险

半导体第三方实验室检测分析涉及多学科，对技术人员的综合素质要求较高。一名能够独立承担项目的工程师，通常需要在理论学习、现场实践和项目历练等方面经历较长时间的积累。

近年来，国内针对半导体及相关检测分析方向的人才培养体系尚在完善，专业人才的供给与行业发展速度存在一定错配。同时，芯片制程演进、先进封装普及、新材料应用等技术发展趋势，对检测分析机构提出持续学习和能力更新的要求，机构既需要具备丰富经验的骨干人员，也需要能够适应新技术的复合型人才。

在此背景下，行业整体在高端技术人员数量、梯队结构和稳定性方面仍存在压力，人员流动也可能对部分机构的技术沉淀和服务连续性带来不利影响。若不能在人才引进、培养与激励机制方面形成较为完善的体系，人才瓶颈将制约检测分析机构能力提升和业务拓展。

C.高端检测分析设备依赖境外进口的风险

半导体第三方实验室检测分析业务具有明显的设备密集型特征，先进检测能力依赖于聚焦离子束显微镜、透射电子显微镜、扫描电子显微镜等高端设备的精度、稳定性及配置完整性。目前，上述高端设备的核心供应商主要集中于欧美及日本等国家和地区。

若未来地缘政治或国际贸易环境发生不利变化，相关供应商可能对特定设备、关键耗材及售后支持采取出口管制或限制供应等措施，将对检测分析业务的正常开展产生一定不利影响。国内设备及耗材供应商正积极推进国产替代，尽管在产品性能和稳定性方面与国际先进水平仍存在一定差距，但已在部分领域实现逐步替代，可一定程度上缓解上述风险。

（6）行业周期性特征

半导体第三方实验室检测分析行业呈现出弱周期性特征，其业务需求的核心驱动力主要来源于下游客户的研发活动，而非单纯依赖半导体制造端的产能波动。研发活动本身具有持续性和刚性需求特征，从而赋予该行业一定的抗周期特征。具体而言：

其一，全球半导体市场虽受供需、产能及技术迭代等因素影响呈现一定周期性波动，但长期呈上升趋势。根据 WSTS 预测，2026 年全球半导体销售额有望突破 1 万亿美元。尤其在中国大陆市场，受益于国产替代加速、供应链自主可控战略推进以及产业政策持续支持，半导体产业增长的确定性和韧性相对更强，为第三方检测分析需求提供了稳定的市场基础。

其二，随着先进制程及先进封装技术逐渐逼近物理极限，工艺复杂度显著提升，对材料纯度、大尺寸晶圆一致性、设备精度及稳定性、SoC 芯片集成度等提出了更高要求。新材料、新结构、新工艺的持续涌现，推动芯片研发阶段的验证需求与失效分析需求不断增加，进而带动第三方检测分析业务持续增长。

其三，集成电路应用领域持续拓展，人工智能、汽车电子等场景对芯片的性能、功耗、可靠性及安全性提出了更为严苛的标准。更高的质量和可靠性要求意味着更充分的检测验证，从而为检测分析行业带来持续的增量需求。

最后，在宏观经济增速放缓或半导体行业进入调整阶段的情况下，该行业亦表现出一定的抗周期韧性。一方面，市场竞争加剧推动半导体企业更聚焦于研发创新与工艺优化，以提升产品竞争力，因而对失效分析、材料表征等辅助研发类检测分析服务的需求保持稳定甚至逆势增长；另一方面，企业为控制成本更倾向于缩减自建实验室投入，转而将检测分析工作交给专业第三方机构完成，以更经济的模式获取技术服务。总体而言，在下行周期中，第三方实验室的业务波动性整体小于半导体制造业。

3、集成电路测试板细分行业

（1）集成电路测试板细分行业概况、所属产业链情况

①细分行业概况

集成电路测试板，是一种用于测试半导体器件性能、可靠性的电路板或模块，作为半导体测试系统中的核心硬件接口组件，主要用于建立自动测试设备与被测芯片之间的精密电气连接和信号通路。作为测试信号传输的物理载体，它承载着电源分配、高速信号传输、时序控制和信号调理等关键功能。集成电路测试板需根据芯片的引脚定义、电气特性和测试要求进行定制化设计，其性能直接决定了测试覆盖的完整性、测量结果的准确性以及测试流程的效率，尤其在面对先进封装、高频高速芯片时，测试板的技术已成为影响产品良率与测试成本的核心因素之一。

集成电路测试板作为关键的硬件接口，其作用贯穿于研发验证与量产测试全过程，从芯片设计到量产过程中涉及的可靠性测试、晶圆测试和芯片成品测试均需要定制化设计测试板。在研发阶段，定制化的测试板用于原型芯片的功能调试与性能评估；在量产阶段，高可靠、高精度的测试板则是实现高效、稳定测试的保障。根据使用环节与功能，集成电路测试板可分为系统板（FPGA testing platform）、探针卡（Probe Card）、测试载板（Load Board）、老化板（Burn-in Board），其定义、用途如下：

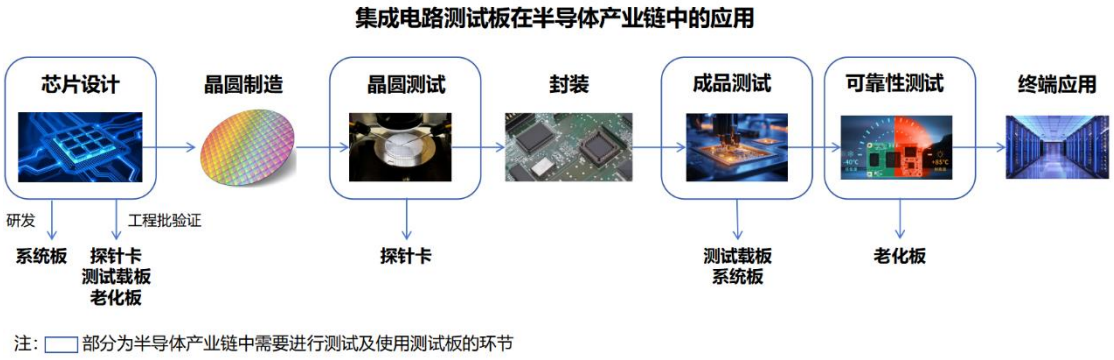
测试板类型	定义及用途
系统板	● 系统板主要用于芯片设计前期的功能验证与硬件原型开发，在流片前通过 FPGA 为客户提供可编程、可重构的硬件环境，支持设计调试与性能评估；在流片后采用实际 ASIC 芯片为客户提供功能验证的硬件环境。
探针卡	● 探针卡主要用于晶圆测试（CP）阶段，是连接测试设备与未切割晶圆的关键接口，由一块布满探针的 PCB 测试电路板、探测头、探测针、载板等组成，其通过微米级探针接触晶圆上的芯片焊盘，实现对裸芯电学性能的初步测试与缺陷筛选，以避免不良品进入后段封装制程造成的封装成本浪费。
测试载板	● 测试载板是芯片成品测试（FT）的核心接口设备，主要用于封装后集成电路的性能验证与良率筛选。其通过连接自动测试设备与被测芯片，实现对电源负载、高速信号完整性及开短路等电学参数的综合检测，确保芯片功能符合设计规范要求。在工作过程中，被测芯片通过载板上的专用测试插座与测试机台建立电气连接，由测试机向芯片输入特定信号并采集反馈数据，载板则负责传输高频信号和稳定电源，并保障信号完整性。
老化板	● 老化板专用于芯片可靠性验证，通过模拟高温、高电压、高负载等严苛工作环境，加速芯片潜在缺陷的暴露。其主要支持老化测试、高温工作寿命测试（HTOL）与高加速应力测试（HAST）等关键评估项目。在测试中，芯片通过插座与老化板连接，整体置入高温测试机箱中持续运行。为满足长期高温环境下的稳定性要求，老化板在材料选择（如耐高温板材）、元件布局及散热设计方面均需采用特殊方案。

除此之外，完整的集成电路测试板方案还包括其他关键零部件，如用于电信号连接的测试插座、用于支撑测试板的精密机械紧固件及周边的电子元器件等。

其中，测试插座是连接芯片与测试板的精密接口装置，通过弹性探针或接触结构建立稳定的电气连接，实现测试信号传输与电源加载，确保芯片引脚与测试主板之间的信号完整性。测试插座支持芯片的快速插拔与更换，避免重复焊接带来的损伤，显著提升测试效率并降低研发与生产成本。根据应用场景不同，测试插座可分为 ATE 测试座、老化测试座及系统级测试座等类型，并针对不同封装形式提供定制化解决方案。

②在半导体产业链中的地位

在半导体产业链中，各类集成电路测试板贯穿从研发到量产的完整验证体系：探针卡在晶圆测试环节执行电性筛选，测试载板在成品测试环节完成性能与功能验证，老化板在可靠性测试中筛选早期失效产品，系统板则在研发阶段提供整机应用环境测试。同时，这些测试板在研发阶段工程批验证中协同工作，逐层确保芯片在电气特性、功能及长期可靠性上达到设计与应用要求。具体如下：



③集成电路测试板的产业链结构

从集成电路测试板的产业链结构来看，行业上游主要是 EDA 软件（用于测试板的高密度互连、高速信号完整性仿真设计等）、核心材料（高频/高速覆铜板等）、关键部件（高性能连接器如探针、插座，精密被动元件如电容、电阻等）以及 PCB 委外加工商；中游主要是集成电路测试板厂商，主要负责设计与销售；下游则主要包括芯片设计公司、量产测试厂以及第三方检测机构等。

（2）所属细分行业技术水平及特点

①高度定制化与快速响应

集成电路测试板作为芯片与测试机台之间的关键接口，必须针对不同芯片的

引脚定义、电气特性与测试程序进行“一对一”设计。从支持高频高速信号传输的精密布线，到适应高密度封装的微细加工与热管理方案，每款产品都是融合电子工程、材料科学和精密机械的定制化工程成果。因此，企业必须具备强大的方案设计能力与敏捷的开发流程，以快速响应客户从研发验证到量产测试的多样化、时效性需求。

②技术要求高

集成电路测试板适用于研发评估及规模量产等不同阶段，为了确保信号的完整性，其叠层结构极为复杂，层数众多，部分高端产品的层数可达近百层。由于集成电路测试板需支持多工位并行测试，且不同的测试工位对信号品质的一致性要求较高，因此对布局布线规则及仿真能力提出了较高要求。此外，集成电路测试板在射频传输、大电流承载、高速接口适配、精密间距（Fine-pitch）以及板面平整度等方面具有严格的技术标准，导致其设计复杂度高、板材选型特殊、加工工艺难度大。

以高带宽存储器（HBM）为例，其测试需要应对极高 I/O 密度与数据速率所带来的接口技术挑战；而 AI 加速芯片的测试则需满足超大算力驱动下复杂电源管理和散热需求。

③小批量、多品种、高价值“耗材”

这一特点在芯片研发阶段尤为显著，集成电路测试板完全根据设计验证需求进行定制，呈现典型的小批量、多品种形态。当芯片进入量产测试阶段后，相应的测试板设计随之固定，可进入相对标准化的生产阶段以保障供应。因其需采用特种基板材料、精密组件并经历复杂的设计与制造流程，整体单价始终维持在较高水平，同时，探针卡、老化板等核心部件在长期机械接触与严苛电测环境下存在必然磨损与老化，需根据测试量定期更换，是一种高价值“耗材”。

④严苛的可靠性与一致性要求

集成电路测试板是评判芯片性能与质量的“标尺”，其自身的可靠性与一致性至关重要。产品必须在高温、高压、长时间连续运行等苛刻的测试环境中保持性能稳定，任何电气参数漂移或机械失效都可能造成芯片误判，带来巨大经济损失。因此，从设计阶段的信号/电源完整性仿真，到制造过程中的精密工艺控制，

再到出厂前的严格验证，全过程都以实现极致的可靠性与批次间一致性为核心目标。

（3）进入本行业主要壁垒

①技术壁垒

集成电路测试板行业存在较高的技术壁垒，这主要源于其技术构成的复合性以及需要适应半导体产业快速迭代的客观要求。

一方面，该行业要求企业系统性地掌握高频高速电路设计、信号与电源完整性仿真、高密度互连与先进封装适配、精密机械设计以及系统热管理等多个专业领域的技术。这些技术必须整合运用，并且能够跟上芯片制程、封装技术（如 HBM、Chiplet）和测试需求（如 AI 芯片的大电流与散热）的发展步伐。这意味着集成电路测试板厂商需要从芯片设计早期就参与客户协同，以开发出相匹配的测试接口方案。

另一方面，在上述技术能力的基础上，企业还需充分理解自动化测试机、老化测试机等测试设备的接口定义与应用场景，深入研究客户被测芯片的管脚电信号特性及周边测试电路，同时熟悉实验室研发环境与量产测试环境的需求差异，并掌握高端 PCB 板厂的板材特性与工艺成熟度。只有综合上述多维度认知，才能设计并生产出满足客户需求、兼具高性价比的集成电路测试板。

②人才与团队壁垒

集成电路测试板行业需要专业化、跨领域且经验丰富的人才，包括射频工程师、SI（信号完整性）/PI（电源完整性）仿真专家、PCB 设计专家、机械工程师以及熟悉 ATE 测试流程的应用工程师，并将这些分散的专业能力整合为高效协同的系统工程团队。这类复合型团队组建难度较大，培养周期长达 5-10 年，从而构成了新进入者难以快速复制的核心能力。

③客户认证与信任壁垒

集成电路测试板作为半导体测试系统中的核心硬件接口组件，是评判芯片性能与质量的“标尺”，其自身的可靠性与一致性对芯片品质和生产效率至关重要。因此，芯片设计公司或测试厂商通常需较长周期（通常为 1 年左右）对测试板供

应商进行技术能力审核、多轮样品验证及量产稳定性评估。一旦通过认证，双方将形成基于深度技术协同和高度信任的战略绑定关系，客户黏性极强，这对新进入者构成了准入障碍。

（4）行业发展态势

①高端芯片国产化与可靠性需求驱动集成电路测试板市场快速增长

A.高端芯片国产化驱动国内测试板需求增长与结构升级

人工智能、汽车电子、5G/6G 通信及高性能存储等领域的高端芯片对性能、可靠性和集成度有较高要求，必须依赖高频高速、高可靠及系统化的测试板进行精准验证与筛选，从而成为驱动测试板技术升级与需求增长的核心动力。在供应链安全与自主可控的国家战略引导下，国内在 CPU、GPU、车规级芯片及高端存储等关键领域的设计与制造能力正快速提升，相应地国内集成电路测试板市场需求也快速增长。

同时，与高端芯片配套的测试验证环节也需逐步实现自主可控，国内高端芯片厂商从过去以成本与全球供应链效率为主导的采购逻辑，逐步切换为关注高端测试板的供应链安全、技术响应速度和协同研发深度，正积极从境外测试板供应商转向具备核心技术的境内合作伙伴。

高端芯片增长带来的市场增量与国产化替代进程，为具备核心技术、能够紧跟甚至预研国内芯片设计路线的本土测试板企业，提供了良好的市场机遇，并推动本土测试板企业向技术壁垒更高、附加值更大的细分领域（如高性能探针卡、高速测试载板等）攀升。

B.下游应用领域对产品可靠性要求提升驱动测试板市场增长

以汽车智能驾驶、AI 数据中心、5G 通信为代表的下游产业，对芯片的功能安全、长期可靠性和极端环境适应性提出了前所未有的苛刻要求。这就要求半导体测试不再仅仅是出厂前的一道“质检工序”，而是贯穿于芯片设计验证、工艺调试、量产监控乃至生命周期管理的核心质量与可靠性保障体系。例如，汽车芯片必须通过严苛的 AEC-Q100 认证，其测试项目、时长和条件（如高温、高电压）远超消费类芯片，这显著增加了对高可靠、长寿命的老化测试板与系统级测试板的需求。在 AI 与数据中心领域，芯片功耗巨大、互连速度极高，测试板必须承

载更大的电流并提供超低噪声的信号路径，其设计和材料成本也相应提升。因此，新兴应用通过提升测试的必要性、复杂性与标准，驱动了测试板市场在需求数量与销售单价的双重提升。

C.芯片复杂度提升推动测试环节前置与重复，显著增加单芯片测试成本

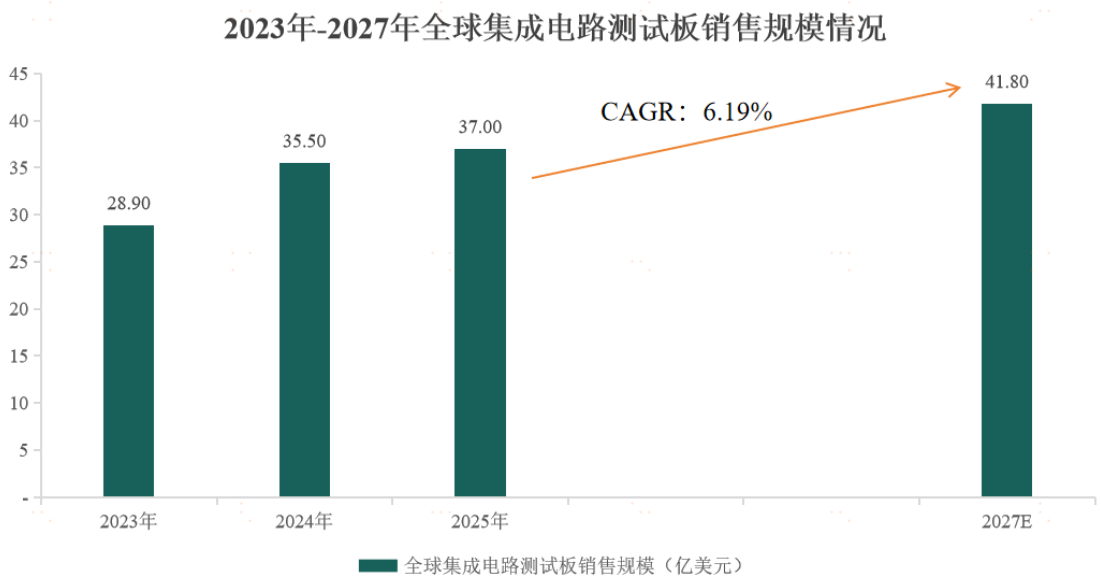
随着先进封装技术（如 Chiplet、3D 封装）和复杂系统级芯片（SoC）设计的普及，芯片制造过程中的测试策略发生了结构性变化。过去仅在封装完成后进行一次最终测试的模式已无法有效保障良率和控制成本。新的技术趋势要求将测试环节大幅提前至制造流程前端，并在多个关键节点进行重复且目标不同的测试。

具体而言，为保障后续高成本的先进封装过程只使用功能完好的芯片单元，必须在晶圆切割前就对裸芯片进行严格的功能与性能筛选。这直接提高了对晶圆级测试设备及测试板的技术要求，需要其具备更高的测试精度、更密集的测试触点以及更强的并行测试能力。同时，芯片在封装后、乃至组装到系统电路板后，仍需进行额外的电性验证和系统功能测试，以确保其在最终应用环境中的可靠性。

这一系列变化导致每颗合格芯片在出厂前所需经历的测试步骤显著增加，分别对应使用探针卡、测试载板、系统测试接口板等多种专用测试硬件。因此，单颗芯片所消耗的测试板种类、数量及对应的测试价值量快速增长，这成为驱动测试板市场需求扩张直接且持续的技术动力。

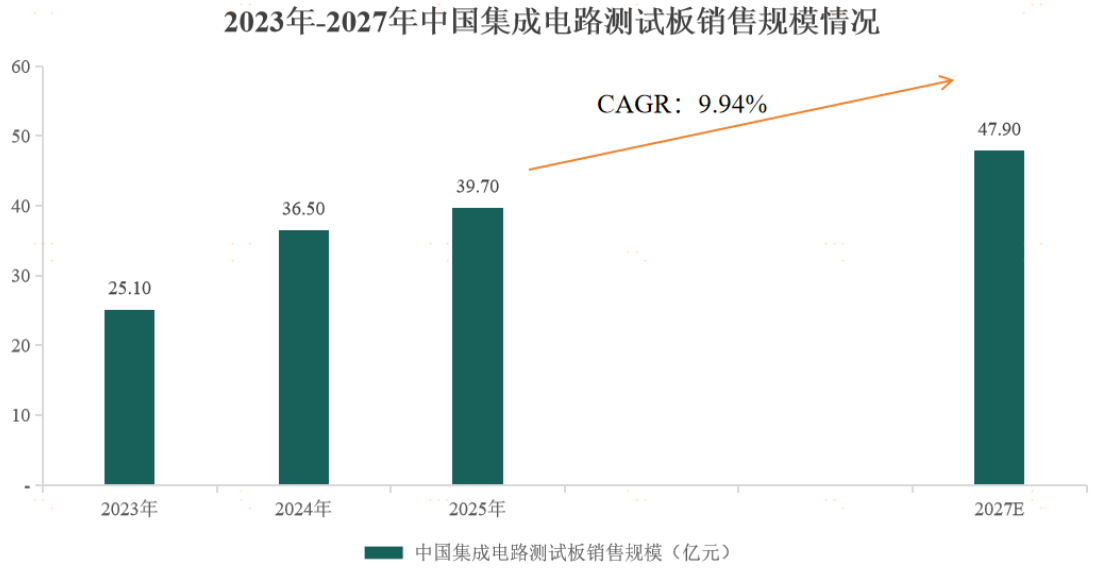
D.国内集成电路测试板市场规模复合增长率显著快于全球市场

根据集微咨询数据，2025 年全球 IC 测试板的市场规模为 37.0 亿美元，预计到 2027 年全球 IC 测试板市场规模将达到 41.8 亿美元，2025-2027 年 CAGR（年复合增长率）约为 6.19%。



数据来源：集微咨询

根据集微咨询数据，2025 年中国大陆 IC 测试板市场规模为 39.7 亿元，其中探针卡、测试载板、老化板市场规模分别为 24.99 亿元、5.99 亿元及 5.54 亿元。预计 2027 年中国大陆 IC 测试板市场规模将达到 47.9 亿元，2025-2027 年 CAGR（年复合增长率）约为 9.94%。



数据来源：集微咨询

②集成电路测试板细分行业技术发展趋势

A.向更高性能与集成度演进，以匹配先进芯片的测试需求

为应对 5G、AI 及高性能计算芯片的测试需求，技术发展聚焦于性能极限的突破。测试板通过采用更高层数、更细线宽及堆叠微孔技术，实现超高 I/O 密度

布线。同时，为保障 112Gbps 以上高速信号的完整性，需选用超低损耗材料并实施精密阻抗控制；而为满足大功率芯片的测试，则必须集成大电流供电网络与高效的嵌入式散热方案。这些突破旨在确保测试硬件能精确匹配被测试芯片的电气与物理极限。

B.向高可靠与长寿命演进，以满足严苛应用的品质要求

为服务汽车电子、工业控制等对可靠性要求极高的领域，测试板自身的耐用性与稳定性已成为核心竞争力。这要求从材料端进行强化，采用在高温、高频及大电流条件下性能稳定的特种基板与镀层工艺。在机械设计上，需通过精密加工确保探针、插座等关键部件在长期使用后仍能保持优异的电气接触性能，从而保障芯片量产测试的长期稳定与可靠。

C.向智能化与高效化演进，以优化测试效率与成本

面对测试时长与成本压力，智能化与自动化成为关键突破口。测试板正向“智能硬件”演进，通过集成传感器及自检电路，实现对高速、大电流测试过程的实时监控与性能校准。模块化设计理念也在普及，通过功能模块的灵活组合，快速适配不同测试需求，降低客户的长期拥有成本。

D.向深度融合与系统解决方案演进，重塑产业角色与生态

技术演进正推动测试板供应商的角色发生根本性转变。测试开发必须与芯片设计阶段深度协同，在芯片设计初期就共同规划测试策略，特别是针对高速接口与大功率模块的测试接入。部分企业正超越单一硬件供应，致力于提供集“专用测试板、定制化测试软件、数据分析平台及工程服务”于一体的系统级解决方案。这种深度融合模式，使测试板企业从配套供应商升级为共同定义测试标准的关键技术伙伴。

（5）面临机遇与风险

①行业发展面临的机遇

A.国家产业政策为行业发展带来良好机遇

集成电路测试板细分行业的发展与集成电路产业密切相关。集成电路产业作为现代信息社会的基石，其发展具有战略意义，一直受到国家层面的高度重视和

持续的政策扶持。“十五五”规划提出，完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。这标志着集成电路产业的战略地位被提升至空前高度，在这一国家顶层战略驱动下，全产业链的自主可控与协同发展成为明确方向。集成电路测试板作为保障芯片性能、可靠性与最终良率的关键检测硬件，其自主化发展直接关系到芯片性能验证的精度、效率，已成为集成电路产业链“强链补链”的关键一环。

B.半导体行业发展方向是测试板行业发展的技术引擎

首先，在人工智能、高性能计算等新兴需求的强劲驱动下，全球集成电路产业正步入新一轮增长周期，这直接拉动了从研发到量产各环节的测试硬件需求。其次，这些高端芯片及其在汽车、数据中心等严苛场景下的应用，对芯片的功能安全、可靠性与“零缺陷”质量提出了史无前例的高标准，使得测试不再仅仅是成本环节，而是保障产品竞争力的核心价值环节，从而显著提升了市场对高可靠性、高性能测试板方案的重视与付费意愿。最后，以 Chiplet（芯粒）和 3D 集成为代表的先进封装技术，要求测试大量前置至晶圆级，并在封装前后进行多次、多目标的复杂测试，这种测试环节前置与重复，使得单颗芯片所消耗的测试板种类、数量及总体价值量大幅增加，测试板的市场需求量和单芯片测试成本均显著提升。

C.半导体产业向中国大陆迁移与高端芯片国产化为行业发展带来机遇

半导体产业向中国大陆的持续迁移与本土化生产，为测试板行业奠定了市场基础。全球制造与封测产能的本地化聚集，直接带来了测试设备与耗材需求的同步扩张，为本土测试板企业提供了规模可观的存量市场。

在此基础上，以 GPU、CPU、高端存储为代表的高端芯片国产化进程，则成为驱动行业向高端升级的核心动力。国内高端芯片企业为实现自主可控，正从芯片设计到制造测试进行全链条突破，为本土测试板供应商打开了高端市场的大门。国内芯片厂商出于供应链安全、快速迭代和深度协同研发的迫切需求，正积极与具备技术潜力的本土伙伴合作。这不仅带来了对高端测试板的增量需求，更推动测试板供应商的角色从硬件提供者，转变为参与客户前沿研发、提供定制化验证方案的关键合作伙伴，从而在价值链中占据更核心的位置。

②行业发展面临的风险

A.市场竞争风险

当前，测试板市场正面临来自多个维度的竞争挤压，行业可能步入激烈竞争阶段。首先，国际及中国台湾的领先企业凭借长期技术积累和品牌优势，正积极布局并深耕中国大陆市场，在高端市场占据主导地位。其次，随着市场前景明朗，众多传统 PCB（印制电路板）企业凭借其在电路板制造方面的通用能力和产能规模，也开始横向切入测试板这一细分赛道，加剧了中低端市场的价格竞争。最后，专业测试板厂商本身也在持续扩产和升级。这种多重竞争格局，使得市场参与者面临利润空间被压缩、客户争夺加剧的风险，对新进入者和技术积累不足的企业构成严峻挑战。

B.技术快速迭代与人才短缺风险

测试板行业的发展高度依赖于持续的高强度研发投入，而技术路线的快速演进则带来了显著的不确定性风险。为匹配芯片朝着更高速度、更高密度和更先进封装方向的发展，测试板必须在材料、设计、工艺上进行近乎同步的升级，这要求企业进行前瞻性且昂贵的研发投资。一旦技术路线判断失误或研发进度落后，将直接导致产品失去市场竞争力。

测试板研发需要同时精通高频高速电路设计、精密机械、材料科学和半导体工艺的复合型专业人才，这类人才较为稀缺，能否吸引、培养并留住核心人才团队，直接决定了企业能否跟上技术迭代的步伐，这构成了行业长期发展的关键瓶颈。

（6）行业周期性特征

与第三方实验室检测分析行业类似，集成电路测试板行业亦呈现出一定的弱周期性特征，其需求核心同样源于下游客户的研发与量产测试活动，具体如下：

一方面，测试板作为芯片研发评估与规模量产测试的关键硬件接口，其需求伴随半导体整体市场规模的扩大而持续增长。另一方面，随着先进制程、先进封装（如 HBM、Chiplet）及 AI 芯片等高端应用的快速发展，测试板的叠层结构、信号完整性、精密间距及散热管理等方面的技术要求不断提高，推动测试板产品持续升级迭代，带来稳定的增量需求。

在行业下行周期中，测试板业务同样表现出一定的抗周期韧性。半导体企业为缩短产品研发与测试验证周期，对高性能测试板的需求保持刚性，且测试板作为测试系统的关键组成部分，其替换与升级需求相对稳定，受短期产能波动影响较小。

4、量产测试行业

传统集成电路量产测试分为晶圆测试（CP）、芯片成品测试（FT），对于高可靠性集成电路量产测试，还需要在其基础上增加系统级测试（SLT）和老化测试（BI），具体如下：

量产测试类型	定义及用途
晶圆测试（CP）	是指通过探针台和测试机的配合使用，对晶圆上的裸芯片进行功能和电参数测试，主要在晶圆制造后、芯片切割封装前进行，以筛选出不良品，避免后续封装成本浪费。
芯片成品测试（FT）	是指通过分选机和测试机的配合使用，对封装完成后的芯片进行功能和电参数测试，主要在封装完成后进行，以确保产品达到设计规格和质量标准。
系统级测试（SLT）	是针对在晶圆测试（CP）及成品测试（FT）完成后仍无法达到芯片出厂不良率管控要求的产品，需要采用系统级电路板及系统级测试程序，以提高测试覆盖率的一种量产测试方法。例如，车规级芯片在三温 CP+FT 测试完成后只能达到 400dppm（每百万颗芯片中不良品数不超过 400 颗，下同）要求的质量水平，为了达到 30dppm 要求，需要增加 SLT 测试。
老化测试（BI）	是一种通过加速可靠性应力环境、持续监测芯片性能随时间变化的测试方法，以筛选出生产制造过程中存在早期寿命缺陷的潜在不良品，确保经过老化测试后的产品在高可靠性应用场景下具备长期稳定的可靠性寿命。例如，汽车发动机及底盘芯片、安全驾驶芯片、航天航空芯片等均需要 100%进行量产老化测试。

受益于中国大陆集成电路产业的发展、高端测试订单向中国大陆回流、国内高端芯片与车规级芯片快速增长等因素，中国大陆集成电路量产测试市场快速发展。根据 Gartner 咨询和法国里昂证券预测，未来几年中国大陆集成电路测试的市场每年继续保持两位数的增长速度，2027 年中国大陆测试服务市场将达到 740 亿元。

随着我国新能源汽车产业高速发展与自动驾驶技术快速演进，车规级芯片的国产化需求日益紧迫。相较于消费类芯片，车规级芯片在可靠性方面有着极为严苛的要求，其测试过程需采用三温探针台、三温分选机及老化测试等专用设备。近年来，随着国产车规级芯片逐步进入大规模量产阶段，市场对高可靠性要求的量产测试需求呈现显著增长态势。根据集微咨询数据，2025 年中国大陆车规芯

片测试市场规模为 75.6 亿元，预计 2027 年将达到 93.1 亿元，年均复合增长率为 11.0%。

5、引用第三方数据

公司引用的部分行业数据来自集微咨询出具的公开付费报告《中国半导体第三方实验室市场研究报告》《中国 IC 测试板市场研究报告》《中国车规级芯片测试市场研究报告》，该报告为公司正常业务开展所需，并非专门为本次发行准备，公司为购买报告支付了正常的费用。除此之外的其他有关行业的统计数据及资料均来自不同的公开研究报告及行业协会提供的信息，公司未为该等第三方数据及资料支付费用或提供帮助。

（四）发行人创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况

公司围绕半导体全产业链提供第三方实验室检测分析、检测硬件产品及量产测试等一站式服务，具有较强的创新、创造、创意特征。公司深度服务半导体全产业链，核心业务属于关键技术攻关与工程化验证的重要配套，符合“十五五”时期全链条推动重点领域核心技术攻关的国家战略导向。公司构建了半导体检测领域“服务+产品”一站式模式，业务覆盖从“0-1”研发验证到规模量产的全过程，并具备软硬件双重开发能力，已自主研发多款定制化仪器设备为实验室赋能，累计服务半导体产业链客户超 3,000 家。同时，公司拥有较强的技术创新能力，技术体系全面覆盖从样品制备到量产测试的多个关键环节，并形成了先进制程逻辑单元立体结构分析、先进封装热失效深度定位技术等具备先进性的核心技术。此外，公司具备技术自主可控能力，拥有丰富的专利布局和完善的检测资质与质量体系。

发行人创新、创造、创意特征的情况请参见本招股说明书之“第二节 概览”之“五、发行人板块定位情况”之“（三）公司的创新、创造、创意性及其表征”。

（五）行业竞争格局

1、第三方实验室检测分析细分行业竞争格局

半导体第三方实验室检测分析行业的发展与半导体产业的技术演进及产能扩张紧密相关。该行业服务于芯片设计、晶圆制造、封装测试、半导体设备、半

导体材料全产业链，其市场需求直接受下游客户研发投入与产品迭代速度的影响。由于半导体企业对于分析检测的时效性要求极高，通常需在较短时间内获取可靠数据以支撑快速决策，第三方实验室的服务能力呈现出较强的区域性特征，普遍围绕主要半导体产业集聚区进行布局。这一特点导致全球范围内第三方实验室检测分析市场格局相对分散，单体企业市场份额有限，即便是业内知名企业如闳康、宜特、发行人、胜科纳米等，其营业收入规模与整体市场容量相比仍然有限，尚未形成具有显著垄断地位的龙头企业。

在国际市场，少数具备全球网络布局的综合性检测分析机构，如 Eurofins（欧陆科技集团）、SGS（通标）等，通过在亚洲、欧洲、北美等全球主要半导体产业聚集区设立分支机构，为跨国客户提供一致性的技术服务。与此同时，在各半导体产业集聚区域本土市场，也普遍成长起一批专注于服务本地产业链的第三方实验室。例如，在中国台湾，闳康、宜特等机构已形成相当规模；在韩国、日本等国家，也存在多家服务于本国半导体企业的专业检测分析公司。这些区域性强企与全球性机构共同构成了多层次的国际竞争格局。

在中国大陆市场，第三方实验室行业的竞争参与者主要可分为四类，各自具备不同的资源禀赋与发展路径。第一类为外资第三方检测分析机构在中国大陆设立的分支机构，如闳康、Eurofins（欧陆）旗下的 EAG 实验室等，它们依托其母公司的全球品牌声誉、国际标准资质与成熟技术体系，在高端客户市场中占据一席之地。第二类为早期布局的国有背景机构，例如工业和信息化部下属的赛宝实验室，其在可靠性试验与认证领域积淀深厚，长期服务于国家重大工程与军工项目。第三类为本土市场化机构，其构成多元：一部分由综合性检测上市公司通过并购或自建切入，如苏试试验收购宜特的上海子公司，华测检测收购蔚思博（中国台湾厂商蔚华电子在中国大陆的业务开展主体），广电计量主要通过自身投入逐步建设半导体检测分析能力，另一部分如季丰电子、胜科纳米等自成立之初便持续专注于半导体检测分析领域的专业机构，凭借深厚的技术积累在细分领域建立了品牌影响力。第四类则为数量众多的本地中小型实验室或高校科研院所设立的对外服务平台，其规模较小，但机制灵活，通常在特定技术点或本地化服务上形成补充。

市场竞争者类型	代表企业	市场定位	特点
外资检测分析机构在中国大陆设立的分支机构	闳康、EAG	● 闳康聚焦于失效分析、材料分析及可靠性 ● EAG 聚焦于材料分析	● 从业时间长，在其领域具有较深的技术积淀； ● 全球化品牌，在海内外均有布局，对全球客户具有较大影响力
国有检测分析机构	赛宝实验室	● 聚焦于国军标的可靠性检测、二次筛选等测试业务	● 具备较高的准入门槛及深厚经验积累，在军工、汽车电子等领域的检测认证具备强制性与权威性； ● 主要服务于国家战略与高可靠领域
专业本土机构	综合性检测公司及下属公司：苏试宜特、广电计量 专注半导体领域机构：季丰电子、胜科纳米	● 季丰电子专注于失效分析、材料分析、可靠性及相关实验室硬件的自主研发生产； ● 苏试宜特及广电计量聚焦于失效分析及可靠性； ● 胜科纳米专注于失效分析及材料分析	● 服务响应快，深度绑定本土核心客户，性价比高； ● 季丰电子及胜科纳米在先进高端实验室设备的投入持续处于较高水平； ● 全球品牌知名度有待进一步提升
区域性补充机构	各地小型实验室、高校平台	● 作为市场补充，主要服务于本地中小型设计公司或科研项目，解决特定、急迫的检测需求	● 可能在某一特定分析项目或本地化服务上具有速度或成本优势； ● 无法提供全面的分析与一站式服务，品牌公信力有限，难以进入主流客户供应链

2、集成电路测试板细分行业竞争格局

集成电路测试板行业作为半导体检测产业链的核心硬件环节，呈现出技术密集、定制化程度高与细分市场分化的显著特征。该行业产品主要包括探针卡、测试载板、老化板及系统板等，其开发必须紧密跟随芯片设计、制造工艺及测试机台的演进。由于下游芯片类型、测试参数及终端应用场景差异巨大，测试板产品普遍具有高度定制化属性，要求供应商不仅具备通用设计与制造能力，更需深度介入客户测试方案的前期设计，形成“定制研发-快速打样-持续服务”的一体化能力，行业壁垒由此构筑。

从细分市场结构来看，探针卡、测试载板、老化板及系统板等不同产品线呈现差异化的竞争格局。在探针卡领域，FormFactor 等国际厂商占据主导地位，中国台湾厂商精测、中国大陆企业强一股份等企业正在加速追赶，季丰电子目前未涉及该领域。在测试载板及老化板等细分市场，市场相对分散但生态绑定较为紧

密，其设计与特定测试机平台（如爱德万、泰瑞达、MCC、长川科技等）高度适配，往往形成“测试机厂商-核心板卡供应商”的共生体系。中国台湾厂商精测、雍智科技以及中国大陆企业季丰电子等专业化厂商凭借与测试机平台的深度适配能力形成竞争优势。

聚焦中国大陆市场，国内高端芯片国产化进程加速，以及终端厂商对芯片质量要求日趋严格，为本土测试板企业创造了结构性成长机遇。在高端探针卡领域，国内企业强一股份等已取得一定突破；而在测试载板、老化板及系统板领域，包括季丰电子在内的一批具备定制化设计能力、快速响应服务和成本优势的本土专业厂商已崭露头角。通过深耕细分赛道（如存储、AI 芯片、射频、模拟、功率半导体），本土专业厂商与国内头部芯片设计公司、封测厂等形成紧密合作，持续提升市场份额，并在部分领域开始与国际厂商展开竞争。

展望未来，随着芯片复杂度持续提升和先进封装等新技术的发展，测试板行业将面临更高性能要求和更短交付周期的挑战。在这一进程中，具备全流程服务能力、深厚技术积累和快速响应优势的企业将获得更大发展空间。中国企业在贴近市场需求、产业链协同和技术迭代速度等方面的固有优势，为其参与全球竞争提供了重要支撑。测试板市场的竞争格局仍处于动态演进过程中，技术突破和市场拓展并重的中国企业有望在未来全球产业格局中占据更加重要的地位。

3、量产测试细分行业竞争格局

集成电路量产测试行业主要有两类企业：封测一体企业和独立第三方测试企业。随着封装技术投入加大、测试难度提升，封测一体厂商将主要精力和资金集中于封装业务，越来越多地将测试业务外包给独立第三方。独立第三方测试模式发源于中国台湾，以京元电子、欣铨、矽格为代表。中国大陆起步较晚，呈现出规模小、集中度低的竞争格局，但是以伟测科技、利扬芯片为代表的内资企业近几年发展速度较快。

4、行业内主要企业

（1）闳康

闳康成立于 2002 年 5 月，注册地为中国台湾，于 2009 年 8 月在中国台湾证券柜台买卖中心挂牌。闳康主营业务是为集成电路、平面显示器、光电产业、封

装测试等产业上中下游提供检测服务，包括可靠性测试、失效分析、材料分析。闳康 2025 年营业收入为 124,791.86 万元、净利润为 9,131.14 万元。[2]

（2）胜科纳米

胜科纳米成立于 2012 年 8 月，注册地为江苏省苏州市，于 2025 年 3 月在上海证券交易所科创板上市。胜科纳米主营业务是半导体第三方检测分析服务，包括失效分析、材料分析、可靠性测试。胜科纳米 2025 年营业收入为 52,952.73 万元，净利润为 6,187.90 万元。

（3）苏试宜特

苏试宜特前身为宜特（3289.TWO）旗下子公司，2019 年被苏试试验（300416.SZ）收购。苏试宜特从事集成电路第三方实验室检测分析服务，可提供可靠性测试、失效分析等服务。根据苏试试验（300416.SZ）披露，苏试宜特 2025 年营业收入为 39,070.17 万元，净利润为 5,779.28 万元。

（4）雍智科技

雍智科技成立于 2006 年 9 月，注册地为中国台湾，于 2019 年 4 月在中国台湾证券柜台买卖中心挂牌。雍智科技主要从事半导体测试板的研发、生产与销售，主要产品包括前段测试载板（探针卡）、后段测试载板（IC 测试载板）、老化测试板及其他相关测试板和服务。雍智科技 2025 年营业收入为 47,757.71 万元，净利润为 9,399.22 万元。

（5）伟测科技

伟测科技成立于 2016 年 5 月，注册地为上海市，于 2022 年 10 月在上海证券交易所科创板上市。伟测科技的主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务，目前拥有晶圆测试、芯片成品测试及测试方案开发、SLT 测试、老化测试等全流程测试服务。伟测科技 2025 年营业收入为 157,464.24 万元，净利润为 30,319.86 万元。

5、发行人与同行业可比公司的比较情况

（1）同行业可比公司的选择依据及相关业务可比程度

[2] 闳康、雍智科技的营业收入、净利润均按 2025 年 12 月 31 日新台币兑人民币汇率 0.2243 折算成人民币。

公司是一家半导体领域检测服务与检测硬件产品的全功能、一站式解决方案提供商，收入主要来源于第三方实验室检测分析服务、集成电路测试板产品、量产测试服务。在选取同行业可比公司时，主要结合以上三块业务，分别选取在各细分领域业务模式、服务/产品类型及下游客户群体相近的上市公司进行对标分析。

其中，闳康、胜科纳米、苏试宜特主要从事半导体第三方实验室检测分析服务，与发行人第三方实验室检测分析服务可比；雍智科技主要从事半导体测试板的研发、生产与销售，与发行人集成电路测试板业务可比；伟测科技的主营业务为量产测试服务，与发行人量产测试服务可比。

（2）经营情况对比

报告期内，发行人与同行业可比公司的经营情况对比如下：

单位：万元

可比公司	年度	营业收入	净利润	总资产	净资产
闳康（3587.TWO）	**2026 年 1-6 月**	**65,410.66**	**4,407.06**	**208,674.83**	**126,664.51**
	2025 年	124,791.86	9,131.14	197,699.59	109,285.11
	2024 年	112,265.58	15,063.01	186,259.93	106,006.48
	2023 年	106,942.79	15,021.16	164,080.48	98,368.54
胜科纳米（688757.SH）	**2026 年 1-6 月**	**29,738.91**	**1,851.62**	**208,378.05**	**88,517.11**
	2025 年	52,952.73	6,187.90	197,291.77	88,804.27
	2024 年	41,527.19	8,118.12	149,210.53	60,596.60
	2023 年	39,398.33	9,853.85	120,722.93	52,168.08
苏试宜特	**2026 年 1-6 月**	**19,772.60**	**2,410.33**	**93,352.11**	**77,671.37**
	2025 年	39,070.17	5,779.28	93,175.20	75,204.22
	2024 年	32,022.67	5,032.59	98,150.74	84,355.82
	2023 年	28,093.20	4,382.08	91,064.24	79,991.68
雍智科技（6683.TWO）	**2026 年 1-6 月**	**28,062.34**	**8,978.77**	**80,460.38**	**60,282.36**
	2025 年	47,757.71	9,399.22	75,534.80	60,875.06
	2024 年	39,380.39	10,503.30	67,003.47	55,755.54
	2023 年	30,878.52	7,753.48	56,492.40	48,654.75
伟测科技（688372.SH）	**2026 年 1-6 月**	**107,185.98**	**15,931.11**	**943,425.34**	**422,791.61**
	2025 年	157,464.24	30,319.86	772,648.13	296,736.97

可比公司	年度	营业收入	净利润	总资产	净资产
	2024 年	107,686.99	12,822.88	491,901.70	261,907.62
	2023 年	73,652.48	11,799.63	360,810.50	245,866.77
发行人	**2026 年 1-6 月**	**37,885.76**	**4,015.83**	**199,767.94**	**93,837.82**
	2025 年	66,949.34	9,125.55	172,698.54	89,472.96
	2024 年	58,348.29	5,437.55	154,312.62	79,650.10
	2023 年	44,336.65	2,045.41	133,033.30	73,490.44

注：苏试宜特系上市公司苏试试验（300416.SZ）控股子公司，其营业收入为苏试试验在各年年报中披露的苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司的相应数据。

（3）市场地位对比

发行人的市场地位参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“二、发行人所处行业情况”之“（六）发行人的行业地位及竞争优劣势”之“1、发行人的行业地位”。

公司创始团队源于高通等行业龙头企业，业务基因天然贴近甲方需求。凭借对客户痛点的深刻理解，公司前瞻性地围绕客户整体检测需求展开业务布局，成为业内少数能够提供覆盖检测服务与检测硬件方案的全功能、一站式半导体检测解决方案的供应商。目前，同行业可比公司大多专注于单一细分领域，例如闳康、胜科纳米聚焦于第三方实验室检测分析业务；雍智科技主攻集成电路测试板产品；伟测科技以量产测试服务为核心。相较于上述公司，公司基于客户需求驱动的全方位业务布局，不仅能更高效、系统地响应客户多元需求，提升服务深度与客户黏性，同时也构建了更丰富的业务增长路径与更强的抗风险能力，为长期可持续发展奠定了差异化优势。

在第三方实验室检测分析市场，2025 年公司营业收入在中国大陆市场位居行业前列，仅次于闳康与胜科纳米，位列市场第三，公司已在第三方实验室检测分析领域建立起坚实的市场地位和客户认可度。

在集成电路测试板市场，雍智科技作为行业内规模较大、市场地位领先的企业，业务覆盖全球市场，相比发行人具有更显著的经营规模与品牌影响力。发行人作为后起之秀，自 2019 年成功进入客户 D 供应链体系以来，凭借在该合作中积累的先进技术及严格质量管控能力，逐步构建起面向高端芯片的测试板解决方案能力，可服务于存储、AI 等高复杂度芯片领域。

（4）技术实力与关键指标对比

①第三方实验室检测分析服务

A. 公司检测能力可覆盖的先进制程节点处于行业前列

随着半导体工艺节点微缩、产品性能要求攀升，公司检测分析业务聚焦先进工艺，先进制程案例已覆盖 3nm 芯片，设备最先进检测能力可达到 2nm 及以下芯片，在同行业可比公司中处于相对靠前的位置。

公司名称	公开披露的可检测集成电路先进制程范围
闳康	Metrios AX TEM 设备支持 2nm 以下工艺研发及量产
胜科纳米	对先进制程的覆盖能力可达到 3nm
苏试宜特	可提供 5nm 及以下制程芯片的线路修改服务
广电计量	可为 3nm 及以下制程芯片提供失效分析、材料分析服务
发行人	**先进制程案例已覆盖 3nm 芯片，设备最先进检测能力可达到 2nm 及以下芯片**

资料来源：公开查询。

B. 公司的实验室检测分析能力已达到相对领先水平

a.失效分析

公司具备行业领先的失效分析检测能力，目前提供的失效分析检测实验手段包括非破坏性分析、电性分析、样品制备、微观形貌表征等，具体如下：

在非破坏性分析领域，公司具备行业领先的 3D X 射线及超声波缺陷识别能力。通过纳米 3D X 射线的无损检测技术，公司能够实现高达 500nm 的分辨率扫描，对于非金属材料亦具备出色的检测能力；公司的超声波无损检测项目，可依据不同材料的特性，精准匹配检测探头，在 50μm-1cm 范围开展超声波检测工作，检测分辨率可达 3μm。

在电性分析领域，公司不仅能够针对芯片整体实施电性分析（空间分辨率可达 0.5μm），还可对单个晶体管进行精准的电性分析。公司纳米探针在先进的晶体管分析方面，已具备应用于 3nm 先进制程芯片分析的能力，并具备动态分析能力，可搭配时钟信号、与非门等进行复杂的电性失效分析应用。

在样品制备领域，公司能够对 3nm 先进制程样品完成整个芯片的去层操作，借助双束离子束样品加工技术，实现动态去层过程的实时观察，实时去层精度可

精确控制在 1nm。此外，公司还能够在真空环境下开展去层作业，完成无污染的样品制备工作。利用双束聚焦离子加工技术，公司可对失效样品进行超薄样品制备，将薄片厚度精准控制在 5nm-10nm 范围。

在微观形貌表征领域，公司拥有观察原子排列的能力，处于行业领先水平。

b. 材料分析

在材料分析领域，公司通过精准解析材料成分与结构，为芯片研发及生产提供关键支撑。在微区结构及成分分析中，公司在样品制备方面掌握行业内领先能力，具备 2nm 先进制程全环绕栅极结构的样品制备能力及最薄 10nm 的样品制备能力，同时能够制备用于三维结构分析的样品，并有效降低在制样过程中产生的样品损伤；公司透射电镜微观结构表征项目可以实现行业内相对领先的纳米级结构分辨能力，可达到 0.06nm 的空间分辨率，球差校正设备能够直接观测单个原子柱，实现对晶体结构、位错、晶界等缺陷的精准识别。

c. 可靠性测试

在可靠性测试领域，公司具备行业内领先的可靠性验证、寿命评估及合规认证能力，可依据 AEC-Q100/101/200、JEDEC、IPC、MIL-STD 等国际主流标准，为半导体芯片、功率器件、车载电子元器件等提供全流程可靠性解决方案，具备单芯片 800W 可靠性的整体方案能力，在关键技术指标与方案落地能力上处于行业先进行列。在车载级可靠性认证中，公司可实现 AEC-Q100 全系列测试项的精准执行，覆盖高温存储（HTS）、低温存储（LTS）、温度循环（TC）、热冲击（TS）、高温工作寿命（HTOL）、功率温度循环（PTC）等核心项目，支持芯片封装从 WLP、QFN 到 BGA 的全品类适配，测试精度与数据重复性达到行业顶尖水平；在消费与工业级可靠性验证中，公司搭建了 ESD（静电放电）/EOS（电过应力）全套测试体系，可完成 2304 通道的 HBM（人体模型）、MM（机器模型）、CDM（充电器件模型）多模式静电测试，同时具备湿热、盐雾、振动冲击等环境应力筛选能力，能快速定位产品在极限工况下的可靠性薄弱点；在定制化可靠性方案开发中，公司可结合客户芯片应用场景（如新能源汽车、工业控制、物联网终端），设计差异化加速老化模型与可靠性验证矩阵，实现从芯片设计阶段到量产阶段的全生命周期可靠性管控。

可靠性工程领域，公司在车载功率器件 HTOL 测试的长期稳定性、芯片级 ESD 防护能力评估的精准度上具备行业内较为前沿的技术实力，与行业内标杆企业的核心可靠性测试能力保持同步。

公司掌握针对不同应用场景、不同技术节点芯片产品的可靠性验证核心逻辑，具备定制化可靠性方案设计与全流程执行的分析技术，可高效精准地解决客户从研发验证、量产质控到失效复盘的全链条可靠性需求，是公司综合技术服务能力的重要组成部分。

C. 公司在高端线路修补方面具备创新性的核心技术

在半导体领域，线路修补是保障产品良率、降低损耗、提升运维效率的重要环节。公司的高端线路修补业务配备了红外热像仪支持背开模式，更适配于先进制程产品的线路修补，可实现精准修改高阶制程芯片的设计缺陷、验证电路设计，具备高精度、高效率、高兼容性及高安全性的核心能力，可全面覆盖模拟芯片、MEMS、算力芯片等多场景修复需求。一方面，公司的高端线路修补业务配备了 GDS 自动导航定位软件，能够在保证客户信息安全的前提下实现精准定位，并配备了高精度蚀刻技术，能实现纳米级精准定位，分辨率可达 3.2nm，可精准修复 2mil 至 20mil 线路，完成 7nm 以上制程的线路修补工作，同时具备循环输出能力以提升批量修复效率。另一方面，公司的线路修补业务可适配不同类型、不同规格的线路修复，涵盖芯片同层与异层金属线切割连接、在表面钝化层上制作十字型键合焊盘、指定位置引出信号线进行测试等多种场景，既能通过金属线飞线、导电银浆点涂等方式修复微小缺陷，也能借助智能控制系统完成局部线路带电修复。

D. 公司获得 CNAS、CMA 认可的检测分析项目数量领先

截至本招股说明书签署日，公司拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的 **201** 个检测项目、检验检测机构资质认定（CMA）的 **56** 个检测项目，与主要竞争对手相比获认可的项目数量领先。具体如下：

公司名称	CNAS 认证数量（个）	CMA 认证数量（个）
闳康	37	-
胜科纳米	**88**	29
苏试宜特	**100**	**136**

公司名称	CNAS 认证数量（个）	CMA 认证数量（个）
广电计量	107	98
华测蔚思博	67	-
发行人	201	56

注：上表列示与发行人所处行业相关的检测分析项目数量，其中广电计量为综合性检测分析机构，认证主体选择主要从事半导体检测相关的实验室，包括广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测（上海）有限公司、广电计量检测（成都）有限公司，检测对象关键词为电子元器件、集成电路。

②集成电路测试板产品

公司的集成电路测试板产品与同行业可比公司的关键技术指标对比如下：

测试板类型	技术指标	发行人	精测	雍智科技
测试载板	最高层数（L）注2	100	100	100
	PIN 脚数（max）注3	10000+	10000+	10000+
	pitch（min）注4	0.25	0.25	0.25
	最大速率（Gbps）注5	112	224	224
	最高频率（Ghz）注6	77	77	77
	最大功率（W）注7	796	1000+	1000+
	DDR 类型注8	DDR5/ LPDDR5	DDR5/ LPDDR5X	DDR5/ LPDDR5X
	最高速率（Mbps）注9	8400	8400	8400
测试板类型	**技术指标**	**发行人**	**Avi-Tech**	**雍智科技**
可靠性测试板	最高层数（L）注2	40+	40+	40+
	PIN 脚数（max）注3	10000+	10000+	10000+
	pitch（min）注4	0.3	0.25	0.25
	最大速率（Mhz）注5	100	100	100
	最大功率（W）注7	560+	1000+	1000+

注 1：精测的产品以晶圆测试卡（包含探针卡）、IC 测试板（测试载板）为主，因此，在对比测试载板时，选择精测、雍智科技为可比公司；Avi-Tech 是一家新加坡公司，主营可靠性测试板等业务，在新加坡交易所上市、股票代码为 1R6.SG，因此选择其为可靠性测试板的可比公司；

注 2：最高层数（L）是指测试板的 PCB 层数，层数越多，布线密度越高，支持更复杂的电路设计，通常越大越好；

注 3：PIN 脚数（max）是指测试板可支持的引脚数量，反映其连接能力，数量越多，可测试的芯片或模块越复杂，越大越好；

注 4：pitch（min）是指引脚之间的最小间距，间距越小，测试板能够适配更精密、更小尺寸的芯片，越小越好；

注 5：最大速率（Gbps/Mbps）是指信号传输的最大速率，速率越高，测试板能够支持更高带宽的应用，越大越好；

注 6：最高频率（GHz）是指测试板能够承载的最高工作频率，频率越高，适应高速信

号的能力越强，越大越好；该指标系公司实际交付产品的技术数据；

注 7：最大功率（W）是指测试板能够承受的最大功耗，功率越高，支持的高性能芯片或负载能力越强，越大越好；

注 8：DDR 类型是指支持的内存类型，类型越新（如 DDR5、LPDDR5X），表示技术越先进，兼容性越强；

注 9：最高速率（Mbps）特指内存测试的最高传输速率，速率越高，测试能力越强，越大越好。

在集成电路测试板行业中，因为中国大陆的先进制程受到限制，先进制程尚未达到国际一流水平，高端市场目前主要由精测、雍智科技、Avi-tech 等境外领先厂商占据。随着中国大陆先进制程能力的提升和大陆芯片复杂度的提升，发行人有望依托本土产业链协同优势，加快技术突破与市场替代。从技术指标对比来看，受制于下游客户芯片产品的制程水平，发行人在部分指标上与精测、雍智科技等头部企业仍存在一定差距，但在最高层数、PIN 脚数、pitch 精度及最高频率等关键指标已追平行业领先水平，具备正面竞争的能力。

（5）研发投入、研发人员及发明专利的比较情况

2025 年度，发行人与同行业可比公司在研发投入、研发人员及发明专利等方面的比较情况如下：

公司	研发费用（万元）	研发费用占营业收入比例	研发人员数量（人）	研发人员数量占比	发明专利（项）
闳康（3587.TWO）	5,291.17	4.24%	未披露	未披露	未披露
胜科纳米（688757.SH）	5,735.85	10.83%	131	13.86%	45
雍智科技（6683.TWO）	6,036.57	12.64%	未披露	未披露	未披露
伟测科技（688372.SH）	17,201.10	10.92%	522	19.53%	19
发行人	5,506.10	8.22%	133	11.91%	53

注：因苏试试验（300416.SZ）未单独披露苏试宜特相关数据，且苏试试验（300416.SZ）整体数据不具有可比性，因此上表未列示苏试宜特相关数据。

（六）发行人的行业地位及竞争优劣势

1、发行人的行业地位

公司在第三方实验室检测分析、集成电路测试板、量产测试服务等领域的市场地位分别如下：

（1）第三方实验室检测分析服务

报告期内，中国大陆第三方实验室检测分析服务市场规模（数据来源：集微

咨询）、发行人第三方实验室检测分析服务收入及市场占有率分别如下：

单位：亿元

项目	2025 年	2024 年	2023 年
中国大陆半导体第三方实验室检测分析服务市场规模	125.5	104.2	89.9
发行人第三方实验室检测分析服务收入	4.24	3.79	2.78
发行人第三方实验室检测分析服务市场占有率	3.38%	3.63%	3.09%

第三方实验室检测分析服务市场呈现出较强的区域性特征，普遍围绕主要半导体产业集聚区进行布局。这一特点导致全球范围内第三方实验室检测分析市场格局相对分散，单体企业市场份额有限。与主要竞争对手相比，公司的第三方实验室业务收入规模居于前列，具体如下：

单位：万元

第三方实验室业务可比公司	2026 年 1-6 月营业收入	2025 年营业收入	2024 年营业收入	2023 年营业收入
闳康	**未披露**	48,123.05	50,928.17	52,003.38
胜科纳米	**29,738.91**	52,952.73	41,527.19	39,398.33
苏试宜特	**19,772.60**	39,070.17	32,022.67	28,093.20
华测蔚思博	**未披露**	未披露	未披露	17,132.35
广电计量	**14,353.80**	30,934.20	25,570.40	20,248.74
季丰电子	**23,002.57**	**42,437.31**	**37,862.80**	**27,760.40**

注 1：闳康的营业收入为其审计报告披露的来源于中国大陆的收入；

注 2：苏试宜特的营业收入参照苏试试验定期报告披露的苏试宜特的营业收入；

注 3：华测蔚思博为华测检测主要从事半导体检测的子公司，华测蔚思博 2023 年收入来自华测检测 2023 年年报；

注 4：广电计量营业收入为其定期报告披露的集成电路测试与分析收入；

注 5：季丰电子营业收入为当期第三方实验室业务技术服务收入，不包含硬件收入。

从第三方实验室业务覆盖范围来看，公司全面覆盖失效分析、材料分析（包括化学分析）、可靠性测试等细分业务类型；从区域布局来看，公司在上海、北京、杭州、深圳、成都等地均设有子公司，覆盖国内主要半导体产业集聚地；从下游客户来看，公司服务于超过 3,000 家半导体产业链客户，包括客户 D、中兴通讯、高通、客户 H、华虹宏力、长电科技等知名企业。

（2）集成电路测试板

集成电路测试板主要分为探针卡、测试载板、老化板、系统板四大类。公司提供的集成电路测试板主要包括测试载板、老化板、系统板。报告期内，中国大陆集成电路测试板市场规模、发行人相应业务的收入以及市场占有率如下：

单位：亿元

项目	2025 年	2024 年	2023 年
中国大陆集成电路测试板市场规模	39.7	36.5	25.1
发行人集成电路测试板收入	1.47	1.21	1.09
市场占有率	3.70%	3.31%	4.33%

在集成电路测试板行业中，高端市场目前主要由精测、雍智科技、Avi-tech 等境外领先厂商占据，发行人等中国大陆企业仍处于追赶阶段，市场占有率较低。随着中国大陆高端芯片国产化进程加速，以及终端厂商对芯片质量要求日趋严格，发行人等本土测试板企业通过深耕细分赛道（如存储、AI 芯片、射频、模拟、功率半导体），在部分领域开始与国际厂商展开竞争。

公司自 2019 年进入客户 D 供应链体系，目前来自该终端客户的收入占比较高。在服务客户 D 的过程中，公司经历了其系统化的质量体系验证与严格管控，形成了符合高端标准的质量管理能力，实现了“零缺陷”交付目标，整体产品品质得到显著提升。依托在这一过程中积累的技术与质量优势，公司已能够为存储、AI 等高端芯片提供集成电路测试板解决方案，并成功导入了长鑫存储、客户 I、矽品科技、恒玄科技、蔚来汽车、翱捷科技、兆易创新、思瑞浦等行业内多家知名客户。

（3）量产测试

公司于 2022 年拓展了量产测试业务，重点布局前景广阔、技术壁垒较高的车规级芯片量产测试市场。报告期内，公司量产测试业务尚处于起步阶段。

综上，公司作为业内少有的半导体检测全功能、一站式解决方案提供商，既具有检测服务与检测硬件产品两块业务的协同优势，又分别在第三方实验室业务、集成电路测试板领域拥有较为突出的市场地位，市场竞争力较强。

2、发行人的竞争优劣势

（1）竞争优势

①全功能、一站式模式优势

公司围绕半导体全产业链企业的检测需求进行业务布局，构建了半导体检测领域“服务+产品”的一站式能力，业务覆盖从“0-1”研发验证到规模量产的全

过程。

对客户而言，公司提供第三方实验室检测分析、检测硬件产品及量产测试服务等全功能解决方案，客户无需分别对接多家供应商，避免了信息错漏与沟通成本，可获得更高效的技术支持与决策依据，有助于客户缩短问题定位与验证周期、提升研发效率、优化工艺良率、降低开发成本。

对公司而言，检测分析与检测硬件业务之间形成了深度协同与迭代效应，使公司具备跨领域解决复杂检测问题的独特能力，可满足 CPU、GPU、存储芯片、复杂 SoC 等高端芯片及先进工艺、先进封装等高端样品的全方位测试与检测分析需求。具体而言，通过检测分析服务为客户解决实际问题的同时，公司积累了丰富的失效案例与前沿需求数据，为硬件产品的技术验证与快速迭代提供了实战基础；性能持续优化的硬件产品反哺检测分析服务，进一步提升检测效率与精准度，形成了“服务牵引硬件迭代，硬件反哺服务升级”的内生循环机制。

②客户和品牌优势

凭借全功能、一站式服务模式，优异的技术能力和服务品质，以及完善的区域布局，公司得到了半导体产业链众多知名客户的认可、客户粘性较强，“季丰电子”在半导体检测领域的品牌知名度较高，具有一定品牌效应。公司在半导体产业链的客户超过 3,000 家，包括客户 D、中兴通讯、高通、紫光展锐、兆易创新、豪威集团、客户 I 等芯片设计企业，客户 H、客户 A、华虹宏力、积塔半导体、客户 G 等芯片制造企业，长电科技、华天科技、甬矽电子、安靠科技、矽品科技等封测企业。基于公司积累的客户基础与市场品牌，公司近年来开拓的量产测试、电子制造服务等新业务板块可实现客户资源的有效复用与交叉转化，降低新业务的市场拓展门槛。

公司的优质客户群体代表了全球半导体产业的最先进技术方向与领先工艺水平，其日益提升的检测需求、严格的技术标准以及对检测效率与可靠性的极致追求，持续驱动公司在检测服务与检测硬件产品两大业务板块进行技术迭代与创新突破。在与行业标杆客户的深度协同中，公司不断汲取前沿的产业洞察，反哺自身在集成电路测试板设计、实验室分析服务能力的升级，实现了从跟随需求到引领创新的能力跨越。这种与优质客户共成长的良性循环，已成为推动季丰电子

技术持续进步、服务不断提升、并巩固其行业地位的核心动力之一。

③技术优势

公司在为庞大的半导体产业链客户群体提供服务的过程中，积累了海量检测分析案例，形成了覆盖样品制备、高端线路修补、失效定位、材料分析、测试板设计仿真、量产老化测试等关键环节的完整技术体系。并且，形成了一批具备先进性的核心技术，包括先进制程逻辑单元立体结构分析方法、先进封装热失效深度定位技术、集成电路测试板设计与仿真技术等。

基于深厚的技术积累，公司形成了多项具备市场竞争力的能力，具体情况如下：在先进制程检测能力方面，公司的先进制程案例已覆盖 3nm 芯片，设备最先进检测能力可达到 2nm 及以下芯片，处于行业前列；在可靠性测试方面，公司具备单芯片 800W 功率的整体方案能力，在关键技术指标与方案落地能力上处于行业较高水平；在高端线路修补方面，公司配备了红外热像仪支持背开模式、GDS 自动导航定位软件，更适配于先进制程产品的线路修补，可实现精准修改高阶制程芯片的设计缺陷、验证电路设计。

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司拥有 140 项专利，其中发明专利 58 项。公司拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的 201 个检测项目、检验检测机构资质认定（CMA）的 56 个检测项目，并获得 ISO9001 国际品质管理认证、ISO/IEC 17025 国际实验室管理体系认证、IATF16949 汽车工业质量管理体系认证等。公司获评为工信部国家级重点“小巨人”企业、国家先进制造业集群（车规级芯片工程化测试服务平台）、“中国芯”优秀支撑服务企业、上海市科技小巨人优秀企业、上海市服务型制造示范平台、上海市专精特新中小企业、优秀专家工作站。

④规模及服务优势

在第三方实验室板块，公司具备仪器设备规模领先且种类齐全、专业团队完备、全国多点布局及信息化管理高效的综合优势。在设备方面，公司在国际高端仪器设备（如聚焦离子束显微镜、透射电子显微镜等）、国产化适配设备及设备种类齐全度上具备明显优势，可以满足客户一站式检测需求。在团队方面，公司已组建近 200 人的专业团队，涵盖设计、仿真、采购、生产组装及应用支持等完

整职能。在区域布局方面，公司在上海、北京、杭州、深圳、成都等半导体产业集聚地建立子公司，能够更好地贴近关键客户、提升响应速度与服务品质。在信息化管理方面，公司自主研发的 LIMS 实验室信息管理系统已在主要实验室投入使用，进一步提升了运营效率与服务质量。2025 年，公司第三方实验室服务收入为 42,437.31 万元，业务规模居于中国大陆前列，展现出较强的市场地位。

公司已将快速响应与高效执行打造为核心服务能力，并使之成为客户项目顺利推进的重要保障。公司能够在客户研发、试产及量产的全流程中，精准识别其差异化与紧迫性需求，依托跨领域技术团队和灵活的组织资源，迅速集结技术力量，实现定制化解决方案的高效交付。这种以客户为中心的高效协同机制，不仅有效支撑了客户的快速产品迭代与市场导入，也使公司赢得了客户的长期信任。

⑤人才优势

公司集聚了一批拥有跨学科背景与丰富行业经验的优秀人才，部分成员来自国内外知名芯片设计公司、大型晶圆制造厂、第三方检测实验室以及先进检测设备企业，形成了跨领域、多背景的复合型人才架构。在人才配置上，公司围绕检测分析、硬件设计、软件开发等核心能力板块，构建了分工明确、协同高效的团队结构。同时，公司通过内部导师制、技术培训及项目实战等机制，持续强化人才梯队建设与技术能力传承。截至 2026 年 6 月 30 日，公司共有 140 名研发人员，占员工总数的比例为 11.17%。

基于对半导体全产业链技术环节与业务场景的深入理解，团队能够真正站在客户立场，精准把握其在产品开发、良率提升与质量管控中的核心诉求与痛点。同时，团队积累了覆盖多种工艺节点与产品类型的海量案例分析能力，更能够从设计意图、制造工艺与测试标准等多维度深刻理解客户差异化需求，使得公司能够为客户提供覆盖芯片全生命周期的全方位、综合性技术支持，成为其产品研发与质量管控体系中值得信赖的外部协作伙伴。

（2）竞争劣势

①资本实力不足

公司作为一家半导体领域检测服务与检测硬件产品的全功能、一站式解决方案提供商，业务布局全面、技术更迭较快，既需要持续投入研发以保持技术竞争

力，又需购置高端检测设备与分析仪器以支撑服务产能。然而，公司目前尚未上市，目前主要依靠自有经营现金流和银行借贷进行投资，资本实力与业务发展速度尚不匹配，在应对快速扩张的市场需求和长期技术投入方面存在一定资金压力。

②高端人才存在一定缺口

伴随公司业务规模扩大与技术复杂度提升，对具备跨学科背景、熟悉先进工艺并拥有丰富产业经验的高端研发与技术人才需求日益迫切。目前，行业内具备失效分析、材料表征、集成电路测试等综合能力的专业人才供给整体不足，公司在吸引和保留复合型高端人才方面仍面临一定挑战，可能对业务拓展与技术迭代的速度产生影响。

三、发行人的销售情况和主要客户

（一）报告期内的销售情况

1、公司主要产品销售收入构成情况

报告期内，公司主要产品的销售收入及占比情况如下：

单位：万元

类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第三方实验室检测分析服务	23,002.57	61.60%	42,437.31	64.02%	37,862.80	65.70%	27,760.40	63.78%
检测硬件产品	8,561.62	22.93%	15,333.34	23.13%	12,473.52	21.65%	11,437.15	26.28%
量产业务（量产测试及电子制造服务）	3,997.05	10.70%	5,720.57	8.63%	3,980.29	6.91%	3,292.01	7.56%
工程样品封装及其他	1,779.75	4.77%	2,796.46	4.22%	3,311.05	5.75%	1,036.59	2.38%
合计	37,341.00	100.00%	66,287.68	100.00%	57,627.66	100.00%	43,526.14	100.00%

2、主要产品及服务的规模、销售价格情况

（1）第三方实验室检测分析服务

①服务规模

公司提供的第三方实验室检测分析服务具有明显的定制化特点，每一个检测分析案件都需要结合样品类型、样品失效问题、样品具体结构、客户需求提供定制化解决方案，因此每个案件所需执行的实验分析项目及数量存在差异，进而导

致各类案件所使用仪器设备的类型、次数、时间以及操作方式等都可能存在差异。因此，公司针对不同案件的分析实验不属于标准化的“流水线”操作，公司难以根据所拥有的仪器设备数量进行产能规模的量化统计，不适用于一般意义的产能、产量、销量概念。

报告期各期，发行人执行第三方实验室检测分析案件数量分别为60,810件、75,090件、86,584件**和46,176件**，报告期内保持持续增长。

②销售单价

报告期内，第三方实验室服务是公司收入主要来源，由失效分析、材料分析和可靠性测试组成，具体构成情况如下：

单位：万元

类别	2026年1-6月		2025年度		2024年度		2023年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
失效分析	**9,906.92**	**43.07%**	18,552.21	43.72%	14,820.25	39.14%	10,446.98	37.63%
材料分析	**7,228.15**	**31.42%**	11,973.04	28.21%	13,203.84	34.87%	8,758.18	31.55%
可靠性测试	**5,867.50**	**25.51%**	11,912.06	28.07%	9,838.72	25.99%	8,555.24	30.82%
合计	**23,002.57**	**100.00%**	**42,437.31**	**100.00%**	**37,862.80**	**100.00%**	**27,760.40**	**100.00%**

失效分析、材料分析、可靠性测试因案件难度、单个案件规模、测试设备类型、时间周期等存在差异，单个案件收费存在明显差异，各业务类型的服务单价具体如下：

业务类型	项目	2026年1-6月	2025年度	2024年度	2023年度
失效分析	销售金额（万元）	**9,906.92**	18,552.21	14,820.25	10,446.98
	案件数量（件）	**29,833**	59,002	49,558	38,846
	案件单价（元/件）	**3,320.79**	3,144.34	2,990.48	2,689.33
	占主营业务收入比例	**26.53%**	27.99%	25.72%	24.00%
材料分析	销售金额（万元）	**7,228.15**	11,973.04	13,203.84	8,758.18
	案件数量（件）	**5,636**	6,486	5,724	8,761
	案件单价（元/件）	**12,824.96**	18,459.82	23,067.50	9,996.78
	占主营业务收入比例	**19.36%**	18.06%	22.91%	20.12%
可靠性测试	销售金额（万元）	**5,867.50**	11,912.06	9,838.72	8,555.24
	案件数量（件）	**11,894**	23,996	22,414	18,670
	案件单价（元/件）	**4,933.16**	4,964.18	4,389.54	4,582.35

业务类型	项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
	占主营业务收入比例	**15.71%**	17.97%	17.07%	19.66%

注：报告期各期，上表各业务类型的案件数量合计大于对应期间的客户委案数量，系单个委案可能同时执行多种类型的检测分析项目；材料分析中主要定价模式是按照“样品数量*每颗样品的单价”定价，案件数量与样品数量存在较大差异。

报告期内，失效分析的案件单价逐年提升，主要是因为双束聚焦离子束电镜、微光电镜、扫描电子显微镜、扫描透射电子显微镜、高端线路修补、3D X-Ray 等单价较高的高端检测分析项目，在先进制程及复杂芯片分析中的执行数量及占比不断增加所致。

报告期内，材料分析的案件单价先增后降。2024 年案件单价较上年提升 130.75%，是因为公司来自于客户 A 的收入大幅增加，客户 A 为晶圆厂，在晶圆制造新工艺开发、产线验证过程中产生大量材料分析需求，主要系晶圆样品制备和透射电镜成像分析项目，单个案件测试芯片数量多、测试难度大、交期要求紧，因此收费水平较高；2025 年案件单价较上年下降 19.97%，主要系公司为稳固现有市场份额并抢占新增市场需求，针对部分晶圆样品制备和透射电镜成像分析项目的报价适当下调；**2026 年上半年，材料分析核心检测项目晶圆样品制备和透射电镜成像分析项目收费单价保持稳定，但因老客户送样安排调整，检测需求被拆分为更多案件执行；新开拓客户合作初期执行案件平均测试样品数量和单价低于存量核心客户，导致整体案件平均单价下滑**。

报告期内，可靠性测试的案件单价在 2024 年下降 4.21%，主要系公司应对市场竞争下调了部分项目收费。2025 年案件单价增长 13.09%，一方面系检测项目收费数量增长推动 RA、ESD 检测案件单价均有所提升；另一方面系收费水平较高的新能源可靠性测试案件收入占比增加导致。

第三方实验室服务的案件单价分析请参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“七、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”之“2、主营业务收入按产品类别分析”之“（1）第三方实验室检测分析服务”。

（2）检测硬件产品

公司提供的检测硬件产品为集成电路测试板、检测仪器设备，其中检测仪器设备收入规模较小，因此主要针对集成电路测试板进行分析，具体如下：

①产品规模

在集成电路测试板业务中，公司专注于集成电路测试板的研发、设计，并将测试板设计方案发送至制板供应商，制板供应商完成 PCB 原板的生产后交付给公司，公司贴片安装后出售。因此，集成电路测试板产品主要原材料为供应商提供，无需公司进行复杂的生产工序。贴片工序较为简单，投资金额不大，在订单数量增加时公司可以扩展投资，必要时也可以委外加工。公司集成电路测试板的产能限制主要在于 PCB 裸板厂的产能与交期。

报告期内，集成电路测试板的产量、销量、产销率情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
产量（片）	**18,710**	43,063	26,887	20,325
销量（片）	**18,432**	41,528	25,031	21,774
产销率	**98.51%**	96.44%	93.10%	107.13%

②销售单价

报告期内，公司集成电路测试板产品的销售单价及变动情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售金额（万元）	**7,865.46**	14,702.37	12,086.67	10,874.93
销售数量（片）	**18,432**	41,528	25,031	21,774
销售单价（元/片）	**4,267.28**	3,540.35	4,828.68	4,994.46
单价变动率	**20.53%**	-26.68%	-3.32%	-

公司的集成电路测试板产品主要应用于从芯片设计到批量生产过程中涉及的可靠性测试、晶圆测试和芯片成品测试，需根据客户产品迭代和技术更新针对化设计，定制化程度较高，不同规格的产品单板价格差异较大。2025 年度，因客户需求变化，公司产品销售结构发生变化，价格偏低的系统板销售数量大幅增加，因此销售单价下降 26.68%。**2026 年 1-6 月，公司集成电路测试板产品平均售价受产品结构优化影响有所回升。**

集成电路测试板的销售单价分析请参见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“七、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”之“2、主营业务收入按产品类别分析”之“（2）检测硬件产品”。

3、不同销售模式下收入构成情况

公司的销售模式均为直销模式，直接面向半导体全产业链客户提供检测分析服务与检测硬件产品，公司不存在其他销售模式。

（二）主要客户情况

报告期各期，公司对前五大客户的销售情况如下表所示：

单位：万元

年度	客户名称	销售金额	占当期营业收入的比重
2026 年 1-6 月	**客户 A**	**3,836.52**	**10.13%**
	禾赛科技	**850.49**	**2.24%**
	客户 K	**800.15**	**2.11%**
	矽品科技	**733.44**	**1.94%**
	客户 D	**682.22**	**1.80%**
	合计	**6,902.82**	**18.22%**
2025 年度	客户 A	7,851.57	11.73%
	苏试试验	1,532.63	2.29%
	客户 D	1,449.41	2.16%
	矽品科技	1,204.21	1.80%
	华测检测	1,190.43	1.78%
	合计	**13,228.24**	**19.76%**
2024 年度	客户 A	9,877.60	16.93%
	绍兴高新技术产业开发区开发建设有限公司	1,521.86	2.61%
	闳康技术检测（上海）有限公司	1,341.42	2.30%
	华测检测	1,171.17	2.01%
	苏试试验	1,139.04	1.95%
	合计	**15,051.09**	**25.80%**
2023 年度	客户 E	2,604.15	5.87%
	思瑞浦	1,493.25	3.37%
	紫光展锐	1,082.61	2.44%
	闳康技术检测（上海）有限公司	1,078.13	2.43%
	苏试试验	1,054.35	2.38%
	合计	**7,312.49**	**16.49%**

注：已合并计算受同一实际控制方控制的客户的销售金额。

上述报告期内前五大客户的主营业务及其业务规模、合作历史等情况如下：

序号	客户名称	主营业务	业务规模	合作历史
1	客户 A	集成电路制造	12 英寸晶圆厂，专注于 28 纳米及以下先进制程集成电路制造	2023 年开始合作
2	客户 D	智能终端提供商	全球领先的智能终端提供商公司	2019 年开始合作
3	矽品科技	集成电路封装制造、测试及销售等相关业务	全球第一大 IC 封测服务商日月光投控旗下成员企业	2015 年开始合作
4	华测检测	RA、FA、IC 电路修补	2025 年营业收入 66.21 亿元，**2026 年上半年收入 34.30 亿元，同比增长 15.86%**	2017 年开始合作
5	绍兴高新技术产业开发区开发建设有限公司	政府投资平台，业务包括半导体检测实验室投建	绍兴市越城区（高新区）基础设施建设与国有资本运营平台	2024 年开始合作
6	闳康技术检测（上海）有限公司	半导体第三方检测分析	2025 年集团全球营业收入 12.48 亿元，**2026 年上半年集团全球营业收入 6.54 亿元**	2020 年开始合作
7	苏试试验	环境试验设备的研发和生产、半导体检测分析	2025 年营业收入 22.48 亿元，**2026 年上半年营业收入 10.80 亿元，同比增长 8.93%**	2020 年开始合作
8	客户 E	集成电路制造	拥有 8 英寸、12 英寸晶圆生产线	2022 年开始合作
9	思瑞浦	芯片设计	2025 年营业收入 21.42 亿元，**2026 年 1-6 月营业收入 16.06 亿元，同比增长 69.19%**	2018 年开始合作
10	紫光展锐	移动通信及物联网核心芯片设计与销售	国内主要移动通信芯片设计企业之一，2024 年营业收入规模约 145 亿元	2015 年开始合作
11	**禾赛科技**	**激光雷达及相关感知系统的研发、生产与销售**	**全球知名激光雷达供应商，2025 年营业收入 30.28 亿元，2026 年 1-6 月营业收入 15.41 亿元，同比增长 25.14%**	**2018 年开始合作**
12	**客户 K**	**半导体装备及零部件、电子制造设备**	**国内核心半导体设备制造商**	**2023 年开始合作**

报告期内，公司前五大客户主要为大型晶圆厂、芯片设计公司、封测厂以及半导体第三方实验室检测分析机构等，整体较为稳定。半导体第三方实验室检测分析机构主要系应其自身客户的要求，向季丰电子采购集成电路测试板用于检测分析。

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员及其他主要关联方或持有公司 5%以上股权的股东在其前五大客户中占有权益的情形。

四、发行人的采购情况和主要供应商

（一）报告期内的采购情况

1、设备、材料等采购情况

公司主要提供第三方实验室检测分析服务、集成电路测试板等检测硬件产品。在第三方实验室检测分析服务中，公司需要采购显微镜、离子源等检测设备、实验耗材；在集成电路测试板业务中，公司需要采购 PCB 板、芯片、连接器等原材料；同时，公司的量产业务等同样均需采购各类生产设备及耗材。

报告期内，公司设备、材料等采购金额如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
设备及维修保养	19,396.29	64.83	25,904.29	60.49	30,207.51	70.21	26,991.05	69.21
材料与耗材	8,746.04	29.23	13,523.11	31.58	9,977.03	23.19	9,339.71	23.95
委外服务	438.02	1.46	714.73	1.67	515.45	1.20	883.03	2.26
其他	1,338.47	4.47	2,679.23	6.26	2,326.82	5.41	1,782.74	4.57
合计	**29,918.82**	**100.00**	**42,821.36**	**100.00**	**43,026.81**	**100.00**	**38,996.52**	**100.00**

注：其他主要为公司生产、经营等所采购的电力及未能归属于上述采购类别的其他采购业务。

2、能源供应情况

公司耗用的能源主要为电力，随着公司业务规模的提升，公司所消耗电力呈逐年提升的态势。报告期内，公司用电情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
用电量（万度）	1,762.28	3,143.33	2,570.19	1,999.30
电费总额（万元）	1,276.89	2,627.49	2,234.22	1,650.04
用电单价（元/度）	0.72	0.84	0.87	0.83
电价变动率	-13.74%	-3.84%	5.33%	/

（二）主要供应商情况

报告期各期，公司向前五大供应商的采购情况如下：

单位：万元

年度	供应商名称	采购金额（不含税）	占当年采购总额的比重
2026 年 1-6 月	**爱德万**	**4,607.90**	**15.40%**
	赛默飞	**4,133.44**	**13.82%**
	日立高新	**917.25**	**3.06%**
	EAST CAPITAL TRADING COMPANY LIMITED	**786.28**	**2.63%**
	上海晶毅电子科技有限公司	**781.24**	**2.61%**
	合计	**11,226.11**	**37.52%**
2025 年度	赛默飞	11,930.00	27.86%
	爱德万	5,571.92	13.01%
	广州兴森快捷电路科技有限公司	1,120.66	2.62%
	天津金海通半导体设备股份有限公司	923.89	2.16%
	安徽凌光红外科技有限公司	893.81	2.09%
	合计	**20,440.28**	**47.73%**
2024 年度	赛默飞	9,963.84	23.16%
	Micro Control Company	2,619.73	6.09%
	日立高新	2,256.44	5.24%
	滨松	1,830.80	4.26%
	利量电子	1,312.18	3.05%
	合计	**17,982.99**	**41.80%**
2023 年度	赛默飞	9,447.91	24.23%
	爱德万	5,562.64	14.26%
	Micro Control Company	1,518.17	3.89%
	江苏瑞蓝自动化设备集团有限公司	1,363.71	3.50%
	滨松	1,160.02	2.97%
	合计	**19,052.45**	**48.86%**

注：已合并计算受同一实际控制方控制的供应商的采购金额。

报告期各期，公司向前五大供应商的采购占比分别为 48.86%、41.80%、47.73%和 37.52%，2024 年前五大供应商采购占比有所降低，主要系公司结合量产测试业务发展情况，在该年度对爱德万的采购额有所降低所致。报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员及其他主要关联方或持有公司 5%以上股权的股东在上述前五大供应商中占有权益的情形。

五、发行人主要固定资产和无形资产

（一）固定资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司拥有的固定资产情况如下：

单位：万元

类别	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
专用设备	142,590.20	39,399.34	103,190.85	72.37%
运输工具	320.45	193.90	126.55	39.49%
其他设备	1,604.74	1,183.23	421.51	26.27%
合计	144,515.39	40,776.47	103,738.91	71.78%

公司固定资产以专用设备为主，主要包括用于实验测试的仪器设备。截至 2026 年 6 月 30 日，发行人固定资产用于日常经营，权属清晰，不存在权属争议的情形，不存在纠纷或潜在纠纷。

截至本招股说明书签署日，发行人未拥有自有房屋及建筑物，公司及其子公司、分公司用于业务开展及经营的租赁房屋情况具体如下：

序号	承租人	出租人	租赁地址	面积（平方米）	租赁期限
1	季丰电子	上海百坚置业有限公司	上海市浦东新区张江祖冲之路 1505 弄 55 号 5 幢，3 层标准厂房第 1 层、第 3 层	1,680.00	2026.02.01-2029.01.31
			上海市浦东新区祖冲之路 1505 弄 55 号内仓库、临时建筑物	115.00	2026.02.01-2029.01.31
2	季丰电子	上海莘光实业公司	上海市闵行区友东路 258 号	5,740.18	2021.09.01-2041.08.31
			上海市闵行区友东路 258-288 号 2 幢 101 室	40.00	2020.08.01-2030.07.31
3	季丰电子	上海圆寓科技服务有限公司	上海市浦东新区盛夏路 666 号盛银大厦 E 栋 203 室	330.00	2026.04.09-2027.07.08
4	季丰电子	上海赛夫特半导体材料有限公司	上海市金山区金瓯路 188 号 3 幢	90.00	2025.04.01-2028.03.31
5	季丰计量	上海神彩印业有限公司	上海市浦东新区顾唐路 1688、金唐路 189 号 4 幢 A 区 1-2 层	3,017.60	2022.04.01-2028.03.31
6	浙江季丰	嘉善经开资产经营管理有限公司	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 8 号 1#厂 1F（东区）	3,100.00	2021.02.01-2035.07.31
			浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 8 号二期厂房 B-1	11,287.43	2022.08.01-2035.07.31
7	杭州季丰	正泰量测技术股份有限公司	浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路 560 号 1 幢 1 号楼 106 室	883.00	2021.06.01-2029.05.31

序号	承租人	出租人	租赁地址	面积（平方米）	租赁期限
8	衢州季丰	浙江汇盛投资集团有限公司	浙江省衢州市衢江区东港园区智能制造加速基地一期（银仓路10号）1栋厂房一楼西侧部分	2,363.00	2022.05.18-2032.05.17
			浙江省衢州市衢江区东港园区智能制造加速基地一期（银仓路10号）1栋厂房一楼西侧部分	2,323.98	2023.06.26-2032.05.17
			浙江省衢州市衢江区东港园区智能制造加速基地一期（银仓路10号）1栋屋面1以及屋面2	539.06	2024.02.01-2027.01.31
			浙江省衢州市衢江区银仓路10号1幢（电子产业园东侧部分）厂房的房屋	**157.44**	**2026.06.01-2031.05.31**
9	深圳季丰	深圳市通产科技发展有限公司	广东省深圳市南山区朗山路28号通产新材料产业园3栋1单元101	748.00	2025.04.01-2028.03.31
			广东省深圳市南山区朗山路28号通产新材料产业园3栋1单元102	440.00	2025.07.01-2028.06.30
			广东省深圳市南山区朗山路28号通产新材料产业园3栋1单元106	220.00	2025.08.01-2028.07.31
			广东省深圳市南山区朗山路28号通产新材料产业园1栋101物业	490.00	**2026.08.24-2028.07.31**
10	江山季丰	江山市城市资产经营有限公司	浙江省衢州市江山市双塔街道文教西路9号第十一层	750.00	2026.01.01-2027.12.31
11	季丰精密	嘉善经开资产经营管理有限公司	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路8号6#厂1F（西南区）及A-2幢三楼	6,224.00	2023.11.10-2029.03.09
			浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路8号二期厂房B-2三楼	3,790.60	2026.03.10-2035.12.31
			浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路8号二期厂房	**2,400.00**	**2026.09.12-2035.12.31**
12	北京季峰	北京中关村集成电路设计园发展有限责任公司	北京市海淀区北清路丰豪东路9号院2号楼3单元3层301-7号	103.40	**2026.06.12-2028.06.11**
			北京市海淀区北清路丰豪东路9号院2号楼3单元3层301-1号	82.45	2023.11.01-2027.10.31
			北京市海淀区北清路丰豪东路9号院2号楼3单元3层301-2号	60.05	2023.11.01-2027.10.31
13	成都季丰	成都天投产业投资有限公司	中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道集萃街619号天府海创园2-2号楼2层	1,642.41	2025.01.01-2026.12.31
14	亦庄季峰	北京爱普益生物科技有限公司	北京市北京经济技术开发区地盛东路1号2幢1层	800.00	2024.05.01-2027.04.30
			北京市北京经济技术开发区地盛东路1号2幢1、2层	500.00	2025.09.01-2027.04.30

序号	承租人	出租人	租赁地址	面积（平方米）	租赁期限
15	西安季丰	西安泰维无线科技有限公司	西安市高新区唐延南路 8 号 5 幢 11 层 1103 室（T2-1103 室）	202.91	2026.08.01-2028.07.31

发行人根据自身资产状况及生产模式，目前在深圳、杭州、北京、成都、嘉善等地租赁了场所主要用于生产经营、产品研发和日常办公等。

（二）无形资产

1、土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司拥有 1 项土地使用证，具体情况如下表所示：

序号	权利人	土地证号	坐落位置	面积（平方米）	取得方式	用途	终止日期	他项权利
1	季丰技术	沪（2025）浦字不动产权第 084159 号	浦东新区北蔡楔形绿地 D02-10 地块	8,972.05	出让	科研设计用地	2075.7.1	抵押

2、专利

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司拥有 140 项中国境内专利，其中发明专利 58 项、实用新型专利 70 项、外观设计专利 12 项。已授权专利具体情况请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“八、发行人及其子公司拥有的专利”。

3、商标

截至本招股说明书签署日，公司拥有 36 项注册商标，具体情况请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“九、发行人及其子公司拥有的注册商标”。

公司上述商标均通过自主申请方式取得，相关商标不存在权属纠纷或商标侵权相关的法律风险。

4、计算机软件著作权

截至本招股说明书签署日，公司拥有 133 项计算机软件著作权，具体情况请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“十、发行人及其子公司拥有的计算机软件著作权”。

5、域名

截至本招股说明书签署日，公司拥有 3 项注册域名，具体情况如下：

序号	网站域名	网站首页网址	网站备案/许可证号	主办单位
1	gf-net.cn	gf-net.cn	沪 ICP 备 18013004 号-3	季丰电子
2	gf-msg.cn	gf-msg.cn	沪 ICP 备 18013004 号-2	季丰电子
3	giga-force.com	giga-force.com	沪 ICP 备 18013004 号-1	季丰电子

（三）公司生产要素情况

前述固定资产和无形资产均为公司的主要资产，公司运用上述资产进行正常生产经营并获取收益。公司已经取得与生产经营直接相关的主要资产，机器设备使用情况良好，商标、专利等的使用不存在影响公司生产经营的重大障碍。

（四）业务资质情况

1、生产经营资质

截至本招股说明书签署日，公司拥有的生产经营资质情况如下：

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书	CNAS L18034	浙江季丰	中国合格评定国家认可委员会	2023.03.23	2023.03.23-2029.03.22
2	中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书	CNAS L20222	深圳季丰	中国合格评定国家认可委员会	2024.02.29	2026.04.13-2030.02.27
3	中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书	CNAS L18870	衢州季丰	中国合格评定国家认可委员会	2023.08.17	2023.08.17-2029.08.16
4	中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书	CNAS L15104	季丰电子	中国合格评定国家认可委员会	2023.09.26	2023.09.26-2027.07.15
5	中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书	CNAS L21124	杭州季丰	中国合格评定国家认可委员会	2024.07.01	2024.07.01-2030.06.30
6	中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书	CNAS L21974	成都季丰	中国合格评定国家认可委员会	2024.11.26	2026.03.03-2030.11.25

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
7	检验检测机构资质认定证书	221109343151	浙江季丰	浙江省市场监督管理局	2022.07.08	2022.07.08-2028.07.07
8	检验检测机构资质认定证书	202319017137	深圳季丰	广东省市场监督管理局	2024.11.22	2024.11.22-2029.06.13
9	检验检测机构资质认定证书	231121343290	衢州季丰	浙江省市场监督管理局	2023.06.08	2023.06.08-2029.06.07
10	检验检测机构资质认定证书	200909341902	季丰电子	上海市监局	2020.12.02	2020.12.02-2026.12.01
11	检验检测机构资质认定证书	221109343086	杭州季丰	浙江省市场监督管理局	2022.01.19	2022.01.19-2028.01.18
12	检验检测机构资质认定证书	242309341005	成都季丰	四川省市场监督管理局	2024.01.05	2024.01.05-2030.01.04
13	高新技术企业证书	GR202531006275	季丰电子	上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局	2025.12.25	三年
14	高新技术企业证书	GR202333002624	浙江季丰	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局	2023.12.08	三年
15	高新技术企业证书	GR202433011255	江山季丰	浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局	2024.12.06	三年
16	高新技术企业证书	GR202433008030	杭州季丰	浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局	2024.12.06	三年
17	高新技术企业证书	GR202511005031	亦庄季峰	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局	2025.12.02	三年
18	高新技术企业证书	GR202544206250	深圳季丰	深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局	2025.12.25	三年
19	高新技术企业证书	GR202531008457	季丰技术	上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局	2025.12.25	三年
20	报关单位备案	1113260A33	亦庄	亦庄海关	2024.06.18	长期有效

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
	证明		季峰			
21	报关单位备案证明	4403962CDK	深圳季丰	福中海关	2022.09.09	长期有效
22	报关单位备案证明	33089609RR	衢州季丰	衢州海关	2022.07.01	长期有效
23	报关单位备案证明	3317960A0K	江山季丰	衢州海关	2024.06.25	长期有效
24	报关单位备案证明	31119602F7	季丰科技	莘庄海关	2022.06.20	长期有效
25	报关单位备案证明	33049698GR	季丰精密	嘉兴海关驻嘉善办事处	2022.11.29	长期有效
26	报关单位备案证明	31119601FD	季丰电子	莘庄海关	2015.08.19	长期有效
27	报关单位备案证明	5101960EAJ	成都季丰	天府新区海关	2022.06.27	长期有效
28	报关单位备案证明	1108960ATY	北京季峰	中关村海关	2023.08.21	长期有效
29	报关单位备案证明	3304969825	浙江季丰	嘉兴海关驻嘉善办事处	2021.04.12	长期有效
30	报关单位备案证明	33013602XV	杭州季丰	钱江海关驻萧然办事处	2021.12.15	长期有效
31	报关单位备案证明	3122261J32	季丰技术	浦东海关	2026.03.06	长期有效
32	固定污染源排污登记回执	91310000677808271X001Y	季丰电子	全国排污许可证管理信息平台	2022.06.28	2022.06.28-2027.06.27
33	**固定污染源排污登记回执**	**91310112MA7JB5FM61001X**	**季丰精密**	**全国排污许可证管理信息平台**	**2025.04.15**	**2025.04.15-2030.04.14**
34	排污许可证	91440300MA5H20HB0P001U	深圳季丰	深圳市生态环境局南山管理局	2023.03.06	2023.03.06-2028.03.05
35	特种设备使用登记证	容 17 沪 L03456（22）	季丰电子	上海市闵行区市场监督管理局	2022.09.06	长期有效
36	辐射安全许可证	沪环辐证[62476]	季丰电子	上海市闵行区生态环境局	2024.04.16	2024.04.16-2029.04.15
37	辐射安全许可证	浙环辐证[F5163]	季丰精密	嘉兴市生态环境局嘉善分局	2025.04.15	2024.04.15-2030.04.14
38	辐射安全许可证	浙环辐证[A1717]	杭州季丰	杭州市生态环境局	2026.04.29	2026.4.29-2031.4.28
39	**辐射安全许可证**	**京环辐证[F1247]**	**北京季峰**	**北京市海淀区生态环境局**	**2026.06.10**	**2026.06.10-2031.06.09**

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司已取得从事生产经营活动所需的许可、备案、注册及认证。上述行政许可、备案、注册及认证均在有效期内，

且不存在被吊销、撤销、注销、撤回的重大法律风险或者到期无法延续的风险。

2、管理体系认证相关资质

截至本招股说明书签署日，公司取得的管理体系认证相关资质情况如下：

认证主体	证书名称	编号/注册号	认证范围	认证依据	有效期限
季丰电子	质量管理体系认证（ISO9001）	CN21/20627	印刷电路板组件和集成电路测试设备的设计与销售；提供集成电路失效分析和材料分析服务；提供电子电工产品的静电测试和可靠性测试服务（限计量认证的检验项目）	ISO9001:2015	2025.05.08-2027.04.05
季丰电子	环境管理体系认证	CN6592-EC	印刷电路板和集成电路测试设备的设计与销售；提供集成电路失效分析和材料分析服务；提供电子电工产品的静电测试和可靠性测试服务（限计量认证的检验项目）	ISO14001:2015	2024.12.10-2027.12.08
季丰电子	中国职业健康安全管理体系认证	CN6592-SC	印刷电路板和集成电路测试设备的设计与销售；提供集成电路失效分析和材料分析服务；提供电子电工产品的静电测试和可靠性测试服务（限计量认证的检验项目）	ISO45001:2018	2024.12.10-2027.12.08
季丰电子	静电防护标准认证	CN26/00001826	提供集成电路失效分析服务；提供电子电工产品的静电测试服务；提供电子电工产品的可靠性测试服务	ANSI/ESDS20.20-2021	2026.03.19-2027.03.18
季丰电子	企业知识产权合规管理体系认证	18124IP0343R1M	印刷电路板和集成电路测试设备的研发、销售、上述过程相关采购的知识产权管理；芯片失效分析和集成电路元器件性能测试、电子类（静电、可靠性）检验检测的服务、销售、上述过程相关采购的知识产权管理	GB/T29490-2023	2024.08.24-2027.08.23
季丰电子	信息安全管理体系认证	011532332777、011532332777/01	信息安全管理体系支持印刷电路板和集成电路测试设备的设计和销售；芯片失效分析和集成电路元器件性能测试服务；电子类（静电可靠性）检验检测服务	ISO/IEC 27001:2022	2026.04.14-2027.04.28
深圳季丰	信息安全管理体系认证	011532332777/02	信息安全管理体系支持芯片失效分析和集成电路元器件性能测试服务；电子类（静电可靠性）检验检测服务	ISO/IEC 27001:2022	2026.04.14-2027.04.28
季丰精密	环境管理体系认证	CN6648-EC	半导体零部件（芯片测试专用治具）的制造；印刷电路板组件的制造	ISO14001:2015	2025.03.28-2028.03.27
季丰精密	中国职业健康安全管理体系认证	CN6648-SC	半导体零部件（芯片测试专用治具）的制造；印刷电路板组件的制造	ISO45001:2018	2025.03.28-2028.03.27
季丰	质量管理	CN24/00	半导体测试零部件的机械加工及组	ISO900	2024.10.08-

认证主体	证书名称	编号/注册号	认证范围	认证依据	有效期限
精密	体系认证（ISO9001）	006250	装；印刷电路板组件的制造	1:2015	2027.10.07
季丰精密	汽车行业质量管理体系认证	CN26/00004294	印刷电路板组件（PCBA）的制造	IATF16949:2016	2026.06.14-2029.06.13
季丰精密	医疗器械质量管理体系认证	CN25/00008408	有源非植入医疗器械的印刷电路板组件的制造	ISO13485:2016	2025.12.29-2028.12.09
衢州季丰	管理体系认证证书	F00526Q00561R117	光伏产品应用性能检验检测服务	ISO9001:2015	2026.07.15-2029.07.14
衢州季丰	环境管理体系认证	TUV104034907	光伏产品应用性能检验检测服务	ISO14001:2015	2024.01.05-2027.01.04
衢州季丰	中国职业健康安全管理体系认证	TUV106034907	光伏产品应用性能检验检测服务	ISO45001:2018	2024.01.05-2027.01.04
季丰科技	环境管理体系认证	CN6590-EC	印刷线路板组件的制造，芯片的封装	ISO14001:2015	2024.12.05-2027.12.04
季丰科技	中国职业健康安全管理体系认证	CN6590-SC	印刷线路板组件的制造，芯片的封装	ISO45001:2018	2024.12.05-2027.12.04
季丰科技	质量管理体系认证（ISO9001）	CN22/00002103	印刷线路板组件的制造，芯片的封装	ISO9001:2015	2025.07.29-2028.07.28
浙江季丰	环境管理体系认证证书	CN23/00006912	半导体芯片测试	ISO14001:2015	2023.12.25-2026.12.24
浙江季丰	质量管理体系认证证书	CN23/00000548	电子类检测（可靠性（限资质许可范围内）、集成电路性能）服务的提供	ISO9001:2015	2026.02.08-2029.02.07
浙江季丰	信息安全管理体系认证证书	CN23/00006714	信息安全管理体系覆盖芯片和晶圆的测试服务	ISO/IEC27001:2022	2023.12.12-2026.12.11
浙江季丰	静电防护标准认证	CN23/00005505	电子类检测（可靠性（限资质许可范围内）、集成电路性能）服务的提供	ANSI/ESDS20.20-2021	2025.12.22-2026.12.21
浙江季丰	汽车行业质量管理体系认证	CN23/00005259	集成电路的熔丝微调	IATF16949:2016	2024.09.03-2027.09.02

（五）资产许可与被许可使用的情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在授权他人使用自身资产或被授权使用他人资产的情况。

（六）特许经营权情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在授权他人或被他人授权的特许经营权。

六、发行人核心技术和研发情况

（一）核心技术

1、核心技术情况

报告期内，公司研发体系完善，具有独立自主的研发能力，核心技术均为自主研发。

公司在为客户提供服务及持续研发创新的过程中，形成了覆盖样品制备、高端线路修补、失效定位、材料分析、测试板设计仿真、量产老化测试等关键环节的完整技术体系，并形成了一批具备先进性的核心技术。截至本招股说明书签署日，公司主要核心技术情况如下：

序号	技术名称	技术应用业务	技术特色	技术来源	技术先进性	涉及专利与著作权	所处阶段
1	高端线路修补技术	失效分析	•技术难点：芯片流片后易存在设计疏漏、互连接线错误、版图工艺缺陷等问题，若直接改版重新流片，周期长、成本高；且新一代架构性能对标验证，无法依赖常规改版流片流程快速完成线路修正与功能实测验证。需要一种晶圆级快速电路修改技术，完成新版流片前修改验证。 •解决方案：通过对样品进行制样处理露出芯片正面或背面后读取施工 GDS，进行电子束成像或 IR 成像以对应芯片实物位置，结合芯片工艺制程选择使用离子束进行刻蚀，刻蚀出目标金属层进行相应切断或沉积金属连接或沉积金属到芯片表面。后续进行验证测试或失效分析。此方案可以快速修复设计缺陷、定位失效、验证原型。	自主研发	快速修复设计缺陷、定位失效、验证原型，显著缩短研发周期、降低成本，是先进半导体研发不可或缺的关键技术。	--	规模化商用
2	扫描电容显微镜离子注入分析技术	失效分析	•技术难点：离子注入后形成的纳米级掺杂分布难以进行非破坏性、定量的电学特性测量。 •解决方案：通过在 PN 结上施加高频交流偏压，诱导半导体表面局域载流子发生周期性的积累与耗尽，从而调制微区电容。测量电容随偏压的变化率，其信号幅度直接反映局域多数载流子浓度，相位则用于判别掺杂类型。对于离子注入区域，激活后的杂质形成自由载流子的空间分布，该分布通过调制 dC/dV 响应被逐点记录。将各测量点的响应重构为二维图像，即可实现对注入区载流子浓度均匀性、结深以及横向扩散的高分辨、非破坏性成像分析。	自主研发	非破坏性检测，空间分辨率达 10 纳米量级，具备卓越的电学敏感性，是工艺监控的关键技术。	--	小批量商用
3	太赫兹时域反射故障定位技	失效分析	•技术难点：先进封装制程中微缩线路因高集成度、多层堆叠导致的高阻、短路等缺陷难以通过外部电气测试有效定位。	自主研发	定位精度达数十微米量级，显著优于传统 TDR 技术，有	--	规模化商用

序号	技术名称	技术应用业务	技术特色	技术来源	技术先进性	涉及专利与著作权	所处阶段
	术		•解决方案：该技术利用太赫兹波对封装介质材料的高穿透特性，向封装内部线路注入皮秒级陡峭脉冲信号，并通过实时采集并分析反射信号的时间差与波形特征，精确计算故障点位置，实现对高阻、短路等缺陷的亚微米级空间定位。		效解决高密度封装内部故障诊断难题		
4	先进封装热失效深度定位技术	失效分析	•技术难点：先进封装（2.5D/3D）中热失效点的深度（Z 轴）信息无法通过二维热成像获取。 •解决方案：基于热传导理论与热积分模型，通过分析热点传导至封装表面的时间延迟效应，结合算法反演计算失效点的三维空间坐标。	自主研发	专为先进封装开发，实现热失效点的深度方向定位，突破传统二维分析局限。	芯片失效分析方法、装置、电子设备及介质【202210132348.0】 一种芯片失效分析去层方法【202511769616.X】	小批量商用
5	纳米探针载流子分布实时分析技术	失效分析	•技术难点：先进制程器件在工作状态下的载流子动态行为难以实时、高分辨率地表征。 •解决方案：基于电子束感应电流原理，实现微纳半导体器件在原位通电工况下载流子行为的实时成像与动态分析。该技术能够精确解析器件内部载流子的空间分布、运动轨迹及扩散范围，并完整捕捉在不同偏置、开关及动态工作模式下，电子-空穴对从产生、分离、输运到复合的分布演化规律。	自主研发	该技术是先进制程器件微观电学缺陷定位与载流子输运机理研究的核心表征手段。公司具备原子级空间分辨率与飞秒级时间分辨率，实现多维度动态表征，技术处于国际前沿。	图像传感器处理方法和分析方法【202510711339.0】 一种芯片失效分析去层方法【202511769616.X】	小批量商用
6	先进制程逻辑单元立体结构分析方法	材料分析	•技术难点：保护层填充难，深孔/沟槽深宽比＞30:1~100:1，Pt/C 保护层难以渗入孔底/侧壁，极易出现空洞、分层、包覆不全；FIB 切割形貌畸变（窗帘效应极强） •解决方案：低功率电子束沉积碳打底，再离子束沉积铂，再镀一层碳。碳能渗入高深宽比微孔，杜绝孔内空洞、分层；FIB 切割工艺优化，倾斜角补偿切割，样品小倾角加工，抵消高深宽比纵向遮挡，减少形貌畸变。	自主研发	掌握高深宽样品的预处理和 FIB 制样能力。	--	规模化商用
7	纳米尺度	材料分	•技术难点：纳米器件（如 FinFET）中的应变	自主	应变分析空间分辨	--	规模化商用

序号	技术名称	技术应用业务	技术特色	技术来源	技术先进性	涉及专利与著作权	所处阶段
	应变场表征技术	析	对性能至关重要，但测量极易受样品制备应力释放的影响。 •解决方案：通过透射电镜（TEM）图像衬度精确控制样品厚度至 10 纳米以内，结合预制电子衍射（PED）技术进行应变分析，将不确定性降至最低。	研发	率达 2 纳米，检测精度达 10^{-4}量级，样品厚度控制技术为独特优势。		
8	纳米结构化学状态分析技术	材料分析	•技术难点：纳米尺度下材料元素价态、化学键合及禁带宽度等化学状态的精准测量对能量分辨率要求极高。 •解决方案：利用高能量分辨率（优于 0.5eV）的扫描透射电镜-电子能量损失谱（STEM-EELS）技术，分析元素的近边精细结构（ELNES）和低损失峰，实现纳米区域化学状态的精准鉴定。	自主研发	EELS 是此类分析的唯一技术手段，公司在该技术的应用能力上处于国内第一梯队。	--	规模化商用
9	透射电镜自动量测技术	材料分析	•技术难点：传统手动量测芯片工艺关键尺寸存在效率低、标准不统一的问题。 •解决方案：自主开发基于图像识别算法的自动量测软件，将 TEM 图像中的工艺界面转换为可识别的像素线段，并自动计算尺寸。	自主研发	实现关键尺寸量测的自动化与标准化，大幅提升量测效率和结果一致性，为国内领先。	一种测量栅氧化层厚度的方法【202511622831.7】 一种扫描电子显微镜的放大倍率校准方法【202511651848.5】	小批量商用
10	亚纳米栅氧厚度表征技术	材料分析	•技术难点：对于厚度小于 1 纳米的先进工艺栅极氧化层，传统 TEM 测量易因制样损伤和成像条件不佳而产生误差。 •解决方案：采用低电压（≤2kV）聚焦离子束（FIB）精细制样，并通过独创的 TEM 模式晶带轴精细调整技术，获取真实、清晰的界面高分辨像进行量测。	自主研发	攻克极薄栅氧层准确表征的业界难题，测量技术具备独创性，处于行业领先地位。	一种超薄 TEM 样品制备方法【202610000316.3】 一种测量栅氧化层厚度的方法【202511622831.7】	小批量商用
11	扫描电容掺杂分析技术	材料分析	•技术难点：纳米尺度区域的掺杂类型（n/p 型）和浓度定量分析是工艺诊断的难点。 •解决方案：利用扫描电容显微镜（SCM）对表面电容变化的高度敏感性，实现纳米分辨率下	自主研发	非破坏性测量，可实现 10 纳米量级区域的掺杂分析，有效支撑工艺开发	--	规模化商用

序号	技术名称	技术应用业务	技术特色	技术来源	技术先进性	涉及专利与著作权	所处阶段
			的掺杂分布成像与半定量分析。		与失效分析。		
12	高纯材料痕量金属分析技术	化学分析	•技术难点：复杂半导体基体（如高纯硅、特种气体）中超痕量金属杂质检测面临严重基体干扰。 •解决方案：采用串联四极杆电感耦合等离子体质谱（ICP-MS/MS）技术，利用反应池模式有效消除干扰，实现超痕量元素的精准定量。	自主研发	可测定超过 60 种元素，检出限达 ppt（万亿分之一）量级，具备卓越的抗干扰能力和灵敏度。	--	规模化商用
13	宽浓度范围元素分析技术	化学分析	•技术难点：样品中高低浓度元素共存时，难以在不稀释的情况下实现同步准确定量。 •解决方案：采用具备同步垂直/水平观测技术的电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES），其宽动态范围设计支持从 μg/L 到百分含量浓度的直接测定。	自主研发	有效克服高盐/有机基体干扰，避免稀释误差，分析效率与数据准确性高。	--	小批量商用
14	射频器件多应力老化试验技术	可靠性测试	•技术难点：射频器件在老化试验中需模拟其真实工作状态，涉及偏压、射频信号输入、寄存器配置等多参数协同控制。 •解决方案：构建定制化测试系统，集成多路射频信号源、精密电源管理、寄存器配置及实时监控模块，实现多维度应力的精准加载与闭环控制。	自主研发	方案整合性强，单系统可以支持 80 工位同时带射频信号老化测试，大幅提升带射频并行批量测试效率，填补了带射频信号输入的偏压老化试验方案空白，支持车规级可靠性验证。	射频信号源【202030620772.1】 射频信号放大器【202030620348.7】	规模化商用

序号	技术名称	技术应用业务	技术特色	技术来源	技术先进性	涉及专利与著作权	所处阶段
15	加速寿命测试与预估技术	可靠性测试	•技术难点：如何通过加速测试精准预估器件在正常工况下的寿命，特别是捕捉如热载子注入等特定失效机理。 •解决方案：应用温度-电压复合应力加速模型，结合 Arrhenius/Eyring 等物理模型，对测试数据进行量化分析，输出中位寿命等关键可靠性参数。	自主研发	测试方法兼容 JESD、AEC 等国际主流标准，寿命预估模型准确性高，特别是针对车规级器件在高温、高电压同时作用下的寿命预估，准确率达到国际领先水平。	电压电流监控设备【202130650774.X】 一种芯片测试装置【201820211187.3】 一种芯片测试及老化测试装置【201820211238.2】 一种 LM2100 崩应可靠度测试机老化板结构【201820376921.1】 一种 LM2100 崩应可靠度测试机多电源模块【201820396967.X】 一种用于老化测试机台的老化板背面测试装置【202021251773.4】 数字老化机【202130691813.0】 芯片测试夹具及芯片测试组件【202511384599.8】 一种微型针座及微型针台【202610188971.6】 一种功率循环测试专用夹具【202423087026.2】 **一种功率循环测试装置【202522052074.6】** **高加速应力测试载板的器件布局方法、装置及电子设备【202610453945.1】**	规模化商用
16	传输线脉	可靠性	•技术难点：传统 HBM/CDM 测试无法提供器	自主	掌握大功率芯片量	--	规模化商用

序号	技术名称	技术应用业务	技术特色	技术来源	技术先进性	涉及专利与著作权	所处阶段
	冲（TLP）测试技术	测试	件 I-V 特性曲线，难以指导 ESD 防护设计优化。 •解决方案：通过施加纳秒级方波脉冲，精确测量器件的动态 I-V 特性，并提取二次击穿电流（It2）、触发电压（VT1）等关键参数。	研发	产测试的完整软硬件设计能力，方案成功率高，测试稳定性与可靠性好。		
17	超快传输线脉冲（VF-TLP）测试技术	可靠性测试	•技术难点：针对 FinFET、GAA 等先进制程芯片，其 ESD 失效机理涉及更快的瞬态事件，传统 TLP 脉冲速度不足。 •解决方案：采用脉宽低至 1.25ns、上升沿小于 1ns 的超快脉冲，模拟高频静电放电事件，精确表征器件的快速响应特性。	自主研发	实现全工业温域的全链路测试覆盖，通过数据关联提升测试价值，助力客户加速产品量产。	一种半导体器件的 VF-TLP 测试系统及其校准方法【202511949471.1】	规模化商用
18	板级系统可靠性评估技术	可靠性测试	•技术难点：板级产品的可靠性涉及环境、机械、电气等多种应力的综合影响，评估体系复杂。 •解决方案：通过高速采样电阻对微欧级电阻变化进行纳秒级实时采集，可在热冲击、机械应力加载过程中连续监测焊接点和导电路径的完整性，能更早发现微裂纹、接触不良等潜在失效，并将监测数据与测试板设计、表面贴装工艺参数关联追溯，从而精准定位失效根源。该方案为高可靠电子产品的快速研制与质量验证提供了技术支撑。	自主研发	具备国内领先的 55MHz 采样频率实时监控能力（采样速度是国内主流设备的 5.5 倍，进口高端设备的 1.8 倍），可快速发现并定位潜在故障，且支持 1000 小时以上不间断数据采集。	电阻自动测试仪【202230109936.3】 **一种芯片测试装置和芯片测试方法【202610304809.6】**	规模化商用
19	芯片老化测试实时监测技术	集成电路测试板	•技术难点：传统老化测试中，密封环境内单个芯片的温度与形变难以独立、实时、高精度监测。 •解决方案：在测试板内设计集成专用的电阻测试层（蛇形金属走线），通过实时监测其电阻值变化反演芯片温度，并利用时域反射计（TDR）分析走线阻抗变化实现形变定位。	自主研发	实现每个待测芯片的独立、实时温度与形变监测，数据精准度高，为可靠性评价提供更详实的数据支撑。	芯片老化测试的监测方法、电子设备和存储介质【202210051803.4】	小批量商用
20	高速接口测试硬件	集成电路测试	•技术难点：PCIe 等高速接口链路需要测试在不同信号衰减（如-5dB 至-25dB）下的性能，	自主研发	大幅提升测试载板的复用率和配置灵	PCIE 差分信号链路的多梯度衰减测试系统、方法	小批量商用

序号	技术名称	技术应用业务	技术特色	技术来源	技术先进性	涉及专利与著作权	所处阶段
	系统技术	板	传统方法需定制多块载板，成本高、周期长。 •解决方案：采用“母板+可插拔衰减子板”的模块化架构，通过更换不同衰减值的子板来快速切换测试条件，无需更换整个母板。		活性，显著降低客户测试成本与周期，支持 PCIeGen5 等高速标准。	和电子设备【202210295130.7】 悬臂探针卡、悬臂探针卡的处理方法、装置及电子设备【202310524053.2】 **一种芯片测试装置和芯片测试方法【202610304809.6】**	
21	半导体测试载板元器件丝印位号自动化调整技术	集成电路测试板	•技术难点：高密度 PCB 设计中，丝印与焊盘、过孔等关键区域的重叠易导致焊接不良、阻抗异常，传统人工调整效率低且易遗漏。 •解决方案：通过自动检测算法精准定义丝印避让区域，结合智能调整规则实现丝印位移与缩放，确保布局与硬件性能匹配。	自主研发	实现全自动化处理，显著提升设计效率与准确性，保障高频高速信号完整性。	元器件丝印位号的调整方法及装置【202210608793.X】	规模化商用
22	集成电路测试板设计与仿真技术	集成电路测试板	•技术难点：传统仿真方法难以覆盖大电流、高速信号等多场景需求，参数设置繁琐且预测精度不足。 •解决方案：融合神经网络与物理模型，通过多阶段训练适配细分场景，实现硬件性能的精准预测与布局优化。	自主研发	突破传统仿真局限，提升多场景适配性与预测可靠性，支持复杂硬件设计。	印刷电路板的仿真方法及装置【202210050392.7】 **高加速应力测试载板的器件布局方法、装置及电子设备【202610453945.1】**	规模化应用
23	动态控温、高电压芯片可靠性测试技术	测试设备	•技术难点：AI 芯片对动态控温要求、车规芯片对高压供电的需求、芯片量产对软件系统性的要求 •解决方案：通过对芯片核心温度读取来进行控温、提供 0.5~120V 供电选择、功能丰富的上位机软件来满足量产老化的需求。	自主研发	通过软硬件创新，让芯片可靠性测试更有效率、测试更全面。	老化机和老化机的接口板【202210002880.0】 电源设备的控制方法、装置、电子设备及介质【202210037154.2】 一种用于老化测试机台的老化板背面测试装置【202021251773.4】 基于 CPLD 的测试板接口	规模化应用

序号	技术名称	技术应用业务	技术特色	技术来源	技术先进性	涉及专利与著作权	所处阶段
						电路【201922097935.7】 一种电压电流监控系统【202220484804.3】	
24	大功率算力芯片量产测试方案技术	量产测试服务	•技术难点：AI/GPU 等大功率算力芯片测试面临高功耗散热、高管脚数、大向量深度及信号完整性等一系列挑战。 •解决方案：提供涵盖 LoadBoard、Socket、ProbeHead 等硬件设计、电源网络优化、信号完整性仿真及测试程序开发的全套解决方案，通过特殊设计控制散热和保证供电稳定。	自主研发	掌握大功率芯片量产测试的完整软硬件设计能力，方案成功率高，测试稳定性与可靠性好。	大功率芯片的功率温度循环试验方法、装置和电子设备【202111645898.4】 芯片测试夹具及芯片测试组件【202511384599.8】 负载板边缘连接器的保护装置【202511596200.2】 悬臂探针卡、悬臂探针卡的处理方法、装置及电子设备【202310524053.2】	小批量商用
25	大功耗三温全链路测试技术	量产测试服务	•技术难点：汽车、工业级大功耗芯片需在极端温度（-55℃~200℃）下进行晶圆测试、成品测试和老化测试，存在数据孤岛和测试稳定性问题。 •解决方案：开发适配全温域的测试硬件夹具与老化板，并集成自动化系统（EAP/MES），实现三温环境下 CP-FT-BI 全链路测试数据的关联与追溯。	自主研发	实现全工业温域的全链路测试覆盖，通过数据关联提升测试价值，助力客户加速产品量产。	芯片测试夹具及芯片测试组件【202511384599.8】 悬臂探针卡、悬臂探针卡的处理方法、装置及电子设备【202310524053.2】	规模化商用
26	跨区域实验室数据与流程一致性技术	软件开发	•技术难点：跨地域、多类型实验室的网络存在数据格式、检测流程不统一的问题，难以实现高效协同与数据贯通。	自主研发	实现跨区域、多类型实验室的流程标准化与数据一致性管理，每日可支持 999 单案件同时流转，数据准确性提高 90%以上，提升整体运营效率。	已授权软著 10 项	规模化应用

2、核心技术的成果情况

（1）发行人获得的重要奖项及荣誉

截至本招股说明书签署日，发行人获得的主要奖项及荣誉的具体情况如下：

序号	荣誉名称	授予主体	颁发机构	授予日期/有效期限
1	第三批国家级专精特新“小巨人”企业	季丰电子	工业和信息化部	2024.07-2027.06
2	国家级专精特新重点“小巨人”企业	季丰电子	工业和信息化部	2025.09
3	2025年上海市制造业单项冠军企业——车规级芯片工程化测试服务	季丰电子	上海市经济和信息化委员会	2025.12
4	中国仪器仪表学会技术发明奖一等奖	季丰电子	中国仪器仪表学会	2025.08
5	“中国芯”优秀支撑服务企业	季丰电子	中国电子信息产业发展研究院（赛迪）	2024.11
6	优秀专家工作站	季丰电子	上海市院士专家工作站指导办公室、上海市闵行区人民政府	2024.11
7	2024年度“先进制造业和现代服务业深度融合发展”典型案例	季丰电子	上海市经济和信息化委员会	2024.10
8	2023年度汽车电子科学技术奖优秀创新产品奖（季丰 H160数字老化测试机）	季丰电子	深圳汽车电子行业协会	2024.06
9	上海市第一届检验检测行业创新大赛优胜奖	季丰电子	上海市市场监督管理局	2024.05
10	2024 年上海专精特新“小巨人”企业品牌价值榜“百佳企业”	季丰电子	上海市中小企业发展服务中心、上海企业文化与品牌研究所	2024.05
11	2024年上海中小企业最具成长品牌榜“百佳企业”	季丰电子	中国品牌经济（上海）论坛组委会、上海企业文化与品牌研究所	2024.05
12	上海市科技小巨人优秀企业	季丰电子	上海市科学技术委员会	2024.01
13	上海市服务型制造示范平台	季丰电子	上海市经济和信息化委员会	2023.09
14	上海市企业技术中心	季丰电子	上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局、上海海关	2023.02
15	国家先进制造业集群——上海集成电路产业集群项目车规级芯片工程化测试服务平台	季丰电子	上海市集成电路行业协会	2022.12
16	浙江省创新型中小企业	杭州季丰	浙江省经济和信息化厅	2025.01-2028.01
17	浙江省科技型中小企业	杭州季丰	浙江省科学技术厅	2024.01

序号	荣誉名称	授予主体	颁发机构	授予日期/有效期限
18	浙江省科技型中小企业	浙江季丰	浙江省科学技术厅	2023.06
19	浙江省科技型中小企业	江山季丰	浙江省科学技术厅	2021.12

（二）研发情况

1、在研项目

截至本招股说明书签署日，公司正在从事的重要研发项目情况如下：

序号	项目名称	对应业务	拟达到的目标	所处阶段
1	基于 COWOS 的分析方法研究	第三方实验室检测分析服务-失效分析	本项目旨在建立一套面向先进封装的高精度、高效率失效定位技术体系，提升对复杂封装结构中潜在缺陷的识别与分析能力，并探索导入 AI/机器学习方法进行缺陷识别与模式分类，提高分析效率与准确性。	技术开发
2	纳米系统的 EBIC 动态截面失效分析研发测试方案	第三方实验室检测分析服务-失效分析	本项目旨在建立面向 MOS（金属氧化物半导体，一种核心电子元件）及纳米系统的 EBIC（电子束感生电流）动态截面分析方法，实现截面器件在加电状态下 Junction（PN 结）形貌、载流子分布、缺陷位置的实时观测，补齐静态测试与仿真之间的技术缺口，提升复杂失效分析的准确性与效率，满足车规级长寿命、高稳定性、严苛环境的分析需求。	技术开发
3	超低 k 介质的无损伤观察方法研发	第三方实验室检测分析服务-失效分析	本项目旨在建立一套适用于超低 k 介质（先进芯片制造中的一种关键绝缘材料）的无损伤观察完整技术方案，实现样品表面与截面形貌、孔结构、界面状态的高保真观测，形成标准化操作流程，支撑先进半导体材料研发、工艺优化与失效分析。	技术开发
4	基于扫描探针显微镜与 X 射线衍射在材料分析与失效分析的检测方法	第三方实验室检测分析服务-失效分析、材料分析	本项目旨在建立基于扫描探针显微镜与 X 射线衍射的综合检测方法，形成标准化的多技术联用检测流程，填补当前在 X 射线衍射薄膜分析领域的方法体系建设空白，进一步提升公司在半导体材料分析与失效分析领域的技术纵深。	技术开发
5	iDPC 技术建立及应用	第三方实验室检测分析服务-材料分析	本项目旨在完成 iDPC 三个主要的应用技术：（a）低剂量成像，通过优化电子束剂量，利用 iDPC-STEM 减少辐照损伤的前提下获取高分辨率图像，对 LowK/光阻材料发生的形变或厚度缩减有更精确的量测；（b）轻元素成像能力，iDPC-STEM 通过增强衬	技术开发

序号	项目名称	对应业务	拟达到的目标	所处阶段
			度，实现了轻元素的可视化，并支持与重元素同时成像；（c）三维结构解析，突破传统二维成像限制，iDPC-STEM 能部分解析样品深度方向的结构信息，突破制样的限制，解决结构重影问题。	
6	先进工艺芯片关键尺寸的 TEM 自动量测技术	第三方实验室检测分析服务-材料分析	本项目旨在建立一套可靠的 TEM（透射电子显微镜）自动量测解决方案，包括适用于 TEM 自动量测的 TEM 样品制备技术、TEM 图像采集和基于 TEM 图像的工艺结构边界识别算法等。该方案能成功实现全自动的芯片工艺的关键尺寸量测，根据任意特定的芯片工艺关键尺寸量测需求，如圆的直径、膜层厚度、孔的深度以及不规则图案的自定义量测等，通过软件算法修改实现全自动大批量量测关键尺寸。	技术开发
7	球差/EELS（电子能量损失谱）/PED（旋进电子衍射）技术建立及应用	第三方实验室检测分析服务-材料分析	本项目旨在建立一套具备原子级别空间分辨率、能量分辨率、元素分析以及高精度应变分析能力的先进透射电子显微镜分析技术，实现从“宏观形貌观察”向“原子级物性解析”的能力跃迁。	技术开发
8	非破坏性 Chiplet（芯粒）封装 CDM 失效定位技术	第三方实验室检测分析服务-可靠性测试	本项目旨在建立一套基于瞬态电流波形重构的 CDM（带电器件模型）失效定位方法，实现芯片内部失效位置的快速、非破坏性诊断，定位误差≤1mm（封装内部）。	技术开发
9	1KW 以上老化机台 BIB 能力建立	检测硬件产品-集成电路测试板	本项目旨在建立≥1KW 大功率 BIB（老化测试板）完整设计、仿真、验证与应用能力，稳定支持 1KW 及以上芯片老化量产测试，并形成可量产使用的高功率老化测试板，满足公司大功率产品老化测试与可靠性验证需求。	技术开发
10	基于 10G 高速通讯接口测试板的研究	检测硬件产品-集成电路测试板	本项目旨在完成基于 10G 高速通讯接口测试板研发，建立 10G 高速信号、射频高速信号、DDR5 接口的 PCB 设计、仿真、选型、验证全流程规范，实现测试板信号完整性与射频性能达标，支撑 10G、DDR5 与射频类芯片 ATE 及老化测试，稳定可靠，降低硬件迭代成本。	技术开发
11	超景深三维数字显微仪器研制	检测硬件产品-检测仪器设备	本项目旨在研发超景深三维数字显微镜，利用照明模块对样品进行照明；利用大数值孔径光学系统的有限景深和垂直扫描方法，实现复杂器件三维	量产验证

序号	项目名称	对应业务	拟达到的目标	所处阶段
			形貌真彩色测量，突破显微镜的光学固有限制，将光学显微镜的使用提升到新的高度。该仪器可广泛应用到芯片检测、集成电路检测、汽车零部件检测等高精密检测领域。	
12	F370 高低温存储芯片可靠性测试机	检测硬件产品-检测仪器设备	本项目基于 F160 存储芯片可靠性测试机的开发经验与软硬件资源，自主开发具有同等功能且拥有知识产权的 F370 高低温（-45 到 150℃）存储芯片（支持 FLASH-闪存测试、SRAM-静态随机存取存储器测试、EFLASH-嵌入式闪存测试）可靠性测试机，构建完整的可靠性测试系统。	**量产验证**
13	基于 93K 的大功耗算力芯片的量产测试开发方法	量产测试服务	本项目旨在开发大算力高功耗芯片的硬件检测产品，形成标准的量产程序软件框架设计，以及性能分析，稳定性分析代码库和分析方法。缩短公司在大功耗大算力芯片项目的评估、开发以及量产的周期和降低部分环节的成本，提高公司技术水平和竞争力。	技术开发
14	自动驾驶大算力芯片（AI/GPU）量产测试能力	量产测试服务	本项目旨在建成满足车规级量产交付的自动驾驶大算力 AI/GPU 芯片全自动量产测试能力，覆盖功能、性能、高速接口、可靠性、功能安全全流程测试，实现高并发、高效率、高覆盖率、数据全追溯，支撑芯片规模化量产测试交付。	技术开发

2、研发投入情况

公司建立了完善的研发流程，保障研发项目的高效顺利执行，能够满足公司发展和市场需求。报告期内，公司研发费用金额分别为 4,405.52 万元、4,962.52 万元、5,506.10 万元**和 2,529.95 万元**，占营业收入的比例分别为 9.94%、8.51%、8.22%**和 6.68%**。

3、研发人员情况

截至报告期末，公司研发人员 **140 人**，研发人员占比为 **11.17%**。报告期各期末，公司研发人员按学历背景分类具体如下：

研发人员学历	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	人数	比例（%）	人数	比例（%）	人数	比例（%）	人数	比例（%）
硕士研究生及以上	**24**	**17.14**	19	14.29	20	17.09	20	16.67

研发人员学历	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	人数	比例（%）	人数	比例（%）	人数	比例（%）	人数	比例（%）
本科	109	77.86	98	73.68	77	65.82	78	65.00
专科及以下	7	5.00	16	12.03	20	17.09	22	18.33
合计	140	100.00	133	100.00	117	100.00	120	100.00

4、合作研发情况

在坚持自主研发创新的基础上，公司积极推动与国内高等院校的合作，进行新型产品研发和重难点技术的攻克，进一步提升了公司研发的理论基础和技术水平。

报告期内，公司与上海交通大学合作研发“超景深三维数字显微仪器研制”项目。该项目围绕半导体失效分析与精密检测需求，开展超景深光学显微镜研发。该项目依托公司在半导体第三方检测领域的应用场景和工艺理解，以及上海交通大学在光学成像、精密仪器设计等方面的技术积累，针对芯片封装结构复杂、元器件尺寸微小、样品表面起伏较大等特点，对光学系统、成像算法和样品运动控制等关键环节进行联合攻关，旨在实现较大景深范围内的高分辨率成像，提升对芯片表面缺陷、封装结构和异物颗粒的检测效率和判断准确性，为公司在相关检测细分领域的技术储备和服务能力提供支持。具体内容如下：

合作单位	上海交通大学
合作项目	超景深三维数字显微仪器研制
合作期限	2021.11.1 签订合同，2024.12.17 项目通过阶段性验收
合同金额	647.00 万元
公司义务	提供项目技术背景资料及技术核心参数设计需求等，以派驻人员的方式，完成系统机械、嵌入式软硬件系统及上位机软件的相关研制工作，开展项目进展检查及阶段验收，支付研究开发经费和报酬
合作方义务	交付研究开发计划，负责仪器光学结构、融合算法及样机的研制，按进度完成研究开发内容并交付研究开发成果，为公司指定的人员提供技术指导和培训或提供与使用该技术开发成果相关的技术服务
研发成果归属	合作开发过程中所产生的技术开发成果及其知识产权（包括专利及非专利）产生的收益归公司所有
保密措施	双方对涉及的业务、研究、产品、软件、服务、市场、客户、财务、技术以及法律事务等保密信息依法保密并承担泄密责任

（三）发行人保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新安排

1、保持技术不断创新的机制

公司的研发需求主要来源于两个层面：一方面，紧密跟随半导体产业链的技术演进，针对先进制程、先进封装工艺及新材料应用带来的检测挑战进行前瞻性技术布局；另一方面，深度响应客户在研发与量产中遇到的实际问题，特别是在失效分析、可靠性测试及特定应用场景（如车规芯片）认证中提出的具体需求。

公司的研发团队由具备电子、材料、化学、机械、软件等跨学科专业人才组成。团队核心成员普遍拥有在芯片设计、晶圆工艺、封装、测试等集成电路行业知名企业的任职经历，积累了丰富的工程实践经验，能够针对复杂问题提出切实可行的解决方案。同时，公司高度重视对研发团队人员的管理，制定了从人才吸引、培养到评价等流程的研发人员激励制度。

在研发活动的开展方式上，公司以自主研发为核心，建有专业实验室并配备了相应设备及团队。同时，公司高度重视与产业界及学术界的研发协同创新，例如与上海交通大学合作研发，并与产业链企业建立联合实验室共同开展功率半导体等领域的技术攻关，以实现资源共享和优势互补。

研发活动所产生的成果，主要体现在检测方法与服务方案的创新、专用定制化的硬件与仪器设备以及相关知识产权积累三个层面。公司在持续改进现有检测分析方案、创新研发新型检测技术的同时，自主研发各类测试板及检测仪器，这些研发成果通过专利申请等方式进行保护，并成功转化应用于对外技术服务与硬件产品供应中，实现了研发投入与成果产出的良性循环机制，进一步巩固了公司在行业内的技术优势。

2、技术储备

发行人在失效分析、材料分析、可靠性分析及集成电路测试板等业务形成了一系列核心技术，例如先进制程逻辑单元立体结构分析方法、先进封装热失效深度定位技术、集成电路测试板设计与仿真技术等。公司技术体系覆盖样品制备、高端线路修补、失效定位、材料成分分析、集成电路测试板设计及仿真、量产老化测试等多个关键环节，能够从单点检测能力向系统级工程验证能力延伸，体现出较强的技术集成能力和工程化服务能力。截至本招股说明书签署日，公司及其

控股子公司拥有 140 项专利，其中发明专利 58 项。

3、技术创新安排

公司的研发活动具备高度的市场导向，是驱动公司核心业务收入持续增长的关键引擎。在日常服务中，公司敏锐捕捉客户在试产与量产环节不断升级的需求，通过持续研发投入形成技术壁垒，并构建了“直接技术变现”与“内部业务赋能”相结合的研发驱动模式，具体体现在以下方面：

（1）检测分析方法的持续攻坚：公司依托检测分析实验室，重点针对先进制程开发新型分析方法，持续为客户工艺研发提供材料分析，并为客户良率提升提供失效分析，检测分析方法的研发创新直接带动检测服务收入的增长。

（2）硬件测试板级方案的迭代：公司紧跟芯片高功率化、高复杂度的演进，自主开发高端集成电路测试板及新型板级测试方案，通过硬件产品的交付直接转化为销售收入。

（3）紧缺测试设备的自主研发与对内赋能：公司针对国内紧缺的工艺可靠性测试设备、高功耗寿命测试设备等核心装备开展自主研发，并率先实现内部使用。这不仅降低了公司对外部设备的依赖，还提升了公司实验室检测分析与量产测试的产能与服务广度，从而转化为更具规模的测试服务收入；同时，自研设备在内部高强度使用场景中的反馈迭代，也为公司未来探索设备商业化对外销售、从而形成独立收入来源准备了坚实基础。

依托上述研发布局，公司实现了对先进工艺、高端特色工艺及先进封装等高端样品的全方位覆盖，确保研发成果能够切实转化为公司的业务护城河与稳健的财务回报。

七、发行人环境保护情况

（一）环境保护情况

公司主要提供第三方实验室检测服务、检测硬件产品以及量产测试服务。公司主营业务不涉及《市场准入负面清单（2022 年版）》中禁止准入事项；公司所处行业不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的限制类或淘汰类产业；公司所处行业不属于《企业环境信用评价办法（试行）》中的重污染行业。

公司设立了 EHS 部门，保障公司在环境（Environment）、健康（Health）与安全（Safety）方面合规、高效、可持续运营；公司严格遵守相关环境保护的法律、法规和行业规范及《环保管理制度》等内部制度，日常环保工作运作严格按照相关制度执行。

公司在运营过程产生的污染物较少，主要为样品制备过程中产生的化学试剂废水等，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律法规要求，同时遵守相关内部制度，根据实际需要配备了必要的环保设施，环保设施运行状况良好，处理能力均满足排放量的要求，使得生产经营过程中产生的废气、废水、固体废弃物及噪声得到了合理有效控制。

类别	主要污染物	主要处理措施
废气	非甲烷总烃、颗粒物、丙酮、氯化氢、氮氧化合物、氟化物、硫酸雾等	生产线产生的废气密闭收集后经“过滤系统+活性炭”装置处理达标后经 15m 高的排气筒排放。
废水	化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油	生活污水和纯水制备废水直接纳入市政污水管网；食堂废水经隔油处理后纳入市政污水管网；失效分析试验室的研磨测试废水、设备、容器后道清洗废水经调节沉淀池处理达标后纳入市政污水管网；清洗废水及研磨废水经废水处理设备处理后部分回用于纯水制备，其余达标废水纳入市政污水管网。
固废	废酸、废碱、废有机溶剂、废包装容器、废活性炭、研磨废液及生活垃圾等	针对固废，公司进行袋装或瓶装收集后，统一存放在专用危废储存场所，委托具有危废处置资质的公司处理
噪声	设备噪声	公司采取选用低噪声设备、减震隔声措施、密闭门窗、加强维护等方式进行处理

报告期内，公司环保投入分别为 33.92 万元、18.86 万元、30.52 万元、**52.25 万元**，主要为废水、固废、废气等废弃物处理费用。报告期内，根据相关主管部门出具的证明文件，公司及其子公司的生产经营符合国家和地方环保法规和要求，公司及其子公司未因违反环境保护有关法律法规而受到行政处罚。

（二）环评批复与验收情况

《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》第五条规定：“本名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理”，公司建设项目不在其规定的建设项目类别内。

公司报告期内已经验收或正在运行中的主营业务产品生产项目的具体情况如下：

序号	项目名称	环评批复	环评验收
1	浦东技术中心项目	**沪浦环保许评〔2026〕119 号《上海市浦东新区生态环境局关于季丰电子浦东技术中心项目（调整）环境影响报告表的审批意见》**	待建成后再进行环评验收
2	年产汽车车规 PCBA30 万套提升改造项目	《建设项目环境影响登记表》已备案（嘉环（善）建备〔2024〕46 号），无需办理环评批复	待建成后再进行环评验收
3	北京亦庄季峰集成电路高质量公共服务平台项目	经环保审字〔2024〕0150 号《关于北京亦庄季峰检测技术有限公司北京亦庄季峰集成电路高质量公共服务平台项目环境影响报告表的批复》	已自主验收
4	新建年产芯片测试专用治具 2 万套、汽车车规 PCBA30 万套项目	《建设项目环境影响登记表》已备案（嘉环（善）建备〔2024〕13 号），无需办理环评批复	已自主验收
5	上海季丰电子股份有限公司产业化项目	闵环保许评〔2021〕289 号《上海市闵行区生态环境局关于上海季丰电子股份有限公司产业化项目环境影响报告表的审批意见》	已自主验收
6	上海季丰电子股份有限公司改扩建项目	沪浦环保许评〔2021〕295 号《上海市浦东新区生态环境局关于上海季丰电子股份有限公司改扩建项目环境影响报告表的审批意见》	已自主验收
7	杭州季丰电子科技有限公司实验室建设项目	杭滨环备〔2021〕36 号《杭州市生态环境局审查意见》	已自主验收
8	天府新区集成电路设计创新公共平台（一期）建设项目	川天环城复〔2022〕8 号《四川天府新区生态环境和城市管理局关于成都天府新区科技投资有限责任公司天府新区集成电路设计创新公共平台（一期）建设项目环境影响报告表的审查批复》[1]	已自主验收
9	深圳季丰检测技术有限公司新建项目	深环南批〔2022〕000009 号《深圳市生态环境局南山管理局关于深圳季丰检测技术有限公司新建项目环境影响报告表的批复》	已自主验收
10	中关村集成电路设计园一站式芯片测试联合实验室项目	海环审字 20230058 号《北京市海淀区生态环境局关于对中关村集成电路设计园一站式芯片测试联合实验室项目环境影响报告表的批复》	已自主验收

注 1：天府新区集成电路设计创新公共平台（一期）建设项目系成都天府新区科技投资有限责任公司投资建设的平台，成都天府新区科技投资有限责任公司与公司签署《工程技术服务运营合同》，以公司子公司成都季丰为主体共同参与该平台的运营。

八、发行人境外经营及境外资产情况

截至招股说明书签署日，公司设有一家香港子公司季峰（香港）电子有限公司。报告期内，香港季峰未实际开展经营活动。

第六节 财务会计信息与管理层分析

本节以报告期内财务数据及实际经营情况为基础，结合管理层对公司所处行业、各项业务的理解，对公司报告期内的经营成果、财务状况、持续经营能力情况及其变动趋势和影响因素进行了讨论与分析，供投资者参考。

本节财务会计数据及相关财务信息，非经特别说明，均引自经注册会计师审计的财务报告，或根据其中相关数据计算得出。公司提醒投资者阅读财务报告及审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	**110,324,215.62**	86,714,598.50	93,146,536.81	106,841,420.97
交易性金融资产	**10,005,277.78**	31,043,055.56	71,485,011.82	114,239,111.11
应收票据	**826,045.75**	1,125,996.03	2,479,413.22	1,548,929.29
应收账款	**220,933,012.07**	143,050,056.45	180,691,140.63	114,335,108.44
应收款项融资	**2,043,132.46**	3,830,509.38	1,331,185.78	2,648,528.15
预付款项	**6,708,099.91**	3,637,187.04	1,493,780.27	3,460,557.99
其他应收款	**3,654,512.00**	3,150,355.02	3,860,089.07	3,816,448.13
存货	**125,770,272.23**	107,884,072.86	76,843,806.53	74,605,772.96
持有待售资产	**-**	7,533,236.14	-	-
其他流动资产	**101,393,837.08**	80,932,928.53	56,236,751.32	38,635,795.55
流动资产合计	**581,658,404.90**	**468,901,995.51**	**487,567,715.45**	**460,131,672.59**
非流动资产：				
长期股权投资	**8,950,596.29**	9,032,421.09	10,341,335.54	1,413,388.57
其他非流动金融资产	**8,868,715.70**	19,504,856.85	15,138,973.31	7,940,740.88
固定资产	**1,037,389,153.15**	867,579,350.83	734,082,821.39	583,784,471.89
在建工程	**115,307,279.42**	120,439,226.39	124,635,334.86	78,779,150.41
使用权资产	**79,561,423.40**	77,336,310.51	87,498,992.71	94,886,176.33
无形资产	**85,201,696.69**	84,998,576.17	5,320,055.39	2,820,817.66

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
商誉	2,085,372.36	2,085,372.36	2,085,372.36	2,085,372.36
长期待摊费用	41,001,937.64	49,472,187.56	68,491,064.71	62,086,338.61
递延所得税资产	7,496,107.37	6,570,714.30	5,417,269.87	4,050,866.22
其他非流动资产	30,158,720.75	21,064,420.27	2,547,310.80	32,354,038.76
非流动资产合计	**1,416,021,002.77**	**1,258,083,436.33**	**1,055,558,530.94**	**870,201,361.69**
资产总计	**1,997,679,407.67**	**1,726,985,431.84**	**1,543,126,246.39**	**1,330,333,034.28**
流动负债：				
短期借款	451,360,885.69	334,716,580.95	343,820,720.22	212,538,226.01
应付账款	110,705,185.69	74,203,981.42	72,295,643.03	52,166,685.01
预收款项	257,220.00	6,970,675.00	435,677.43	-
合同负债	8,840,363.75	12,240,274.31	1,212,750.93	2,183,359.65
应付职工薪酬	24,545,954.22	38,026,246.11	32,691,699.90	25,939,010.61
应交税费	6,498,024.44	7,798,234.35	13,190,569.88	6,535,911.73
其他应付款	468,277.07	942,485.27	1,027,292.64	459,536.84
一年内到期的非流动负债	101,050,364.77	86,172,929.46	57,302,291.43	29,352,246.29
其他流动负债	1,728,711.13	2,348,171.99	999,258.95	1,560,949.98
流动负债合计	**705,454,986.76**	**563,419,578.86**	**522,975,904.41**	**330,735,926.12**
非流动负债：				
长期借款	249,192,768.95	158,832,579.14	106,599,547.18	152,421,716.35
租赁负债	75,385,129.81	74,990,826.32	84,627,950.04	91,425,708.92
长期应付款	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益	29,268,299.11	33,012,846.36	30,421,843.27	18,845,274.78
非流动负债合计	**353,846,197.87**	**268,836,251.82**	**223,649,340.49**	**264,692,700.05**
负债合计	**1,059,301,184.63**	**832,255,830.68**	**746,625,244.90**	**595,428,626.17**
所有者权益（或股东权益）：				
股本	115,586,000.00	115,586,000.00	115,586,000.00	115,586,000.00
资本公积	563,108,976.88	559,597,133.68	552,607,430.30	545,397,735.34
其他综合收益	163,169.85	184,729.40	201,293.69	189,876.67
盈余公积	20,253,495.16	20,253,495.16	14,628,331.36	7,331,090.73
未分配利润	239,266,581.15	199,108,242.92	113,477,946.14	66,399,705.37
归属于母公司所有者权益合计	**938,378,223.04**	**894,729,601.16**	**796,501,001.49**	**734,904,408.11**
所有者权益合计	**938,378,223.04**	**894,729,601.16**	**796,501,001.49**	**734,904,408.11**

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
负债和所有者权益总计	1,997,679,407.67	1,726,985,431.84	1,543,126,246.39	1,330,333,034.28

（二）合并利润表

单位：元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	378,857,555.13	669,493,408.69	583,482,920.27	443,366,542.34
其中：营业收入	378,857,555.13	669,493,408.69	583,482,920.27	443,366,542.34
二、营业总成本	336,158,984.30	603,533,432.61	526,612,398.53	417,968,890.93
其中：营业成本	252,464,227.76	430,864,339.21	365,462,410.81	273,549,267.23
税金及附加	514,791.28	1,274,245.90	1,069,958.16	741,950.52
销售费用	13,179,544.31	27,256,638.45	26,978,167.19	19,410,285.47
管理费用	34,912,716.84	69,406,131.46	64,590,481.00	61,774,859.89
研发费用	25,299,490.87	55,060,968.99	49,625,233.59	44,055,231.29
财务费用	9,788,213.24	19,671,108.60	18,886,147.78	18,437,296.53
加：其他收益	9,081,377.39	37,827,720.40	15,386,113.62	12,316,460.03
投资收益（损失以“-”号填列）	49,710.18	2,273,032.66	4,894,333.54	3,179,060.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,862,085.49	2,923,927.28	4,818,438.70	333,444.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,786,340.33	586,319.26	-7,264,826.03	236,400.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,903,771.73	-12,119,830.79	-11,009,043.32	-13,789,524.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,033,000.66	118,753.07	29,525.89	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,034,632.49	97,569,897.96	63,725,064.14	27,673,492.72
加：营业外收入	42,412.73	158,672.84	109,138.28	117,893.81
减：营业外支出	1,440,560.41	261,589.97	236,997.18	183,805.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,636,484.81	97,466,980.83	63,597,205.24	27,607,581.04
减：所得税费用	7,478,146.58	6,211,520.25	9,221,723.84	7,153,529.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,158,338.23	91,255,460.58	54,375,481.40	20,454,051.21
（一）按经营持续性分类：				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,158,338.23	91,255,460.58	54,375,481.40	20,454,051.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
（二）按所有权归属分类：				
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	**40,158,338.23**	91,255,460.58	54,375,481.40	23,386,665.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	**-**	-	-	-2,932,613.99
六、其他综合收益的税后净额	**-21,559.55**	**-16,564.29**	**11,417.02**	**13,277.93**
七、综合收益总额	**40,136,778.68**	**91,238,896.29**	**54,386,898.42**	**20,467,329.14**
归属于母公司所有者的综合收益总额	**40,136,778.68**	91,238,896.29	54,386,898.42	23,399,943.13
归属于少数股东的综合收益总额	**-**	-	-	-2,932,613.99
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	**0.35**	0.79	0.47	0.21
（二）稀释每股收益	**0.35**	0.79	0.47	0.21

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	**317,865,223.04**	756,977,521.81	542,368,664.83	474,903,579.19
收到的税费返还	**-**	7,915,676.98	5,877,997.41	23,560,979.57
收到其他与经营活动有关的现金	**7,463,958.04**	33,034,542.58	36,693,428.87	55,284,317.75
经营活动现金流入小计	**325,329,181.08**	**797,927,741.37**	**584,940,091.11**	**553,748,876.51**
购买商品、接受劳务支付的现金	**129,331,190.13**	234,846,057.64	165,650,791.28	141,575,826.48
支付给职工以及为职工支付的现金	**140,995,638.77**	232,645,069.10	200,357,298.93	164,586,457.94
支付的各项税费	**11,497,546.17**	23,995,146.27	9,837,246.81	9,043,090.44
支付其他与经营活动有关的现金	**15,660,655.18**	27,200,823.04	27,375,698.98	43,273,452.97
经营活动现金流出小计	**297,485,030.25**	**518,687,096.05**	**403,221,036.00**	**358,478,827.83**
经营活动产生的现金流量净额	**27,844,150.83**	**279,240,645.32**	**181,719,055.11**	**195,270,048.69**
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	**8,458,522.29**	-	-	-
取得投资收益收到的现金	**8,209,017.11**	3,581,947.11	5,066,386.57	4,617,606.08

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	**6,391,333.72**	6,728,175.00	160,756.13	-
收到其他与投资活动有关的现金	**107,000,000.00**	929,000,000.00	332,374,305.56	273,507,698.63
投资活动现金流入小计	**130,058,873.12**	**939,310,122.11**	**337,601,448.26**	**278,125,304.71**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	**241,111,118.77**	372,049,021.88	309,162,881.89	345,147,967.31
投资支付的现金	**4,000,000.00**	-	9,100,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	**-**	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	**86,000,000.00**	890,000,000.00	292,000,000.00	226,449,180.18
投资活动现金流出小计	**331,111,118.77**	**1,262,049,021.88**	**610,262,881.89**	**571,597,147.49**
投资活动产生的现金流量净额	**-201,052,245.65**	**-322,738,899.77**	**-272,661,433.63**	**-293,471,842.78**
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	**-**	1,900,000.00	-	130,769,736.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	**-**	-	-	-
取得借款收到的现金	**441,649,481.57**	561,709,942.29	437,898,484.04	525,304,062.28
收到其他与筹资活动有关的现金	**-**	-	-	-
筹资活动现金流入小计	**441,649,481.57**	**563,609,942.29**	**437,898,484.04**	**656,073,798.28**
偿还债务支付的现金	**224,013,519.92**	490,957,273.28	324,472,802.52	413,491,387.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	**7,955,335.19**	14,585,036.82	15,771,280.61	14,668,050.13
支付其他与筹资活动有关的现金	**13,162,988.37**	21,861,333.79	21,185,622.93	103,852,322.17
筹资活动现金流出小计	**245,131,843.48**	**527,403,643.89**	**361,429,706.06**	**532,011,760.18**
筹资活动产生的现金流量净额	**196,517,638.09**	**36,206,298.40**	**76,468,777.98**	**124,062,038.10**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**300,073.85**	**-363,492.26**	**-221,281.61**	**28,015.60**
五、现金及现金等价物净增加额	**23,609,617.12**	**-7,655,448.31**	**-14,694,882.15**	**25,888,259.61**
加：期初现金及现金等价物余额	**83,490,288.16**	91,145,736.47	105,840,618.62	79,952,359.01
六、期末现金及现金等价物余额	**107,099,905.28**	**83,490,288.16**	**91,145,736.47**	**105,840,618.62**

（四）审计意见、关键审计事项及重要性水平

1、审计意见

天健会计师审计了上海季丰电子股份有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日**及 2026 年 6 月 30 日**的合并及母公司资产负债表，2023 年度、2024 年度、2025 年度**及 2026 年 1-6 月**的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并出具了编号为**天健审【2026】17872 号**的标准无保留意见《审计报告》，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了季丰电子 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日**及 2026 年 6 月 30 日**的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度、2024 年度、2025 年度**及 2026 年 1-6 月**的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、关键审计事项

（1）收入确认

①事项描述

季丰电子的营业收入主要来自于第三方实验室检测分析服务、检测硬件产品和量产业务（量产测试及电子制造服务）等。2023 年度、2024 年度、2025 年度**和 2026 年 1-6 月**，季丰电子营业收入金额分别为 44,336.65 万元、58,348.29 万元、66,949.34 万元**和 37,885.76 万元**，营业收入是季丰电子关键绩效指标之一，可能存在季丰电子管理层（以下简称“管理层”）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此天健会计师将营业收入的确认作为关键审计事项。

②审计应对

在财务报表审计中，天健会计师针对收入确认实施的重要审计程序包括：

A、了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

B、检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

C、对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存

在重大或异常波动，并查明波动原因；

D、以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、确认交付成果邮件、检测报告、结案确认邮件等；

E、结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证报告期销售额；

F、采用现场走访的方式对主要客户进行访谈，了解公司与客户的交易背景、交易金额等，对公司与客户业务往来的真实性和商业合理性进行核查；

G、以抽样方式检查销售收款的银行进账单据，核对付款单位、金额、日期与收款凭证是否一致；

H、对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试，评价收入是否在恰当期间确认；

I、检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2、存货相关风险

①事项描述

截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日**和 2026 年 6 月 30 日**，公司存货账面价值分别为 7,460.58 万元、7,684.38 万元、10,788.41 万元**和 12,577.03 万元**。

由于公司存货余额较大，存货的准确性和计价分摊存在较高风险，天健会计师将存货相关风险确定为关键审计事项。

②审计应对

针对存货相关风险，天健会计师实施的审计程序主要包括：

A、了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

B、复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

C、结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、款式陈旧、质量瑕疵等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

D、测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

E、检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

3、重要性水平的判断标准

涉及重要性标准判断的披露事项	重要性标准确定方法和选择依据
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的应收账款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的核销应收账款	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的核销其他应收款	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额×0.5%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的账龄超过 1 年或逾期的预收款项	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额×5%
重要的境外经营实体	资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15%
重要的子公司、非全资子公司	资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15%
重要的合营企业、联营企业	单项长期股权投资账面价值超过集团净资产的 15%/单项权益法核算的投资收益超过集团利润总额的 15%

（五）财务报表的编制基础及合并财务报表范围

1、编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响公司持续经营能力的事项，公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

3、合并财务报表范围及变化情况

本报告期纳入公司合并财务报表范围的子公司共有 14 家，具体情况如下：

序号	子公司名称	取得方式	持股情况	纳入合并财务报表范围的时间
1	季峰（香港）电子有限公司	设立	100.00%	2023 年 1 月 1 日至 **2026 年 6 月 30 日**
2	江山季丰电子科技有限公司	设立	100.00%	2023 年 1 月 1 日至 **2026 年 6 月 30 日**
3	浙江季丰电子科技有限公司	设立	100.00%	2023 年 1 月 1 日至 **2026 年 6 月 30 日**
4	杭州季丰电子科技有限公司	设立	100.00%	2023 年 1 月 1 日至 **2026 年 6 月 30 日**
5	北京季峰检测技术有限公司	设立	100.00%	2023 年 1 月 1 日至 **2026 年 6 月 30 日**
6	深圳季丰检测技术有限公司	设立	100.00%	2023 年 1 月 1 日至 **2026 年 6 月 30 日**
7	衢州季丰检测技术有限公司	设立	100.00%	2023 年 1 月 1 日至 **2026 年 6 月 30 日**
8	上海季丰电子科技有限公司	设立	100.00%	2023 年 1 月 1 日至 **2026 年 6 月 30 日**
9	上海季丰物业管理有限公司	设立	100.00%	2023 年 1 月 1 日至 **2026 年 6 月 30 日**
10	浙江季丰精密电子有限公司	非同一控制下企业合并	100.00%	2023 年 1 月 1 日至 **2026 年 6 月 30 日**
11	上海季丰计量有限公司	设立	100.00%	2023 年 1 月 1 日至 **2026 年 6 月 30 日**
12	成都季丰检测技术有限公司	设立	100.00%	2023 年 1 月 1 日至 **2026 年 6 月 30 日**
13	上海季丰技术有限公司	设立	100.00%	2024 年 1 月 24 日至 **2026 年 6 月 30 日**
14	北京亦庄季峰检测技术有限公司	设立	100.00%	2024 年 6 月 12 日至 **2026 年 6 月 30 日**

（六）分部信息

报告期内，公司主营业务收入按产品或服务类别列示如下：

单位：万元

类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第三方实验室检测分析服务	**23,002.57**	**61.60%**	42,437.31	64.02%	37,862.80	65.70%	27,760.40	63.78%

类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
检测硬件产品	8,561.62	22.93%	15,333.34	23.13%	12,473.52	21.65%	11,437.15	26.28%
量产业务（量产测试及电子制造服务）	3,997.05	10.70%	5,720.57	8.63%	3,980.29	6.91%	3,292.01	7.56%
工程样品封装及其他	1,779.75	4.77%	2,796.46	4.22%	3,311.05	5.75%	1,036.59	2.38%
合计	37,341.00	100.00%	66,287.68	100.00%	57,627.66	100.00%	43,526.14	100.00%

报告期内，公司主营业务收入按区域列示如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华东地区	22,545.85	60.38%	39,403.13	59.44%	34,378.85	59.66%	32,454.64	74.56%
华北地区	6,778.23	18.15%	11,991.79	18.09%	13,091.56	22.72%	2,911.53	6.69%
华南地区	4,688.68	12.56%	8,550.73	12.90%	6,353.05	11.02%	5,170.15	11.88%
西南地区	2,225.11	5.96%	3,785.86	5.71%	2,257.49	3.92%	1,811.87	4.16%
其他地区	979.38	2.62%	2,174.59	3.28%	1,348.81	2.34%	966.26	2.22%
境内小计	37,217.25	99.67%	65,906.10	99.42%	57,429.77	99.66%	43,314.43	99.51%
境外地区	123.75	0.33%	381.58	0.58%	197.90	0.34%	211.71	0.49%
合计	37,341.00	100.00%	66,287.68	100.00%	57,627.66	100.00%	43,526.14	100.00%

注：其他区域包括：华中地区、东北地区以及西北地区

二、主要会计政策和会计估计

本节仅披露报告期内对公司财务状况和经营成果有重大影响的主要会计政策和会计估计，包括收入确认、存货、应收款项、固定资产、股份支付等，其他会计政策和会计估计请参见审计报告财务报表附注相关内容。

（一）收入

1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来

的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时，累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3、收入确认的具体方法

结合公司自身经营模式和结算方式，各类业务收入确认时间的具体判断标准如下：

（1）检测分析服务：公司提供的检测分析服务已经完成，并将检测分析成果交付客户，客户对检测分析成果以及服务金额认可后确认收入，具体在取得客户对账确认邮件时确认收入。

（2）检测硬件产品内销：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，公司将客户验收时点作为控制权转移时点确认收入，对无法取得客户验收单据的，以合同约定的异议期满确认视同验收通过时点确认收入。

（3）检测硬件产品外销：公司以 FOB 等方式交易，根据合同约定将产品报关出口，在取得承运人出具的提单时，作为控制权转移时点确认收入。

（二）存货

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

5、存货跌价准备

存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（三）应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收财务公司承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

3、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

（四）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2、各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
专用设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

（五）在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
机器设备	安装调试校准后达到设计要求或合同规定的标准

（六）股份支付

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（七）政府补助

1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认

（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本

费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（八）租赁

1、公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2、公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入

当期损益。

3、售后租回

（1）公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

（2）公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

（九）重要会计政策、会计估计的变更情况

1、重要会计政策变更

无。

2、会计估计变更

无。

三、税项

（一）主要税种和税率

报告期内，公司执行的主要税种和税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	1%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、15%、20%、25%

其中，公司及子公司具体执行的企业所得税税率如下：

纳税主体名称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
季丰电子、浙江季丰	15%	15%	15%	15%
季丰科技	25%	25%	25%	25%
成都季丰、季丰物业、江山季丰	20%	20%	20%	20%
季丰计量	25%	25%	20%	20%
衢州季丰	20%	25%	25%	20%
北京季峰	20%	20%	20%	25%
深圳季丰	15%	15%	25%	25%
香港季峰	8.25%	8.25%	8.25%	8.25%
杭州季丰	15%	15%	20%	25%
季丰精密	25%	25%	25%	20%
季丰技术	15%	15%	20%	-
亦庄季峰	15%	15%	25%	-

（二）主要税收优惠政策

1、企业所得税优惠及批文

（1）公司于 2022 年 12 月 14 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局核发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202231004241，有效期三年，2022 年-2024 年企业所得税税率减按 15%计缴。

公司于 2025 年 12 月 25 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局核发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202531006275，有效期三年，2025 年-2027 年企业所得税税率减按 15%计缴。

（2）浙江季丰于 2023 年 12 月 8 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局核发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202333002624，有效期三年，2023 年-2025 年企业所得税税率减按 15%计缴；杭州季丰于 2024 年 12 月 6 日取得浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局核发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202433008030，有效期三年，2024 年-2026 年企业所得税税率减按 15%计缴；江山季丰于 2024 年 12 月 6 日取得浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局核发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202433011255，有效期三年，2024 年-2026 年企业所得税税率减按 15%计缴；深圳季丰于 2025 年 12 月 25 日取得深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局核发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202544206250，有效期三年，2025 年-2027 年企业所得税税率减按 15%计缴；季丰技术于 2025 年 12 月 25 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局核发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202531008457，有效期三年，2025 年-2027 年企业所得税税率减按 15%计缴；亦庄季峰于 2025 年 12 月 2 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局核发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202511005031，有效期三年，2025 年-2027 年企业所得税税率减按 15%计缴。

（3）根据财政部、税务总局发布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）和财政部、税务总局发布的《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。成都季丰、季丰物业、江山季丰在报告期内属于小型微利企业，享受相关税收优惠政策；季丰计量公司在 2023 年和 2024 年属于小型微利企业，享受相关税收优惠政策；衢州季丰在 2023 年、**2026 年 1-6**

月属于小型微利企业，享受相关税收优惠政策；北京季峰在 2024 年、2025 年和 2026 年 1-6 月属于小型微利企业，享受相关税收优惠政策；季丰技术在 2024 年属于小型微利企业，享受相关税收优惠政策；杭州季丰在 2024 年属于小型微利企业，享受相关税收优惠政策。

（4）根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委和工业和信息化部于 2020 年 12 月 11 日发布的《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号），国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，亦庄季峰经申请被认定为国家鼓励的集成电路企业，报告期内享受该税收优惠政策。

（5）根据《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委 工业和信息化部公告 2023 年第 44 号）的规定，集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 220%在税前摊销。2024 年和 2025 年，公司和亦庄季峰享受该优惠政策。

2、综合性税收优惠及批文

（1）根据财政部、国家税务总局于 2023 年 4 月 20 日发布的《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业（以下称集成电路企业），按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额，公司经申请被认定为集成电路企业，报告期内享受该税收优惠政策。

（2）公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，2023 年 1 月 1 日起至今公司的退税率为 13%。

四、经注册会计师鉴证的非经常性损益表

报告期内，公司非经常性损益的构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	**393.15**	11.73	-1.72	-3.47
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	**219.53**	1,337.36	878.86	946.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	**199.36**	650.59	988.48	350.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	**-129.67**	-10.15	-8.11	-3.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	**-**	-	-	-482.56
小计	**682.37**	**1,989.53**	**1,857.51**	**807.13**
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	**71.66**	220.83	256.82	133.33
少数股东权益影响额（税后）	**-**	-	-	148.09
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	**610.71**	**1,768.70**	**1,600.69**	**525.71**
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	**3,405.12**	**7,356.84**	**3,836.86**	**1,812.95**

报告期各期，公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额分别为 525.71 万元、1,600.69 万元、1,768.70 万元**和 610.71 万元**，主要是**非流动性资产处置损益**、政府补助和交易性金融资产公允价值变动损益。上述非经常性损益净额对报告期内公司经营成果不产生重大影响。

五、报告期内的主要财务指标

（一）基本财务指标

财务指标	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年	2024 年 12 月 31 日/2024 年	2023 年 12 月 31 日/2023 年
流动比率（倍）	**0.82**	0.83	0.93	1.39
速动比率（倍）	**0.50**	0.50	0.68	1.05
资产负债率（母公司）	**50.04%**	46.08%	40.91%	37.40%
资产负债率（合并）	**53.03%**	48.19%	48.38%	44.76%
利息保障倍数（倍）	**5.75**	6.02	4.26	2.39

财务指标	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年	2024 年 12 月 31 日/2024 年	2023 年 12 月 31 日/2023 年
应收账款周转率（次/年）	**3.91**	3.89	3.73	3.47
存货周转率（次/年）	**3.78**	4.03	4.37	3.82
息税折旧摊销前利润（万元）	**15,215.94**	28,431.93	21,702.07	14,340.93
归属于发行人股东的净利润（万元）	**4,015.83**	9,125.55	5,437.55	2,338.67
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（万元）	**3,405.12**	7,356.84	3,836.86	1,812.95
研发投入占营业收入的比例	**6.68%**	8.22%	8.51%	9.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	**0.24**	2.42	1.57	1.69
每股净现金流量（元/股）	**0.20**	-0.07	-0.13	0.22
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	**8.12**	7.74	6.89	6.36

注：指标计算公式如下：

1.流动比率=流动资产/流动负债。

2.速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债。

3.资产负债率=负债总额/资产总额。

4.利息保障倍数=息税前利润/利息费用。

5.应收账款周转率=营业收入×2/（期初应收账款余额＋期末应收账款余额）。

6.存货周转率=营业成本×2/（期初存货余额＋期末存货余额）。

7.息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息费用+折旧+摊销。

8.研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入。

9.每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额。

10.每股净现金流量＝现金流量净额/期末股本总额。

11.归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的期末净资产/期末股本总额。

12.为保证指标的可比性，每股经营活动产生的现金流量净额、每股净现金流量、归属于发行人股东的每股净资产均按照公司报告期末股本总额计算。

13.2026 年 1-6 月应收账款周转率、存货周转率等财务指标计算考虑年化影响。

（二）净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

1、加权平均净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）			
	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于公司普通股股东的净利润	**4.38**	10.80	7.10	3.53

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）			
	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.72	8.70	5.01	2.73

2、每股收益

报告期利润	每股收益（元/股）							
	基本每股收益				稀释每股收益			
	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.35	0.79	0.47	0.21	0.35	0.79	0.47	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.29	0.64	0.33	0.16	0.29	0.64	0.33	0.16

注[1]：加权平均净资产收益率的计算公式如下：

加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0），其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

注[2]：基本每股收益可参照如下公式计算：

基本每股收益=P0÷S，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk，其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

注[3]：稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数），其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

注[4]：发行人报告期内因公积金转增股本、股票股利分配增加股份数，计算每股收益时该等股份数自报告期初纳入计算。

六、资产负债表日后事项、承诺及或有事项、其他重要事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在应披露未披露的重大资产负债表日后事项、承诺及或有事项、其他重要事项。

七、经营成果分析

（一）营业收入分析

1、营业收入的构成与变动

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	**37,341.00**	**98.56%**	66,287.68	99.01%	57,627.66	98.76%	43,526.14	98.17%
其他业务收入	**544.76**	**1.44%**	661.66	0.99%	720.63	1.24%	810.51	1.83%
合计	**37,885.76**	**100.00%**	**66,949.34**	**100.00%**	**58,348.29**	**100.00%**	**44,336.65**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务收入分别为 43,526.14 万元、57,627.66 万元、66,287.68 万元**和 37,341.00 万元**，占同期营业收入的比例分别为 98.17%、98.76%、99.01%**和 98.56%**，主营业务突出。

报告期内，公司其他业务收入分别为 810.51 万元、720.63 万元、661.66 万元**和 544.76 万元**，占同期营业收入的比例分别为 1.83%、1.24%、0.99%**和 1.44%**，占比较小，主要系为客户提供材料及配件等实现的收入。

报告期内，公司主营业务收入快速增长，具体原因如下：

（1）在国际贸易争端背景之下，半导体产业链迅猛发展，第三方检测市场需求旺盛

在国际贸易争端背景之下，保证产业链自主可控，发展半导体产业已上升至国家战略层面，推动半导体产业技术进步是国家坚定不移发展的大方向。在半导体国产化趋势深化的大环境和国家科技重大专项与产业投资基金的支持下，我国半导体产业链不断完善，国内已陆续涌现一大批优秀的芯片设计、芯片制造及封测厂商。而半导体行业技术的更新迭代促进业内厂商大规模开展研发项目，随着半导体工艺复杂度的提升、工艺节点的拓展，对失效分析、材料分析等第三方检测分析需求和集成电路测试板等检测硬件需求持续增长。根据集微咨询统计，2025 年中国大陆半导体第三方实验室检测分析市场规模将达到约 125.5 亿元，预计到 2027 年有望达到 181.5 亿元，年复合增长率为 20.3%。行业规模迅速增长带

动公司经营业绩持续上升。

（2）公司依托深厚的技术积累，以客户需求为导向持续投入研发，赢得客户信任的同时驱动业绩增长

在为超过 3,000 家半导体产业链客户提供检测分析服务与检测硬件产品的过程中，公司积累了对各种芯片类型进行测试、对各类失效情况进行检测分析的海量案例，在失效分析、材料分析、可靠性测试及集成电路测试板设计与仿真等方面形成了一系列核心技术。公司深厚的技术积累确保公司在为客户提供服务时，能够精准识别并高效解决从设计验证、工艺调试到量产测试全流程中的复杂检测技术难题，显著提升客户的开发效率与产品良率。

公司敏锐把握客户在研发、试产及量产各阶段提出的更新、更高的技术需求，并以此为导向持续加大研发投入，实现与客户的协同发展。伴随半导体前沿技术进步与下游应用快速迭代，公司紧跟客户研发方向，不断提升硬件开发与检测分析能力，在与客户持续深化合作的同时建立了深厚的信任基础，是公司业绩高速增长的重要驱动力。

（3）公司多点布局，凭借快速响应、优异的服务质量拓展了全国优质客户

客户在选择第三方检测供应商时，响应的及时性是重要的考量因素。公司结合半导体产业链集聚情况和规划情况，近年来以上海为总部，在北京、杭州、深圳、成都等地建立子公司，加大先进设备投入，培养专业服务团队，持续扩张服务半径、完善区域布局。凭借及时布局、优异的技术能力和服务品质，迅速获取了产业链诸多知名客户的认可。同时，公司积极开拓量产测试及电子制造服务等新业务，打造多极增长曲线，报告期内各地实验室和子公司收入高速增长，是公司整体营收规模高速增长的重要组成。

2、主营业务收入按产品类别分析

报告期内，公司主营业务收入按产品品种构成情况如下：

单位：万元

类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第三方实验室检测分析服务	**23,002.57**	**61.60%**	42,437.31	64.02%	37,862.80	65.70%	27,760.40	63.78%

类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
检测硬件产品	**8,561.62**	**22.93%**	15,333.34	23.13%	12,473.52	21.65%	11,437.15	26.28%
量产业务（量产测试及电子制造服务）	**3,997.05**	**10.70%**	5,720.57	8.63%	3,980.29	6.91%	3,292.01	7.56%
工程样品封装及其他	**1,779.75**	**4.77%**	2,796.46	4.22%	3,311.05	5.75%	1,036.59	2.38%
合计	**37,341.00**	**100.00%**	**66,287.68**	**100.00%**	**57,627.66**	**100.00%**	**43,526.14**	**100.00%**

报告期内，公司第三方实验室检测分析服务、量产业务（量产测试及电子制造服务）和检测硬件产品收入均呈高速增长趋势，公司主营业务收入结构相对稳定。报告期各期，公司主营业务收入主要来自于第三方实验室检测分析服务和检测硬件产品销售，相关产品和服务的销售收入占主营业务收入的比例**均在 80%以上**。

报告期内，公司各类产品或服务收入变动情况及分析如下：

（1）第三方实验室检测分析服务

报告期内，第三方实验室服务是公司收入主要来源，由失效分析、材料分析和可靠性测试组成，具体构成情况如下：

单位：万元

类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
失效分析	**9,906.92**	**43.07%**	18,552.21	43.72%	14,820.25	39.14%	10,446.98	37.63%
材料分析	**7,228.15**	**31.42%**	11,973.04	28.21%	13,203.84	34.87%	8,758.18	31.55%
可靠性测试	**5,867.50**	**25.51%**	11,912.06	28.07%	9,838.72	25.99%	8,555.24	30.82%
合计	**23,002.57**	**100.00%**	**42,437.31**	**100.00%**	**37,862.80**	**100.00%**	**27,760.40**	**100.00%**

上述业务因案件难度、单个案件规模、测试设备类型、时间周期等存在差异，单个案件收费存在明显差异，因此针对不同业务类型的检测分析服务具体分析。

①失效分析

报告期内，公司失效分析业务对应的销售收入、案件数量及单价变化情况如下所示：

单位：万元、件、元/件

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售金额	**9,906.92**	18,552.21	14,820.25	10,446.98
案件数量	**29,833**	59,002	49,558	38,846
案件单价	**3,320.79**	3,144.34	2,990.48	2,689.33
占主营业务收入比例	**26.53%**	27.99%	25.72%	24.00%

注：单个案件可能同时执行多种类型检测分析项目，上述案件数量将执行过失效分析项目的案件均纳入统计范围

报告期内，公司失效分析业务的销售收入分别为 10,446.98 万元、14,820.25 万元、18,552.21 万元**和 9,906.92 万元**，占主营业务收入的比例分别为 24.00%、25.72%、27.99%**和 26.53%，2023 年至 2025 年度**销售收入及占比呈逐年增长的趋势。

在半导体产业升级与需求多元化的驱动下，第三方实验室检测分析需求持续旺盛，公司凭借多点布局一站式服务的优势，报告期内失效分析业务销售案件数量持续稳步增长，2024 年和 2025 年分别同比增长 27.58%和 19.06%。同时受益于双束聚焦离子束检测制样、扫描电子显微镜检测分析项目等检测分析项目需求增加，失效分析业务案件单价亦有所增长，2024 年和 2025 年分别同比增长 11.20%和 5.14%。在销售数量和单价双驱动下，**2023 至 2025 年度**，公司失效分析业务营收规模持续增长。**2026 年上半年，失效分析需求稳定增长，案件单价小幅上升。**

②材料分析

报告期内，公司材料分析业务对应的销售收入、案件数量及单价变化情况如下所示：

单位：万元、件、元/件

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售金额	**7,228.15**	11,973.04	13,203.84	8,758.18
案件数量	**5,636**	6,486	5,724	8,761
案件单价	**12,824.96**	18,459.82	23,067.50	9,996.78
占主营业务收入比例	**19.36%**	18.06%	22.91%	20.12%

注：单个案件可能同时执行多种类型检测分析项目，上述案件数量将执行过材料分析项目的案件均纳入统计范围

报告期内，公司材料分析业务的销售收入分别为 8,758.18 万元、13,203.84

万元、11,973.04 万元**和 7,228.15 万元**，占主营业务收入的比例分别为 20.12%、22.91%、18.06%**和 19.36%**。

2024 年，公司材料分析业务案件数量减少但是单个案件单价显著提升，上述变化主要系与客户 A 合作持续加深所致，客户 A 系晶圆厂，因产线设备调试、工艺优化导致材料分析需求旺盛，其订单主要系晶圆样品制备和透射电镜成像分析项目，单个案件测试芯片数量多、测试难度大、交期要求紧，因此单个案件收费水平较高。2024 年公司材料分析中该项目测试数量较上年度持续提升，推动材料分析业务整体营收规模较上年增长 50.76%。

2025 年，公司材料分析业务收入规模较上年减少 1,230.80 万元，同比下降 9.32%。一方面，公司为稳固现有市场份额并抢占新增市场需求，针对部分晶圆样品制备和透射电镜成像分析项目的报价进行优化，导致案件单价较上年下滑；另一方面，随着客户 A 研发项目的持续推进，其材料分析需求有所减少，两者共同导致公司 2025 年材料分析业务整体营收规模较上年出现下滑。

2026 年 1-6 月，公司材料分析业务案件数量明显增长但是案件单价出现下滑，主要系客户结构及案件结构阶段性变化所致：一方面，部分核心客户内部送检安排、检测批次或管理流程调整，检测需求被拆分为更多案件执行，导致执行晶圆样品制备和透射电镜成像分析项目的案件数量年化后增长 66.44%，但单案件内测试样品颗数下降 23.01%；另一方面，新开拓大客户尚处于合作初期导入阶段，已执行案件平均测试样品数量和单价低于存量核心客户平均水平，从而结构性摊薄平均案件单价。但是在案件数量大幅增长推动下，2026 年上半年公司材料分析收入规模已呈增长趋势。

③可靠性测试

报告期内，公司可靠性测试业务对应的销售收入、案件数量及单价变化情况如下所示：

单位：万元、件、元/件

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售金额	**5,867.50**	11,912.06	9,838.72	8,555.24
案件数量	**11,894**	23,996	22,414	18,670
案件单价	**4,933.16**	4,964.18	4,389.54	4,582.35

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
占主营业务收入比例	**15.71%**	17.97%	17.07%	19.66%

注：单个案件可能同时执行多种类型检测分析项目，上述案件数量将执行过可靠性测试项目的案件均纳入统计范围

报告期内，公司可靠性测试业务的销售收入分别为 8,555.24 万元、9,838.72 万元、11,912.06 万元**和 5,867.50 万元**，占主营业务收入的比例分别为 19.66%、17.07%、17.97%**和 15.71%**。

2024 年，公司可靠性测试业务案件数量较上年增加 20.05%，是可靠性测试业务收入规模增长的主要驱动因素。公司紧跟半导体行业可靠性测试需求的发展趋势，持续进行设备投入，扩充检测分析能力，2024 年能向客户提供的可靠性测试检测项目种类明显增加，对应的开拓客户数量和检测案件数量均呈上升趋势，进而推动可靠性测试业务整体销售收入持续增长。

2025 年度，公司可靠性测试业务营收规模较上年增加 2,073.34 万元，同比增幅 21.07%，主要系案件单价增长所致。一方面，客户对各类可靠性项目需求持续旺盛，随着公司测试能力的提升，检测项目收费数量增长推动 RA、ESD 检测案件单价均有所提升；另一面，收费水平较高的新能源可靠性测试案件收入占比增加，两者共同带动可靠性测试案件单价整体提升。

（2）检测硬件产品

公司检测硬件产品包括集成电路测试板、测试插座和检测仪器设备，各类产品的销售情况如下：

单位：万元

类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
集成电路测试板	**7,865.46**	**91.87%**	14,702.37	95.88%	12,086.67	96.90%	10,874.93	95.08%
测试插座	**399.67**	**4.67%**	478.22	3.12%	154.91	1.24%	260.03	2.27%
检测仪器设备	**296.50**	**3.46%**	152.75	1.00%	231.94	1.86%	302.19	2.64%
合计	**8,561.62**	**100.00%**	**15,333.34**	**100.00%**	**12,473.52**	**100.00%**	**11,437.15**	**100.00%**

如上表所示，集成电路测试板是公司检测硬件产品的主要组成部分，报告期各期销售占比均超过 **90%**。报告期内，公司集成电路测试板产品对应的销售收入、销量及单价变化情况如下所示：

单位：万元、片、元/片

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售金额	**7,865.46**	14,702.37	12,086.67	10,874.93
销售数量	**18,432**	41,528	25,031	21,774
销售单价	**4,267.28**	3,540.35	4,828.68	4,994.46
占主营业务收入比例	**21.06%**	22.18%	20.97%	24.98%

报告期内，公司集成电路测试板产品的销售收入分别为 10,874.93 万元、12,086.67 万元、14,702.37 万元**和 7,865.46 万元**，占主营业务收入的比例分别为 24.98%、20.97%、22.18%**和 21.06%**。

受高端芯片国产化与高可靠性需求驱动，集成电路测试板市场快速增长，报告期内，公司集成电路测试板产品收入规模持续增长。公司的集成电路测试板产品主要应用于从芯片设计到量产过程中涉及的可靠性测试等需求，需根据客户产品迭代和技术更新针对化设计，定制化程度较高。2024 年度，受下游客户需求旺盛影响，公司产品销量同比增长 14.96%，带动集成电路测试板产品销售额同比增长 11.14%。2025 年度，公司集成电路测试板产品平均售价下滑，系销售结构发生变化，个别客户价格偏低的系统板销售数量大幅增加带动平均售价非常规下滑，导致集成电路测试板产品销量同比增长 65.91%，单价下降 26.68%，由于销量上升的幅度大于单价下降幅度，2025 年度集成电路测试板销售收入较 2024 年度增长 21.64%。**2026 年 1-6 月，公司集成电路测试板产品平均售价受产品结构优化影响有所回升。**

（3）量产业务（量产测试及电子制造服务）

公司量产业务包括量产测试及电子制造服务（EMS），具体情况如下表所示：

单位：万元

类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占主营业务收入的比例	金额	占主营业务收入的比例	金额	占主营业务收入的比例	金额	占主营业务收入的比例
量产测试	**2,794.84**	**7.48%**	4,433.24	6.69%	2,799.67	4.86%	2,032.84	4.67%
EMS	**1,202.21**	**3.22%**	1,287.33	1.94%	1,180.62	2.05%	1,259.17	2.89%
合计	**3,997.05**	**10.70%**	**5,720.57**	**8.63%**	**3,980.29**	**6.91%**	**3,292.01**	**7.56%**

报告期各期，公司量产测试业务的销售收入分别为 2,032.84 万元、2,799.67

万元、4,433.24 万元和 2,794.84 万元，占主营业务收入的比例分别为 4.67%、4.86%、6.69%和 7.48%。公司量产测试业务主要服务于高可靠性芯片（如车规级芯片）的测试需求，目前处于起步阶段，整体规模较小。报告期内，公司持续进行设备、研发投入，测试能力不断提升，客户开拓顺利，销售收入保持高速增长趋势。

报告期各期，公司 EMS 业务的销售收入分别为 1,259.17 万元、1,180.62 万元、1,287.33 万元和 1,202.21 万元，占主营业务收入的比例分别为 2.89%、2.05%、1.94%和 3.22%。公司基于自身在检测服务与硬件开发方面的能力积淀，近年来在嘉善工厂规模化投入 EMS 产线，进一步完善面向客户的一站式解决方案能力。因该业务处于前期投入、新客户导入阶段，目前营收规模和收入增速均维持在较低水平。

（4）工程样品封装及其他

公司工程样品封装及其他包括工程样品封装业务及实验室建设项目收入。

报告期各期，公司工程样品封装业务的销售收入分别为 1,036.59 万元、1,789.20 万元、2,796.46 万元和 1,779.75 万元，占主营业务收入的比例分别为 2.38%、3.10%、4.22%和 4.77%。工程样品封装业务为实验室分析业务提供了快速响应与技术支撑，具有较强的协同效应。报告期内，在第三方实验室业务的带动下，公司积极拓展，与新老客户合作持续加深，工程样品封装业务收入规模保持高速增长趋势。

公司实验室建设项目收入系 2024 年度公司为绍兴高新技术产业开发区开发建设有限公司提供实验室环境维持系统及所需设备项目完工验收，确认收入 1,521.86 万元。2024 年以来，公司利用在半导体检测分析服务领域积累的运营经验、供应商资源等协助客户进行半导体检测实验室建设，随着未来半导体检测分析服务市场需求进一步增大，公司预计未来将会有更多的客户寻求第三方实验室搭建服务，该类收入将成为公司收入来源之一。

3、主营业务收入按销售地区分析

报告期内，公司主营业务收入按销售地区的构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华东地区	**22,545.85**	**60.38%**	39,403.13	59.44%	34,378.85	59.66%	32,454.64	74.56%
华北地区	**6,778.23**	**18.15%**	11,991.79	18.09%	13,091.56	22.72%	2,911.53	6.69%
华南地区	**4,688.68**	**12.56%**	8,550.73	12.90%	6,353.05	11.02%	5,170.15	11.88%
西南地区	**2,225.11**	**5.96%**	3,785.86	5.71%	2,257.49	3.92%	1,811.87	4.16%
其他地区	**979.38**	**2.62%**	2,174.59	3.28%	1,348.81	2.34%	966.26	2.22%
境内小计	**37,217.25**	**99.67%**	**65,906.10**	**99.42%**	**57,429.77**	**99.66%**	**43,314.43**	**99.51%**
境外地区	**123.75**	**0.33%**	381.58	0.58%	197.90	0.34%	211.71	0.49%
合计	**37,341.00**	**100.00%**	**66,287.68**	**100.00%**	**57,627.66**	**100.00%**	**43,526.14**	**100.00%**

注：其他区域包括：华中地区、东北地区以及西北地区

报告期内，公司在上海、北京、深圳、成都等地多点布局，销售区域以内销为主，境内销售收入合计分别为 43,314.43 万元、57,429.77 万元、65,906.10 万元**和 37,217.25 万元**，占当期主营业务收入的比例分别为 99.51%、99.66%、99.42%**和 99.67%**。

4、主营业务收入季节性变动情况

报告期内，公司主营业务收入季节性变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	**14,817.44**	**39.68%**	12,642.84	19.07%	10,028.09	17.40%	8,963.95	20.59%
第二季度	**22,523.56**	**60.32%**	18,470.61	27.86%	13,098.60	22.73%	10,633.84	24.43%
第三季度	-	-	17,304.43	26.11%	13,982.92	24.26%	10,122.87	23.26%
第四季度	-	-	17,869.80	26.96%	20,518.06	35.60%	13,805.49	31.72%
合计	**37,341.00**	**100.00%**	**66,287.68**	**100.00%**	**57,627.66**	**100.00%**	**43,526.14**	**100.00%**

总体而言，公司主营业务收入的季节性分布相对均匀。各年度第一季度收入占比偏低，主要系受到春节假期等因素影响，公司下游客户通常在一季度制定全年经营计划，后续陆续投入研发以及生产工作，因此公司下半年的收入占比略高于上半年。

5、第三方回款情况

报告期内，公司存在少量第三方回款的情况，具体如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
同一控制下关联方代付	**8.51**	**0.02%**	32.04	0.05%	6.43	0.01%	5.65	0.01%
委托第三方代付	**0.62**	**0.00%**	0.26	0.00%	0.31	0.00%	-	0.00%
合计	**9.13**	**0.02%**	**32.31**	**0.05%**	**6.74**	**0.01%**	**5.65**	**0.01%**

报告期内，公司存在少量第三方回款，系部分客户基于集团内部财务安排或支付便捷性，由其集团内其他主体、关联方或经办人员代为支付。

报告期内第三方回款具有真实的业务背景和商业合理性，不存在虚构交易的情形，不存在因第三方回款导致货款归属纠纷的情形。

（二）营业成本分析

1、营业成本的构成情况

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	**24,930.37**	**98.75%**	42,596.30	98.86%	35,995.25	98.49%	26,774.16	97.88%
其他业务成本	**316.05**	**1.25%**	490.13	1.14%	551.00	1.51%	580.77	2.12%
合计	**25,246.42**	**100.00%**	**43,086.43**	**100.00%**	**36,546.24**	**100.00%**	**27,354.93**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务成本占营业成本的比例达到 95%以上，是营业成本的主要构成。其他业务成本占比相对较小，对公司经营成果的影响较小。

报告期内，公司主营业务成本、其他业务成本的变动趋势与对应收入的变动趋势总体匹配。

2、主营业务成本按产品构成分析

报告期内，公司按产品划分的主营业务成本构成情况如下所示：

单位：万元

类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第三方实验室检测分析服务	**11,779.55**	**47.25%**	20,793.60	48.82%	18,140.88	50.40%	13,140.34	49.08%
检测硬件产品	**5,886.94**	**23.61%**	10,579.15	24.84%	8,016.01	22.27%	7,327.10	27.37%
量产业务（量产测试及电子制造服务）	**5,599.43**	**22.46%**	8,443.63	19.82%	6,722.00	18.67%	4,544.01	16.97%
工程样品封装及其他	**1,664.45**	**6.68%**	2,779.92	6.53%	3,116.35	8.66%	1,762.71	6.58%
合计	**24,930.37**	**100.00%**	**42,596.30**	**100.00%**	**35,995.25**	**100.00%**	**26,774.16**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务成本由第三方实验室检测分析服务、检测硬件产品、量产业务等成本构成，各类业务及产品成本占营业成本的比例整体保持稳定，整体变动趋势与同期主营业务收入变动趋势基本相符。

报告期各期，第三方实验室检测分析服务成本和检测硬件产品成本为主营业务成本的主要构成。量产业务属于公司仍处于前期投入中的业务，整体业务规模较小，目前仍处于亏损状态，因此业务成本占比高于其收入占比。

3、主营业务成本的构成与变动

报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
材料成本	**7,375.80**	**29.59%**	12,433.87	29.19%	10,147.15	28.19%	7,523.97	28.10%
人工成本	**7,719.73**	**30.97%**	13,156.86	30.89%	11,401.92	31.68%	8,840.21	33.02%
折旧摊销及租赁费	**7,778.30**	**31.20%**	13,369.01	31.39%	11,462.71	31.85%	7,661.12	28.61%
委外加工	**261.22**	**1.05%**	400.29	0.94%	327.48	0.91%	774.14	2.89%
水电费	**1,088.46**	**4.37%**	2,146.33	5.04%	1,814.34	5.04%	1,438.70	5.37%
其他	**706.86**	**2.84%**	1,089.95	2.56%	841.65	2.34%	536.01	2.00%
合计	**24,930.37**	**100.00%**	**42,596.30**	**100.00%**	**35,995.25**	**100.00%**	**26,774.16**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务成本包括材料成本、人工成本、折旧摊销及租赁费、委外加工费、水电费等。材料成本、人工成本和折旧摊销及租赁费是公司主营业务成本的主要组成部分，报告期内合计占主营业务成本的比例分别为 89.73%、

91.71%、91.46%以及 91.75%，占比保持稳定。

（1）材料成本

报告期内，公司材料成本金额分别为 7,523.97 万元、10,147.15 万元、12,433.87 万元和 7,375.80 万元，占当期主营业务成本的比重分别为 28.10%、28.19%、29.19%和 29.59%，材料成本主要系集成电路测试板产品生产领用的原材料和检测分析服务耗材，金额随着相关业务销售规模的扩大逐年提升。

（2）人工成本

报告期内，公司主营业务成本中人工成本的金额分别为 8,840.21 万元、11,401.92 万元、13,156.86 万元和 7,719.73 万元，占当期主营业务成本的比重分别为 33.02%、31.68%、30.89%和 30.97%。人工成本主要为员工工资奖金、社会保险费、福利费等，报告期内，随着公司各地实验室经营规模的快速增长，公司员工数量逐年增加，对应的人工成本增幅明显。

（3）折旧摊销及租赁费

报告期内，公司主营业务成本中折旧摊销及租赁费的金额分别为 7,661.12 万元、11,462.71 万元、13,369.01 万元和 7,778.30 万元，占当期主营业务成本的比重分别为 28.61%、31.85%、31.39%和 31.20%。折旧摊销及租赁费由固定资产折旧、长期待摊费用摊销、使用权资产摊销、无形资产摊销和少量租赁费组成。报告期内，半导体检测分析行业需求旺盛，公司持续扩充产能，业务快速扩张，增加检测设备投入，固定资产规模稳健增长，因此折旧摊销及租赁费持续增长。

（4）委外加工

报告期内，公司主营业务成本中委外加工费的金额分别为 774.14 万元、327.48 万元、400.29 万元和 261.22 万元，占当期主营业务成本的比重分别为 2.89%、0.91%、0.94%和 1.05%。委外加工费主要为向其他机构支付的测试项目的检测费用及硬件加工费用。报告期内，随着检测分析能力的提升，委外加工费用有所减少。

（5）水电费

报告期内，公司主营业务成本中水电费的金额分别为 1,438.70 万元、1,814.34

万元、2,146.33万元和1,088.46万元，占当期主营业务成本的比重分别为5.37%、5.04%、5.04%和4.37%。随着各地实验室经营规模的增长，公司支付的水电费用持续增长。

（6）其他

公司主营业务成本中其他主要系运费、维修保养费用、办公费等费用。报告期内，上述费用的金额分别为536.01万元、841.65万元、1,089.95万元和706.86万元，占主营业务成本的比重分别为2.00%、2.34%、2.56%和2.84%。报告期内，相关费用占比维持在较低水平。

（三）毛利和毛利率分析

1、毛利分析

报告期内，公司综合毛利的构成情况如下：

单位：万元

项目	2026年1-6月		2025年度		2024年度		2023年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务毛利	12,410.63	98.19%	23,691.38	99.28%	21,632.42	99.22%	16,751.99	98.65%
其他业务毛利	228.70	1.81%	171.53	0.72%	169.63	0.78%	229.74	1.35%
合计	12,639.33	100.00%	23,862.91	100.00%	21,802.05	100.00%	16,981.73	100.00%

报告期各期，公司主营业务毛利分别为16,751.99万元、21,632.42万元、23,691.38万元和12,410.63万元，占同期营业毛利的比例分别为98.65%、99.22%、99.28%和98.19%，是营业毛利的主要来源；其他业务毛利分别为229.74万元、169.63万元、171.53万元和228.70万元，占同期营业毛利的比例较低。

报告期内，公司主营业务毛利按产品品种的构成情况如下：

单位：万元

类别	2026年1-6月		2025年度		2024年度		2023年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第三方实验室检测分析服务	11,223.02	90.43%	21,643.70	91.36%	19,721.93	91.17%	14,620.06	87.27%
检测硬件产品	2,674.68	21.55%	4,754.20	20.07%	4,457.51	20.61%	4,110.05	24.53%
量产业务（量产测试及电子制造服务）	-1,602.38	-12.91%	-2,723.06	-11.49%	-2,741.71	-12.67%	-1,252.00	-7.47%

类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工程样品封装及其他	**115.30**	**0.93%**	16.53	0.07%	194.70	0.90%	-726.12	-4.33%
合计	**12,410.63**	**100.00%**	**23,691.38**	**100.00%**	**21,632.42**	**100.00%**	**16,751.99**	**100.00%**

报告期内，随着经营规模的持续扩大，公司主营业务毛利保持增长。其中第三方实验室检测分析服务实现销售毛利 14,620.06 万元、19,721.93 万元、21,643.70 万元**和 11,223.02 万元**，检测硬件产品实现销售毛利 4,110.05 万元、4,457.51 万元、4,754.20 万元**和 2,674.68 万元**，上述业务是公司主营业务毛利的主要来源。

公司量产业务毛利为负数，主要系相关业务属于公司近年来新布局的业务，前期设备投资规模和折旧规模较大，业务初期产能暂未完全释放，规模效应暂未显现，较高的固定成本暂时无法被收入规模覆盖，进而出现阶段性亏损。

2、主营业务毛利率分析

报告期内，公司主营业务毛利率按产品构成变化情况如下所示：

类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
第三方实验室检测分析服务	**48.79%**	**61.60%**	51.00%	64.02%	52.09%	65.70%	52.67%	63.78%
检测硬件产品	**31.24%**	**22.93%**	31.01%	23.13%	35.74%	21.65%	35.94%	26.28%
量产业务（量产测试及电子制造服务）	**-40.09%**	**10.70%**	-47.60%	8.63%	-68.88%	6.91%	-38.03%	7.56%
工程样品封装及其他	**6.48%**	**4.77%**	0.59%	4.22%	5.88%	5.75%	-70.05%	2.38%
合计	**33.24%**	**100.00%**	**35.74%**	**100.00%**	**37.54%**	**100.00%**	**38.49%**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 38.49%、37.54%、35.74%**和 33.24%**，出现小幅下降，主要受各类业务毛利率及收入占比的共同影响。具体分析如下：

（1）第三方实验室检测分析服务

报告期各期，公司第三方实验室检测分析服务的毛利率分别为 52.67%、52.09%、51.00%**和 48.79%，毛利率水平小幅下滑**，公司第三方实验室检测分析服务毛利率情况如下表所示：

类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
失效分析	**49.29%**	**43.07%**	51.51%	43.72%	47.92%	39.14%	55.57%	37.63%
材料分析	**55.84%**	**31.42%**	58.76%	28.21%	68.95%	34.87%	55.59%	31.55%
可靠性测试	**39.26%**	**25.51%**	42.42%	28.07%	35.75%	25.99%	46.13%	30.82%
合计	**48.79%**	**100.00%**	**51.00%**	**100.00%**	**52.09%**	**100.00%**	**52.67%**	**100.00%**

第三方实验室检测分析服务由失效分析、材料分析和可靠性测试组成，因客户结构、测试项目难度、固定资产投入差异等因素，不同业务各年度毛利率水平存在一定波动，报告期内，失效分析、材料分析和可靠性测试的毛利率变动及其原因分析如下：

①失效分析

报告期内，公司失效分析业务的毛利率情况如下：

单位：元/件

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
单价	**3,320.79**	3,144.34	2,990.48	2,689.33
单位成本	**1,684.00**	1,524.74	1,557.49	1,194.99
毛利率	**49.29%**	51.51%	47.92%	55.57%

报告期内，公司失效分析业务毛利率分别为 55.57%、47.92%、51.51%**以及 49.29%**，其中各年变动分析如下：

2024 年失效分析业务毛利率较 2023 年下降 7.65 个百分点。主要原因系为应对中国大陆分布广泛且持续旺盛的市场需求，公司加大聚焦离子束显微镜等高价值失效分析检测设备投入，扩充专业检测分析团队规模，产能暂未完全消化，对应的单位折旧摊销费用和单位人工成本明显增长，从而对失效分析业务毛利率变动产生负向影响。

2025 年度，失效分析业务毛利率较 2024 年增长 3.59 个百分点，主要系随着客户需求提升，双束聚焦离子束检测制样、线路修补等检测分析项目的收费数量和收入占比进一步提升，该类检测分析项目使用的设备价值高、操作难度大，对应的案件收费水平和毛利率较高，进而导致失效分析业务毛利率水平进一步提高。

2026 年 1-6 月，失效分析毛利率较 2025 年下降 2.22 个百分点，主要系受

单位成本变动影响，近年来公司持续保持先进设备及检测分析人才团队投入，检测分析能力持续提升带动当期失效分析案件单价上升的同时，单位折旧摊销成本和人工成本持续增长，从而对毛利率产生负向影响。

②材料分析

报告期内，公司材料分析业务的毛利率情况如下：

单位：元/件

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
单价	**12,824.96**	18,459.82	23,067.50	9,996.78
单位成本	**5,663.03**	7,613.26	7,163.59	4,439.88
毛利率	**55.84%**	58.76%	68.95%	55.59%

报告期内，公司材料分析业务毛利率分别为 55.59%、68.95%、58.76%**以及 55.84%**，其中各年变动分析如下：

公司材料分析业务以晶圆厂客户为主，其工艺优化会产生旺盛的材料分析需求。2024 年材料分析业务毛利率较 2023 年上升 13.36 个百分点，主要系公司与晶圆厂大客户合作持续深入，获取的订单金额显著增长所致。晶圆厂客户订单主要为晶圆样品制备和透射电镜成像分析项目，该类测试项目检测难度大、交期要求紧，收费水平高，2024 年度公司执行检测分析样品数量显著增加，设备利用率提升，推动材料分析整体毛利率水平显著增长。

2025 年公司材料分析业务毛利率回归到正常水平。一方面，2025 年度材料分析核心检测项目晶圆样品制备和透射电镜成像分析检测样本数量保持持续增长，但是公司为稳固现有市场份额并抢占新增市场需求，针对部分客户的报价进行优化，收费水平有所下滑；另一方面，公司为增加产能和市场竞争力，增加了检测分析设备投入，2025 年设备折旧及摊销费用有所提升。

2026 年 1-6 月材料分析业务毛利率较 2025 年小幅下降 2.91 个百分点。2026 年上半年公司材料分析业务收入重回增长区间，对应执行检测分析案件数量大幅增长，但是公司亦加大了球差透射电子显微镜、聚焦离子束电子显微镜等先进设备投入，北京、上海、深圳等地材料分析实验室设备原值较上年末增长 7,547.99 万元，对应固定资产折旧及人工成本明显增加，导致毛利率出现小幅下滑。

③可靠性测试

报告期内，公司可靠性测试业务的毛利率情况如下：

单位：元/件

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
单价	**4,933.16**	4,964.18	4,389.54	4,582.35
单位成本	**2,996.45**	2,858.56	2,820.47	2,468.40
毛利率	**39.26%**	42.42%	35.75%	46.13%

报告期内，公司可靠性测试业务毛利率分别为 46.13%、35.75%、42.42%和**39.26%**，其中各年变动分析如下：

2024 年可靠性测试业务毛利率同比下降 10.39 个百分点，主要系公司加大对可靠性测试业务设备投入，检测分析设备数量和检测分析能力持续提升，对应设备折旧规模增幅明显，但业务规模起量需要一定时间，进而导致 2024 年可靠性测试业务毛利率出现下滑。

2025 年可靠性测试业务毛利率较 2024 年上升 6.67 个百分点。一方面，静电放电类检测项目收费数量持续增长，设备利用率提升带动该类检测项目毛利率水平明显提升；另一方面，新能源可靠性检测项目收入规模明显增长，规模效应初现，该类检测项目毛利率水平由负转正，进一步推动了可靠性测试业务整体毛利率提升。

2026 年 1-6 月可靠性测试业务毛利率较 2025 年下降 3.16 个百分点，主要系可靠性测试各细分领域需求结构分化影响所致。本期静电放电类检测可靠性测试需求持续旺盛，收入占比、案件单价及毛利率均呈上升趋势；新能源可靠性检测业务受部分客户需求减少影响，收入规模下降，出现阶段性亏损；传统老化可靠性检测则受人工成本上升及案件单价下滑的双重挤压，毛利率下滑。上述因素共同导致可靠性检测业务整体毛利率有所下降。

（2）检测硬件产品

报告期各期，公司检测硬件产品的毛利率分别为 35.94%、35.74%、31.01%**和 31.24%**，具体而言公司检测硬件产品毛利率情况如下：

类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
集成电路测试板	**31.30%**	**91.87%**	31.42%	95.88%	36.22%	96.90%	36.26%	95.08%
测试插座	**21.24%**	**4.67%**	15.76%	3.12%	13.75%	1.24%	25.10%	2.27%
检测仪器设备	**43.24%**	**3.46%**	38.67%	1.00%	25.35%	1.86%	33.58%	2.64%
合计	**31.24%**	**100.00%**	**31.01%**	**100.00%**	**35.74%**	**100.00%**	**35.94%**	**100.00%**

公司检测硬件产品主要由集成电路测试板构成，相关产品的毛利率变动情况如下：

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度
	毛利率	变动率	毛利率	变动率	毛利率	变动率	毛利率
集成电路测试板	**31.30%**	**下降 0.12 个百分点**	31.42%	下降 4.79 个百分点	36.22%	下降 0.04 个百分点	36.26%

公司集成电路测试板产品需根据客户产品迭代和技术更新针对化设计，定制化程度较高。2025 年该产品毛利率同比下降 4.79 个百分点，主要系公司为提升市场份额，调整了 ATE 板、可靠性测试板等产品报价。**2026 年 1-6 月，集成电路测试板产品的毛利率与 2025 年度基本持平。**

（3）量产业务（量产测试及电子制造服务）

公司量产业务包含量产测试业务和电子制造服务，具体情况如下：

类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
量产测试	**-26.15%**	**69.92%**	-34.20%	77.50%	-76.02%	70.34%	-61.10%	61.75%
EMS	**-72.49%**	**30.08%**	-93.74%	22.50%	-51.96%	29.66%	-0.79%	38.25%
合计	**-40.09%**	**100.00%**	**-47.60%**	**100.00%**	**-68.88%**	**100.00%**	**-38.03%**	**100.00%**

公司量产测试业务主要服务于高可靠性芯片（如车规级芯片）的测试需求，目前尚处于起步阶段，客户对供应商测试能力和设备规模均有较高的要求，报告期内公司为获得客户的资质认证并进入其供应链体系，持续保持资本投入，导致固定成本较高。但随着量产测试销售额快速提升，规模效应已开始凸显，毛利率水平已呈现快速改善趋势。2025 年度及 **2026 年 1-6 月，**公司量产测试服务负毛利率水平快速收窄。

报告期内，公司 EMS 业务毛利率分别为-0.79%、-51.96%、-93.74%和-72.49%。随着下游客户对系统级模组业务以及高端模组制造能力的需求日益增长，公司依托在第三方实验室领域积累的深厚的分析和验证能力，基于原有集成电路测试板业务所储备的技术能力及团队，近年来开始规模化投入，目前公司已完成 6 条 EMS 产线配置，但该业务目前仍处于前期投入阶段，客户导入滞后于产线投产，因此仍处于负毛利状态。

当前，公司量产业务正处于快速成长期；未来随着公司业务布局逐渐完善、客户供应链体系导入完成、产能规模逐步释放，量产业务规模效应将逐步显现，盈利水平将有望进一步提升。

（4）工程样品封装及其他

报告期内，公司工程样品封装业务毛利率分别为-70.05%、-13.56%、0.59%和 6.48%，受益于与第三方实验室服务良好的协同效应以及客户开拓，报告期内工程样品封装业务收入规模持续保持高速增长趋势，规模效应逐步显现，毛利率水平快速回升，2025 年度该业务已回归正毛利率水平。

3、同行业可比公司毛利率分析

报告期内，公司主营业务毛利率与同行业可比公司的比较情况如下：

公司	可比业务	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
胜科纳米	第三方实验室检测分析业务	**38.13%**	40.63%	46.86%	54.28%
苏试宜特	第三方实验室检测分析业务	**41.99%**	41.46%	39.67%	43.28%
闳康	第三方实验室检测分析业务	**32.47%**	28.51%	32.90%	35.29%
雍智科技	集成电路测试板	**49.81%**	46.14%	53.01%	50.03%
伟测科技	量产测试业务	**33.59%**	39.37%	37.11%	38.96%
平均值		**39.20%**	**39.22%**	**41.91%**	**44.37%**
季丰电子	**主营业务毛利率**	**33.24%**	**35.74%**	**37.54%**	**38.49%**
	第三方实验室检测分析业务	**48.79%**	51.00%	52.09%	52.67%
	集成电路测试板	**31.30%**	31.42%	36.22%	36.26%
	量产测试业务	**-26.15%**	-34.20%	-76.02%	-61.10%

注 1：苏试宜特数据来源于苏试试验定期报告中集成电路验证与分析服务的分部业务数据。

公司主要为半导体全产业链企业提供集成电路测试板等检测硬件产品以及第三方实验室检测分析服务。目前尚未有业务模式和产品种类与季丰电子完全一致的上市公司，因此就公司各类业务分别选取产品或模式具有一定可比性的上市公司或其某一业务板块进行对比分析。

如上表所示，公司的销售毛利率低于同行业可比公司平均水平，但是处于同行业可比公司的区间内。由于各可比公司的主营业务存在差异，因此分业务及产品类别进行比较如下：

（1）第三方实验室业务

①与胜科纳米、苏试宜特的比较

2023 年，公司第三方实验室业务的毛利率水平处于胜科纳米和苏试宜特之间；2024 年开始，该业务毛利率逐步高于胜科纳米和苏试宜特。主要原因系公司多点布局一站式服务战略成效显现，2024 年度客户开拓进展顺利，大客户的导入以及新老客户合作加深带动公司检测分析业务高速增长，新布局产能得以消化，维持了较高的毛利率水平。但是胜科纳米和苏试宜特 2024 年开始在多地新建实验室投入运营后，部分实验室产能仍处于爬坡状态，资产折旧、人员薪资等成本增加，导致毛利率出现下滑。

②与闳康比较

闳康为中国台湾上市公司，报告期各期闳康毛利率水平明显低于公司，主要系二者在销售地域、客户群体上存在差异。公司主要客户群体为中国大陆的半导体厂商，闳康在中国大陆地区的收入占比约为 50%，报告期内随着中国大陆半导体市场的快速发展，公司凭借一站式服务模式和较强的技术实力，开拓了部分高毛利率客户，而闳康在中国大陆本土厂商的冲击下，2025 年度中国大陆地区收入规模出现下滑。

（2）集成电路测试板业务

雍智科技主要销售半导体后道测试板，双方销售区域和应用环节存在明显差异。雍智科技主要客户群体集中在中国台湾，在半导体先进制程方面，中国台湾目前对中国大陆地区保持一定优势，先进制程对测试板产品精度要求更高导致产品附加值更高，因此产品单价及毛利率更高。

（3）量产测试业务

伟测科技主要提供半导体晶圆、成品和集成电路的量产测试，为公司量产测试业务可比公司。目前公司量产测试仍处于前期投入阶段，规模效应暂未体现，因此与伟测科技毛利率水平存在较大差异。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用以及占当期营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	1,317.95	3.48%	2,725.66	4.07%	2,697.82	4.62%	1,941.03	4.38%
管理费用	3,491.27	9.22%	6,940.61	10.37%	6,459.05	11.07%	6,177.49	13.93%
研发费用	2,529.95	6.68%	5,506.10	8.22%	4,962.52	8.51%	4,405.52	9.94%
财务费用	978.82	2.58%	1,967.11	2.94%	1,888.61	3.24%	1,843.73	4.16%
合计	8,318.00	21.96%	17,139.48	25.60%	16,008.00	27.44%	14,367.77	32.41%

报告期内，公司期间费用合计分别为 14,367.77 万元、16,008.00 万元、17,139.48 万元和 8,318.00 万元，占营业收入的比例分别为 32.41%、27.44%、25.60%和 21.96%，期间费用随着公司经营规模扩大呈上升趋势，期间费用率则随营业收入增长而逐年下降。

1、销售费用

（1）销售费用的构成与变动

报告期内，公司销售费用情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	943.39	71.58%	1,972.07	72.35%	1,849.39	68.55%	1,383.11	71.26%
业务招待费	86.31	6.55%	204.19	7.49%	262.08	9.71%	148.71	7.66%
广宣费	108.08	8.20%	200.07	7.34%	210.57	7.81%	158.77	8.18%
股份支付	72.58	5.51%	175.84	6.45%	190.97	7.08%	132.41	6.82%
差旅费	22.52	1.71%	56.53	2.07%	67.38	2.50%	49.57	2.55%
折旧与摊销	19.53	1.48%	39.49	1.45%	44.72	1.66%	24.70	1.27%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他	**65.55**	**4.97%**	77.46	2.84%	72.70	2.69%	43.75	2.25%
合计	**1,317.95**	**100.00%**	**2,725.66**	**100.00%**	**2,697.82**	**100.00%**	**1,941.03**	**100.00%**

报告期内，公司销售费用分别为 1,941.03 万元、2,697.82 万元、2,725.66 万元**和 1,317.95 万元**，占营业收入的比例分别为 4.38%、4.62%、4.07%**和 3.48%**，主要为职工薪酬、业务招待费、广宣费、股份支付等，销售费用率整体保持平稳。

2024 年较 2023 年，随着公司经营规模扩大，为拓宽市场，公司加强了营销力度并提高了销售团队薪酬水平，相应的销售费用有明显增加且销售费用率略有上升。2025 年较 2024 年，公司加大费用管控力度，销售费用中的业务招待费、差旅费等较 2024 年有所减少；随着销售人员数量及人均薪酬增加，销售费用中的职工薪酬较 2024 年有所增加；整体来看，销售费用增幅低于收入增长，销售费用率有所降低。

①职工薪酬

报告期内，公司销售费用中的职工薪酬分别为 1,383.11 万元、1,849.39 万元、1,972.07 万元**和 943.39 万元**，占当期销售费用的比例分别为 71.26%、68.55%、72.35%**和 71.58%**，为公司销售费用的主要构成部分。**2024-2025 年**，随着公司经营规模扩大，销售团队人员数量及人均激励有所上升，销售人员整体薪酬总额相应增加。**2026 年 1-6 月，公司职工薪酬占比保持稳定。**

②业务招待费

报告期内，公司销售费用中的业务招待费分别为 148.71 万元、262.08 万元、204.19 万元**和 86.31 万元**，其中 2024 年业务招待费较 2023 年增长 113.37 万元，主要系公司营业收入增长，市场开拓、客户接待等业务招待活动增多所致；2025 年**及 2026 年 1-6 月**，公司加大费用管控，业务招待费金额有所下降。

③广宣费

报告期内，公司销售费用中的广宣费分别为 158.77 万元、210.57 万元、200.07 万元**和 108.08 万元**，主要系公司支付的会展、纪念品等费用。其中 2024 年较 2023 年增长 51.80 万元，主要系公司持续加强市场开拓力度，积极参与各类展会

进行客户开拓，相应的会展费支出有明显增长。

④股份支付

报告期内，公司销售费用中的股份支付分别为 132.41 万元、190.97 万元、175.84 万元**和 72.58 万元**，公司通过持股平台上海季双、江山季兴及季铭源对部分员工进行股权激励，公司根据被激励员工类型将股份支付计入相应的费用科目。

（2）销售费用与同行业可比公司比较分析

报告期内，公司销售费用率与同行业可比公司对比情况如下：

证券简称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
胜科纳米	**2.24%**	3.42%	3.24%	4.11%
伟测科技	**2.28%**	2.69%	3.31%	3.26%
闳康	**3.81%**	3.89%	4.41%	4.77%
雍智科技	**3.80%**	3.67%	4.61%	3.83%
苏试试验	**7.60%**	7.04%	7.46%	6.40%
平均值	**3.95%**	**4.14%**	**4.61%**	**4.47%**
季丰电子	**3.48%**	**4.07%**	**4.62%**	**4.38%**

同行业公司中胜科纳米和伟测科技客户群体相对集中，销售人员占员工总数比例较低，因此销售费用率较低。苏试试验销售人员数量较多，且业务招待费及差旅费较高，导致其销售费用率较高。公司销售费用率与同行业可比公司平均水平总体差异不大，处于同行业可比公司合理区间内。

2、管理费用

（1）管理费用的构成与变动

报告期内，公司管理费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	**1,872.25**	**53.63%**	3,763.32	54.22%	3,500.86	54.20%	2,800.27	45.33%
折旧与摊销	**410.61**	**11.76%**	885.48	12.76%	914.20	14.15%	775.10	12.55%
中介机构服务费	**369.63**	**10.59%**	621.99	8.96%	502.10	7.77%	699.86	11.33%
物业水电费	**193.76**	**5.55%**	414.22	5.97%	347.28	5.38%	249.05	4.03%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
办公费	117.00	3.35%	237.82	3.43%	201.18	3.11%	297.17	4.81%
差旅交通费	95.40	2.73%	188.30	2.71%	167.57	2.59%	128.75	2.08%
股份支付	121.83	3.49%	173.66	2.50%	240.17	3.72%	687.09	11.12%
业务招待费	92.37	2.65%	137.40	1.98%	168.00	2.60%	171.11	2.77%
保险费	52.96	1.52%	84.93	1.22%	74.76	1.16%	65.42	1.06%
其他	165.45	4.74%	433.50	6.25%	342.91	5.31%	303.66	4.92%
合计	3,491.27	100.00%	6,940.61	100.00%	6,459.05	100.00%	6,177.49	100.00%

报告期内，公司管理费用分别为 6,177.49 万元、6,459.05 万元、6,940.61 万元和 3,491.27 万元，占营业收入的比例分别为 13.93%、11.07%、10.37%和 9.22%。主要为职工薪酬、折旧与摊销、中介机构服务费、股份支付等，随着公司业务规模的提升，公司管理费用率有所下降。

①职工薪酬

报告期内，公司管理费用中的职工薪酬分别为 2,800.27 万元、3,500.86 万元、3,763.32 万元和 1,872.25 万元，占当期管理费用的比例分别为 45.33%、54.20%、54.22%和 53.63%，为公司管理费用的主要构成部分。2023-2025 年，随着公司经营规模的扩大，公司管理人员数量及薪酬水平有所上升。

②折旧与摊销

报告期内，公司管理费用中的折旧与摊销分别为 775.10 万元、914.20 万元、885.48 万元和 410.61 万元，主要系各行政管理部门使用固定资产所计提的折旧及无形资产所计提的摊销。2024 年管理费用中折旧与摊销金额增加主要系公司购置的软件和系统摊销增加所致。

③中介机构服务费

报告期内，公司管理费用中的中介机构服务费分别为 699.86 万元、502.10 万元、621.99 万元和 369.63 万元，主要系公司筹备上市等事项产生的中介机构等服务费支出存在一定变动。

④股份支付

报告期内，公司管理费用中的股份支付分别为 687.09 万元、240.17 万元、173.66 万元**和 121.83 万元**，公司通过持股平台上海季双、江山季兴及季铭源对部分员工进行股权激励，公司根据被激励员工类型将股份支付计入相应的费用科目。

（2）管理费用与同行业可比公司比较分析

报告期内，公司管理费用率与同行业可比公司对比情况如下：

证券简称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
胜科纳米	**12.69%**	14.09%	11.78%	11.88%
伟测科技	**4.59%**	5.50%	7.12%	6.66%
闳康	**9.08%**	8.89%	8.91%	8.11%
雍智科技	**4.56%**	4.93%	5.31%	4.16%
苏试试验	**10.64%**	10.19%	10.94%	11.88%
平均值	**8.31%**	**8.72%**	**8.81%**	**8.54%**
季丰电子	**9.22%**	**10.37%**	**11.07%**	**13.93%**

报告期内，公司管理费用率分别为 13.93%、11.07%、10.37%**和 9.22%**，高于同行业费用率的平均值，2023 年度管理费用率高于同行业可比公司，主要系公司当年度确认股份支付金额较大，且当时公司业务规模偏小。2024 年和 2025 年随着公司业务规模的提升，公司管理费用率有所下降，管理费用率与境内上市的胜科纳米、苏试试验相近。闳康和雍智科技均为中国台湾上市公司，采用的会计准则不同，可比性较低。

3、研发费用

（1）研发费用的构成与变动

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	**1,885.64**	**74.53%**	3,940.95	71.57%	3,681.72	74.19%	3,219.12	73.07%
折旧与摊销	**419.29**	**16.57%**	908.52	16.50%	642.37	12.94%	598.88	13.59%
物料消耗费	**68.24**	**2.70%**	491.85	8.93%	219.21	4.42%	285.09	6.47%
其他	**156.78**	**6.20%**	164.78	2.99%	419.22	8.45%	302.43	6.86%
合计	**2,529.95**	**100.00%**	**5,506.10**	**100.00%**	**4,962.52**	**100.00%**	**4,405.52**	**100.00%**

报告期内，公司研发费用分别为 4,405.52 万元、4,962.52 万元、5,506.10 万元**和 2,529.95 万元**，占营业收入的比例分别为 9.94%、8.51%、8.22%**和 6.68%**。报告期内，公司坚持自主研发与创新，重视技术团队培养，持续加码研发投入，推动测试水平和产品性能的持续提升，积累核心技术，研发费用维持在较高水平。公司研发费用由职工薪酬、折旧与摊销费用和物料消耗组成，具体情况如下：

①职工薪酬

报告期内，公司研发费用中职工薪酬分别为 3,219.12 万元、3,681.72 万元、3,940.95 万元**和 1,885.64 万元**，占当期研发费用的比例分别为 73.07%、74.19%、71.57%**和 74.53%**，为公司研发费用的主要构成部分。报告期内，公司为保持市场竞争力，适应技术迭代及经营规模扩张产生的研发需求，公司研发人员数量逐年增加，研发费用中职工薪酬金额呈逐年增长趋势。

②折旧与摊销

报告期内，公司研发费用中折旧与摊销分别为 598.88 万元、642.37 万元、908.52 万元**和 419.29 万元**，占当期研发费用的比例分别为 13.59%、12.94%、16.50%**和 16.57%**。2025 年度，公司研发费用中折旧及摊销费用金额及占比增长明显，主要系 2025 年度研发项目更聚焦于先进制程，部分研发项目使用聚焦离子电子显微镜等高价值设备，导致研发占用工时增加，进而导致研发工时分摊的折旧金额较高。

③物料消耗费

报告期内，公司研发费用中物料消耗费分别为 285.09 万元、219.21 万元、491.85 万元**和 68.24 万元**，占当期研发费用的比例分别为 6.47%、4.42%、8.93%**和 2.70%**，物料消耗主要系公司集成电路测试板等硬件研发项目领用的材料。2025 年度，公司新增设备研发项目，领用材料增加，导致物料消耗金额和占比均有所增长。**2026 年 1-6 月，随着 F370 高低温存储芯片可靠性测试机样机的完成，本期研发费用中的物料消耗相应下降。**

④其他

研发费用其他主要系股份支付费用和合作研发费用。2024 年度，公司产生合作研发费用 129.40 万元，系与上海交通大学合作研发“超景深三维数字显微

仪器研制”项目产生的费用，该合作研发项目具体内容请参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“六、发行人核心技术和研发情况”之“（二）研发情况”之“**4**、合作研发情况”相关内容。

（2）研发费用分项目明细表

报告期内，公司主要研发项目（金额大于 100 万元）投入情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	整体预算	研发支出				研发阶段
			2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度	
1	超景深三维数字显微仪器研制	**1,560.00**	**55.97**	187.23	357.19	265.77	进行中
2	导电阳极丝与表面绝缘阻抗评估系统	610.00	**45.00**	324.85	241.65	-	已结题
3	工艺可靠性电迁移 EM 测试设备的研发	300.00	**52.58**	107.55	52.82	-	进行中
4	F370 高低温存储芯片可靠性测试机	1,000.00	**148.51**	549.77	-	-	进行中
5	ATELB 高速信号的完整性研究	400.00	**57.55**	396.70	-	-	已结题
6	老化板生产测试平台研究	560.00	**84.13**	577.97	-	-	已结题
7	半导体掺杂分析技术开发-原子力显微镜多功能应用	1,120.00	**56.96**	516.93	-	-	已结题
8	low k 材料的 iDPC 成像技术开发	500.00	**71.59**	437.73	-	-	已结题
9	生产设备自动化数字管理分析平台研发	590.00	**48.88**	199.26	240.14	-	已结题
10	功率器件动态老化测试系统	180.00	**24.18**	153.50	-	-	已结题
11	Thermal 测试能力的研究应用	190.00	**9.10**	132.76	-	-	已结题
12	高阶电路修补技术的开发	530.00	**55.89**	329.01	-	-	已结题
13	EMMI 低高温探针台的研发	300.00	**87.23**	221.19	-	-	**已结题**
14	基于 93K-WSRF 的 Dig-RF 芯片的量产程序开发	230.00	**51.45**	237.56	-	-	已结题
15	纳米束衍射技术在 FinFet 先进制程研发中的应用	860.00	**75.60**	572.91	304.70	-	已结题
16	存储类芯片的高温可靠性测试机设备的研发	475.00	**-**	-	226.08	173.96	已结题
17	半导体前道缺陷检测硬件平台的研发	590.00	**-**	-	112.52	455.92	已结题
18	半导体 ATE 测试载板验证平台	420.00	**-**	-	438.87	-	已结题
19	半导体 BIB 板时钟完整性研究	292.00	**-**	-	290.45	-	已结题
20	集成电路 Lowk 材料的 FIB 制样及 TEM 表征研究	170.00	**-**	-	131.93	-	已结题
21	利用 Pickup 系统提升 TEM 试片制样效率的创新研究	265.00	**-**	-	238.43	-	已结题

序号	项目名称	整体预算	研发支出				研发阶段
			2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度	
22	超声波切割研磨样品制备	440.00	-	-	377.37	-	已结题
23	ATE 板载频率信号分路及功率放大器研发	210.00	-	-	187.62	-	已结题
24	半导体测试设备中功能数据卡研发	155.00	-	-	159.52	-	已结题
25	PCB 基板逆向版图及工艺提取	160.00	-	-	126.05	-	已结题
26	集成电路纳米器件中微观结构的 EDS 定量方法	210.00	-	-	181.94	-	已结题
27	晶圆级探针系统中高低温载物台的研发	200.00	-	-	119.78	67.75	已结题
28	先进制程逻辑单元的立体结构分析方法研发	500.00	-	-	-	360.04	已结题
29	中高功率芯片独立温控可靠性测试机的设备研发	495.00	-	35.04	96.42	136.50	已结题
30	先进制程器件透射样品制备方法的研发	1,000.00	-	-	-	135.84	已结题
31	大功率 BGA 芯片高温 socket 测试中避免熔锡的方法研究	500.00	-	-	-	437.01	已结题
32	射频类芯片可靠性测试系统研发	110.00	-	-	-	100.05	已结题
33	超高压功率器件失效分析中热点分析方法的研发	180.00	-	-	-	137.64	已结题
34	针对车规级大功耗 SOC 及 AI 芯片的功率温度循环试验方法的研发	110.00	-	-	-	100.62	已结题
35	基于 V93000 平台的超高精度多通道 VDAC、IDAC、ADC 测试方法研发	300.00	-	-	-	225.61	已结题
36	多通道精密阻抗自动化（AMR）测试设备研发	210.00	-	-	-	202.16	已结题
37	功率器件的模组级功率循环测试系统的研发	150.00	-	-	-	112.92	已结题
38	晶圆自动光学检测系统的研发	220.00	-	-	-	175.38	已结题
39	3380P 上兼容多种芯片测试的接口板研发	110.00	-	-	-	102.47	已结题
40	双束 FIB 试验测试系统研发	250.00	-	-	-	164.42	已结题
41	芯片去层分析（Delayer）方法研究	180.00	-	-	-	103.00	已结题
42	**iDPC 技术建立及应用**	**600.00**	**132.00**	**-**	**-**	**-**	**进行中**
43	**1KW 以上老化机台 BIB 能力建立**	**390.00**	**128.43**	**-**	**-**	**-**	**进行中**
44	**基于 Magnum5 存储 LB 能力建立**	**240.00**	**122.87**	**-**	**-**	**-**	**进行中**
45	**先进制程失效分析方法研究**	**500.00**	**111.65**	**23.45**	**-**	**-**	**进行中**
46	**球差校正/EELS/PED 技术建立及应用**	**555.00**	**100.88**	**-**	**-**	**-**	**进行中**
合计		**19,117.00**	**1,520.45**	**5,003.41**	**3,883.48**	**3,457.05**	

（3）同行业可比公司研发费用率比较

报告期内，公司研发费用率与可比公司对比情况如下：

证券简称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
胜科纳米	**12.52%**	10.83%	11.03%	10.80%
苏试试验	**8.71%**	7.75%	8.12%	7.87%
伟测科技	**8.39%**	10.92%	13.22%	14.09%
闳康	**4.26%**	4.24%	5.67%	5.53%
雍智科技	**12.79%**	12.64%	14.31%	11.78%
平均值	**9.33%**	**9.28%**	**10.47%**	**10.02%**
季丰电子	**6.68%**	**8.22%**	**8.51%**	**9.94%**

报告期内，公司研发费用率整体处于同行业可比公司区间范围内。报告期内，公司收入规模高速增长，但基于公司前期制定的发展目标和研发计划，各年研发投入增速较为稳定，导致研发费用率有所下降。

4、财务费用

（1）财务费用的构成与变动

报告期内，公司财务费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息支出	**801.27**	1,512.98	1,478.90	1,500.92
减：利息收入	**6.29**	24.93	98.98	63.96
银行手续费	**13.91**	17.52	16.24	15.08
汇兑损益	**-31.91**	34.69	23.02	-91.31
租赁负债确认融资费用	**201.84**	426.85	469.44	483.01
合计	**978.82**	**1,967.11**	**1,888.61**	**1,843.73**

报告期内，公司财务费用分别为 1,843.73 万元、1,888.61 万元、1,967.11 万元**和 978.82 万元**，公司财务费用主要由利息收支、租赁负债确认融资费用等构成。报告期内，公司因投资扩产从金融机构取得借款，利息支出维持在较高水平。

报告期内，公司财务费用占营业收入的比例分别为 4.16%、3.24%、2.94%**和 2.58%**。因收入保持高速增长，财务费用率有所下滑。

（2）财务费用与同行业可比公司比较分析

报告期内，公司财务费用率与同行业可比公司对比情况如下：

证券简称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
胜科纳米	**3.84%**	3.26%	3.25%	3.61%
伟测科技	**3.59%**	3.97%	3.32%	5.06%
闳康	**0.96%**	0.94%	0.79%	0.71%
雍智科技	**0.02%**	0.02%	0.02%	0.03%
苏试试验	**1.30%**	1.50%	1.48%	1.16%
平均值	**1.94%**	**1.94%**	**1.77%**	**2.11%**
季丰电子	**2.58%**	**2.94%**	**3.24%**	**4.16%**

报告期内，公司财务费用率分别为 4.16%、3.24%、2.94%**和 2.58%**，高于同行业可比公司财务费用率的平均值，主要系①同行业可比公司闳康、雍智科技经营规模稳定，对外借款较少，导致其财务费用率维持在较低水平；②公司用于业务开展及经营的房屋及建筑物均为租赁使用，报告期各期，公司租赁负债确认融资费用较高。随着公司业务规模的提升，公司财务费用率逐年下降，财务费用率与境内上市公司胜科纳米、伟测科技相近。

（五）利润表其他项目分析

1、税金及附加

报告期内，公司税金及附加情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
印花税	**35.85**	67.82	55.69	67.56
城市维护建设税	**7.29**	29.26	26.07	3.63
教育费附加	**4.13**	17.41	15.04	1.80
地方教育附加	**2.75**	11.61	10.03	1.20
车船税	**0.11**	0.21	0.17	-
土地使用税	**1.35**	1.12	-	-
合计	**51.48**	**127.42**	**107.00**	**74.20**

报告期各期，公司税金及附加分别为 74.20 万元、107.00 万元、127.42 万元**和 51.48 万元**，公司税金及附加主要为印花税、城市维护建设税、教育费附加、

地方教育附加等。

2、其他收益

报告期各期，公司其他收益分别为 1,231.65 万元、1,538.61 万元、3,782.77 万元**和 908.14 万元**，具体如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
与资产相关的政府补助	**374.45**	846.70	577.98	249.84
与收益相关的政府补助	**219.53**	1,337.36	878.86	946.10
增值税加计抵减[1]	**301.75**	1,586.28	72.91	0.22
代扣个人所得税手续费返还	**12.41**	12.43	8.86	35.48
合计	**908.14**	**3,782.77**	**1,538.61**	**1,231.65**

注 1：根据财政部、国家税务总局于 2023 年 4 月 20 日发布的《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号）取得的税收优惠。

报告期内，公司政府补助具体项目情况如下：

单位：万元

补助项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度	与资产相关/与收益相关	经常性/非经常性损益
杭州高新开发区（滨江）鼓励国家高新技术企业发展奖励	**20.00**	-	-	-	**与收益相关**	**非经常性**
2025 年全年科技服务业营收增长奖励	**30.50**	**-**	**-**	**-**	**与收益相关**	**非经常性**
支持公共平台运营服务补贴收入	-	476.80	-	-	与收益相关	非经常性
“闵行区产业政策扶持”-鼓励现代服务业跨越式发展	**67.00**	323.00	-	-	与收益相关	非经常性
小巨人企业实施期初奖	-	283.00	-	-	与收益相关	非经常性
上海市闵行区莘庄镇产业政策补贴	**80.00**	40.00	-	-	与收益相关	非经常性
国家高新技术企业认定奖励		30.00	-	-	与收益相关	非经常性
衢州智造新城管委会厂房租金补助	-	27.89	57.37	53.86	与收益相关	非经常性
北京市科学技术委员会关于“科技服务中小企业项目”补贴	-	25.00	-	-	与收益相关	非经常性
科技创新财政扶持金	-	21.39	-	2.00	与收益相关	非经常性
2024 年高新技术企业市奖/区奖	-	20.00	-	-	与收益相关	非经常性
上海市经济和信息化委员会“小升规”补助	-	20.00	-	-	与收益相关	非经常性

补助项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度	与资产相关/与收益相关	经常性/非经常性损益
小巨人绩效评价	-	-	300.00	-	与收益相关	非经常性
上海市集成电路行业协会——先进产业集群考核奖励	-	-	210.00	-	与收益相关	非经常性
“闵行区产业政策扶持”-加大培育优质企业	-	-	100.00	-	与收益相关	非经常性
集成电路项目房租补助	-	-	51.57	-	与收益相关	非经常性
上海市大型科学仪器设施共享服务奖励	-	-	29.13	95.51	与收益相关	非经常性
生产性服务业示范企业补贴	-	-	20.00	-	与收益相关	非经常性
小微企业招用高校毕业生社保补贴	-	-	17.98	33.22	与收益相关	非经常性
嘉善开发区检测运营机构补贴款	-	-	-	300.00	与收益相关	非经常性
莘庄镇助力集成电路相关产业发展“莘十条”补贴	-	-	-	232.00	与收益相关	非经常性
2023 年第二批闵行区鼓励引导企业上市（挂牌）补助	-	-	-	100.00	与收益相关	非经常性
2022 年小巨人资助	-	-	-	50.00	与收益相关	非经常性
长三角技术创新研究院联合创新中心第二期运营经费	-	-	-	25.00	与收益相关	非经常性
专家工作站资助	-	-	-	20.00	与收益相关	非经常性
其他	22.03	70.29	92.81	34.51	与收益相关	非经常性
浙江季丰厂房装修补贴	33.96	135.85	135.85	135.85	与资产相关	经常性
集成电路品质工程技术改造项目	72.52	125.05	48.88	-	与资产相关	经常性
浙江季丰设备投资补贴	54.34	111.93	126.75	-	与资产相关	经常性
衢州季丰厂房改造装修补助	51.78	103.56	34.52	-	与资产相关	经常性
2021 年度闵行区先进制造业专项（第一批）拟扶持项目	29.75	101.77	5.13	5.13	与资产相关	经常性
中关村集成电路设计园高品质科技园区建设项目	47.81	95.62	51.86	-	与资产相关	经常性
上海市服务业发展引导资金	18.28	51.27	85.96	40.50	与资产相关	经常性
进口贴息	24.22	48.78	49.62	41.00	与资产相关	经常性
高质量专项第十一批	18.76	37.51	28.89	16.82	与资产相关	经常性
2024 年度闵行区现代服务业项目（生产性服务业专项）	11.08	24.83	-	-	与资产相关	经常性
上海市促进产业高质量发展专项资金（汽车芯片产业发展专项）	4.19	-	-	-	与资产相关	经常性
其他	7.76	10.53	10.53	10.53	与资产相关	经常性
合计	593.98	2,184.06	1,456.84	1,195.94		

注：政府补助金额不超过 20 万元的汇总列示为“其他”。

3、投资收益

报告期内，公司投资收益具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
联营企业权益法投资收益	**-8.18**	-130.89	-17.21	1.06
理财及大额存单收益	**13.15**	358.19	506.64	461.76
远期结售汇损失	**-**	-	-	-144.92
合计	**4.97**	**227.30**	**489.43**	**317.91**

报告期内，公司投资收益分别为 317.91 万元、489.43 万元、227.30 万元**和 4.97 万元**。公司投资收益主要受理财产品利息收入、远期结售汇损失及联营企业亏损的综合影响。

4、公允价值变动收益

报告期各期，公司公允价值变动收益分别为 33.34 万元、481.84 万元、292.39 万元**和 186.21 万元**，系划分为交易性金融资产的银行理财产品和其他非流动金融资产公允价值变动所形成。

5、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收票据坏账损失	**-**	-	1.16	-1.16
应收账款坏账损失	**-459.19**	119.91	-604.54	65.70
其他应收款坏账损失	**-19.45**	-61.28	-123.10	-40.91
合计	**-478.63**	**58.63**	**-726.48**	**23.64**

注：损失以“-”号填列。

报告期各期，公司信用减值损失分别为 23.64 万元、-726.48 万元、58.63 万元**和-478.63 万元**，主要为应收账款和其他应收款坏账损失。2024 年度，公司营业收入较以前年度大幅提升，应收账款规模较大，当期计提的应收账款坏账损失相应增加。公司其他应收款坏账损失，主要系押金保证金账龄变化，公司按照账龄计提坏账准备导致。**2026 年 1-6 月，公司营业收入上涨导致应收账款余额较**

上年末有所增加，信用减值损失相应提升。

6、资产减值损失

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
存货跌价损失	**-390.38**	-1,120.88	-1,100.90	-360.69
商誉减值损失	**-**	-	-	-1,018.26
持有待售资产减值损失	**-**	-91.11	-	-
合计	**-390.38**	**-1,211.98**	**-1,100.90**	**-1,378.95**

报告期各期，公司存货跌价损失分别为 360.69 万元、1,100.90 万元、1,120.88 万元**和 390.38 万元**，主要系对部分原材料、库存商品、合同履约成本和发出商品计提的跌价准备形成。2024 年度，因自研设备更新升级，公司对部分不具有使用价值的设备原材料计提了跌价导致存货跌价损失较 2023 年度有所上升。

2023 年度，公司计提商誉减值损失 1,018.26 万元，主要系收购上海针台半导体科技有限公司（现已更名为季丰精密）产生的商誉全额计提了减值。

（六）税费分析

报告期内，公司所得税费用情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
当期所得税费用	**840.35**	736.50	1,058.81	909.54
递延所得税费用	**-92.54**	-115.34	-136.64	-194.19
合计	**747.81**	**621.15**	**922.17**	**715.35**

报告期内，公司所得税费用与公司利润规模相匹配，公司所得税费用与会计利润的关系如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利润总额	**4,763.65**	9,746.70	6,359.72	2,760.76
按适用税率计算的所得税费用	**721.31**	1,462.00	953.96	414.11
子公司适用不同税率的影响	**-208.71**	-680.46	-153.56	48.30
调整以前期间所得税的影响	**1.80**	2.51	-12.42	36.66
不征税和免税收入的影响	**1.23**	19.63	2.58	-0.16

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	**86.85**	134.61	116.47	341.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	**-75.54**	-403.91	-207.17	-67.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	**627.04**	933.67	882.91	388.07
研发费用加计扣除影响	**-406.16**	-816.19	-660.27	-619.47
税率变动的影响	**-**	-30.72	-0.86	175.10
其他	**-**	-	0.53	-1.23
所得税费用	**747.81**	621.15	922.17	715.35

重大税收政策变化及税收优惠对公司的影响请参见本招股说明书“第六节财务会计信息与管理层分析”之“三、税项”。

八、财务状况分析

（一）资产分析

报告期各期末，公司资产情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	**58,165.84**	**29.12%**	46,890.20	27.15%	48,756.77	31.60%	46,013.17	34.59%
非流动资产	**141,602.10**	**70.88%**	125,808.34	72.85%	105,555.85	68.40%	87,020.14	65.41%
合计	**199,767.94**	**100.00%**	**172,698.54**	**100.00%**	**154,312.62**	**100.00%**	**133,033.30**	**100.00%**

报告期各期末，公司资产总额分别为 133,033.30 万元、154,312.62 万元、172,698.54 万元**和 199,767.94 万元**。**报告期各期末，**随着公司业务规模扩大和经营效益提升，公司资产总额持续增长。资产结构方面，公司资产以非流动资产为主，报告期内占比超过 65%，与公司的业务特点和经营模式相匹配。

1、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	11,032.42	18.97%	8,671.46	18.49%	9,314.65	19.10%	10,684.14	23.22%
交易性金融资产	1,000.53	1.72%	3,104.31	6.62%	7,148.50	14.66%	11,423.91	24.83%
应收票据	82.60	0.14%	112.60	0.24%	247.94	0.51%	154.89	0.34%
应收账款	22,093.30	37.98%	14,305.01	30.51%	18,069.11	37.06%	11,433.51	24.85%
应收款项融资	204.31	0.35%	383.05	0.82%	133.12	0.27%	264.85	0.58%
预付款项	670.81	1.15%	363.72	0.78%	149.38	0.31%	346.06	0.75%
其他应收款	365.45	0.63%	315.04	0.67%	386.01	0.79%	381.64	0.83%
存货	12,577.03	21.62%	10,788.41	23.01%	7,684.38	15.76%	7,460.58	16.21%
持有待售资产	-	-	753.32	1.61%	-	-	-	-
其他流动资产	10,139.38	17.43%	8,093.29	17.26%	5,623.68	11.53%	3,863.58	8.40%
合计	58,165.84	100.00%	46,890.20	100.00%	48,756.77	100.00%	46,013.17	100.00%

报告期各期末，公司流动资产规模随着业务规模增加而整体有所提升，金额分别为 46,013.17 万元、48,756.77 万元、46,890.20 万元和 58,165.84 万元，占总资产比例分别为 34.59%、31.60%、27.15%和 29.12%。

报告期内，公司流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货，上述资产占公司流动资产的比重分别为 89.11%、86.59%、78.63%和 80.29%。

公司主要流动资产项目具体分析如下：

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
库存现金	-	-	-	-
银行存款	10,705.86	8,348.14	9,108.05	9,785.59
其他货币资金	326.56	323.32	206.61	898.55
合计	11,032.42	8,671.46	9,314.65	10,684.14

报告期各期末，公司货币资金分别为 10,684.14 万元、9,314.65 万元、8,671.46

万元和 11,032.42 万元，占流动资产的比例分别为 23.22%、19.10%、18.49%和 18.97%。

报告期各期末，公司货币资金以银行存款为主，其他货币资金主要为保函保证金和存出投资款等。2023 年末至 2025 年末，公司货币资金余额有所下降，主要原因系报告期内公司固定资产投资力度较大，各年投资活动流出资金较多；同时，公司 2023 年对外融资，吸收股东投资导致该年度货币资金余额较多。

（2）交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,000.53	3,104.31	7,148.50	11,423.91
其中：银行理财产品和可转让大额存单	1,000.53	3,104.31	7,148.50	11,423.91
合计	1,000.53	3,104.31	7,148.50	11,423.91

报告期内，公司根据资金的实际使用情况，将部分暂时闲置资金投资购买持有期限较短、可回收性强的理财产品和可转让大额存单等，期末金额分别为 11,423.91 万元、7,148.50 万元、3,104.31 万元和 1,000.53 万元。报告期各期末，公司理财产品规模有所降低。

（3）应收票据和应收款项融资

①应收票据和应收款项融资

报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	82.60	112.60	247.94	132.95
商业承兑汇票	-	-	-	21.95
应收款项融资	204.31	383.05	133.12	264.85
合计	286.92	495.65	381.06	419.75
应收票据和应收款项融资合计/当期营业收入	0.76%	0.74%	0.65%	0.95%

报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资合计分别为 419.75 万元、381.06 万元、495.65 万元**和 286.92 万元**，占当期营业收入的比例分别为 0.95%、0.65%、0.74%**和 0.76%**，占比较小。

②票据背书转让情况

报告期各期末，公司已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据和应收款项融资的情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	**47.20**	**50.83**	123.08	33.61	108.20	39.97	13.82	91.39
商业承兑汇票	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-
合计	**47.20**	**50.83**	**123.08**	**33.61**	**108.20**	**39.97**	**13.82**	**91.39**

③票据到期未能兑现

报告期内，公司不存在因出票人未履约而将票据转应收账款情况。

④应收票据坏账准备计提情况

报告期各期末，公司未对银行承兑汇票计提坏账准备，对商业承兑汇票的坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
商业承兑汇票余额	**-**	-	-	23.10
商业承兑汇票坏账准备	**-**	-	-	1.15
计提比例	**-**	-	-	5.00%

报告期各期末，公司商业承兑汇票已按规定计提坏账准备，坏账计提充分。报告期内，公司在 2023 年存在收入确认时以应收账款进行初始确认后转为商业承兑汇票结算的情形，并已经按照账龄连续计算的原则对应收票据计提坏账准备。

（4）应收账款

①应收账款变动分析

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
应收账款余额	**23,497.62**	15,250.41	19,203.84	12,043.10
减：坏账准备	**1,404.32**	945.41	1,134.73	609.59
应收账款账面价值	**22,093.30**	14,305.01	18,069.11	11,433.51
营业收入	**37,885.76**	66,949.34	58,348.29	44,336.65
应收账款余额/营业收入	**31.01%**	22.78%	32.91%	27.16%

注：2026 年 6 月 30 日之应收账款余额/营业收入数据已年化。

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 12,043.10 万元、19,203.84 万元、15,250.41 万元**和 23,497.62 万元**，占当期营业收入的比例分别为 27.16%、32.91%、22.78%**和 31.01%**。

2023-2025 年，公司应收账款余额占营业收入的比例整体有所下降。2024 年末，公司应收账款余额及应收账款余额占营业收入比例均较高，主要系公司与客户 A 合作持续加深，其 2024 年下半年测试需求增长，年末存在较大金额的应收账款，从而导致该年度公司应收账款余额及占营业收入的比例均较高。

2025 年四季度以来，随着客户 A 研发项目的持续推进，其材料分析需求有所减少，从而导致该客户 2025 年末的应收账款余额下降明显，进而导致公司 2025 年末应收账款余额较 2024 年末降低。

2026 年 6 月末，应收账款余额上升一方面系营业收入上涨，另一方面系客户回款有所延后所致。

整体来看，报告期内公司下游行业景气度较高，公司产品的市场需求旺盛，回款情况整体良好，公司也不断加强客户信用政策和应收账款管理，使得在营业收入保持较快增长速度的同时，应收账款规模整体得到有效控制。

②应收账款账龄分析

报告期各期末，公司应收账款的账龄及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	**23,021.77**	14,812.63	18,862.07	11,894.48
1-2 年	**298.63**	243.20	321.07	148.61
2-3 年	**146.53**	194.00	20.71	-
3 年以上	**30.68**	0.59	-	-
应收账款余额	**23,497.62**	**15,250.41**	**19,203.84**	**12,043.10**
减：坏账准备	**1,404.32**	945.41	1,134.73	609.59
应收账款净额	**22,093.30**	**14,305.01**	**18,069.11**	**11,433.51**

报告期各期末，公司 1 年以内的应收账款占比分别为 98.77%、98.22%、97.13%和 97.97%，应收账款账龄较短。公司主要客户多为知名半导体企业和上市公司等，主要客户的信用良好，应收账款质量较高。

③应收账款的坏账准备

报告期各期末，公司应收账款计提坏账准备情况如下：

单位：万元

2026 年 6 月 30 日				
项目	**账面余额**	**比例**	**坏账准备**	**账面价值**
单项计提预期信用损失的应收账款	**222.51**	**0.95%**	**222.51**	**-**
按组合计提预期信用损失的应收账款	**23,275.10**	**99.05%**	**1,181.80**	**22,093.30**
合计	**23,497.62**	**100.00%**	**1,404.31**	**22,093.30**
2025 年 12 月 31 日				
项目	**账面余额**	**比例**	**坏账准备**	**账面价值**
单项计提预期信用损失的应收账款	165.74	1.09%	165.74	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	15,084.68	98.91%	779.67	14,305.01
合计	**15,250.41**	**100.00%**	**945.41**	**14,305.01**
2024 年 12 月 31 日				
项目	**账面余额**	**比例**	**坏账准备**	**账面价值**
单项计提预期信用损失的应收账款	165.74	0.86%	165.74	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	19,038.10	99.14%	968.99	18,069.11
合计	**19,203.84**	**100.00%**	**1,134.73**	**18,069.11**

2023 年 12 月 31 日				
项目	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,043.10	100.00%	609.59	11,433.51
合计	**12,043.10**	**100.00%**	**609.59**	**11,433.51**

报告期各期末，公司应收账款坏账准备实际计提比例分别为 5.06%、5.91%、6.20%和 5.98%。报告期内，公司坏账计提比例略有提高，但总体保持相对稳定，主要是因为一方面公司加强应收账款管理，另一方面较好的市场行情亦使得大部分下游客户的付款相对良好。

报告期内，公司与同行业可比公司账龄组合的坏账准备计提比例对比如下：

账龄	胜科纳米	闳康	苏试试验	伟测科技	雍智科技	季丰电子
1 年以内	5%	注	5%	5%	注	5%
1 至 2 年	10%		15%	10%		10%
2 至 3 年	50%		40%	30%		50%
3 至 4 年	100%		60%	50%		100%
4 至 5 年	100%		80%	80%		100%
5 年以上	100%		100%	100%		100%

注：闳康和雍智科技坏账计提为按照款项是否逾期计算，逾期 180 天以上 100%计提。

与同行业可比公司相比，公司坏账计提比例更为谨慎。

④应收账款前五名情况

报告期各期末，公司应收账款余额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	2026 年 6 月 30 日			
	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
客户 A	非关联方	4,319.89	1 年以内	18.38%
矽品科技	非关联方	828.79	1 年以内	3.53%
上海晟矽微电子股份有限公司	非关联方	612.19	1 年以内	2.61%
紫光展锐（上海）科技股份有限公司	非关联方	531.72	1 年以内	2.26%
客户 0	非关联方	495.45	1 年以内	2.11%
合计	-	6,788.04	-	28.89%

单位名称	2025 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
客户 A	非关联方	1,012.22	1 年以内	6.64%
禾赛科技	非关联方	407.61	1 年以内	2.67%
苏试试验	非关联方	392.39	1 年以内	2.57%
浙江优祺自动控制技术有限公司	非关联方	377.40	1 年以内	2.47%
矽品科技	非关联方	355.96	1 年以内	2.33%
合计	-	**2,545.58**	-	**16.68%**
单位名称	**2024 年 12 月 31 日**			
	与本公司关系	**金额**	**账龄**	**占应收账款总额的比例**
客户 A	非关联方	4,975.39	1 年以内	25.91%
绍兴高新技术产业开发区开发建设有限公司	非关联方	1,203.79	1 年以内	6.27%
华测检测	非关联方	747.75	1 年以内	3.89%
苏试试验	非关联方	527.69	1 年以内	2.75%
矽品科技	非关联方	386.74	1 年以内	2.01%
合计	-	**7,841.36**	-	**40.83%**
单位名称	**2023 年 12 月 31 日**			
	与本公司关系	**金额**	**账龄**	**占应收账款总额的比例**
客户 C	非关联方	890.52	1 年以内	7.39%
苏试试验	非关联方	701.26	1 年以内	5.82%
华测检测	非关联方	628.01	1 年以内	5.21%
客户 G	非关联方	552.28	1 年以内	4.59%
客户 A	非关联方	536.66	1 年以内	4.46%
合计	-	**3,308.74**	-	**27.47%**

报告期各期末，公司应收账款前五大客户主要为客户 A、客户 C 等国内知名晶圆厂商，苏试试验等规模较大的半导体测试厂商，公司应收账款坏账风险较小；公司应收账款中不存在持有公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款。

（5）预付款项

①预付款项的账龄结构

报告期各期末，预付款项的账龄结构如下：

单位：万元

账龄	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	**510.51**	**76.10%**	359.45	98.83%	148.35	99.31%	311.83	90.11%
1-2 年	**159.22**	**23.74%**	3.24	0.89%	1.03	0.69%	34.10	9.85%
2-3 年	**0.08**	**0.01%**	1.03	0.28%	-	-	0.12	0.04%
3 年以上	**0.99**	**0.15%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
合计	**670.81**	**100.00%**	**363.72**	**100.00%**	**149.38**	**100.00%**	**346.06**	**100.00%**

报告期各期末，公司预付款项账面价值分别为 346.06 万元、149.38 万元、363.72 万元**和 670.81 万元**，占流动资产的比例分别为 0.75%、0.31%、0.78%**和 1.15%**，预付账款主要系预付货款和各类费用款项等。

②预付款项前五名情况

截至 **2026 年 6 月末**，公司预付款项余额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	占比	账龄	款项性质
上海钜蛟光电科技有限公司	**166.37**	**24.80%**	**1 年以内、1-2 年**	**货款**
太仓展飞半导体科技有限公司	**117.41**	**17.50%**	**1 年以内**	**货款**
南京轴芯科技有限公司	**101.65**	**15.15%**	**1 年以内**	**货款**
卡伦测控技术（无锡）有限公司	**47.50**	**7.08%**	**1 年以内**	**货款**
Smartech Innovation Service Co., Ltd.	**31.76**	**4.73%**	**1 年以内**	**货款**
合计	**464.69**	**69.27%**		

报告期各期末，公司不存在账龄超过 1 年且金额重大的预付款项，公司无预付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

（6）其他应收款

①其他应收款的构成情况

报告期各期末，公司其他应收款构成及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
押金保证金	**403.87**	408.16	415.60	333.65
员工借款	**145.62**	136.74	117.40	121.00

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收暂付款	**109.58**	44.31	65.91	16.78
其他应收款余额	**659.07**	**589.21**	**598.90**	**471.44**
减：坏账准备	**293.62**	274.17	212.89	89.79
其他应收款账面价值	**365.45**	**315.04**	**386.01**	**381.64**

报告期各期末，公司其他应收款余额分别为 471.44 万元、598.90 万元、589.21 万元**和 659.07 万元**，主要系押金保证金、员工借款等。

②其他应收款的坏账计提

报告期各期末，公司其他应收款计提坏账准备情况如下：

单位：万元

2026 年 6 月 30 日				
项目	**账面余额**	**计提比例**	**坏账准备**	**账面价值**
单项计提预期信用损失的其他应收款	**-**	**-**	**-**	**-**
按组合计提预期信用损失的其他应收款	**659.07**	**44.55%**	**293.62**	**365.45**
小计	**659.07**	**44.55%**	**293.62**	**365.45**
2025 年 12 月 31 日				
项目	**账面余额**	**计提比例**	**坏账准备**	**账面价值**
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	589.21	46.53%	274.17	315.04
小计	**589.21**	**46.53%**	**274.17**	**315.04**
2024 年 12 月 31 日				
项目	**账面余额**	**计提比例**	**坏账准备**	**账面价值**
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	598.90	35.55%	212.89	386.01
小计	**598.90**	**35.55%**	**212.89**	**386.01**
2023 年 12 月 31 日				
项目	**账面余额**	**计提比例**	**坏账准备**	**账面价值**
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	471.44	19.05%	89.79	381.64

小计	471.44	19.05%	89.79	381.64

④ 其他应收款前五名情况

截至 2026 年 6 月末，公司其他应收款余额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例
上海神彩印业有限公司	非关联方	押金保证金	71.59	3 年以上	10.86%
上海莘光实业有限公司	非关联方	押金保证金	70.00	3 年以上	10.62%
深圳市通产科技发展有限公司	非关联方	押金保证金	49.73	1 年以内，1-3 年，3 年以上	7.55%
华润深国投信托有限公司	非关联方	押金保证金	40.00	1 年以内	6.07%
周天飞	非关联方	员工借款、应收暂付款	24.00	1 年以内	3.64%
合计	-	-	255.33	-	38.74%

截至报告期末，公司前五名其他应收款的款项内容主要为公司及各子公司生产经营租赁房屋的押金保证金，公司按照账龄组合对上述款项计提坏账准备。

（7）存货

①存货构成与变动

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日			2025 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面金额	账面余额	跌价准备	账面金额
原材料	5,157.33	729.26	4,428.06	4,110.92	843.48	3,267.44
生产成本	913.56	-	913.56	295.54	-	295.54
库存商品	1,473.87	159.66	1,314.20	1,091.76	184.66	907.11
周转材料	71.21	-	71.21	37.75	-	37.75
委托加工物资	17.48	-	17.48	9.21	-	9.21
合同履约成本	4,148.01	490.88	3,657.13	3,493.38	446.59	3,046.79
发出商品	2,342.98	167.60	2,175.39	3,527.26	302.69	3,224.56
合计	14,124.43	1,547.40	12,577.03	12,565.83	1,777.43	10,788.41

项目	2024 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面金额	账面余额	跌价准备	账面金额
原材料	3,153.50	803.56	2,349.94	2,662.54	95.12	2,567.42
生产成本	707.05	-	707.05	592.82	-	592.82
库存商品	675.77	118.16	557.60	911.25	37.21	874.04
周转材料	3.87	-	3.87	5.60	-	5.60
委托加工物资	4.14	-	4.14	19.25	-	19.25
合同履约成本	2,402.18	187.26	2,214.92	1,856.03	278.30	1,577.73
发出商品	1,888.21	41.36	1,846.85	1,839.58	15.85	1,823.73
合计	**8,834.72**	**1,150.34**	**7,684.38**	**7,887.06**	**426.48**	**7,460.58**

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 7,460.58 万元、7,684.38 万元、10,788.41 万元**和 12,577.03 万元**，占流动资产的比例分别为 16.21%、15.76%、23.01%**和 21.62%**，公司存货主要由原材料、合同履约成本和发出商品构成。

其中，原材料主要为公司生产集成电路测试板等检测硬件产品所需材料；发出商品主要为已发送给客户但客户尚未完成验收的集成电路测试板等检测硬件产品；合同履约成本方面，由于公司单个案件金额较低、客户检测需求频次较高，在期末时点，公司存在已完成测试但尚未结案的案件的情形，公司将该类案件的成本归入合同履约成本核算。

2025 年末，公司存货较 2024 年末增长 40.39%，主要系随着公司业务规模的增长，一方面公司加大了集成电路测试板等检测硬件产品所需材料的采购力度；另一方面，公司硬件及设备类产品送达客户后，需经客户测试完成后方可验收；此外，公司检测分析服务完成后，通常采用按月对账结算模式，即于次月月初向客户发送上月实验室汇总的数量及金额账单，经双方核对确认、案件结案后确认收入。上述业务模式导致公司发出商品、合同履约成本等余额较高且随着公司业务规模增长亦有明显增加。报告期内，公司不存在存货余额异常增长或存货结构异常变动的情况。

2026 年 1-6 月，公司各业务板块收入均实现同比增长；截至 2026 年 6 月 30 日，在手订单规模较上年末进一步提升。伴随业务规模扩张，原材料、库存商品、合同履约成本及发出商品等主要存货项目随之出现不同程度增长。

②存货跌价准备

报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为 426.48 万元、1,150.34 万元、1,777.43 万元**以及 1,547.40 万元**，占各期期末存货账面余额的比例分别为 5.41%、13.02%、14.14%**以及 10.96%**。报告期内公司存货跌价准备具体情况如下：

单位：万元

存货跌价	2023 年期初余额	本期计提	本期转回	本期转销	2023 年期末余额
原材料	39.77	55.36	-	0.01	95.12
库存商品	31.72	11.18	-	5.69	37.21
发出商品	19.57	15.85	-	19.57	15.85
合同履约成本	99.79	278.30		99.79	278.30
合计	**190.85**	**360.69**		**125.06**	**426.48**
存货跌价	**2024 年期初余额**	**本期计提**	**本期转回**	**本期转销**	**2024 年期末余额**
原材料	95.12	772.82	-	64.38	803.56
库存商品	37.21	99.47	-	18.52	118.16
发出商品	15.85	48.38	-	22.87	41.36
合同履约成本	278.30	180.24	-	271.28	187.26
合计	**426.48**	**1,100.90**	**-**	**377.05**	**1,150.34**
存货跌价	**2025 年期初余额**	**本期计提**	**本期转回**	**本期转销**	**2025 年期末余额**
原材料	803.56	226.05	-	186.13	843.48
库存商品	118.16	142.44	-	75.95	184.66
发出商品	41.36	305.79	-	44.46	302.69
合同履约成本	187.26	446.59	-	187.26	446.59
合计	**1,150.34**	**1,120.88**	**-**	**493.79**	**1,777.43**
存货跌价	**2026 年期初余额**	**本期计提**	**本期转回**	**本期转销**	**2026 年 6 月末余额**
原材料	**843.48**	**17.09**	**-**	**131.31**	**729.26**
库存商品	**184.66**	**20.64**	**-**	**45.63**	**159.66**
发出商品	**302.69**	**99.39**	**-**	**234.49**	**167.60**
合同履约成本	**446.59**	**253.25**	**-**	**208.96**	**490.88**
合计	**1,777.43**	**390.38**	**-**	**620.40**	**1,547.40**

公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，存货跌价计提充分。

报告期内，公司与可比公司存货跌价计提比例的比较情况如下：

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
胜科纳米	**3.15%**	2.75%	0.90%	0.15%
伟测科技	**-**	-	-	-
苏试试验	**1.16%**	1.15%	0.34%	0.04%
闳康	**未披露**	未披露	未披露	未披露
雍智科技	**未披露**	未披露	未披露	未披露
平均值	**2.15%**	**1.95%**	**0.62%**	**0.10%**
季丰电子	**10.96%**	14.14%	13.02%	5.41%

注：可比公司数据来源于 Wind 资讯。

报告期内，公司结合存货特点、市场价格、未来使用方式确定存在减值迹象的存货的可变现净值，并计提存货跌价准备，公司存货跌价计提比例高于可比公司平均值，主要系公司与可比公司业务模式存在差异所致。

报告期内，同行业可比公司中胜科纳米、苏试试验明确披露了存货跌价准备余额数据，公司存货跌价比例明显高于上述可比公司。

其中胜科纳米从事半导体第三方实验室检测业务，其存货由原材料和已完工未结算成本构成；苏试试验除从事集成电路第三方检测服务外，还致力于环境试验设备的研发和生产；该两家可比公司的存货跌价比例均相对较低。

公司的测试业务方面，量产测试服务为公司投入开拓中的业务，该业务收入高速增长但处于亏损状态，由此导致该类测试业务形成的合同履约成本跌价准备金额较高。

公司与单纯从事第三方实验室或量产测试业务的可比公司相比，存在较多硬件业务形成的原材料、在产品、库存商品等。硬件业务方面的存货跌价主要来自于集成电路测试板业务，公司向客户提供集成电路测试板等产品的过程中，为应对预期之外的产品毁损或不合格情况、保证客户订单的准时交付，存在进行测试板额外备货的情形，额外备货的测试板属于客户定制产品一般无法再行销售给其他客户，因此导致公司存货跌价比例较高。

综上，公司存货跌价计提比例与同行业可比公司存在较大差异，系由业务结构不同所导致，跌价计提比例差异较大具有合理性。

（8）持有待售资产

2025 年末，公司持有待售资产金额为 753.32 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待出售设备	844.43	91.11	753.32	-	-	-	-	-	-
合计	**844.43**	**91.11**	**753.32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

2025 年 7 月公司与南通山口动能科技有限公司就公司拥有的某透射电子显微镜签订合同，将上述设备出售予该公司。截至 2025 年 12 月 31 日，上述设备出售尚未完成，故公司将该设备转入持有待售设备核算，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。**截至 2026 年 6 月 30 日，上述设备已完成出售。**

（9）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产账面价值分别为 3,863.58 万元、5,623.68 万元、8,093.29 万元**和 10,139.38 万元**，占流动资产的比例分别为 8.40%、11.53%、17.26%**和 17.43%**，主要系待认证、待抵扣进项税，报告期内由于公司设备购置规模较高，产生的待抵扣及待认证增值税进项税额较多，因此导致公司其他流动资产金额较高。公司其他流动资产具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
待抵扣及待认证增值税进项税额	**8,594.99**	7,057.26	5,245.14	3,712.77
其他摊销费用	**785.57**	643.19	364.79	149.39
预缴企业所得税	**448.36**	392.84	13.75	1.42
预付上市费用	**310.47**	-	-	-
合计	**10,139.38**	**8,093.29**	**5,623.68**	**3,863.58**

2、非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	**895.06**	**0.63%**	903.24	0.72%	1,034.13	0.98%	141.34	0.16%
其他非流动金融资产	**886.87**	**0.63%**	1,950.49	1.55%	1,513.90	1.43%	794.07	0.91%
固定资产	**103,738.92**	**73.26%**	86,757.94	68.96%	73,408.28	69.54%	58,378.45	67.09%
在建工程	**11,530.73**	**8.14%**	12,043.92	9.57%	12,463.53	11.81%	7,877.92	9.05%
使用权资产	**7,956.14**	**5.62%**	7,733.63	6.15%	8,749.90	8.29%	9,488.62	10.90%
无形资产	**8,520.17**	**6.02%**	8,499.86	6.76%	532.01	0.50%	282.08	0.32%
商誉	**208.54**	**0.15%**	208.54	0.17%	208.54	0.20%	208.54	0.24%
长期待摊费用	**4,100.19**	**2.90%**	4,947.22	3.93%	6,849.11	6.49%	6,208.63	7.13%
递延所得税资产	**749.61**	**0.53%**	657.07	0.52%	541.73	0.51%	405.09	0.47%
其他非流动资产	**3,015.87**	**2.13%**	2,106.44	1.67%	254.73	0.24%	3,235.40	3.72%
合计	**141,602.10**	**100.00%**	**125,808.34**	**100.00%**	**105,555.85**	**100.00%**	**87,020.14**	**100.00%**

报告期各期末，公司非流动资产主要为固定资产、在建工程和使用权资产，合计占非流动资产的比例在 80%以上。

公司主要非流动资产项目具体分析如下：

（1）长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资为对联营企业的投资，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
普锍电子	**202.29**	177.39	169.99	141.34
四川数智	**692.77**	725.85	864.14	-
合计	**895.06**	**903.24**	**1,034.13**	**141.34**

报告期各期末，公司长期股权投资账面价值分别为 141.34 万元、1,034.13 万元、903.24 万元**和 895.06 万元**，占非流动资产的比例分别为 0.16%、0.98%、0.72%**和 0.63%**，系对联营企业普锍电子、四川数智的投资，其中公司对上述企业的投资情况如下所示：

单位：万元

序号	名称	公司持股比例	公司出资金额	入股时间	主要业务
1	普锍电子	10.00%	80.00	2015 年 3 月 4 日	半导体测试探针卡的

序号	名称	公司持股比例	公司出资金额	入股时间	主要业务
					加工、组装及销售
2	四川数智	13.00%	1,300.00	2024 年 9 月 18 日	传感器检验检测服务

（2）其他非流动金融资产

报告期各期末，公司其他非流动金融资产为公司对股权投资基金进行的投资，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	**886.87**	1,950.49	1,513.90	794.07
合计	**886.87**	**1,950.49**	**1,513.90**	**794.07**

报告期各期末，公司其他非流动金融资产主要系对君丰桐芯的投资，公司于 2021 年 6 月投资该基金，作为有限合伙人，不执行合伙事务，在该企业中的份额比例为 9.25%。

君丰桐芯系君桐资本旗下的基金，君桐资本是一家在半导体产业内较为知名且活跃的投资机构，该机构管理的基金已在多个半导体细分领域完成投资，发行人投资其管理的君丰桐芯基金主要为了拓展半导体相关企业的协同联系、增加潜在的合作机会。

2026 年 6 月 30 日，其他非流动金融资产余额减少主要系当期收到君丰桐芯的投资收益并收回部分投资本金所致。

（3）固定资产

①固定资产构成与变动

报告期各期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	**144,515.39**	**120,799.84**	**95,270.71**	**70,756.46**
专用设备	**142,590.20**	118,859.35	93,573.20	69,359.29
运输工具	**320.45**	340.23	318.20	261.18

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
其他设备	**1,604.74**	1,600.25	1,379.31	1,135.99
二、累计折旧合计	**40,776.47**	**34,041.90**	**21,862.43**	**12,378.01**
专用设备	**39,399.34**	32,789.02	20,879.35	11,717.68
运输工具	**193.90**	237.26	190.82	128.55
其他设备	**1,183.23**	1,015.62	792.26	531.77
三、减值准备合计	**-**	-	-	-
专用设备	**-**	-	-	-
运输工具	**-**	-	-	-
其他设备	**-**	-	-	-
四、账面价值合计	**103,738.92**	**86,757.94**	**73,408.28**	**58,378.45**
专用设备	**103,190.85**	86,070.33	72,693.85	57,641.61
运输工具	**126.55**	102.97	127.38	132.63
其他设备	**421.51**	584.63	587.05	604.22
设备成新率	**71.78%**	**71.82%**	**77.05%**	**82.51%**

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 58,378.45 万元、73,408.28 万元、86,757.94 万元**和 103,738.92 万元**，占非流动资产的比例分别为 67.09%、69.54%、68.96%**和 73.26%**。公司固定资产主要系芯片检测分析和硬件生产所用的各类专用设备等。报告期内，公司固定资产增加较多，主要系随着业务规模提升，公司设备投入增加。

报告期各期末，公司固定资产主要为各类检测分析和生产设备，该等设备的整体运行情况良好，设备成新率分别为 82.51%、77.05%、71.82%**和 71.78%**，不存在减值迹象。

②固定资产折旧政策

公司与同行业可比公司均采用年限平均法对固定资产计提折旧，同行业可比上市公司与发行人的固定资产折旧政策对比如下：

单位：年

公司名称	类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）
胜科纳米	机器设备	年限平均法	3-10	-
	运输设备	年限平均法	3-5	-
	电子设备及其他	年限平均法	3-7	-

公司名称	类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）
伟测科技	房屋建筑物	年限平均法	20	-
	专用设备	年限平均法	5-10	-
	办公设备	年限平均法	2-5	-
苏试试验	房屋建筑物	年限平均法	20	5
	机器设备	年限平均法	10	5
	电子设备	年限平均法	3	5
	运输设备	年限平均法	4	5
	办公及其他设备	年限平均法	5	5
闳康	机器设备	年限平均法	3-5	-
	运输设备	年限平均法	5	-
	生财器具	年限平均法	2-5	-
	租赁改良	年限平均法	2-5	-
雍智科技	厂房建筑物	年限平均法	50	-
	厂房附属设施	年限平均法	10-20	-
	机器设备	年限平均法	1-9	-
	办公设备	年限平均法	1-5	-
	运输设备	年限平均法	5	-
	其他设备	年限平均法	3	-
季丰电子	专用设备	年限平均法	5-10	5
	运输工具	年限平均法	3-5	5
	其他设备	年限平均法	3-5	5

注：同行业可比公司数据取自其定期报告。

由上表可见，公司的各类固定资产折旧年限与可比公司折旧年限不存在显著差异。

（4）在建工程

报告期各期末，公司在建工程构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
设备安装工程	**5,206.67**	10,772.66	12,382.06	7,494.39
浦东技术中心基建项目	**5,166.04**	863.43	21.84	-
软件	**399.59**	326.62	59.63	-

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
装修工程	**758.42**	81.21	-	383.52
合计	**11,530.73**	**12,043.92**	**12,463.53**	**7,877.92**

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 7,877.92 万元、12,463.53 万元、12,043.92 万元**和 11,530.73 万元**，占非流动资产的比例分别为 9.05%、11.81%、9.57%**和 8.14%**。

公司在建工程整体规模较大，主要系公司在报告期内购置的生产设备需要安装、调试、验收所致。2024 年末和 2025 年末，公司在建工程金额较 2023 年末增加较多，主要系公司业务规模扩张，需要投入的专用设备较多、部分设备在当年年末尚未完成验收转固所致。

报告期内，公司在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，各期转入固定资产的金额分别为 30,033.81 万元、24,252.43 万元、26,244.23 万元**和 24,204.27 万元**，主要系公司购置的需要安装的专用设备，设备在达到预定可使用状态时结转为固定资产，转固依据为设备验收单。

报告期内，公司在建工程不存在减值的情况。

（5）使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	**14,216.15**	**13,166.32**	**12,781.37**	**12,042.48**
房屋及建筑物	**13,446.48**	12,396.65	12,011.70	11,272.81
专用设备	**769.67**	769.67	769.67	769.67
二、累计折旧合计	**6,260.00**	**5,432.69**	**4,031.47**	**2,553.86**
房屋及建筑物	**5,721.24**	4,970.89	3,723.61	2,399.93
专用设备	**538.77**	461.80	307.87	153.93
三、账面价值合计	**7,956.14**	**7,733.63**	**8,749.90**	**9,488.62**
房屋及建筑物	**7,725.24**	7,425.76	8,288.10	8,872.88
专用设备	**230.90**	307.87	461.80	615.73

报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 9,488.62 万元、8,749.90 万

元、7,733.63 万元**和 7,956.14 万元**，占非流动资产的比例分别为 10.90%、8.29%、6.15%**和 5.62%**，包括公司租赁的房屋及建筑物、专用设备。

公司在上海、北京、深圳、成都等多地设有分子公司，各分子公司的生产、经营场所均系自外部出租方处租入，故报告期内公司使用权资产金额较高。

（6）无形资产

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	**9,757.62**	**9,476.49**	**1,098.94**	**594.36**
土地使用权	**8,142.07**	8,142.07	-	-
软件	**1,593.68**	1,312.55	1,082.37	577.79
专利使用权	**21.88**	21.88	16.57	16.57
二、累计摊销合计	**1,237.46**	**976.64**	**566.93**	**312.28**
土地使用权	**162.84**	81.42	-	-
软件	**1,056.72**	878.20	555.89	306.76
专利使用权	**17.90**	17.01	11.05	5.52
三、减值准备合计	**-**	-	-	-
土地使用权	**-**	-	-	-
软件	**-**		-	-
专利使用权	**-**	-	-	-
四、账面价值合计	**8,520.17**	**8,499.86**	**532.01**	**282.08**
土地使用权	**7,979.22**	8,060.65	-	-
软件	**536.96**	434.35	526.48	271.04
专利使用权	**3.98**	4.87	5.52	11.05

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 282.08 万元、532.01 万元、8,499.86 万元**和 8,520.17 万元**，占非流动资产的比例分别为 0.32%、0.50%、6.76%**和 6.02%**。

公司无形资产主要为土地使用权和软件，2025 年大幅增加主要系购置土地使用权，用于建设浦东技术中心。报告期内，公司无形资产不存在减值的情况。

（7）商誉

报告期各期末，公司商誉系收购季丰精密和化学分析测试业务所致，具体情

况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日			2025 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
季丰精密公司	1,018.26	1,018.26	-	1,018.26	1,018.26	-
化学分析测试业务	208.54	-	208.54	208.54	-	208.54
合计	1,226.80	1,018.26	208.54	1,226.80	1,018.26	208.54
项目	2024 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
季丰精密公司	1,018.26	1,018.26	-	1,018.26	1,018.26	-
化学分析测试业务	208.54	-	208.54	208.54	-	208.54
合计	1,226.80	1,018.26	208.54	1,226.80	1,018.26	208.54

2022 年 6 月，发行人收购上海针台半导体科技有限公司（后更名为季丰精密），此收购行为形成 1,018.26 万元商誉。收购后，季丰精密的经营情况不及预期。公司根据坤元资产评估有限公司就该等资产于 2023 年 12 月 31 日基准日的价值的评估结果，对季丰精密相关的商誉全额计提了减值准备。

2022 年 11 月，张江季丰（上海）检测技术有限公司（下称“张江季丰”）（季丰计量前身）与江苏赛夫特签订《资产收购合作协议》，张江季丰收购江苏赛夫特符合要求的全部检测检验业务对应的资产组，此收购行为形成 208.54 万元商誉。

（8）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 6,208.63 万元、6,849.11 万元、4,947.22 万元和 4,100.19 万元，占非流动资产的比例分别为 7.13%、6.49%、3.93%和 2.90%，公司长期待摊费用主要为各地分子公司租入的经营场所的装修费。

（9）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税资

	差异	资产	差异	产
资产减值准备	1,345.97	229.95	1,008.70	150.04
内部交易未实现利润	584.26	94.84	849.83	134.25
租赁负债	9,126.05	1,474.77	8,976.35	1,420.07
交易性金融工具公允价值变动	-	-	-	-
递延收益	2,571.59	314.70	2,804.83	344.85
与递延所得税负债互抵金额	-	-1,364.66	-	-1,392.14
合计	13,627.87	749.61	13,639.71	657.07

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	863.04	129.74	617.61	92.56
内部交易未实现利润	908.88	150.58	710.98	106.23
租赁负债	9,829.99	1,293.52	10,399.39	1,368.33
交易性金融工具公允价值变动	-	-	205.93	30.89
递延收益	2,192.14	244.01	1,559.61	143.94
与递延所得税负债互抵金额	-	-1,276.12	-	-1,336.87
合计	13,794.05	541.73	13,493.51	405.09

报告期各期末，公司递延所得税资产账面价值分别为 405.09 万元、541.73 万元、657.07 万元和 749.61 万元，主要系资产减值准备、租赁负债、内部交易未实现利润等原因形成的可抵扣暂时性差异。

（10）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产系购建各类设备的预付款项，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
预付设备款	3,015.87	2,106.44	254.73	3,235.40
合计	3,015.87	2,106.44	254.73	3,235.40

报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为 3,235.40 万元、254.73 万元、2,106.44 万元和 3,015.87 万元。2024 年末金额下降较多，主要系公司在

该年度采购的各类专用设备在年末多已到货，相应的预付设备款结转较多所致。

（二）负债分析

报告期各期末，公司负债情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	**70,545.50**	**66.60%**	56,341.96	67.70%	52,297.59	70.05%	33,073.59	55.55%
非流动负债	**35,384.62**	**33.40%**	26,883.63	32.30%	22,364.93	29.95%	26,469.27	44.45%
合计	**105,930.12**	**100.00%**	**83,225.58**	**100.00%**	**74,662.52**	**100.00%**	**59,542.86**	**100.00%**

报告期各期末，公司负债总额分别为 59,542.86 万元、74,662.52 万元、83,225.58 万元**和 105,930.12 万元**，负债总额的变动主要系由于应付账款、租赁负债和银行借款的波动所导致的。报告期内，公司负债以流动负债为主，随着公司业务规模提升，公司短期借款规模有所提高，从而导致流动负债占比有所提高。

1、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	**45,136.09**	**63.98%**	33,471.66	59.41%	34,382.07	65.74%	21,253.82	64.26%
应付账款	**11,070.52**	**15.69%**	7,420.40	13.17%	7,229.56	13.82%	5,216.67	15.77%
预收款项	**25.72**	**0.04%**	697.07	1.24%	43.57	0.08%	-	-
合同负债	**884.04**	**1.25%**	1,224.03	2.17%	121.28	0.23%	218.34	0.66%
应付职工薪酬	**2,454.60**	**3.48%**	3,802.62	6.75%	3,269.17	6.25%	2,593.90	7.84%
应交税费	**649.80**	**0.92%**	779.82	1.38%	1,319.06	2.52%	653.59	1.98%
其他应付款	**46.83**	**0.07%**	94.25	0.17%	102.73	0.20%	45.95	0.14%
一年内到期的非流动负债	**10,105.04**	**14.32%**	8,617.29	15.29%	5,730.23	10.96%	2,935.22	8.87%
其他流动负债	**172.87**	**0.25%**	234.82	0.42%	99.93	0.19%	156.09	0.47%
合计	**70,545.50**	**100.00%**	**56,341.96**	**100.00%**	**52,297.59**	**100.00%**	**33,073.59**	**100.00%**

报告期各期末，公司流动负债总额分别为 33,073.59 万元、52,297.59 万元、56,341.96 万元**和 70,545.50 万元**。公司流动负债主要由短期借款、应付账款、应付职工薪酬和一年内到期的非流动负债组成。

公司主要流动负债项目具体分析如下：

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
保证借款	**37,606.09**	22,024.76	24,845.47	19,844.62
信用借款	**7,530.00**	11,446.90	9,536.60	1,409.20
合计	**45,136.09**	**33,471.66**	**34,382.07**	**21,253.82**

报告期各期末，公司短期借款分别为 21,253.82 万元、34,382.07 万元、33,471.66 万元**和 45,136.09 万元**，占流动负债的比例分别为 64.26%、65.74%、59.41%**和 63.98%**。报告期内，由于公司经营规模扩张，日常经营周转所需资金增加，公司短期借款余额整体有所增长。

（2）应付账款

①应付账款的构成与变动

报告期各期末，公司应付账款按项目划分情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
货款	**5,831.65**	4,658.57	4,126.45	2,278.92
费用款	**116.42**	108.00	260.33	159.44
设备工程款	**5,122.45**	2,653.83	2,842.78	2,778.31
合计	**11,070.52**	**7,420.40**	**7,229.56**	**5,216.67**

报告期各期末，公司应付账款的账面余额分别为 5,216.67 万元、7,229.56 万元、7,420.40 万元**和 11,070.52 万元**，占流动负债的比例分别为 15.77%、13.82%、13.17%**和 15.69%**。公司应付账款主要为应付货款和应付设备工程款，报告期内随着公司经营规模的扩大，公司对供应商的应付货款规模逐步增长；加之公司近年来新增各类检测分析和生产设备较多，应付设备工程款规模亦有所提高，两方面因素综合导致报告期内公司应付账款规模有所提升。

②应付账款前五名情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司应付账款余额前五名情况如下：

单位：万元

公司名称	账面余额	占比	款项性质
THERMO FISHER ELECTRONIC TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT (SHANGHAI)CO.LTD	1,183.34	10.69%	设备工程款
浙江联仓建设集团有限公司	1,094.21	9.88%	设备工程款
广州兴森快捷电路科技有限公司	523.64	4.73%	货款
绅克半导体科技（苏州）有限公司	463.90	4.19%	设备工程款
天津金海通半导体设备股份有限公司	413.02	3.73%	设备工程款
合计	3,678.11	33.22%	-

（3）预收款项/合同负债

报告期各期末，公司预收款项/合同负债的情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
租金	25.72	24.25	43.57	-
预收出售固定资产款项	-	672.82	-	-
商品服务等收入款项	884.04	1,224.03	121.28	218.34
合计	909.76	1,921.09	164.84	218.34

报告期各期末，公司预收款项/合同负债账面余额分别为 218.34 万元、164.84 万元、1,921.09 万元和 909.76 万元，主要为预收货款。

（4）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
短期薪酬	2,258.25	3,599.32	3,119.82	2,453.87
离职后福利-设定提存计划	184.11	172.72	149.35	140.03
辞退福利	12.24	30.59	-	-
合计	2,454.60	3,802.62	3,269.17	2,593.90

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 2,593.90 万元、3,269.17 万元、3,802.62 万元和 2,454.60 万元，占流动负债的比例分别为 7.84%、6.25%、6.75%和 3.48%，主要系已计提但尚未发放的工资、奖金等，短期薪酬明细情况如下所示：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2026 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	**3,442.50**	**10,108.54**	**11,460.41**	**2,090.63**
职工福利费	**-**	**389.48**	**389.48**	**-**
社会保险费	**96.15**	**610.30**	**603.02**	**103.43**
其中：医疗保险费	**92.46**	**585.39**	**578.64**	**99.21**
工伤保险费	**3.69**	**24.91**	**24.38**	**4.22**
住房公积金	**60.66**	**467.96**	**464.44**	**64.18**
工会经费和职工教育经费	**-**	**1.30**	**1.30**	**-**
合计	**3,599.32**	**11,577.58**	**12,918.64**	**2,258.25**
项目	**2024 年 12 月 31 日**	**本期增加**	**本期减少**	**2025 年 12 月 31 日**
工资、奖金、津贴和补贴	2,981.45	18,944.02	18,482.97	3,442.50
职工福利费	-	783.58	783.58	-
社会保险费	82.13	1,104.83	1,090.81	96.15
其中：医疗保险费	79.47	1,061.93	1,048.94	92.46
工伤保险费	2.66	42.89	41.86	3.69
住房公积金	56.24	844.23	839.81	60.66
工会经费和职工教育经费	-	16.56	16.56	-
合计	**3,119.82**	**21,693.23**	**21,213.73**	**3,599.32**
项目	**2023 年 12 月 31 日**	**本期增加**	**本期减少**	**2024 年 12 月 31 日**
工资、奖金、津贴和补贴	2,322.55	16,454.88	15,795.98	2,981.45
职工福利费	-	590.03	590.03	-
社会保险费	80.55	967.29	965.71	82.13
其中：医疗保险费	78.78	939.87	939.18	79.47
工伤保险费	1.77	27.42	26.53	2.66
住房公积金	50.78	747.05	741.58	56.24
工会经费和职工教育经费	-	9.62	9.62	-
合计	**2,453.87**	**18,768.87**	**18,102.92**	**3,119.82**
项目	**2022 年 12 月 31 日**	**本期增加**	**本期减少**	**2023 年 12 月 31 日**
工资、奖金、津贴和补贴	2,160.62	13,116.45	12,954.52	2,322.55
职工福利费	-	566.64	566.64	-
社会保险费	207.18	855.69	982.32	80.55
其中：医疗保险费	205.64	836.11	962.97	78.78

工伤保险费	1.54	19.58	19.35	1.77
住房公积金	39.07	621.35	609.64	50.78
工会经费和职工教育经费	-	3.99	3.99	-
合计	**2,406.87**	**15,164.13**	**15,117.12**	**2,453.87**

（5）应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
企业所得税	**613.57**	757.50	1,287.93	527.41
印花税	**20.86**	20.62	22.86	25.54
增值税	**6.05**	0.96	0.72	4.16
城市维护建设税	**4.35**	0.04	0.90	0.39
教育费附加	**2.57**	0.02	0.54	0.21
地方教育附加	**1.71**	0.01	0.36	0.14
土地使用税	**0.67**	0.67	-	-
代扣代缴个人所得税	**-**	-	5.74	95.74
合计	**649.80**	**779.82**	**1,319.06**	**653.59**

报告期各期末，公司应交税费账面价值分别为 653.59 万元、1,319.06 万元、779.82 万元**和 649.80 万元**，占流动负债的比例分别为 1.98%、2.52%、1.38%**和 0.92%**。公司应交税费主要系应交企业所得税。2024 年末，公司应交税费余额较 2023 年末有所增长，主要系随着公司业务规模和经营能力提升，应交企业所得税在该年度有所增长。

（6）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付暂收款	**20.67**	74.28	72.78	20.09
经营性费用类款项	**25.09**	19.56	29.95	25.87
押金保证金	**1.06**	0.40	-	-
合计	**46.83**	**94.25**	**102.73**	**45.95**

报告期各期末，公司其他应付款账面价值分别为 45.95 万元、102.73 万元、

94.25 万元**和 46.83 万元**，整体金额较小，主要系人才奖励、社保等应付款项。

（7）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债包括一年内到期的长期借款和一年内到期的租赁负债，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	**8,391.87**	7,263.17	4,404.11	1,699.95
一年内到期的租赁负债	**1,513.17**	1,354.12	1,326.12	1,235.27
一年内到期的长期应付款	**200.00**	**-**	**-**	**-**
合计	**10,105.04**	**8,617.29**	**5,730.23**	**2,935.22**

报告期内，随着公司业务规模的增长，公司长期借款、租入的使用权资产增加，相应地公司一年内到期的长期借款和租赁负债也有所增长。

（8）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债主要系预收货款对应的待转销项税，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
待转销项税	**96.29**	147.03	10.36	17.11
预提费用	**25.75**	54.18	49.60	47.59
已背书未终止确认的应收票据	**50.83**	33.61	39.97	91.39
合计	**172.87**	**234.82**	**99.93**	**156.09**

2、非流动负债分析

报告期各期末，公司非流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	**24,919.28**	**70.42%**	15,883.26	59.08%	10,659.95	47.66%	15,242.17	57.58%
长期应付款	**-**	**-**	200.00	0.74%	200.00	0.89%	200.00	0.76%
租赁负债	**7,538.51**	**21.30%**	7,499.08	27.89%	8,462.80	37.84%	9,142.57	34.54%

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
递延收益	**2,926.83**	**8.27%**	3,301.28	12.28%	3,042.18	13.60%	1,884.53	7.12%
合计	**35,384.62**	**100.00%**	**26,883.63**	**100.00%**	**22,364.93**	**100.00%**	**26,469.27**	**100.00%**

报告期各期末，公司非流动负债分别为 26,469.27 万元、22,364.93 万元、26,883.63 万元**和 35,384.62 万元**，总体金额有所增长，主要系随着公司业务规模提升，公司近年来投资力度较大，为满足资金需求借入的长期借款持续增长所致。

公司主要非流动负债项目具体分析如下：

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
保证/抵押借款	**24,919.28**	15,883.26	10,659.95	14,540.90
信用借款	**-**	-	-	701.27
合计	**24,919.28**	**15,883.26**	**10,659.95**	**15,242.17**

报告期各期末，公司长期借款账面价值分别为 15,242.17 万元、10,659.95 万元、15,883.26 万元**和 24,919.28 万元**，占非流动负债的比例分别为 57.58%、47.66%、59.08%**和 70.42%**。报告期内，公司保证/抵押借款规模较高，主要系随着公司业务、资产规模扩张，公司所需资金量较大，存在各类银行借款所致。

（2）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
租赁付款额	**9,890.02**	9,945.83	11,267.84	12,316.32
未确认融资费用	**-2,351.50**	-2,446.75	-2,805.04	-3,173.75
合计	**7,538.51**	**7,499.08**	**8,462.80**	**9,142.57**

报告期各期末，公司租赁负债账面价值分别为 9,142.57 万元、8,462.80 万元、7,499.08 万元**和 7,538.51 万元**，占非流动负债的比例分别为 34.54%、37.84%、

27.89%和 21.30%，主要系公司为满足经营需求，在上海、北京、深圳、成都等地租入办公、生产等经营用房所形成的。

（3）递延收益

报告期各期末，公司递延收益均为与资产相关的政府补助，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
政府补助	**2,926.83**	3,301.28	3,042.18	1,884.53
合计	**2,926.83**	**3,301.28**	**3,042.18**	**1,884.53**

（三）股东权益分析

报告期内，公司股东权益情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
股本	**11,558.60**	11,558.60	11,558.60	11,558.60
资本公积	**56,310.90**	55,959.71	55,260.74	54,539.77
其他综合收益	**16.32**	18.47	20.13	18.99
盈余公积	**2,025.35**	2,025.35	1,462.83	733.11
未分配利润	**23,926.66**	19,910.82	11,347.79	6,639.97
合计	**93,837.82**	**89,472.96**	**79,650.10**	**73,490.44**

报告期内，公司股东权益的变动主要与各期实现的净利润有关。

报告期内，公司未分配利润变动的具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
期初未分配利润	**19,910.82**	11,347.79	6,639.97	4,799.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	**4,015.83**	9,125.55	5,437.55	2,338.67
减：提取法定盈余公积	**-**	562.52	729.72	498.16
期末未分配利润	**23,926.66**	19,910.82	11,347.79	6,639.97

九、偿债能力、流动性与持续经营能力

（一）偿债能力分析

1、主要偿债能力指标及变动分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
流动比率（倍）	**0.82**	0.83	0.93	1.39
速动比率（倍）	**0.50**	0.50	0.68	1.05
资产负债率（母公司）	**50.04%**	46.08%	40.91%	37.40%
资产负债率	**53.03%**	48.19%	48.38%	44.76%
息税折旧摊销前利润（万元）	**15,215.94**	28,431.93	21,702.07	14,340.93
利息保障倍数（倍）	**5.75**	6.02	4.26	2.39

注 1：流动比率=流动资产/流动负债。
注 2：速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债。
注 3：息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧+摊销总额。
注 4：利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息支出。

报告期内，公司流动比率、速动比率有所降低，资产负债率有所上升，主要系公司近年来为顺应客户检测需求，购置专业设备加大对外投资导致银行贷款规模增加，具体情况如下：

近年来，在中国大陆，半导体第三方实验室行业是伴随本土产业链的成熟而逐步发展起来的。早期的高端市场需求主要由国际领先检测机构（如 SGS、Eurofins、闳康、宜特等）以及部分国家级、国有科研院所的检测平台来满足，本土商业化的第三方检测能力相对薄弱。随着国内半导体产业在政策扶持下进入高速发展期，尤其是设计公司数量激增和制造产能大幅扩张，对本地化、快速响应、成本可控的检测分析需求变得极为迫切。

在此背景下，一批本土第三方实验室（如季丰电子、胜科纳米等）逐渐兴起，从最初提供基础的失效分析、可靠性测试，逐步发展到能够覆盖材料表征、工艺监控、可靠性认证、芯片拆解与逆向分析等全流程服务。近年来，在供应链安全、国产化替代与技术创新的双重驱动下，该行业正朝着更专业化、规模化、平台化的方向加速发展，已成为支撑中国半导体产业实现自主可控与质量提升的重要技

术基石。

因此，为了更加贴近国内集成电路主流市场，缩短终端客户的服务半径，公司已经在北京、上海、深圳、成都等地设立子公司，并在上海筹建研发中心，旨在为长三角和北京等地区客户提供更加便捷的服务，及时响应客户需求，增强客户粘性。

此外，公司还积极布局规模量产业务，在量产测试及 EMS 等业务板块持续加大设备投入，以上方面均要求公司加大对外投资，购置专业化设备以满足客户的检验、检测需求，而作为非上市公司的季丰电子目前主要依靠经营积累和银行借款来满足自身业务发展需求，大量的借款导致公司资产负债率水平有所增长。

此外，**2023-2025 年，**公司息税折旧摊销前利润总体上保持增长，利息保障倍数持续提升。

综上，公司主要偿债能力指标良好，偿债能力不存在重大不确定性。

2、与同行业可比公司偿债能力的对比分析

报告期内，公司与同行业可比公司偿债能力指标的比较如下：

公司	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
（1）流动比率				
胜科纳米	**1.20**	1.16	0.84	1.3
伟测科技	**0.98**	1.00	1.32	1.63
苏试试验	**1.68**	1.65	1.8	1.86
闳康	**2.52**	1.66	1.55	1.95
雍智科技	**3.08**	3.84	4.24	5.96
平均值	**1.89**	**1.86**	**1.95**	**2.54**
季丰电子	**0.82**	**0.83**	**0.93**	**1.39**
（2）速动比率				
胜科纳米	**0.92**	0.83	0.69	1.12
伟测科技	**0.59**	0.66	1.00	1.34
苏试试验	**1.41**	1.43	1.51	1.59
闳康	**2.39**	1.55	1.51	1.89
雍智科技	**2.35**	3.83	4.22	5.61

平均值	**1.53**	**1.66**	**1.79**	**2.31**
季丰电子	**0.50**	**0.50**	**0.68**	**1.05**
（3）资产负债率				
胜科纳米	**57.52%**	54.99%	59.39%	56.79%
伟测科技	**55.19%**	61.59%	46.76%	31.86%
苏试试验	**39.54%**	40.68%	38.21%	38.68%
闳康	**39.30%**	44.72%	43.09%	40.05%
雍智科技	**25.08%**	19.41%	16.79%	13.87%
平均值	**43.33%**	**44.28%**	**40.85%**	**36.25%**
季丰电子	**53.03%**	**48.19%**	**48.38%**	**44.76%**

注 1：可比公司数据来源于 Wind 资讯。
注 2：流动比率=流动资产/流动负债。
注 3：速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债。
注 4：资产负债率=负债总额/资产总额。

流动比率和速动比率方面，由于各公司在业务模式、产品类别、财务管理策略等方面的差异，相关指标差异较大。总体来说报告期内公司流动比率、速动比率、资产负债率等指标与胜科纳米、伟测科技等同行业 A 股可比公司平均水平较为接近。

公司近年来规划 IPO 进程，2023 年存在一定规模的股权融资导致资产负债率水平相对较低；2024 年和 2025 年公司持续加大固定资产投资力度，各年投资活动流出资金较多，从而导致流动比率和速动比率均有所降低，低于同行业可比公司平均水平。

（二）资产运营能力分析

1、资产运营能力指标及变动分析

报告期内，公司资产运营能力指标如下：

财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次/年）	**3.91**	3.89	3.73	3.47
存货周转率（次/年）	**3.78**	4.03	4.37	3.82

注 1：应收账款周转率=营业收入×2/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）。
注 2：存货周转率=营业成本×2/（期初存货余额+期末存货余额）。
注 3：2026 年 1-6 月数据经年化。

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 3.47、3.73、3.89 和 3.91，应收账

款周转速度较快且有所增长。报告期内，公司不断优化客户信用管理及货款催收管理，在营业收入保持较快增长的同时，应收账款规模能够得到控制，应收账款周转率保持在较高水平。

报告期各期，公司存货周转率分别为 3.82、4.37、4.03 和 3.78，存货周转速度较快。报告期内，公司产品市场需求旺盛，销售情况良好，能够始终保持相对较高的存货周转速度。

2、与同行业可比公司资产运营能力的对比分析

（1）应收账款周转率

报告期内，公司与同行业可比公司的应收账款周转率如下：

单位：次/年

公司	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
胜科纳米	**3.28**	4.05	4.36	4.94
伟测科技	**3.68**	3.40	3.09	2.59
苏试试验	**1.29**	1.48	1.49	1.94
闳康	**3.41**	**3.69**	**3.87**	**3.76**
雍智科技	**6.47**	**7.11**	**5.39**	**5.58**
平均值	**3.63**	**3.95**	**3.64**	**3.76**
季丰电子	**3.91**	**3.89**	**3.73**	**3.47**

注：可比公司数据来源于 Wind 资讯，**2026 年 1-6 月数据经年化**。

与同行业可比公司相比，**公司应收账款周转率与同行业可比公司平均水平接近**。报告期内，公司应收账款周转率有所上升，主要原因系近年来，国内半导体产业处于快速发展阶段，面对下游半导体客户旺盛的检测分析需求，公司既持续加强新客户开拓力度，又不断深入与老客户的合作；在良好的合作关系下，加之公司主要客户信用情况均较为良好，公司应收账款整体回款情况良好，应收账款周转率在报告期内有所提升。

（2）存货周转率

报告期内，公司与同行业可比公司的存货周转率如下：

单位：次/年

公司	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
胜科纳米	**7.84**	8.82	10.08	8.68

公司	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
伟测科技	**55.93**	65.38	89.16	91.08
苏试试验	**3.16**	3.48	3.13	3.14
闳康	**不适用**	不适用	不适用	不适用
雍智科技	**2.08**	**2.14**	**1.93**	**1.53**
平均值	**17.25**	**19.96**	**26.08**	**26.11**
平均值（扣除伟测科技和闳康后）	**4.36**	**4.81**	**5.05**	**4.45**
季丰电子	**3.78**	4.03	4.37	3.82

注 1：可比公司数据来源于 Wind 资讯。

注 2：闳康披露的年度报告内显示其无任何存货项目，故不适用。

注 3：2026 年 1-6 月数据经年化。

与同行业可比公司相比，公司存货周转率低于行业平均水平，与扣除伟测科技和闳康后的同行业可比公司平均值相近。具体来看，公司的存货周转率与同行业可比公司中苏试试验的存货周转率水平相近，高于雍智科技，低于胜科纳米和伟测科技。

同行业可比公司中，胜科纳米存货由原材料和已完工未结算成本构成，伟测科技的存货主要为原材料，上述两家可比公司的原材料主要为搭配分析仪器使用的耗材，两家可比公司的整体存货水平均相对较低，从而导致存货周转率水平较高。

苏试试验除从事集成电路第三方检测服务外，还致力于环境试验设备的研发和生产；雍智科技主要从事半导体测试板的研发、生产与销售，主要产品包括前段测试载板（探针卡）、后段测试载板（IC 负载板）、老化测试板及其他相关测试板和服务。上述可比公司的主营业务均包含硬件类产品业务，存货水平较高、存货周转率相对较低。

公司存货除包含测试业务相关的耗材和合同履约成本外，还包含各类硬件业务相关的备货存货，从而导致公司存货余额较高，存货周转率相对较低。

（三）现金流量分析

报告期内，公司现金流量的基本情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	**2,784.42**	27,924.06	18,171.91	19,527.00
投资活动产生的现金流量净额	**-20,105.22**	-32,273.89	-27,266.14	-29,347.18
筹资活动产生的现金流量净额	**19,651.76**	3,620.63	7,646.88	12,406.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响	**30.01**	-36.35	-22.13	2.80
现金及现金等价物净增加额	**2,360.96**	-765.54	-1,469.49	2,588.83

1、经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	**31,786.52**	75,697.75	54,236.87	47,490.36
收到的税费返还	**-**	791.57	587.80	2,356.10
收到其他与经营活动有关的现金	**746.40**	3,303.45	3,669.34	5,528.43
经营活动现金流入小计	**32,532.92**	**79,792.77**	**58,494.01**	**55,374.89**
购买商品、接受劳务支付的现金	**12,933.12**	23,484.61	16,565.08	14,157.58
支付给职工以及为职工支付的现金	**14,099.56**	23,264.51	20,035.73	16,458.65
支付的各项税费	**1,149.75**	2,399.51	983.72	904.31
支付其他与经营活动有关的现金	**1,566.07**	2,720.08	2,737.57	4,327.35
经营活动现金流出小计	**29,748.50**	**51,868.71**	**40,322.10**	**35,847.88**
经营活动产生的现金流量净额	**2,784.42**	**27,924.06**	**18,171.91**	**19,527.00**

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 19,527.00 万元、18,171.91 万元、27,924.06 万元**和 2,784.42 万元**。公司经营活动现金流量主要来源于销售商品、提供劳务收到的现金，与公司销售收入变动趋势一致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的勾稽关系如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
净利润	**4,015.83**	9,125.55	5,437.55	2,045.41
加：资产减值准备	**390.38**	1,211.98	1,100.90	1,378.95

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
信用减值准备	**478.63**	-58.63	726.48	-23.64
固定资产折旧、使用权资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	**7,968.81**	13,899.48	11,044.34	7,630.44
无形资产摊销	**179.40**	409.70	254.65	140.51
长期待摊费用摊销	**1,300.98**	2,436.23	2,095.03	1,825.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	**-403.30**	-11.88	-2.95	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	**10.15**	0.15	4.67	3.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	**-186.21**	-292.39	-481.84	-33.34
财务费用（收益以“-”号填列）	**971.20**	1,974.52	1,971.36	1,892.62
投资损失（收益以“-”号填列）	**-4.97**	-227.30	-489.43	-317.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	**-92.54**	-115.34	-136.64	-185.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	**-**	-	-	-8.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	**-2,638.99**	-4,224.90	-1,324.71	-1,569.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	**-10,132.75**	1,014.66	-8,906.48	1,760.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	**576.61**	2,273.28	6,158.01	3,865.20
其他	**351.18**	508.97	720.97	1,122.55
经营活动产生的现金流量净额	**2,784.42**	27,924.06	18,171.91	19,527.00

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异主要受固定资产折旧、使用权资产折旧、长期待摊费用摊销、财务费用、经营性应收项目、经营性应付项目等变动影响。

2、投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	**845.85**	-	-	-
取得投资收益收到的现金	**820.90**	358.19	506.64	461.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	**639.13**	672.82	16.08	-

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收到其他与投资活动有关的现金	**10,700.00**	92,900.00	33,237.43	27,350.77
投资活动现金流入小计	**13,005.89**	**93,931.01**	**33,760.14**	**27,812.53**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	**24,111.11**	37,204.90	30,916.29	34,514.80
投资支付的现金	**400.00**	-	910.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	**-**	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	**8,600.00**	89,000.00	29,200.00	22,644.92
投资活动现金流出小计	**33,111.11**	**126,204.90**	**61,026.29**	**57,159.71**
投资活动产生的现金流量净额	**-20,105.22**	**-32,273.89**	**-27,266.14**	**-29,347.18**

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-29,347.18 万元、-27,266.14 万元、-32,273.89 万元**和-20,105.22 万元**。报告期内，公司投资活动现金流出金额较大。主要系公司业务发展迅速，采购机器设备等固定资产支出金额较大。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	**-**	190.00	-	13,076.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	**-**	-	-	-
取得借款收到的现金	**44,164.95**	56,170.99	43,789.85	52,530.41
收到其他与筹资活动有关的现金	**-**	-	-	-
筹资活动现金流入小计	**44,164.95**	**56,360.99**	**43,789.85**	**65,607.38**
偿还债务支付的现金	**22,401.35**	49,095.73	32,447.28	41,349.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	**795.53**	1,458.50	1,577.13	1,466.81
支付其他与筹资活动有关的现金	**1,316.30**	2,186.13	2,118.56	10,385.23
筹资活动现金流出小计	**24,513.18**	**52,740.36**	**36,142.97**	**53,201.18**
筹资活动产生的现金流量净额	**19,651.76**	**3,620.63**	**7,646.88**	**12,406.20**

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 12,406.20 万元、

7,646.88 万元、3,620.63 万元和 19,651.76 万元，主要系取得股东增资款、取得和偿还银行借款以及支付少数股东股权收购款所致。

（四）报告期内股利分配的具体实施情况

报告期内，公司不涉及股利分配的情况。

（五）流动性风险分析

截至报告期末，公司资产负债结构稳健，偿债能力指标良好，资产负债率处于合理水平。报告期内，公司业务发展情况良好，经营活动产生的现金流持续为正且较为充沛，为公司生产经营及资本性支出提供了良好的保障。综上，公司流动性不存在重大变化或风险。

（六）对持续经营能力产生重大不利影响的因素及管理层自我评判的依据

1、对持续经营能力产生重大不利影响的因素

能对公司持续经营能力产生重大不利影响的因素主要有：市场竞争的风险、技术泄密的风险、固定资产规模较大的风险、应收账款发生坏账的风险、经营业绩及毛利率、净利率下降的风险、量产测试及电子制造服务业务尚未盈利的风险等，具体情况请参见本招股说明书“第三节 风险因素”。

2、管理层自我评判的依据

管理层认为，公司所处行业处于快速发展期，市场需求保持旺盛，公司凭借多年来积累的优质客户资源、技术服务能力、良好品牌形象、一站式方案解决能力，主营业务实现可持续稳健发展，资产质量、财务状况和盈利能力良好。公司的经营模式、产品或服务的品种结构、行业地位及所处行业的经营环境未发生重大变化，公司最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户不存在重大依赖，公司最近一年的净利润不是主要来自合并财务报表范围以外的投资收益。综上，公司未来业务发展战略清晰，能够积极应对和防范各种风险因素，具备持续经营能力。

十、资本性支出

（一）报告期内的重大投资或资本性支出事项

报告期内，公司无重大资产业务重组或股权收购、合并的情况。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求量

公司未来可预见的重大资本性支出项目为本次发行股票募集资金拟投资的“浦东技术中心项目”“车规级高可靠量产测试服务建设项目”及“芯片中试平台工程技术研发项目”，具体情况请参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。除前述项目外，未来无其他可预见的重大资本性支出计划。

十一、发行人盈利预测情况

公司未编制盈利预测报告。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用概况

（一）募集资金运用计划

公司第四届董事会第三次会议、2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》，公司募集资金扣除发行费用后主要用于投资以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	浦东技术中心项目	45,000.00	37,097.00
2	车规级高可靠量产测试服务建设项目	20,477.87	20,477.87
3	芯片中试平台工程技术研发项目	14,800.01	14,800.01
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		**100,277.88**	**92,374.88**

以上募集资金投资项目均已进行了详细、充分的可行性研究。本次募集资金金额与投资项目和公司现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标相适应，投资项目具有较好的市场前景；本次募集资金到位后，发行人能够有效使用募集资金，增强资本实力、提高经营效益，从而进一步增强市场竞争力；本次募集资金用于发行人提升第三方实验室检测分析能力、车规级高可靠量产测试能力、先进芯片检测分析技术及补充流动资金等，相关项目实施后不会新增构成重大不利影响的同业竞争，对发行人的独立性不会产生不利影响。

（二）实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排

若本次发行上市募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目实际进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金。募集资金到位后，若本次发行上市实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过银行贷款等融资方式解决。

（三）募集资金投向符合国家产业政策等法规的说明

公司本次募集资金运用均围绕主营业务开展，是在目前主营业务基础之上的延伸与业务优化，不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等财务性投资的计划，也不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的计划。公司本次发行募集资金投向的建设项目已分别履行了项目备案、环评批复等程序，符合国家产业政策、环境保护等法律、法规和规章规定。

本次募集资金投资项目的备案情况和环保批复情况如下：

序号	项目名称	实施主体	项目备案号	环评批复
1	浦东技术中心项目	季丰技术	上海市企业投资项目备案证明（上海代码：310115MAD9C1PE020251D3101002）	已取得**沪浦环保许评〔2026〕119号《上海市浦东新区生态环境局关于季丰电子浦东技术中心项目（调整）环境影响报告表的审批意见》**
2	车规级高可靠量产测试服务建设项目	浙江季丰	浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（项目代码：2603-330421-04-01-846835）	【无需办理环评】
3	芯片中试平台工程技术研发项目	发行人	上海市企业投资项目备案证明（上海代码：31011267780827120261D3101001）	【无需办理环评】

（四）公司募集资金专项存储制度的建立及执行情况

为了规范公司募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、部门规章和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。《募集资金管理制度》对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。在募集资金到位后，公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（五）募集资金投资项目与主营业务的关系、对经营战略的影响、对业务创新创造创意性的支持作用

本次募集资金投资项目是公司战略规划实施的重要组成部分，是公司主营业

务发展的重要举措。“浦东技术中心项目”系公司进一步扩充第三方实验室业务产能，提升高端检测分析服务能力，完善公司在集成电路第三方检测领域的区位布局，巩固公司市场地位，从而进一步提升盈利水平。“车规级高可靠量产测试服务建设项目”旨在进一步布局量产测试业务，有利于公司实现从“0 到 1”第三方实验室业务到规模量产业务的延伸，拓展公司的“第二增长曲线”。“芯片中试平台工程技术研发项目”有利于发行人聚焦人工智能及高性能计算等前沿领域，布局大功率、先进制程、先进封装芯片的检测分析技术。通过补充与主营业务相关的营运资金，有利于缓解公司营运资金压力，夯实公司发展基础。本次募集资金投资项目的实施，有助于提升发行人自主创新能力，增强发行人综合竞争能力，进一步扩大业务规模、提升盈利能力。

本次募集资金运用具体情况请参见本招股说明书“第十二节　附件”之“七、募集资金具体运用情况”。

二、未来发展规划

（一）总体发展战略

公司将把握国内半导体行业快速发展及供应链国产化的历史机遇，坚持“技术驱动、品质为先”的经营战略。依托现有的技术积累和优质客户资源，公司将进一步完善产业链布局，深化半导体检测领域“服务+产品”的一站式能力，强化从“0-1”阶段的检验检测业务到规模量产业务的双轮驱动模式，致力于成为全球领先的半导体全功能、一站式解决方案提供商，更好地服务于国家半导体产业发展战略。

（二）具体经营计划

1、紧跟先进制程演进，持续投入研发与产能扩充

随着国内半导体晶圆制造工艺向 14nm 及更先进的 7nm、5nm、3nm 等制程演进，以及先进封装技术的广泛应用，高端检测分析需求将持续快速增长。公司将保持高强度的研发投入，紧跟国际技术路线，重点突破先进制程下的失效分析与检测技术。同时，公司将稳步实施先进产能扩充计划，以匹配我国集成电路产业规模扩张与技术升级的双重需求，满足国产设备验证及芯片设计公司新产品研发带来的增量市场需求，巩固技术领先地位。

2、深挖客户全生命周期需求，拓展规模量产业务

公司将充分利用公司在现有客户研发验证阶段已建立的品牌优势与客户粘性，积极向产业链后端延伸。公司计划将业务从“研发验证分析”向“规模量产”阶段拓展，在为客户提供第三方实验室检测分析业务的基础上，拓展规模量产业务（包括量产测试、EMS），实现业务纵向延伸，打造业绩的第二增长极。

3、发挥半导体检测领域“服务+产品”协同效应，构建技术闭环优势

公司将继续深化“检测服务”与“配套产品”的协同发展战略。一方面，利用自主研发的测试板、测试插座及实验室仪器设备支撑检测服务的高效交付；另一方面，通过高频次的服务场景快速验证并迭代自研产品，实现技术与数据的反哺。未来，公司将进一步扩大技术闭环优势，提升综合解决方案能力，构建差异化竞争壁垒。

4、推进跨行业横向拓展，打造多元化检测集团

在以集成电路为核心的第三方实验室及规模量产服务的基础上，公司拟向系统级检测、计量校准、新能源检测等领域进行横向复制与拓展。通过多领域布局，有效降低单一行业周期波动风险，发挥行业间的技术协同与客户协同优势，逐步将公司建设成为具备多事业部架构、抗风险能力强的综合性检测集团。

第八节 公司治理与独立性

一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，逐步建立健全了由股东会、董事会、独立董事和高级管理人员组成的治理结构。公司建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》等制度规则，并建立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。

公司股东会、董事会及相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制，不存在违法违规情况。报告期内公司不存在公司治理缺陷，公司董事、高级管理人员不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

根据创业板相关制度要求，2026 年 3 月 20 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《公司章程（草案）》等一系列公司治理制度，有助于进一步提升公司治理的规范性。

二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见

（一）管理层的自我评估意见

公司管理层认为：自公司成立以来，公司建立并逐步健全了法人治理结构，内部控制制度也不断完善并已得到有效运行。内部控制制度有力地保证了公司业务经营的有效进行，保护了公司资产的安全和完整，能够防止并及时发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，能够保证内部控制目标的达成。公司将根据公司业务发展和内部机构调整的需要，及时补充完善内部控制制度，使公司内部控制制度不断改进、充实和完善，促进公司持续、稳健发展。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

（二）注册会计师的鉴证意见

天健会计师根据《企业内部控制审计指引》对公司 2026 年 6 月 30 日的财务报告内部控制的有效性进行了专项审计，并出具了“天健审【2026】17873 号”《内部控制审计报告》。该报告认为：公司于 2026 年 6 月 30 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、发行人报告期内违法违规情况

公司严格遵守国家的有关法律与法规，报告期内不存在重大违法违规行为，也未受到国家行政机关及行业主管部门的重大处罚。

四、发行人资金占用和对外担保情况

报告期内，公司不存在资金被实际控制人及其控制的其他企业占用的情况；除为合并报表范围内的子公司提供担保之外，公司不存在为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

五、发行人的独立性

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立、健全公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司实际控制人控制的企业完全分开、独立运作，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整

公司由季丰有限整体变更设立，承继了季丰有限的所有资产、负债及权益。公司合法拥有与研发、经营有关的机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司资产与股东资产严格分离，不存在与股东共用资产的情况，不存在资产被实际控制人占用而损害公司利益的情形。

（二）人员独立

公司具备健全的法人治理结构，公司董事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生和任职，程序合法有效。公司的总经理、副总

经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司按照《公司法》《企业会计准则》等法律法规和规范性文件的要求，设立了独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，制定了符合企业会计准则的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，建立了独立的财务会计核算体系，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开户，独立支配自有资金和资产，未与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

（四）机构独立

公司按照《公司法》和《公司章程》设置了股东（大）会、董事会、监事会等决策及监督机构并制定了相应的议事规则，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构依照《公司法》《公司章程》和各项规章制度的规定在各自职责范围内独立行使经营管理职权，公司与实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

公司的业务独立于实际控制人及其控制的其他企业，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（六）公司主营业务、控制权、管理团队稳定

报告期内，公司主营业务、控制权、管理团队稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均未发生重大不利变化；实际控制人所持公司的股份权属清晰，最近两年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

（七）对持续经营有重大影响的事项

报告期内，公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

六、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争

截至本招股说明书签署日，公司无控股股东，公司实际控制人郑朝晖、郑琦君控制的其他企业情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业”。

公司主营业务为检测服务与检测硬件产品，与实际控制人控制的其他企业从事的业务存在明显差异，不存在同业竞争的情形。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能产生的同业竞争事项，公司实际控制人及其一致行动人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体情况请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。

七、关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则》《上市规则》等相关规定，报告期内公司关联方及关联关系如下：

（一）控股股东及实际控制人，及其一致行动人

公司实际控制人为郑朝晖、郑琦君，其基本情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人基本情况”。

公司实际控制人的一致行动人为陈洋森、李定学、季铭源、江山季兴、上海季双，其基本情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人基本情况”。

（二）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人

关联方名称	关联关系
季铭源	持有公司 5%以上股份

关联方名称	关联关系
嘉善芯创	均系上海君桐股权投资管理有限公司控制的私募基金，该等基金合计持有公司 5%以上股份
嘉兴君源	
南通中皋	
嘉兴君晋	

（三）子公司、合营企业和联营企业

公司子公司、合营企业和联营企业的基本情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、发行人的子公司及参股公司”。

（四）控股股东、实际控制人控制的其他企业

公司实际控制人郑朝晖、郑琦君控制的其他企业基本情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业”。

（五）公司董事、高级管理人员

关联方名称	在公司任职情况
郑朝晖	董事长、总经理
倪卫华	董事、副总经理
杨小明	董事
陶卫	董事
张绍敏	董事
毛余喜	职工董事
杨勤法	独立董事
王泽霞	独立董事
何卫锋	独立董事
朱勇	副总经理
李定学	副总经理
庄振宏	副总经理
邵文宗	副总经理、董事会秘书、财务总监

（六）前述 1-5 项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母

（七）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人、董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织

关联方	关联关系
江山市绿业有限公司	实际控制人的一致行动人陈洋森持股 71.77%并担任董事长的企业
江山市绿业园艺有限公司	实际控制人的一致行动人陈洋森控制并担任董事长兼总经理的企业
江山绿业旅游有限公司	实际控制人的一致行动人陈洋森控制并担任执行董事的企业
江山市华生林业有限公司	实际控制人的一致行动人陈洋森担任董事长兼总经理的企业
科尔沁左翼后旗绿业农牧业发展有限公司	实际控制人的一致行动人陈洋森控制并担任执行董事兼总经理的企业
江山市新涛白酒小作坊	实际控制人的一致行动人陈洋森的儿子陈碧涛作为经营者的个体工商户
衢州百阳人力资源有限公司	实际控制人的一致行动人陈洋森儿子的配偶杨欢持股 40%并担任执行董事兼经理的企业
衢州寰晟园区管理有限公司	**实际控制人的一致行动人陈洋森儿子的配偶杨欢持股 60%的企业**
杭州实踏实贸易有限公司	实际控制人的一致行动人陈洋森配偶的弟弟程如画持股 100%并担任执行董事兼总经理的企业
四川数智	董事兼副总经理倪卫华担任董事的企业，公司持股 13%
常州高晟传感技术有限公司	董事陶卫的配偶万松持股 50.9%并担任执行董事兼经理的企业
广芯电子技术（上海）股份有限公司	董事张绍敏担任董事的企业
杭州中欣晶圆半导体股份有限公司	董事张绍敏担任董事的企业
上海慧永盛信息技术有限公司	独立董事杨勤法的配偶方慧庆持股 50%的企业
上海翱帆科技有限公司（已吊销未注销）	独立董事杨勤法的配偶方慧庆持股 50%的企业
杭州明泽云软件有限公司	独立董事王泽霞持股 50%并担任董事长兼总经理、王泽霞的儿子童千里持股 40%并担任董事的企业
凤凰智能电子（杭州）有限公司	独立董事王泽霞的配偶童学平担任董事长的企业
黑龙江省粮农开发建设有限责任公司	独立董事何卫锋配偶的姐姐贾彦彦担任财务负责人的企业
普铄电子	实际控制人的一致行动人、副总经理李定学担任董事、公司持股 10%的企业
振立汽车商行（中国台湾企业）	副总经理庄振宏的弟弟庄振亿控制的企业

关联方	关联关系
苏州明微科技有限公司	**董事陶卫担任经理并持股 40%的企业**

（八）其他关联方

除上述已披露的关联方之外，公司的关联方还包括根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司利益对其倾斜的自然人、法人或者其他组织，在相关交易或安排生效后 12 个月内具有前述情形之一的自然人、法人或者其他组织，以及在相关交易或安排发生前 12 个月内曾经具有前述情形之一的自然人、法人或者其他组织。该等关联方主要如下：

关联方	关联方与本公司的关系
闻威	报告期内曾任董事，已于 2025 年 9 月离任，目前通过嘉善芯创、嘉兴君源、南通中皋、嘉兴君晋控制公司 10.35%表决权
高强	报告期内曾任董事、副总经理，已于 2025 年 9 月离任
周子学	报告期内曾任董事，已于 2025 年 9 月离任
尹琦	报告期内曾任监事，已于 2025 年 9 月离任
陶雪芬	报告期内曾任监事，已于 2025 年 9 月离任
祁耀亮	报告期内曾任董事，已于 2024 年 1 月离任
嘉善季兴管理咨询中心（有限合伙）	实际控制人郑朝晖曾经担任执行事务合伙人的企业，已于 2022 年 5 月注销
嘉善季嘉管理咨询中心（有限合伙）	实际控制人郑朝晖曾经担任执行事务合伙人的企业，已于 2022 年 5 月注销
衢州钴锰锂环保科技有限公司	实际控制人的一致行动人陈洋森儿子的配偶杨欢曾经持股 50%的企业，已于 2022 年 6 月注销
黑龙江省寒地龙药中草药种植有限公司	独立董事何卫锋配偶的姐姐贾彦彦曾经担任财务负责人的企业，贾彦彦已于 2025 年 9 月离任
黑龙江正德汽车租赁有限公司	独立董事何卫锋配偶的姐姐贾彦彦曾经担任财务负责人的企业，贾彦彦已于 2025 年 6 月离任
黑龙江粮农农业集团有限公司	独立董事何卫锋配偶的姐姐贾彦彦曾经担任董事兼财务负责人的企业，贾彦彦已于 2025 年 2 月离任
苏州群芯汇电子科技有限公司	副总经理庄振宏持股 41%并担任执行董事兼总经理的企业，已于 2023 年 9 月注销
郑州昂普科技有限公司	报告期内前任董事闻威持股 79.21%的企业
上海君桐星辰企业管理有限公司	报告期内前任董事闻威持股 49%的企业
上海君桐股权投资管理有限公司（及其控制的企业）	报告期内前任董事闻威持股 44.35%并担任董事长兼总经理的企业
上海昂普电子商务有限公司	报告期内前任董事闻威持股 67.33%并担任执行董事的企业
南京法赛迪信息科技有限公司（已吊销未注销）	报告期内前任董事闻威持股 31.98%的企业

关联方	关联方与本公司的关系
上海威忱企业管理咨询有限公司	报告期内前任董事闻威持股 100%并担任执行董事的企业
无锡君熠投资企业（有限合伙）	报告期内前任董事闻威持股 41.81%的企业，已于 2026 年 3 月注销
嘉兴君卓投资合伙企业（有限合伙）	报告期内前任董事闻威持股 35.80%的企业
嘉兴君巍股权投资合伙企业（有限合伙）	报告期内前任董事闻威持股 32.7%的企业
上海北科创星际私募基金管理合伙企业（有限合伙）	报告期内前任董事闻威持股 33.15%，并通过上海君桐星辰企业管理有限公司间接持股 14.58%的企业
海南君擎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	报告期内前任董事闻威持股 30%并担任执行事务合伙人的企业
安太力生命科学（浙江）有限公司	报告期内前任董事闻威担任董事的企业
上海灵动微电子股份有限公司	报告期内前任董事闻威担任董事的企业，**已于 2026 年 6 月离任**
上海陛通半导体能源科技股份有限公司	报告期内前任董事闻威担任董事的企业
郑州和讯通信技术有限公司	报告期内前任董事闻威曾经持股 79.21%的企业，已于 2024 年 9 月注销
上海衡桦纳米科技有限公司	报告期内前任董事闻威的配偶郭艳芬持股 34.27%的企业
上海茂源祥企业管理咨询服务有限公司	报告期内前任董事闻威的配偶郭艳芬持股 100%并担任执行董事兼财务负责人的企业，**已于 2026 年 6 月离任和退出持股**
宁波耀晶企业管理咨询有限公司	报告期内前任董事祁耀亮持股 100%，并担任执行董事兼总经理的企业
上海铭荃商务咨询中心	报告期内前任董事祁耀亮持股 100%的企业，**已于 2024 年 5 月注销**
浙江泓芯新材料股份有限公司	报告期内前任董事祁耀亮担任独立董事的企业，**已于 2026 年 7 月离任**
睿晶半导体有限公司	报告期内前任董事祁耀亮担任董事长兼经理的企业
宁波晶募企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	报告期内前任董事祁耀亮担任执行事务合伙人的企业
宁波贤睿达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	报告期内前任董事祁耀亮担任执行事务合伙人的企业
宁波募贤企业管理合伙企业（有限合伙）	报告期内前任董事祁耀亮担任执行事务合伙人的企业
苏州汉朗光电有限公司	报告期内前任董事祁耀亮担任董事的企业，已于 2026 年 1 月离任
苏州长瑞光电有限公司	报告期内前任董事祁耀亮担任董事的企业，已于 2024 年 8 月离任
伟测科技	报告期内前任董事祁耀亮担任董事的企业，已于 2024 年 7 月离任
昇显微电子（苏州）股份有限公司	报告期内前任董事祁耀亮担任董事的企业，已于 2024 年 9 月离任
强一股份	报告期内前任董事祁耀亮担任董事的企业，已于 2024 年 5 月离任

关联方	关联方与本公司的关系
重庆汉朗精工科技有限公司	报告期内前任董事祁耀亮担任董事的企业，已于2024年4月离任
昆腾微电子股份有限公司	报告期内前任董事祁耀亮担任董事的企业，已于2024年9月离任
西安吉利电子新材料股份有限公司	报告期内前任董事祁耀亮担任董事的企业，已于2024年3月离任
宁波创润新材料有限公司	报告期内前任董事祁耀亮担任董事的企业，已于2024年7月离任
浙江亚笙半导体设备有限公司	报告期内前任董事祁耀亮担任董事的企业，已于2024年3月离任
重庆晶朗光电有限公司	报告期内前任董事祁耀亮担任董事的企业，已于2024年4月离任
圆周率半导体（南通）有限公司	报告期内前任董事祁耀亮担任董事的企业，已于2024年7月离任
京微齐力（北京）科技股份有限公司	报告期内前任董事祁耀亮担任董事的企业，已于2024年11月离任
捷螺智能设备（苏州）有限公司	报告期内前任董事祁耀亮担任董事的企业，已于2024年9月离任
管芯微技术（上海）有限公司	报告期内前任董事祁耀亮担任董事的企业，已于2024年2月离任
同源微（北京）半导体技术有限公司	报告期内前任董事祁耀亮担任董事的企业，已于2024年3月离任
泓浒（苏州）半导体科技有限公司	报告期内前任董事祁耀亮担任董事的企业，已于2024年5月离任
成都启英泰伦科技有限公司	报告期内前任董事祁耀亮担任董事的企业，已于2024年1月离任
世疃微电子科技有限公司	报告期内前任董事祁耀亮担任董事的企业，已于2024年10月离任
上海优立取人才咨询有限公司	报告期内前任董事高强的哥哥高峰峰曾经持股30%的企业，已于2022年10月退出
有为（常州）安全环境技术有限公司	报告期内前任董事高强的哥哥高峰峰控制的企业，已于2023年1月注销
中亘兰谷安全科技（上海）有限公司	报告期内前任董事高强的哥哥高峰峰持股90%并担任执行董事兼总经理的企业
安智谷能源科技（上海）有限公司	报告期内前任董事高强的哥哥高峰峰持股80%并担任执行董事的企业
必禄劳务派遣（上海）有限公司	报告期内前任董事高强的哥哥高峰峰持股60%的企业
上海桐君电子有限公司	报告期内前任董事高强的配偶的弟弟朱康平持股80%并担任董事的企业
上海厚君企业管理有限公司	报告期内前任董事周子学持股60%并担任董事的企业
海南青山雪科技发展有限公司	报告期内前任董事周子学持股100%并担任董事的企业
上海青山雪科技发展有限公司	报告期内前任董事周子学持股100%并担任执行董事的企业
浙江晶盛机电股份有限公司	报告期内前任董事周子学担任董事的企业

关联方	关联方与本公司的关系
仙鹤股份有限公司	报告期内前任董事周子学担任独立董事的企业
浙江盛洋科技股份有限公司	报告期内前任董事周子学担任独立董事的企业
上海厚雪私募基金管理有限公司	报告期内前任董事周子学担任董事的企业，并通过上海厚君企业管理有限公司间接持股 24%
长电科技	报告期内前任董事周子学曾经担任董事长的企业，已于 2023 年 3 月离任
海信视像科技股份有限公司	报告期内前任董事周子学曾经担任董事的企业，已于 2023 年 9 月离任
巨秉（上海）实业有限公司	报告期内前任监事陶雪芬的配偶雷光虎持股 100%并担任执行董事的企业
云和梯田投资发展有限公司	报告期内前任监事尹琦曾经担任董事的企业，已于 2022 年 7 月离任
客户 H	报告期内前任董事曾担任董事的企业
北京广信融科技术有限责任公司	**实际控制人的一致行动人陈洋森持股 45.38%并担任董事的企业，已于 2026 年 8 月注销**
建德市大同镇余孝鞋店	**职工董事毛余喜的哥哥毛余孝作为经营者的个体工商户，已于 2026 年 7 月不再经营**

其他由上述关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的法人或其他组织（公司及其控股子公司除外）均属于公司的关联方。

（九）报告期内曾存在关联关系的关联方

发行人报告期内关联方的变化情况参见本节“七、关联方及关联关系”之“（八）其他关联方”。

八、关联交易情况

（一）重大关联交易的判断标准及依据

参照《上市规则》规定的上市公司应当及时披露的关联交易标准及公司制定的《关联交易管理制度》中规定的应提交董事会审议的关联交易标准，公司将达到以下标准之一的关联交易界定为重大关联交易：

（1）公司与关联法人之间发生的单笔关联交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 0.5%以上的关联交易，以及公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的；

（2）公司与关联自然人之间发生的单笔关联交易金额在 30 万元以上的，以

及公司与关联自然人就同一标的或者公司与同一关联自然人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的。

（二）经常性关联交易

1、关联采购交易

报告期内，公司向关联方采购原材料情况如下：

单位：万元

关联方名称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
普锍电子	**7.24**	12.26	15.10	12.32
合计	**7.24**	**12.26**	**15.10**	**12.32**

注：普锍电子系公司参股公司

报告期内，公司向关联方采购主要系委外服务、测试板成品，交易金额分别为 12.32 万元、15.10 万元、12.26 万元**和 7.24 万元**，交易规模较小。因集成电路测试板料号较多，以客户定制件为主，为满足特定客户定制化需求，公司会对外采购测试板及配套服务，具有定制化特征，定价遵循市场化原则。

2、关联销售交易

报告期内，公司向关联方销售商品和服务情况如下：

单位：万元

关联方名称	交易内容	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
普锍电子	检测硬件产品	**30.10**	26.90	58.90	48.72
伟测科技	检测服务	-	-	0.06	0.32
上海灵动微电子股份有限公司	检测服务、检测硬件产品	**10.00**	11.17	23.31	89.07
昆腾微电子股份有限公司	检测服务、检测硬件产品	**-**	18.82	9.98	0.92
广芯电子技术（上海）股份有限公司	检测服务、检测硬件产品	**15.60**	5.86	9.40	0.90
京微齐力（北京）科技股份有限公司	检测服务、检测硬件产品	-	29.76	3.65	-
世疃微电子科技有限公司	检测服务	-	1.84	2.28	2.83
强一股份	检测硬件产品	-	-	0.90	6.72
同源微（北京）半导体技术有限公司	检测服务	-	2.76	1.28	-
上海陛通半导体能源科技股份有限公司	检测服务	-	3.18	-	-

关联方名称	交易内容	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
杭州中欣晶圆半导体股份有限公司	检测服务	**2.77**	**0.91**	-	-
长电科技	检测服务、检测硬件产品	-	-	-	21.61
客户 H	检测服务、检测硬件产品	-	-	-	34.13
合计		**58.47**	**101.21**	**109.76**	**205.22**

注 1：已合并计算受同一实际控制方控制的关联方的收入。

报告期内，公司与上述关联方交易的内容主要系检测服务、检测硬件产品，占营收比例分别为 0.46%、0.19%、0.15%**和 0.15%**。服务与产品的定价均参考公司向其他无关联第三方客户提供同等规模、同等技术复杂度服务的收费标准，经双方商业谈判确定，定价原则与市场化交易一致，符合行业惯例。

3、关键管理人员报酬

报告期内，公司支付关键管理人员报酬情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	**280.35**	728.24	775.88	631.28

（三）偶发性关联交易

报告期内，公司与关联方之间发生的关联担保，均系公司实际控制人及其配偶为公司银行借款提供连带责任担保，基本情况如下：

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑朝晖	760.00	2021.08.26	2024.06.21	是
郑朝晖	1,250.00	2021.10.20	2024.09.21	是
郑朝晖	333.00	2021.12.09	2024.09.21	是
郑朝晖、章莉	1,200.00	2022.12.14	2031.04.08	正在履行中
	500.00	2023.01.10	2031.04.08	
	3,400.00	2023.02.15	2031.04.08	
	900.00	2023.04.19	2031.04.08	
	800.00	2023.10.09	2031.04.08	
	980.00	2023.11.23	2031.04.08	
	2,220.00	2024.03.25	2031.04.08	

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑朝晖、章莉	512.26	2023.01.10	2024.01.10	是
郑朝晖、章莉	1,600.00	2023.02.09	2024.02.08	是
郑朝晖、章莉	832.31	2023.02.21	2024.02.21	是
郑朝晖、章莉	990.00	2023.04.12	2024.04.12	是
郑朝晖、章莉	990.00	2023.04.14	2024.04.14	是
郑朝晖、章莉	990.00	2023.04.28	2024.04.28	是
郑朝晖、章莉	990.00	2023.05.26	2024.05.26	是
郑朝晖、章莉	990.00	2023.06.26	2024.06.26	是
郑朝晖、章莉	990.00	2023.07.07	2024.06.26	是
郑朝晖、章莉	990.00	2023.07.12	2024.06.26	是
郑朝晖、章莉	990.00	2023.08.16	2024.05.27	是
郑朝晖、章莉	990.00	2023.08.21	2024.05.27	是
郑朝晖、章莉	5,000.00	2023.08.25	2028.08.24	正在履行中
郑朝晖、章莉	1,000.00	2023.09.06	2024.05.27	是
郑朝晖、章莉	850.00	2023.09.07	2024.08.09	是
郑朝晖	1,500.00	2023.09.14	2025.09.07	是
郑朝晖、章莉	990.00	2023.09.22	2024.05.27	是
郑朝晖	800.00	2023.09.28	2026.03.07	是
郑朝晖、章莉	990.00	2023.10.09	2024.08.09	是
郑朝晖、章莉	700.00	2023.10.25	2024.08.09	是
郑朝晖、章莉	990.00	2023.11.08	2024.08.09	是
郑朝晖、章莉	990.00	2023.11.09	2024.07.04	是
郑朝晖、章莉	620.00	2023.12.05	2024.07.05	是
郑朝晖	1,700.00	2024.03.25	2026.09.07	是
郑朝晖、章莉	1,000.00	2024.03.25	2027.03.20	正在履行中
郑朝晖、章莉	3,970.00	2024.05.27	2025.05.21	是
郑朝晖、章莉	800.00	2024.06.14	2025.06.14	是
郑朝晖、章莉	2,000.00	2024.06.20	2025.06.14	是
郑朝晖、章莉	2,970.00	2024.06.24	2025.06.19	是
郑朝晖、章莉	1,000.00	2024.06.25	2025.06.25	是
郑朝晖、章莉	1,470.00	2024.07.03	2025.07.02	是
郑朝晖、章莉	2,600.00	2024.07.24	2025.07.10	是

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑朝晖、章莉	1,600.00	2024.07.25	2025.07.10	是
郑朝晖、章莉	3,530.00	2024.08.09	2025.08.08	是
郑朝晖	900.00	2024.10.08	2025.10.08	是
郑朝晖、章莉	4,800.00	2024.11.06	2025.05.14	是
郑朝晖、章莉	1,070.00	2024.11.27	2025.11.10	是
郑朝晖、章莉	930.00	2024.12.06	2025.11.10	是
郑朝晖、章莉	400.00	2024.12.20	2027.12.19	正在履行中
郑朝晖、章莉	1,900.00	2025.02.20	2027.12.19	正在履行中
郑朝晖、章莉	400.00	2025.03.11	2027.12.19	正在履行中
郑朝晖、章莉	990.00	2025.03.12	2025.12.25	是
郑朝晖、章莉	1,300.00	2025.04.11	2027.12.19	正在履行中
郑朝晖	830.00	2025.05.07	2025.12.23	是
郑朝晖	4,800.00	2025.05.14	2026.05.08	是
郑朝晖、章莉	4,000.00	2025.05.20	2026.05.20	是
郑朝晖、章莉	1,200.00	2025.06.06	2026.06.05	是
郑朝晖、章莉	580.00	2025.06.12	2028.06.09	正在履行中
郑朝晖、章莉	4,000.00	2025.06.13	2025.10.09	是
郑朝晖、章莉	1,770.00	2025.06.18	2025.12.26	是
郑朝晖、章莉	1,000.00	2025.6.26	2026.6.22	**是**
郑朝晖、章莉	1,470.00	2025.7.2	2026.7.1	**是**
郑朝晖、章莉	900.00	2025.7.7	2026.7.7	**是**
郑朝晖	4,200.00	2025.07.09	2026.07.09	**是**
郑朝晖	800.00	2025.07.09	2025.12.30	是
郑朝晖、章莉	390.00	2025.07.17	2028.07.17	正在履行中
郑朝晖、章莉	970.00	2025.08.06	2026.08.06	**是**
郑朝晖、章莉	1,095.00	2025.09.08	2028.09.08	正在履行中
郑朝晖、章莉	970.00	2025.09.08	2029.09.08	正在履行中
郑朝晖、章莉	2,628.65	2025.09.10	2030.09.09	正在履行中
郑朝晖、章莉	1,000.00	2025.10.09	2029.10.08	正在履行中
郑朝晖、章莉	1,000.00	2025.10.29	2029.10.28	正在履行中
郑朝晖	870.00	2025.11.7	2027.1.16	正在履行中
郑朝晖、章莉	2,800.00	2025.11.11	2030.11.08	正在履行中

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑朝晖	369.00	2025.12.18	2028.05.10	正在履行中
郑朝晖	221.16	2025.12.25	2030.06.30	正在履行中
郑朝晖、章莉	1,270.00	2025.12.26	2030.12.26	正在履行中
郑朝晖、章莉	4,732.37	2026-01-07	2029-07-09	正在履行中
郑朝晖、章莉	550.00	2026-01-08	2031-01-08	正在履行中
郑朝晖	286.00	2026-01-26	2028-11-10	正在履行中
郑朝晖、章莉	500.00	2026-02-06	2027-07-27	正在履行中
郑朝晖、章莉	2,000.00	2026-02-06	2027-07-27	正在履行中
郑朝晖	601.00	2026-02-10	2029-05-10	正在履行中
郑朝晖、章莉	1,090.00	2026-02-10	2031-02-10	正在履行中
郑朝晖、章莉	950.00	2026-03-06	2027-07-27	正在履行中
郑朝晖、章莉	550.00	2026-03-06	2027-07-27	正在履行中
郑朝晖、章莉	990.00	2026-03-24	2029-07-09	正在履行中
郑朝晖、章莉	3,108.58	2026-03-26	2031-03-25	正在履行中
郑朝晖、章莉	1,000.00	2026-04-03	2027-07-27	正在履行中
郑朝晖、章莉	990.00	2026-04-03	2029-07-09	正在履行中
郑朝晖	900.00	2026-04-09	2028-05-12	正在履行中
郑朝晖、章莉	870.00	2026-04-23	2029-07-09	正在履行中
郑朝晖	4,100.00	2026-05-07	2028-05-12	正在履行中
郑朝晖	1,071.00	2026-05-09	2030-05-10	正在履行中
郑朝晖、章莉	4,000.00	2026-05-19	2033-11-11	正在履行中
郑朝晖	998.00	2026-05-25	2026-11-05	正在履行中
郑朝晖	380.00	2026-05-25	2030-05-10	正在履行中
郑朝晖、章莉	1,200.00	2026-06-04	2033-11-11	正在履行中
郑朝晖、章莉	500.00	2026-06-09	2033-11-11	正在履行中
郑朝晖、章莉	900.00	2026-06-10	2033-11-11	正在履行中
郑朝晖、章莉	1,016.00	2026-06-11	2031-06-10	正在履行中
郑朝晖、章莉	886.00	2026-06-18	2031-06-10	正在履行中
郑朝晖、章莉	950.00	2026-06-22	2028-06-22	正在履行中
郑朝晖、章莉	900.00	2026-06-23	2028-06-23	正在履行中
郑朝晖、章莉	350.00	2026-06-25	2028-06-25	正在履行中
郑朝晖	836.00	2026-06-25	2030-11-10	正在履行中

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑朝晖、章莉	1,930.00	2026-06-29	2033-11-11	正在履行中
郑朝晖、章莉	1,470.00	2026-06-29	2033-11-11	正在履行中
郑朝晖、章莉	1,000.00	2025-9-24	2026-9-24	正在履行中

（四）关联方往来款项

报告期各期末，公司的关联往来应收、应付款项情况如下：

单位：万元

项目	单位名称	2026年6月30日		2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	普锍电子	17.06	0.85	15.82	0.79	2.60	0.13	5.44	0.27
	伟测科技	-	-	-	-	0.06	-	0.34	0.02
	上海灵动微电子股份有限公司	-	-	-	-	1.34	0.07	3.86	0.19
	昆腾微电子股份有限公司	-	-	11.35	0.57	0.44	0.02	-	-
	广芯电子技术（上海）股份有限公司	0.99	0.05	0.10	0.01	-	-	-	-
	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司	2.33	0.12	-	-	-	-	-	-
预付款项	普锍电子	-	-	-	-	-	-	0.60	-
应付账款	普锍电子	9.87	-	9.55	-	8.64	-	2.69	-

（五）全部关联交易的简要汇总表

报告期内，公司关联交易汇总表如下：

单位：万元

类别	交易内容	关联方	2026年1-6月	2025年度	2024年度	2023年度
经常性关联交易	原材料采购	普锍电子	7.24	12.26	15.10	12.32
	提供商品和服务	普锍电子	30.10	26.90	58.90	48.72
		伟测科技	-	-	0.06	0.32
		上海灵动微电子股份有限公司	10.00	11.17	23.31	89.07

类别	交易内容	关联方	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
		昆腾微电子股份有限公司	-	18.82	9.98	0.92
		广芯电子技术（上海）股份有限公司	15.60	5.86	9.40	0.90
		京微齐力（北京）科技股份有限公司	-	29.76	3.65	-
		世疃微电子科技有限公司	-	1.84	2.28	2.83
		强一股份	-	-	0.90	6.72
		同源微（北京）半导体技术有限公司	-	2.76	1.28	-
		上海陛通半导体能源科技股份有限公司	-	3.18	-	-
		杭州中欣晶圆半导体股份有限公司	2.77	0.80	-	-
		长电科技	-	-	-	21.61
		客户 H	-	-	-	34.13
	关键管理人员报酬	报告期内公司董监高	280.35	728.24	775.88	631.28
偶发性关联交易	关联担保	郑朝晖、章莉	参见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“八、关联交易情况”之“（三）偶发性关联交易”			

（六）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司发生的经常性关联交易为向关联方采购商品、销售商品以及关联租赁等，主要按照市场价格定价，占同类采购或销售比例较小；公司发生的偶发性关联交易系关联方向公司提供担保。公司发生的关联交易属于公司业务正常经营的需要，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

（七）关联交易制度安排

公司已在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及专门制定的《关联交易管理制度》中，对关联交易的决策权限、决策程序、回避制度作出了详细规定。

（八）报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见

公司已在其《公司章程》《公司章程（草案）》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部治理文件中，明确规定了关联交易的决策权限及决策程序等

事项，并制定了《关联交易管理制度》。该制度就关联方的界定、关联交易的范围、关联交易的程序与披露等内容进行了具体规定。

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二次会议，于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易的议案》。

2026 年 1 月 26 日，公司全体独立董事对报告期内的关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易是公司因正常经营需要而发生的，符合公司利益，公司与关联方所进行的关联交易为正常的商业往来，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不会对公司的经营产生不利影响，不会损害公司及股东的利益，也不会构成对公司独立运行的影响。

公司于 2026 年 6 月 8 日召开第四届董事会第六次会议，于 2026 年 6 月 29 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2026 年 1-6 月已发生的关联交易均在预计的关联交易范围。

2026 年 6 月 8 日，公司全体独立董事对报告期内的关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易是公司因正常经营需要而发生的，符合公司利益，公司与关联方所进行的关联交易为正常的商业往来，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不会对公司的经营产生不利影响，不会损害公司及股东的利益，也不会构成对公司独立运行的影响。

（九）报告期内关联方的变化情况

公司报告期内曾存在关联关系的关联方情况请参见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“七、关联方及关联关系”之“（九）报告期内曾存在关联关系的关联方”。

（十）减少和规范关联交易的措施

公司将严格执行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》中关于关联交易、关联方资金占用的规定，尽量减少关联交易、资金占用的发生。对于不可避免的关联交易，公司将严格执行《公司章程》《关联交易管理制度》制定的关联交易决策程序、回避制度和信息披露制度，加强独

立董事对关联交易的监督，进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

为规范与发行人之间的关联交易，发行人的实际控制人及其一致行动人、直接持股 5%以上股东、董事、高级管理人员已出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体内容请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。

第九节 投资者保护

一、本次发行完成前滚存利润的分配安排

为兼顾新老股东的利益，公司 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》，本次公开发行股票前滚存的未分配利润，由发行完成后的新老股东按持股比例共享。

二、股利分配政策

（一）发行后的股利分配政策和决策程序

根据公司《公司章程（草案）》的规定，公司的具体利润分配政策及决策程序如下：

1、利润分配的基本原则

公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、利润分配的形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

3、现金分红的具体条件和比例

在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年度采取的利润分配方式中应当含有现金分配方式，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

4、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，适用前项规定。

5、利润分配方案的实施

公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

6、利润分配政策的调整

公司利润分配政策，属于董事会和股东会的重要决策事项，原则上不得随意调整；有正当理由，确需调整或变更利润分配政策的，应按照如下要求进行：

（1）公司利润分配政策制定和修订由公司董事会向公司股东会提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，需在考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。

（2）若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续发展时，公司董事会应提出修改利润分配政策；公司董事会提出修改利润分配政策时应以股东利益为出发点，充分考虑中小股东的利益和意见，注重对投资者利益的保护，并在提交股东会的议案中详细说明修订的原因。

（3）公司董事会制定与修订利润分配政策，应当通过网络、电话以及见面会等各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的

意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（4）公司董事会制订和修改的利润分配政策，需经董事会过半数表决通过。

（5）公司利润分配政策制定和修订需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会审议调整或者变更现金分红政策议题时，公司应向股东提供网络形式的投票平台，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司公众股东征集投票权。

7、利润分配政策的披露

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，公司未进行现金分红的应当披露具体原因以及下一步为增强投资者回报拟采取的举措，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还需详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

（二）本次发行前后股利分配政策的差异情况

本次发行前，公司根据《公司法》制定了公司的基本股利分配政策，股利分配政策重点规定了利润的分配顺序及股利分配的前提条件。

本次发行后，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规规定，从利润分配方式、利润分配的期间间隔、现金分红的条件和比例、股票股利分配的条件、利润分配需履行的决策程序、利润分配政策调整程序等方面进行了详细规定，兼顾投资者回报及公司业务发展，股利分配政策更为完善合理。

三、长期回报规划

公司重视股东的合理投资回报，将持续增强利润分配决策的透明度和可操作性，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并保证股利分配政策的连续性和稳定性。公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司的利润分配方案应充分考虑公司现金流状况、业务发展情况等

因素。在公司盈利、符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。

公司回报规划应当着眼于公司的战略发展规划及可持续经营情况，综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从现实与长远两个方面综合考虑股东利益，建立对投资者科学、持续、稳定的股东回报规划和机制。

四、发行人特别表决权股份、协议控制架构或类似安排的情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似安排的情况。

第十节 其他重要事项

一、重要合同

本节重要合同是指对公司报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的已履行、正在履行和将要履行的合同。

（一）销售合同

发行人根据客户交易习惯，与部分客户签订框架型的销售合同，并通过订单的方式确定服务或产品种类和价格等内容；与部分客户签订非框架型销售合同进行交易，该等合同直接明确服务或产品种类和价格。

报告期内，公司及子公司与报告期各期前**五**大客户签署的已履行、正在履行的框架合同、重大订单合同情况如下表所示：

序号	客户名称	合同内容	合同金额（万元）	签订日期	履行情况
1	客户 E	采购产品	1,656.80	2023.02.10	履行完毕
2	客户 E	采购产品	1,332.45	2023.07.12	履行完毕
3	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	采购服务	框架合同	2023.02.01	履行完毕
4	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	采购物料	框架合同	2023.02.10	**履行完毕**
5	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	采购服务	框架合同	2024.04.29	**履行完毕**
6	展讯通信（上海）有限公司	采购产品	框架合同	2022.12.07	履行中
7	展讯通信（上海）有限公司	产品与测试服务	框架合同	2023.01.30	履行完毕
8	展讯通信（上海）有限公司	延长期限，更新报价单	框架合同	2023.09.27	履行完毕
9	展讯通信（上海）有限公司	延长期限，更新报价单	框架合同	2024.12.31	**履行完毕**
10	客户 A	产品与测试服务	框架合同	2025.05.26	**履行完毕**
11	客户 A	产品与测试服务	框架合同	2023.06.20	履行中
12	绍兴杭电集成电路研发有限公司、绍兴高新技术产业开发区开发建设有限公司	实验环境维持系统及微组装设备采购	1,719.70	2024.03.26	履行完毕
13	上海禾赛科技有限公司	采购产品	框架合同	2023.02.15	履行完毕
14	上海禾赛科技有限公司	采购产品	框架合同	2024.11.08	履行中

序号	客户名称	合同内容	合同金额（万元）	签订日期	履行情况
15	上海禾赛科技有限公司	量产测试	框架合同	2025.04.14	履行中
16	客户 D	采购产品	框架合同	2024.08.23	履行中
17	**客户 K**	**采购服务**	**框架合同**	**2025.10.27**	**履行中**

（二）采购合同

报告期内，公司及子公司与供应商签署的金额超过 1,000 万元的已履行、正在履行和将要履行的框架合同、重大订单合同情况如下表所示：

序号	供应商名称	合同内容	币种	合同金额（万元）	签订日期	履行情况
1	上海晶毅电子科技有限公司	探针台	日元	15,440.00	2023.06.10 等	履行完毕
2	赛默飞世尔电子技术研发（上海）有限公司	电子显微镜	美元	280.00	2023.05.11 等	**履行完毕**
3	滨松光子学科学仪器（北京）有限公司	PHEMOS-XC15765-01	日元	38,400.00	2023.11.06	履行完毕
4	THERMO KEYTEK LLC	静电放电测试系统	美元	262.70	2023.09.15 等	履行完毕
5	赛默飞世尔电子技术研发（上海）有限公司	电子显微镜	美元	875.92	2023.09.15 等	履行完毕
6	MICRO CONTROL COMPANY	老化测试设备	美元	160.00	2023.03.30	履行完毕
7	ADVANTEST CORPORATION	V93000SOCSystem	日元	99,171.70	2023.10.12 等	履行完毕
8	赛默飞世尔电子技术研发（上海）有限公司	电子显微镜	美元	1,162.87	2024.12.12 等	**履行完毕**
9	POWER ELECTRON TRADE LIMITED	贴片机	美元	172.76	2024.05.31	履行完毕
10	HITACHI HIGH-TECH SCIENTIFIC SOLUTIONS CO.,LIMITED	纳米探针	美元	330.00	2024.06.28 等	履行完毕
11	ADVANTEST CORPORATION	V93000SOCSeriesSystem	美元	1,423.86	2025.02.13 等	**履行完毕**
12	赛默飞世尔电子技术研发（上海）有限公司	电子显微镜	美元	1,095.56	2025.08.07 等	履行中
13	安徽凌光红外科技有限公司	热红外显微镜	人民币	1,010.00	2025.03.31 等	履行完毕
14	广州兴森快捷电路科技有限公司	PCB 板	人民币	框架合同	2024.03.26	履行中
15	**ADVANTEST CORPORATION**	**V93000 SOC 集成电路测试机**	**美元**	**977.62**	**2026.01.16 等**	**履行中**
16	**THERMO FISHER ELECTRONIC TECHNOLOGY**	**电子显微镜**	**美元**	**257.20**	**2026.02.10 等**	**履行中**

序号	供应商名称	合同内容	币种	合同金额（万元）	签订日期	履行情况
	RESEARCH AND DEVELOPMENT (SHANGHAI)CO.LTD					

注：公司各主体与同一供应商在同一会计年度签订的同类型多笔订单金额合并计算。

（三）借款合同

截至报告期末，公司及子公司自报告期初以来已履行、正在履行的重要借款合同情况如下：

单位：万元

序号	合同号	借款银行	合同金额	签订日期	借款期限	担保方式
1	《固定资产贷款合同》（编号：Z2108LN15607353）	交通银行股份有限公司上海静安支行	3,000.00	2021.08.20	2021.08.04-2025.08.04	担保、抵押
2	《固定资产贷款合同》（编号：Z2306LN15663899）	交通银行股份有限公司上海静安支行	4,000.00	2023.06.30	2023.04.25-2027.04.25	担保、抵押
3	《并购贷款借款合同》（编号：70398234540521）	上海农村商业银行股份有限公司	5,000.00	2023.08.24	2023.08.25-2028.08.24	担保、抵押
4	《固定资产借款合同》（编号：72275244570541）	上海农村商业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行	4,000.00	2024.12.19	2024.12.20-2027.12.19	担保、抵押
5	《流动资金循环借款合同》（编号：23222018001）	上海银行股份有限公司闵行支行	3,000.00	2022.06.24	2022.06.24-2023.06.16	担保
6	《流动资金借款合同》（编号：00004224010371）	上海农村商业银行股份有限公司	3,000.00	2022.07.14	2022.07.14-2023.07.13	担保
7	《非承诺性固定资产融资协议》（编号：FA818639221027-2）	花旗银行（中国）有限公司上海分行	400 万美元	2022.11.09	2022.11.09 起 12 个月	担保
8	《非承诺性固定资产融资协议》（编号：FA818639221027-1）	花旗银行（中国）有限公司上海分行	500 万美元	2022.11.09	2022.11.09 起 12 个月	担保
9	《人民币流动资金贷款合同》（编号：506134923069）	中国建设银行股份有限公司上海闵行支行	5,000.00	2023.06.26	2023.06.20-2024.06.20	担保
10	《流动资金借款合同》（编号：2023 年沪中闵贷字 01000004 号）	中国银行股份有限公司上海闵行支行	3,000.00	2023.01.10	2023.01.13-2024.01.13	担保
11	《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》（编号：31010120240001603）	中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行	5,000.00	2024.05.15	2024.05.15-2025.05.14	担保
12	《流动资金借款合同》（编号：23224032701）	上海银行股份有限公司市南分行	2,970.00	2024.06.24	2024.06.24-2025.06.19	担保
13	《人民币流动资金贷款合同》（编号：【银【沪信 e 融 2024	中信银行股份有限公司上海分行	2,000.00	2024.06.20	2024.06.20-2025.06.20	信用

序号	合同号	借款银行	合同金额	签订日期	借款期限	担保方式
	年】字/第【905988052801】号202400131150】）					
14	《人民币流动资金贷款合同》（编号：【银【沪信 e 融 2024 年】字/第【905988052801】号202400157777】）	中信银行股份有限公司上海分行	2,600.00	2024.07.24	2024.07.24-2025.07.24	信用
15	《流动资金借款合同》（编号：98432024280219）	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	3,970.00	2024.05.17	2024.05.27-2025.05.21	担保
16	《借款合同》（编号：20809200 浙商银借字 2025 第 00208 号）	浙商银行股份有限公司上海分行	4,000.00	2025.06.13	2025.06.13-2026.04.12	担保
17	《流动资金借款合同》（编号：29251000046）	中国工商银行股份有限公司上海浦东分行	4,800.00	2025.05.13	2025.05.14-2026.05.08	担保
18	《流动资金借款合同》（编号：23225025201）	上海银行股份有限公司闵行支行	4,000.00	2025.05.20	2025.05.20-2026.05.20	担保
19	《贷款合同》（编号：平银沪徐家汇贷字 20250709 第 002 号）	平安银行股份有限公司上海分行	4,200.00	2025.07.08	2025.07.09-2026.07.09	担保
20	《固定资产贷款合同》（编号：HTZ330637400GDZC2022N00A）	中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	10,000.00	2022.12.09	2022.12.09-2031.04.08	担保、抵押
21	《授信协议》（编号：121XY2022012246）	招商银行股份有限公司上海分行	3,000.00	2022.04.21	2022.04.21-2023.04.20	担保
22	《综合授信合同》（编号：232230206）	上海银行股份有限公司闵行支行	6,000.00	2023.06.07	2023.06.07-2024.05.26	担保
23	《综合授信合同》（编号：232220180）	上海银行股份有限公司闵行支行	3,000.00	2022.06.24	2022.06.24-2023.06.16	担保
24	《综合授信合同》（编号：公授信字第 026820228001000）	中国民生银行股份有限公司上海分行	2,000.00	2022.09.15	2022.09.15-2023.09.14	担保
25	《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（编号：121XY2023021667）	招商银行股份有限公司上海分行	8,000.00	2023.06.27	2023.06.27-2026.06.26	担保
26	《综合授信合同》（编号：232240327）	上海银行股份有限公司市南分行	12,000.00	2024.06.24	2024.06.24-2025.06.21	担保
27	《中信银行“信 e 融”业务合作协议》（编号：银【沪信 e 融 2024 年】字/第【905988052801】）	中信银行股份有限公司上海分行	10,000.00	2024.05.31	2024.05.31-2025.05.10	担保
28	《国内信用证议付合同（无追索权业务专用电子合同）》（编号：（ZTC290000001）浙商银国议字（2023）第 00016 号）	浙商银行股份有限公司上海分行	6,340.00	2023.02.23	2023.02.23-2023.12.29	信用
29	《综合授信合同（适用于单位流动资金类业务）》	中国民生银行股份有限公司上海	8,000.00	2024.08.26	2024.08.26-2025.08.25	担保

序号	合同号	借款银行	合同金额	签订日期	借款期限	担保方式
	（编号：公授信字第02682024070001号）	分行				
30	《流动资金贷款合同》（编号：3697022025022）	中国光大银行股份有限公司上海临港新片区支行	1,000.00	2025.10.09	2025.10.09-2026.10.08	担保
31	《流动资金贷款合同》（编号：3697022025035）	中国光大银行股份有限公司上海临港新片区支行	1,000.00	2025.10.29	2025.10.29-2026.10.28	担保
32	《信托贷款合同》（编号：2025-0070-DK003）	华润深国投信托有限公司	4,000.00	2025.10.09	2025.10.09-2026.09.26	信用
33	《固定资产贷款合同》（编号：HTZ310780000GDZC2025N006）	中国建设银行股份有限公司上海闵行支行	3,120.79	2025.09.10	2025.09.10-2030.09.09	担保、抵押
34	《中信银行“信e融”业务合作协议》（编号：银【沪信e融2024年】字/第【731101202568】）	中信银行股份有限公司上海分行	1,000.00	2025.09.03	2025.09.24-2026.09.24	担保
35	**《固定资产借款合同》（编号：232250590）**	**上海银行股份有限公司闵行支行**	**30,000.00**	**2025.11.11**	**2025.11.11-2035.11.09**	**保证、抵押**
36	**《流动资金借款合同》（编号：Z2617LN15621761）**	**交通银行股份有限公司上海静安支行**	**4,100.00**	**2026.04.28**	**2026.04.24-2027.03.27**	**保证**
37	**《流动资金借款合同》（编号：31010120260000467）**	**中国农业银行股份有限公司上海张江科技支行**	**2,000.00**	**2026.01.28**	**2026.02.06-2027.02.05**	**保证**
38	**《流动资金借款合同》（编号：31010120260001091）**	**中国农业银行股份有限公司上海张江科技支行**	**1,000.00**	**2026.03.06**	**2026.04.03-2027.04.02**	**保证**
39	**《流动资金借款合同》（编号：31010120260000927）**	**中国农业银行股份有限公司上海张江科技支行**	**1,500.00**	**2026.03.06**	**2026.03.06-2027.03.05**	**保证**
40	**《固定资产借款合同》（编号：232260094）**	**上海银行股份有限公司闵行支行**	**1,090.00**	**2026.02.10**	**2026.02.10-2031.02.10**	**保证、抵押**
41	**《固定资产借款合同》（编号：232260462）**	**上海银行股份有限公司闵行支行**	**1,016.00**	**2026.06.11**	**2026.06.11-2031.06.10**	**保证、抵押**
42	**《固定资产贷款合同》（编号：HTZ310780000GDZC2026N002）**	**中国建设银行股份有限公司上海闵行支行**	**3,156.00**	**2026.03.26**	**2026.03.25-2031.03.25**	**保证、抵押**

（四）抵押/质押合同

截至报告期末，公司及子公司自报告期初以来已履行、正在履行的抵押/质押合同情况如下：

序号	合同编号	合同日期	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	是否履行完毕
1	C210811MG3101139	2021.08.20	交通银行股份有限公司上海静安支行	向交通银行申请固定资产贷款提供抵押	机器设备	2021.08.04-2025.08.04	履行完毕
2	C240313MG3104193	2024.03.24	交通银行股份有限公司上海静安支行	向交通银行申请固定资产贷款提供抵押	机器设备	2024.03.24-2027.04.25	正在履行
3	703982440800062	2024.03.20	上海农村商业银行股份有限公司	向上海农村商业银行申请固定资产贷款提供抵押	机器设备	2024.03.21-2027.03.20	正在履行
4	703982340800522	2023.08.24	上海农村商业银行股份有限公司	向上海农村商业银行申请并购贷款提供抵押	机器设备	2023.08.25-2028.08.24	正在履行
5	722752440800561	2024.12.19	上海农村商业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行	向上海农村商业银行申请固定资产贷款提供抵押	机器设备	2024.12.20-2027.12.19	正在履行
6	HTC330637400ZGDB2023N01B	2023.10.31	中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	向中国建设银行申请固定资产贷款提供最高额抵押	机器设备	2023.10.31-2031.04.08	正在履行
7	（93100000）浙商资产池质字（2022）第 12512 号	2022.06.20	浙商银行股份有限公司上海分行	向浙商银行申请流动资产贷款提供质押	大额存单	2022.06.20-2024.06.20	履行完毕
8	HTC310780000ZGDB2025N01F	2025.11.03	中国建设银行股份有限公司上海闵行支行	向中国建设银行申请固定资产贷款提供最高额抵押	机器设备	2025.09.10-2030.09.10	正在履行
9	**ZDB23226002101、BG-ZDB23226002101-01**	**2026.02.13、2026.03.13**	**上海银行股份有限公司闵行支行**	**向上海银行申请固定资产借款提供最高额抵押**	**机器设备**	**2026.02.13-2031.01.08**	**正在履行**
10	**ZDB23226009401**	**2026.03.12**	**上海银行股份有限公司闵行支行**	**向上海银行申请固定资产借款提供最高额抵押**	**机器设备**	**2026.02.10-2031.02.10**	**正在履行**
11	**ZDB23225059001**	**2026.04.03**	**上海银行股份有限公司闵行支行**	**向上海银行申请固定资产借款提供最高额抵押**	**机器设备**	**2026.04.03-2035.11.09**	**正在履行**
12	**ZDB23225059002**	**2026.06.24**	**上海银行股份有限公司闵行支行**	**向上海银行申请固定资产借款提供最高额抵押**	**机器设备**	**2026.06.24-2035.11.09**	**正在履行**

（五）其他重大合同

报告期内，公司签订的重大施工合同如下表所示：

单位：万元

序号	采购方	合同名称	合同日期	供应商名称	合同内容	合同金额	是否履行完毕
1	季丰精密	建筑装饰工程施工合同	2023.12.27	衢州宏坤环境建设有限公司	年产芯片测试专用治具 2 万套、汽车车规 PCBA30 万套装修项目	1,543.00	履行完毕
2	季丰技术	建设工程施工合同	2025.09.01	浙江联仓建设集团有限公司	季丰电子浦东技术中心施工项目	14,890.00	履行中

二、对外担保事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保事项。

三、诉讼或仲裁事项

（一）发行人的重大诉讼及仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

（二）公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司无控股股东，公司实际控制人、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员和核心人员不存在尚未了结的、对发行人正常生产经营或本次发行上市产生重大不利影响的诉讼或仲裁事项，也不存在涉及刑事诉讼的情况。

第十一节 声明

一、发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事：

郑朝晖　　倪卫华　　杨小明

毛余喜　　陶　卫　　张绍敏

杨勤法　　王泽霞　　何卫锋

审计委员会委员：

王泽霞　　杨勤法　　毛余喜

除兼任董事以外的高级管理人员：

朱　勇　　李定学　　庄振宏

邵文宗

上海季丰电子股份有限公司

2026 年 9 月 18 日

二、发行人控股股东及实际控制人声明

本人承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

实际控制人：

郑朝晖　　郑琦君

2026年9月18日

三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

肖 权

保荐代表人：

朱 喆 谈钟灵

法定代表人：

刘秋明

光大证券股份有限公司

2026年 9月 18日

保荐人（主承销商）总裁声明

本人已认真阅读上海季丰电子股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐人总裁：

刘秋明

光大证券股份有限公司

2026年 9月 18日

保荐人（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读上海季丰电子股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐人董事长：

赵 陵

光大证券股份有限公司

2026年9月18日

四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读上海季丰电子股份有限公司招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师：

王浚哲　　谢显清

沈倩雯

律师事务所负责人：

王　丽

北京德恒律师事务所

2020年9月18日

PAN-CHINA 天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

地址：杭州市钱江路 1366 号
邮编：310020
电话：（0571） 8821 6888
传真：（0571） 8821 6999

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《上海季丰电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2026〕17872 号）、《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕17873 号）及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对上海季丰电子股份有限公司在招股说明书中引用的上述审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

宋 鑫

杨文平

天健会计师事务所负责人：

沈培强

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年 九 月十八日

六、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：

（已离职） （已离职）

肖 明 施周静

资产评估机构负责人：

杨伟暾

上海立信资产评估有限公司

2026 年 9 月 18 日

关于签字资产评估师离职的说明

本机构于 2016 年 7 月 1 日出具了《上海季丰电子股份有限公司拟进行股份制改制项目资产评估报告》（信资评报字（2016）第 2079 号），签字资产评估师为肖明，现将资产评估相关情况说明如下：

截至本说明书出具之日，肖明因个人原因已于 2022 年 9 月从本公司离职，故上海季丰电子股份有限公司本次发行声明文件中资产评估机构声明无签字资产评估师肖明的签名，肖明的离职不影响本机构出具的上述资产评估报告的法律效力。

特此说明。

资产评估机构负责人签名：

杨伟暾

上海立信资产评估有限公司

2026 年 9 月 18 日

关于签字资产评估师离职的说明

本机构于 2016 年 7 月 1 日出具了《上海季丰电子股份有限公司拟进行股份制改制项目资产评估报告》（信资评报字（2016）第 2079 号），签字资产评估师为施周静，现将资产评估相关情况说明如下：

截至本说明书出具之日，施周静因个人原因已于 2018 年 3 月从本公司离职，故上海季丰电子股份有限公司本次发行声明文件中资产评估机构声明无签字资产评估师施周静的签名，施周静的离职不影响本机构出具的上述资产评估报告的法律效力。

特此说明。

资产评估机构负责人签名：杨伟暾

杨伟暾

上海立信资产评估有限公司

2026 年 9 月 18 日

天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants
地址：杭州市钱江路 1366 号
邮编：310020
电话：（0571） 8821 6888
传真：（0571） 8821 6999

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《上海季丰电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《验资报告》（天健验〔2026〕149 号、天健验〔2023〕331 号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对上海季丰电子股份有限公司在招股说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

宋 鑫

杨文平

耿 振

马晓英

天健会计师事务所负责人：

沈培强

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年二月十八日

天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants
地址：杭州市钱江路 1366 号
邮编：310020
电话：（0571） 8821 6888
传真：（0571） 8821 6999

验资复核机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《上海季丰电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《实收资本复核报告》（天健验〔2026〕154 号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对上海季丰电子股份有限公司在招股说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

宋 鑫

杨文平

天健会计师事务所负责人：

沈培强

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年九月十八日

第十二节 附件

一、备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

（一）发行保荐书；

（二）上市保荐书；

（三）法律意见书；

（四）财务报告及审计报告；

（五）公司章程（草案）；

（六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；

（七）与投资者保护相关的承诺；

（八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；

（九）发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报告及审阅报告（如有）；

（十）盈利预测报告及审核报告（如有）；

（十一）内部控制鉴证报告；

（十二）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；

（十三）股东（大）会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；

（十四）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；

（十五）募集资金具体运用情况；

（十六）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地址及时间

查阅时间：工作日上午 9:00-11:00，下午 2:00-5:00

查阅地点：发行人及保荐机构（主承销商）的住所

除以上查阅地点外，投资者可以登录深圳证券交易所指定网站查阅。

三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

（一）落实投资者关系管理相关规定的安排

1、信息披露制度和流程

公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等制定了《信息披露管理制度》，从信息披露的一般要求、信息披露的内容、信息披露的程序、信息披露管理与职责、信息披露的保密措施和责任追究等方面对信息披露进行了明确规定。

根据公司《信息披露管理制度》的有关规定，公司和相关信息披露义务人披露信息，应当真实、准确、完整，简明清晰，充分披露对公司有重大影响的信息，揭示可能产生的重大风险，不得有选择地披露部分信息，不得虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取信息，不得向单个或部分投资者透露或泄露；除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。

2、投资者沟通渠道的建立情况

为进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司投资价值，依照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等，公司制定了《投资者关系管理制度》，确立了合规性原则、平等性原则、主动性原则、诚实守信原则等投资者关系管理的基本原则。

根据《投资者关系管理制度》，投资者关系工作的主要职责包括：（1）拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；（2）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；（3）组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司董事会以及管理层；（4）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；（5）保障投资者依法行使股东权利；（6）配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；（7）统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；（8）开展有利于改善投资者关系管理的其他活动。

董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。

3、未来开展投资者关系管理的规划

本次发行上市后，公司将持续完善投资者关系管理及相关的制度措施，以保障公司与投资者实现良好的沟通，为投资者尤其是中小投资者在获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面提供制度保障；同时，公司将主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动，从而达到提升公司治理水平、实现公司整体利益最大化和切实保护投资者权益的目标。

（二）股利分配决策程序

公司在进行利润分配时，公司董事会应当结合《公司章程（草案）》、盈利情况、资金需求和股东回报规划，先制定分配预案并进行审议。董事会审议并通过利润分配方案后提交股东会审议批准。

如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者

未完全采纳的具体理由。审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当督促其及时改正。

公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（三）发行人股东投票机制的建立情况

发行人《公司章程（草案）》对股东投票机制作出了规定，包括中小投资者单独计票制、累积投票制、网络投票制、征集投票权等，具体如下：

1、中小投资者单独计票制

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者，可以单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

2、累积投票制

股东会就选举董事进行表决时，可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分开进行选举。

3、网络投票制

公司召开股东会的地点为公司的住所或股东会通知中指定的地点。股东会将设置会场，以现场会议形式召开，并可以同时采用电子通信方式召开，股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。

4、征集投票权

公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

四、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项

（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺

1、实际控制人及其一致行动人

（1）郑朝晖、李定学（同时担任董事、高级管理人员）承诺：

“自发行人股票上市之日起 36 个月（以下简称“锁定期”）内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

本人所持发行人股份在锁定期届满后 24 个月内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人在本次发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将相应进行调整）。

若发行人本次发行上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人在本次发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将相应进行调整，下同），或者发行人本次发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人于本次发行前直接或间接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。

如发行人上市后出现业绩下滑情形，本人对本人所直接或间接持有的股份作出补充锁定承诺如下：1、发行人上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定

期限 6 个月；2、发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；3、发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。前述“届时所持股份”分别指本人在发行人上市前取得、上市当年及之后第二年、第三年公司年报披露时仍持有的股份。

锁定期届满后，在本人就任发行人董事或高级管理人员时确定的任职期间内，每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%，在本人离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份。

如本人在锁定期届满后减持股份的，本人将严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。如本人届时存在法定不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持。如相关法律法规或中国证监会、深圳证券交易所对股份锁定、持股、减持有其他规定或要求的，本人将严格按照法律法规的规定或中国证监会的要求执行。

若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

（2）郑琦君、陈洋森、季铭源、上海季双、江山季兴承诺：

“自发行人股票上市之日起 36 个月（以下简称“锁定期”）内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

本人/本企业所持发行人股份在锁定期届满后 24 个月内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人在本次发行上市后至本人/本企业减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将相应进行调整）。

若发行人本次发行上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人在本次发行上市后至本人/本企业减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将相应进行调整，下同），或者发行人本次发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人/本企业于本次发行前直接或间接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。

如发行人上市后出现业绩下滑情形，本人/本企业对本人/本企业所直接或间接持有的股份作出补充锁定承诺如下：1、发行人上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；2、发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；3、发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月。前述“届时所持股份”分别指本人/本企业在发行人上市前取得、上市当年及之后第二年、第三年公司年报披露时仍持有的股份。

如本人/本企业在锁定期届满后减持股份的，本人/本企业将严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。如本人/本企业届时存在法定不得减持股份的情形的，本人/本企业不得进行股份减持。如相关法律法规或中国证监会、深圳证券交易所对股份锁定、持股、减持有其他规定或要求的，本人/本企业将严格按照法律法规的规定或中国证监会的要求执行。

若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。”

2、本次发行上市申请前 12 个月内取得发行人股份（以下简称“突击入股股份”）的新增股东（含本次发行上市申请前 6 个月受让实际控制人控制企业持有的股份）芜湖聚源、江阴瀚联、厦门同琅、共青城创丰、大零号湾、畅享季、交大小苗、苏州清石、渝兴益华贰号、新锐克胜、曾劲涛、张军承诺：

“本人/本企业自取得突击入股股份之日起 36 个月内，且自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的突击入股股份，也不由发行人回购该部分股份，前述锁定期以届满时间较晚者为准。

前述突击入股股份中，如涉及在本次发行上市申请前 6 个月内受让自发行人实际控制人控制企业持有的股份，则该等股份比照实际控制人关于股份锁定的承诺进行锁定，即自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的该等股份，也不由发行人回购该等股份。

如本人/本企业在前述锁定期届满后减持股份的，本人/本企业将严格按照《公

司法》《证券法》及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。如本人/本企业届时存在法定不得减持股份的情形的，本人/本企业不得进行股份减持。如相关法律法规或中国证监会、深圳证券交易所对股份锁定、持股、减持有其他规定或要求的，本人/本企业将严格按照法律法规的规定或中国证监会的要求执行。

若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。”

3、本次发行上市申请前 6 个月内受让实际控制人控制企业持有的股份（以下简称“受让股份”）的股东柴春波承诺：

“本人所持有的受让股份，比照实际控制人关于股份锁定的承诺进行锁定，即自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的受让股份，也不由发行人回购该部分股份。

自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的除前述受让股份之外的其他发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

如本人在前述锁定期届满后减持股份的，本人将严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。如本人届时存在法定不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持。如相关法律法规或中国证监会、深圳证券交易所对股份锁定、持股、减持有其他规定或要求的，本人将严格按照法律法规的规定或中国证监会的要求执行。

若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

4、其他自然人股东郑建生、谢丽、徐莺、张群仙承诺：

“自发行人股票上市之日起 12 个月（以下简称“锁定期”）内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

如本人在锁定期届满后减持股份的，本人将严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。如本人届时存在法定不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持。如相关法律法规或中国证监会、深圳证

券交易所对股份锁定、持股、减持有其他规定或要求的，本人将严格按照法律法规的规定或中国证监会的要求执行。

若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

5、其他非自然人股东嘉善芯创、苏州元禾、财通创新、福州嘉衍、俱成秋实、沪电股份、渝富益华、尚成一号、芜湖信芯、嘉兴君源、俱成秋实贰号、绍兴绿杉、南通中皋、春山锐卓、湖州创投、天津合泰、衢州金藤、思瑞浦、衢州绿发、普冉股份、嘉兴君晋、商络电子、成都励石、上海丽平承诺：

“自发行人股票上市之日起 12 个月（以下简称“锁定期”）内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

如本企业经营期限在前述锁定期届满前到期的，本企业承诺届时将营业期限展期至前述锁定期届满之后。

如本企业在锁定期届满后减持股份的，本企业将严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。如本企业届时存在法定不得减持股份的情形的，本企业不得进行股份减持。如相关法律法规或中国证监会、深圳证券交易所对股份锁定、持股、减持有其他规定或要求的，本企业将严格按照法律法规的规定或中国证监会的要求执行。

若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。”

（二）关于股份锁定期满后持股意向、减持意向的承诺

1、5%以上股东（及其一致行动人）及持有股份的董事、高级管理人员承诺：

“本人/本企业持续看好发行人及其所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人的股份。

本人/本企业将严格遵守已做出的关于本次发行上市前股份锁定的承诺，在股份锁定期内不减持持有的发行人股票。

股份锁定期届满后，本人/本企业减持股票的，将严格遵守中国证监会及深

圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，保证发行人的稳定经营。如本人/本企业确定减持所持发行人股份，本人/本企业届时将按照法律、法规等规定提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人。

本人/本企业在承诺的股份锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格（如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。本人/本企业将严格遵守中国证监会及证券交易所关于减持的相关规定，考虑稳定发行人股价、资本运作、长远发展等因素并根据自身需要审慎减持所持有的发行人股份。

本人/本企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人/本企业减持所持有的发行人股份时，若通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，将在首次减持前 15 个交易日予以公告；通过其他方式减持公司股份的，将提前 3 个交易日予以公告。未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持发行人股份，此外还应符合相关法律、行政法规、部门规章的规定及深圳证券交易所的其他规则并及时、准确地履行信息披露义务。

如果中国证监会和深圳证券交易所对持股及减持另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。

若本人/本企业因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。”

（三）关于股价稳定的承诺

1、发行人承诺：

“自公司上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将根据当时有效的法律、法规、规范性文件、《上海季丰电子股份有限公司章程》等规定启动《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》，并与实际控制人、非独立董事、高级管理人员协商一致提出稳定股价的具体方案，并及时履行相应的审批程序和信息披露义务。公司公告

稳定股价方案后，如公司股票连续 10 个交易日收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产时，公司将停止实施股价稳定措施。公司保证稳定股价措施实施后，公司的股权分布仍应符合上市条件。

若公司情况触发启动条件，且公司情况同时满足监管机构对于回购等股本变动行为规定的，公司承诺按照《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》的规定回购公司股票或采取其他稳定股价措施。

在启动条件满足时，如公司未采取前述稳定股价的具体措施，公司承诺接受《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》中规定的约束措施。”

2、实际控制人承诺：

“本人将无条件遵守《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》的相关规定，履行相关各项义务。

自公司上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，且公司情况同时满足监管机构对于增持等股本变动行为规定的，本人承诺依照《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》中规定的相关程序通过增持公司股票等方式启动稳定股价措施。

在启动条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人承诺接受《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》中规定的约束措施。”

3、非独立董事（不含未在公司领薪的非独立董事）、高级管理人员承诺：

“本人认可公司股东会审议通过的《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》。

若公司触发需采取稳定股价的情形，本人承诺将督促公司履行稳定股价事宜的决策程序；涉及本人在公司召开董事会对稳定股价作出决议时，本人承诺就该等稳定股价事宜在董事会中投赞成票。

本人将无条件遵守《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》的相关规定，履行相关各项义务。”

（四）关于填补被摊薄即期回报措施的承诺

1、发行人承诺：

“（1）积极实施募投项目，提升公司盈利水平和综合竞争力

本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司的持续盈利能力及市场竞争力。公司董事会对募集资金投资项目进行了充分的论证，在募集资金到位后，公司将积极推动募投项目的实施，积极拓展市场，进一步提高收入水平和盈利能力。

（2）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用

公司已按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定制定《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效的使用募集资金，本次募集资金到账后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金按照规定用于指定的投资项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

（3）积极提升公司核心竞争力，规范内部制度

公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，加大研发投入，扩大产品与技术领先优势，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

（4）优化利润分配制度，强化投资者回报机制

公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了公司上市后三年股东分

红回报规划，明确公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。

本次发行完成后，公司将严格执行利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

（5）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断优化治理结构、加强内部控制，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保审计委员会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。”

2、实际控制人承诺：

“（1）不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益；

（2）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

3、董事、高级管理人员承诺：

为降低本次发行摊薄即期回报的影响，发行人的董事、高级管理人员承诺如下：

（1）忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法利益。

（2）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。

（3）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

（4）本人承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

（5）促使董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

（6）若公司后续制定股权激励政策，本人将尽职促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

本承诺函出具后至发行人首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且发行人及其实际控制人、董事、高级管理人员做出的上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，发行人及其实际控制人、董事、高级管理人员承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

（五）关于避免同业竞争的承诺：实际控制人及其一致行动人

“截至本承诺函签署之日，除发行人及其控股子公司（含直接或间接控制的企业，下同）外，本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业不存在从事与发行人及其控股子公司的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争且对发行人及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动。本企业/本人亦不会在中国境内外从事、或直接/间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）通过控制的其他企业从事与发行人及其控股子公司的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争且对发行人及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动。

如果未来本企业/本人控制的其他企业所从事的业务或所生产的最终产品构成对发行人及其控股子公司造成重大不利影响的竞争关系，本企业/本人承诺发行人有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决所构成重大不利影响的同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购本企业/本人控制的其他企业的股权、资产；要求本企业/本人控制的其他企业将构成同业竞争的股权、资产、业务转让给无关联的第三方；如果本企业/本人控制的其他企业获得了新的与发行人及其控股子公司的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，本企业/本人控制的其他企业将授予发行人及其控股子公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，发行人及其控股子公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。”

如违反上述承诺给发行人造成损失的，本企业/本人将依法承担赔偿责任。

（六）关于规范关联交易的承诺：实际控制人及其一致行动人，5%以上股东及其一致行动人、董事、高级管理人员

“本人/本企业将尽量避免与发行人之间的关联交易。

对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/本企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与发行人签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护发行人及其他股东的利益。

本人/本企业保证不利用在发行人的地位和影响通过关联交易损害发行人或其他股东的合法权益，或利用关联交易转移、输送利润，或违规占用、转移发行人的资金、资产及其他资源，或要求发行人违规提供担保。

本承诺在发行人存续且本人/本企业依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为发行人关联方期间内持续有效。”

（七）关于欺诈发行上市的股份购回承诺

1、发行人承诺：

“发行人保证本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。

如发行人不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，发行人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。购回价格按照中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件依法确定。”

2、实际控制人承诺：

“本人保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。

如发行人不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。购回价格按照中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件依法确定。”

（八）关于依法赔偿投资者损失的承诺

1、发行人承诺：

“公司首次公开发行招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

若证券监督管理部门或其他有权部门认定公司首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司承诺将依法回购公司首次公开发行的全部新股，方式如下：

（1）若上述情形发生于公司首次公开发行股票已经完成但未上市交易之前，则公司将于有权机关对上述情形作出相应决定之日起 10 个工作日内，基于法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，依照发行价并加算银行同期存款利息返还给网上中签投资者及网下配售投资者。

（2）若上述情形发生于公司首次公开发行股票已经完成且上市并交易之后，则公司将于有权机关对上述情形作出相应决定之日起 10 个交易日内，基于法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东会，启动股份回购措施。回购价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格与银行同期活期存款利息之和（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，回购底价按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。

若证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。

有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分须经有权机关生效法律文件确认。在证券主管部门或司法机关认定公司存在前述违法违规情形后，公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额向投资者依法进行赔偿。若法律法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，公司自愿遵从

该等规定。

若违反本承诺，不及时进行回购或赔偿投资者损失的，公司将在股东会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会投资者道歉，股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求公司履行承诺。因不履行承诺造成股东及社会公众投资者损失的，公司将依法进行赔偿。”

2、实际控制人承诺：

“发行人首次公开发行招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

若证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人首次公开发行招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，具体操作办法根据届时有关法律法规执行。

若证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，方式如下：

（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人因此应当依法承担责任的，本人在收到该等认定书面通知后 10 个交易日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。

（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

如未履行上述承诺，本人将在发行人股东会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人社会公众投资者道歉，并在前述认定发生之日起停止领取薪酬及现金分红（如有），同时不得转让持有的发行人股份，直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。”

3、董事、高级管理人员承诺：

“发行人首次公开发行招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

若证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。具体操作办法根据届时有关法律法规执行。

若证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，方式如下：

（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人因此应当依法承担责任的，本人在收到该等认定书面通知后 10 个交易日内，将与发行人及其实际控制人等相关主体启动赔偿投资者损失的相关工作。

（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

如未履行上述承诺，本人将在发行人股东会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人社会公众投资者道歉，并在前述认定发生之日起停止领取薪酬及现金分红（如有），同时不得转让持有的发行人股份（如有），直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。”

（九）关于社会保险及住房公积金问题的承诺：实际控制人

“如发行人及其控股子公司因首次公开发行前未严格遵守劳动用工相关法律法规及规范性文件被有权机关处罚的，或未严格执行为员工缴纳社会保险和住房公积金政策事宜被有权机关处罚或要求补缴社会保险或住房公积金的，或因未足额缴纳需要承担任何罚款、滞纳金，或因有关人员向发行人及其控股子公司追索，或因上述情形给发行人或其控股子公司造成损失的，本人将对发行人及其控

股子公司作出全额补偿，并承担连带责任，且在承担后不向发行人及其控股子公司追偿，保证发行人及其控股子公司不会因此遭受任何损失。”

（十）关于避免资金占用的承诺：实际控制人

“截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业不存在非经营性占用发行人或其子公司资金的情况，也不存在由发行人或其子公司为本人及本人控制的其他企业提供担保的情况。

本人保证依法行使股东权利，不滥用实际控制人地位损害发行人或其他股东的利益，不以借款、代偿债务、代垫款项等方式直接或间接占用发行人或其子公司资金或要求发行人或其子公司违规提供担保。

如因本人违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿给发行人或其他股东造成的损失。”

（十一）关于发行人历史上出资瑕疵事项的承诺：实际控制人

“若因公司（或其前身）在历史发展阶段曾存在出资方面的瑕疵（以下简称“该等出资瑕疵”）导致任何有权机关（包括但不限于监管部门、司法机关）认定发行人股东（包括本人）存在出资不实、未足额出资或出资存在其他权利瑕疵等情形，并要求补足出资、返还出资或承担其他责任的，本人将无条件承担全部责任，并以现金方式及时、足额地向发行人补足相应出资及其可能产生的利息，确保发行人的资本充实，不会因此遭受任何损失。

若因该等出资瑕疵，导致发行人或其前身需要承担任何罚款、滞纳金或其他经济损失，或因该等出资瑕疵引发任何争议、诉讼、仲裁，并导致发行人需要支付赔偿金、违约金、诉讼费、律师费等任何费用或遭受损失的，本人将全额承担该等所有费用及损失，确保发行人不会因此遭受任何经济损失。

本人确认，尽管存在历史上的出资瑕疵，但发行人是合法设立并有效存续的法人主体，其目前注册资本已充实，股权权属清晰，该等历史瑕疵不影响发行人主体的合法有效存续，亦不构成本次发行上市的实质性法律障碍。若因该等瑕疵导致上述判断被有权机关否定，本人将承担由此引发的一切后果。”

（十二）关于发行人历史沿革中可能存在的税务问题的承诺：实际控制人

“若因公司在本次发行上市前因虚拟股安排、整体变更设立股份公司、股权转让、享受税收优惠等事项存在任何税务问题，导致公司被税务机关追缴税款、滞纳金或罚款，或因税务问题遭受任何经济损失，均属于本人承担责任的范畴。

对于上述范围内的任何税务补缴、处罚或损失，本人将承担全部责任，并向公司提供全额、无条件的现金补偿，确保公司自身不因此遭受任何经济损失。

本人将以个人全部资产（包括但不限于持有的公司股份及其他财产）作为履行本承诺的保证。公司有权从应付给本人的分红、薪酬等任何款项中直接扣划相应资金。”

（十三）关于未履行公开承诺的约束措施：发行人及其相关主体

“如发行人及其相关主体非因不可抗力未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则将采取以下约束措施：1．及时、充分披露承诺事项未能完全有效履行的具体原因，并向社会公众投资者道歉；2．相关承诺可以继续履行的应继续履行，如无法继续履行，应向投资者提出补充承诺或替代承诺；3．对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；4．自完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，发行人将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；5．给投资者造成直接损失的，应当依法赔偿投资者的损失；因违反承诺有违法所得的，按相关法律法规处理；6．根据届时法律、法规规定可以采取的其他措施。

如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，发行人及相关主体需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1．公开说明未履行的具体原因并向社会公众投资者道歉；2．尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东会审议，尽可能地保护投资者利益。”

（十四）关于为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：保荐人、天健会计师、德恒律师、立信评估

“因本公司在发行人首次公开发行股票并在创业板上市工作期间未勤勉尽责，导致本公司制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投

资者造成实际损失的，在该等违法事实被认定后，将依法赔偿投资者损失。”

（十五）关于股东信息披露的专项承诺的承诺：发行人

“1．公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息，公司股东均依法有效存续，具备法律、法规、规章和规范性文件规定的持有公司股份的资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形。

2．公司历史沿革中存在的股权代持、委托持股等情形已彻底解除，不存在股份权属纠纷或潜在纠纷。

3.本次发行上市的中介机构光大证券股份有限公司、北京德恒律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份的情形。

4．截至本承诺函出具日，公司直接或间接自然人股东不属于《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》规定的证监会系统离职人员或其父母、配偶、子女及其配偶，不存在证监会系统离职人员或其父母、配偶、子女及其配偶直接或间接入股的情形。

5．公司股东不存在以公司股份进行不当利益输送的情形。

6．公司及公司各股东已经及时向本次发行上市的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合本次发行上市的中介机构开展尽职调查，依法履行信息披露义务。

若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”

五、股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

（一）股东会、董事会、监事会的建立健全和运行情况

公司股东会是最高权力机构，由全体股东组成，股东会按照《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关规定行使职权。

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定行使职

权。公司现任董事中 2 人兼任高级管理人员，少于董事总人数的二分之一。

公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权。2025 年 9 月 30 日，发行人召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，取消监事会并以审计委员会承接监事会职权。公司监事会取消前曾由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会取消前按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定规范运作，有效履行了监督等职责。

自股份公司成立以来，公司股东会、董事会、监事会在召集、议事、表决等方面能够严格按照相关法律法规和公司各项制度合法、有效执行。

（二）独立董事制度的建立健全和运行情况

为进一步规范法人治理结构，建立科学完善的现代企业制度，促进公司规范运作，公司聘任了王泽霞、杨勤法、何卫锋为公司独立董事。上述独立董事当选后参加了历次董事会会议并参与表决。此外，公司制定了《独立董事工作制度》。本公司 9 名董事会成员中，独立董事人数为 3 人，不少于董事总人数的三分之一，且其中 1 名为会计专业人员。

公司所聘任的独立董事除对相关事项发表独立意见外，还在董事会下设的专门委员会中发挥重要作用：独立董事担任审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会召集人。独立董事能够严格按照相关法律法规以及《公司章程》等规定勤勉尽责履行职责，审慎独立对待审议事项并发表意见，维护公司整体利益及中小股东合法权益，为董事会决策提供专业意见，促进公司治理进一步完善。

（三）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司设董事会秘书 1 名，由邵文宗担任。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司董事会秘书的主要职责为负责公司信息披露管理事务；协助公司董事会加强公司治理机制建设，组织筹备并列席公司董事会和股东会会议；负责公司投资者关系管理事务，包括公司投资者的沟通、接待等工作。公司董事会秘书自任职以来，按照《公司法》《公司章程》

认真履行了各项职责。

六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

截至本招股说明书签署日，公司董事会各专门委员会的人员构成如下：

序号	专门委员会名称	专门委员会成员	召集人
1	审计委员会	王泽霞、杨勤法、毛余喜	王泽霞
2	战略委员会	郑朝晖、何卫锋、陶卫	郑朝晖
3	提名委员会	何卫锋、郑朝晖、陶卫	何卫锋
4	薪酬与考核委员会	杨勤法、王泽霞、倪卫华	杨勤法

2025 年 9 月 30 日，发行人召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《董事会审计委员会工作细则》，决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权。

公司董事会各专门委员会自设立以来，按照法律法规、《公司章程》以及公司各专门委员会议事规则等相关规定履行相关职责。公司各专门委员会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

七、募集资金具体运用情况

（一）浦东技术中心项目

1、项目概况

本项目旨在上海市浦东新区新建第三方实验室检测分析项目，面向芯片设计、晶圆制造、封装等半导体全产业链企业，提供失效分析、材料分析、可靠性测试等第三方实验室检测分析服务。

2、项目投资概算

本项目预计投资人民币 45,000 万元。其中，工程建设投资为 20,423.57 万元，设备购置费用为 20,807.93 万元，项目预备费为 2,061.58 万元，铺底流动资金为 1,706.92 万元。

单位：万元

序号	项目	T+1	T+2	T+3	合计投资额
一	**工程建设投资**	**16,667.40**	**3,756.17**	**-**	**20,423.57**

序号	项目	T+1	T+2	T+3	合计投资额
1.1	土地购置费用	7,903.00	-	-	7,903.00
1.2	建筑工程费用	8,347.04	3,577.30	-	11,924.35
1.3	建筑工程其他费用	417.35	178.87	-	596.22
二	**设备购置费用**	**-**	**8,530.77**	**12,277.16**	**20,807.93**
三	**项目预备费**	**833.37**	**614.35**	**613.86**	**2,061.58**
四	**铺底流动资金**	**1,706.92**	**-**	**-**	**1,706.92**
合计		**19,207.69**	**12,901.29**	**12,891.02**	**45,000.00**

3、项目实施的可行性分析及与公司业务的关系

（1）项目实施的可行性分析

①公司在本项目从事的业务上已形成较强的市场地位与客户资源

本项目是公司现有半导体第三方实验室检测分析业务的产能扩充项目，在上海浦东新增检测设备、扩充场地，形成浦东技术中心。对于本项目从事的第三方实验室检测分析业务，公司已形成良好的业务基础与市场地位，2025 年，公司第三方实验室服务收入为 42,437.31 万元，业务规模居于中国大陆前列。

经过多年发展，公司已积累了覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试等产业链各环节的客户群体，累计服务客户数量超过 3,000 家。现有客户在研发验证、工艺调试、良率分析、可靠性认证等环节存在持续性需求，为公司提供了稳定且可预期的订单来源，为新建实验室投产初期的产能爬坡提供了基础订单保障。同时，随着客户自身技术升级，其检测需求在深度与广度上持续提升，先进制程、车规级芯片等高附加值案件的分析复杂度显著增加，单个案件所需设备类型、使用时长及价值量均有明显增长。本项目新增的高端设备与扩充的检测能力，可更好地满足现有客户日益增长的高端分析需求，实现对存量客户价值的深度挖掘。

②市场空间广阔，为项目提供坚实基础

半导体第三方实验室检测分析市场正迎来持续扩容的战略机遇期。首先，集成电路国产化进程加速，国内芯片设计、晶圆制造、封测等企业在研发验证、工艺调试、良率提升等环节对第三方检测服务的需求持续增长。其次，汽车电子、工业控制、人工智能等高可靠性应用对芯片质量提出更高要求，如车规级认证标准（如 AEC-Q100）推动检测项目扩项及检测成本提升，单客户价值贡献持续增

加。此外，先进制程、先进封装及第三代半导体的普及，显著增加了检测分析的复杂性与必要性，单个案件的分析难度与设备使用价值量不断提升。在上述因素叠加下，半导体第三方检测市场空间持续扩张，为本项目产能消化提供了充足的市场容量。

③上海浦东区位优势显著，可实现本地化高效服务

上海浦东新区（尤其是张江科学城、临港新片区）是我国集成电路产业规模最大、产业链最完整的区域之一，集聚了超过 200 家芯片设计企业、多家头部晶圆制造厂、先进封装基地及设备材料龙头企业。公司本次新建实验室选址上海浦东，可实现对目标客户的近距离覆盖，显著缩短样品运输时间，满足半导体企业对检测分析“时效性优先”的核心诉求。同时，公司现有实验室受场地与设备容量限制，部分高端设备处于高负荷运行状态，通过本次新建实验室新增核心设备并扩充场地，可进一步优化资源配置，有效满足现有客户持续增长的分析需求，提升对核心客户的服务保障能力。

④技术优势突出，为项目市场竞争力提供有力支撑

公司在先进制程检测能力方面已覆盖 3nm 芯片，设备最先进检测能力可达到 2nm 及以下芯片，处于行业前列；在可靠性测试方面具备单芯片 800W 功率的整体方案能力，在关键技术指标与方案落地能力上处于行业较高水平；在高端线路修补方面配备了红外热像仪支持背开模式、GDS 自动导航定位软件，更适配于先进制程产品的线路修补。同时，公司形成了覆盖样品制备、高端线路修补、失效定位、材料分析等关键环节的完整技术体系，并拥有 140 项专利（其中发明专利 58 项）及多项国际认可的资质认证。依托本项目新增的高端设备与扩充的技术团队，公司将进一步强化技术领先优势，有效拓展新客户群体，为项目持续获客提供有力支撑。

（2）与公司业务的关系

本项目系公司为进一步扩充第三方实验室检测业务产能，在上海浦东新增检测设备、扩充场地，以形成浦东技术中心，从而提升高端检测服务能力，完善公司在集成电路第三方实验室检测领域的区位布局。

4、项目实施进度安排

本项目预计建设工期为 3 年，项目进度计划内容如下：

序号	实施步骤	T+1年				T+2年				T+3年				T+4年	T+5年	T+6年	T+7年	T+8年	T+9年	T+10年
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8							
1	项目规划																			
2	厂房建设																			
3	设备采购																			
5	设备安装及调试																			
6	正式投产																			
7	产能爬坡																			
8	项目达产																			

5、投资项目的选址、环保影响及措施

本项目由发行人子公司上海季丰技术有限公司实施，项目建设地址位于上海市浦东新区北蔡镇。项目实施主体已通过出让方式取得该项目用地的产权证书（沪〔2025〕浦字不动产权第 084159 号）。

本项目将在生产过程中严格遵守国家和地方的法律法规，严格执行建设项目环境评价和环境管理制度。项目生产过程中产生的废水、废气、固体废弃物、噪声和危险废物均经过相应的环保设施处理，对周围环境不会造成污染，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。

本项目已取得上海市企业投资项目备案证明（上海代码：310115MAD9C1PE020251D3101002）。本项目已取得**沪浦环保许评〔2026〕119 号《上海市浦东新区生态环境局关于季丰电子浦东技术中心项目（调整）环境影响报告表的审批意见》**。

（二）车规级高可靠量产测试服务建设项目

1、项目概况

本项目旨在浙江省嘉兴市嘉善县进一步扩充量产测试业务产能，依托自动化测试设备、老化测试机、数字化管理系统以及覆盖宽温区的测试环境，主要服务于高可靠性芯片（如车规级芯片）的测试需求，为客户提供晶圆测试（CP）、成品测试（FT）、系统级测试（SLT）以及老化测试（BI）。

2、项目投资概算

本项目预计投资人民币 20,477.87 万元。其中，设备购置费 18,477.97 万元，项目预备费为 923.90 万元，铺底流动资金 1,076.00 万元。

单位：万元

序号	项目	T+1	T+2	合计投资额
一	设备购置费	11,086.78	7,391.19	18,477.97
二	项目预备费	554.34	369.56	923.90
三	铺底流动资金	1,076.00	-	1,076.00
合计		**12,717.12**	**7,760.75**	**20,477.87**

3、项目实施的可行性分析及与公司业务的关系

（1）项目实施的可行性分析

①车规级量产测试的市场空间广阔、增长确定性高

车规级量产测试市场空间广阔、增长确定性高，为本项目产能消化提供了坚实的市场基础。首先，汽车电动化与智能化趋势加速推进，单车芯片用量从传统燃油车的 300-500 颗提升至电动智能汽车的 1,000-2,000 颗，带动车规级芯片测试需求呈指数级增长。其次，车规级芯片对可靠性要求极为严苛，需满足 AEC-Q100 等标准，测试项目覆盖温度循环、HTOL、ESD、Latch-up 等，测试周期长、项目多、成本高，单颗芯片的测试价值量显著高于消费级芯片。再次，国内车规级芯片国产化进程加速，越来越多本土芯片企业进入车规供应链，但多数设计企业缺乏自建量产测试能力，对第三方专业测试服务的需求迫切。此外，随着新能源汽车渗透率持续提升及自动驾驶向 L3/L4 级演进，对 MCU、功率芯片、传感器、通信芯片等车规级芯片的测试需求将持续释放。根据集微咨询数据，2025 年中国大陆车规芯片测试市场规模为 75.6 亿元，预计 2027 年将达到 93.1 亿元，年均复合增长率为 11.0%。

②公司现有客户从研发端向量产端延伸，形成可预期的订单来源

公司经过多年发展，已积累覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试等产业链各环节的客户群体超过 3,000 家，其中部分客户已进入或正在布局车规级芯片领域，为本项目提供了客户转化基础。目前，公司主要为上述客户提供失效分析、可靠性测试等研发阶段的检测服务，随着客户车规级芯片逐步完成设计验证并通过认证，其需求自然延伸至量产测试环节，公司可依托现有合作基础，将服务链条从研发端延伸至量产端，实现从工程批测试到大批量量产测试的客户价值深度挖掘。这一过程中，单客户测试订单量有望实现数倍甚至数十倍增长，且量产测试客户

切换供应商的成本较高，一旦切入，合作关系具有较强的稳定性和持续性。因此，现有客户从研发到量产的延伸需求，为本项目提供了可预期的订单来源。

③公司具备一定差异化优势和客户拓展能力

公司可通过独特的差异化优势和较强的市场销售团队，有效拓展尚未合作的车规级芯片企业新客户。公司在第三方实验室检测分析、集成电路测试板等领域积累的技术经验与专业口碑，有助于降低车规级客户对公司量产测试质量的信任门槛。尤其在系统级测试（SLT）和老化测试（BI）方面，公司具备差异化的技术能力与方案优势，形成了区别于竞争对手的核心竞争力。在本项目投资之前，公司已拥有一定的量产测试能力，结合本次项目的产能扩充，预计将初步达到大客户对产能规模的门槛要求，从而有利于导入更多优质车规级客户。目前，公司在量产测试业务客户拓展方面能力较强，预计禾赛科技与蔚来汽车今年量产测试需求将放量增长；另有部分客户已通过筛选或处于报价、工程验证等不同阶段，后续随着公司固定资产投资到位，相关合作有望持续推进。

（2）与公司业务的关系

本项目系公司进一步布局量产测试业务。公司量产测试业务主要服务于高可靠性车规芯片的测试需求，下游客户以国内新能源汽车品牌为主，由于单个客户测试体量较大，为顺利通过产线验证并导入整车厂客户，公司需提前布局、预留充足的测试产能，车规级量产测试业务需要“产能先行”。公司目前拥有一定的量产测试能力，结合本次项目的产能扩充，预计将初步达到大客户对产能规模的门槛要求，从而有利于导入更多优质车规级客户。

4、项目实施进度安排

本项目预计建设工期为 2 年，项目进度计划内容如下：

序号	实施步骤	T+1年				T+2年				T+3年	T+4年	T+5年	T+6年	T+7年	T+8年	T+9年	T+10年
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4								
1	项目规划																
2	设备采购及安装																
3	设备调试																
4	正式投产																
5	产能爬坡																
6	项目达产																

5、投资项目的选址、环保影响及措施

本项目由发行人子公司浙江季丰实施，建设地址位于浙江省嘉兴市嘉善县鑫

达路，本项目拟使用浙江季丰现有场地。

本项目将在生产过程中严格遵守国家和地方的法律法规，严格执行建设项目环境评价和环境管理制度。项目生产过程中产生的废水、废气、固体废弃物、噪声和危险废物均经过相应的环保设施处理，对周围环境不会造成污染，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。

本项目实施主体浙江季丰已取得浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（项目代码：2603-330421-04-01-846835）；本项目无需办理环评。本项目已履行了项目建设所需的审批、核准及备案手续，项目实施不存在障碍。

（三）芯片中试平台工程技术研发项目

1、项目概况

本项目为芯片中试平台工程技术研发项目，核心建设内容为围绕三大行业关键共性技术研究方向进行攻关，并以此为基础构建面向高端芯片领域的中试服务能力，具体包括：“大功率先进芯片可靠性测试方案研究”“先进封装芯片互连失效机理与分析方法研究”以及“动态热点分析中测试向量推送装置研发”。

本项目定位为集成电路产业关键基础设施，旨在依托公司在高端芯片测试领域的技术积累，攻克从实验室到量产（Lab to Fab）的工程技术瓶颈，构建面向大功率与先进芯片的开放式测试验证中试平台。平台重点聚焦当前市场需求最为迫切、技术挑战最为集中的高端人工智能芯片领域，涵盖图形处理器（GPU）、智能辅助驾驶芯片（ADAS）及数据中心高性能计算（HPC）芯片等战略性关键产品。

2、项目投资概算

本项目预计投资人民币 14,800.01 万元。项目建设投资为 11,266.01 万元，其中，研发设备投入费用为 10,329.54 万元，软件投入费用为 400 万元，项目预备费为 536.48 万元；研发人员投入费用为 3,334.00 万元；其他研发投入为 200 万元。

单位：万元

序号	项目	T+1	T+2	合计投资额
一	**项目建设投资**	**7,802.21**	**3,463.80**	**11,266.01**

序号	项目	T+1	T+2	合计投资额
1.1	研发设备投入	7,230.68	3,098.86	10,329.54
1.2	软件投入	200.00	200.00	400.00
1.3	项目预备费	371.53	164.94	536.48
二	**研发人员投入**	**520.00**	**2,814.00**	**3,334.00**
三	**其他研发投入**	**100.00**	**100.00**	**200.00**
合计		**8,422.21**	**6,377.80**	**14,800.01**

3、项目实施的可行性分析及与公司业务的关系

（1）项目实施的可行性分析

①公司的人才队伍、技术积累与业务基础，为项目攻关提供核心支撑

公司集聚了一批拥有跨学科背景与丰富行业经验的优秀人才，部分成员来自国内外知名芯片设计公司、大型晶圆制造厂、第三方检测实验室以及先进检测设备企业，形成了跨领域、多背景的复合型人才架构。公司在为超过 3,000 家半导体产业链客户提供服务的过程中，积累了对各种芯片类型进行测试、对各类失效情况进行检测分析的海量案例，覆盖了从成熟制程到先进制程、从传统封装到先进封装、从消费电子到车规级芯片的广泛产品类型。

在技术体系方面，公司已形成覆盖样品制备、高端线路修补、失效定位、材料分析、测试板设计仿真、量产老化测试等关键环节的完整技术体系，在第三方实验室检测分析、集成电路测试板设计与仿真、量产测试等方面形成了一系列核心技术。其中，在先进制程检测能力方面，公司案例已覆盖 3nm 芯片，设备最先进检测能力可达到2nm及以下芯片;在可靠性测试方面,公司具备单芯片800W功率的整体方案能力；在高端线路修补方面，公司配备了红外热像仪支持背开模式、GDS 自动导航定位软件。

上述人才储备、案例积累与技术能力，为本项目围绕“大功率先进芯片可靠性测试方案研究”“先进封装芯片互连失效机理与分析方法研究”以及“动态热点分析中测试向量推送装置研发”三大方向开展技术攻关提供了坚实的核心支撑与丰富的实践验证基础。

②检测分析与检测硬件深度协同，形成独特技术能力

公司检测分析与检测硬件业务之间形成了深度协同与迭代效应，使公司具备跨领域解决复杂检测问题的独特能力，可满足 CPU、GPU、存储芯片、复杂 SoC 等高端芯片及先进工艺、先进封装等高端样品的全方位测试与检测分析需求。具体而言，检测分析服务为客户解决实际问题的同时，为公司积累了丰富的失效案例与前沿需求数据，为硬件产品的技术验证与快速迭代提供了实战基础；性能持续优化的硬件产品反哺检测分析服务，进一步提升检测效率与精准度，形成了“服务牵引硬件迭代，硬件反哺服务升级”的内生循环机制。

③优质客户深度协同，驱动技术持续迭代与创新突破

公司的优质客户群体代表了全球半导体产业的最先进技术方向与领先工艺水平，涵盖客户 D、中兴通讯、高通、紫光展锐、客户 H、长电科技等芯片设计、制造及封测领域的知名企业，其日益提升的检测需求、严格的技术标准以及对检测效率与可靠性的极致追求，持续驱动公司在检测服务与检测硬件产品两大业务板块进行技术迭代与创新突破。在与行业标杆客户的深度协同中，公司不断汲取前沿的产业洞察，反哺自身在集成电路测试板设计、实验室分析服务能力的升级，实现了从跟随需求到引领创新的能力跨越。这种与优质客户共成长的良性循环，已成为推动季丰电子技术持续进步、服务不断提升并巩固其行业地位的核心动力之一。

本项目聚焦的图形处理器（GPU）、智能辅助驾驶芯片（ADAS）及数据中心高性能计算（HPC）芯片等战略性关键产品，正是公司优质客户当前重点布局与迫切需求的方向，公司可依托与标杆客户的深度合作关系，在项目研发过程中获得明确的需求牵引与应用验证场景，从而有效降低技术攻关的不确定性，加速中试平台服务能力的成熟与落地。

（2）与公司业务的关系

本项目为芯片中试平台工程技术研发项目，旨在聚焦人工智能及高性能计算等前沿领域，布局大功率、先进制程、先进封装芯片的检测分析技术。这些前沿技术的研发将为公司现有业务的持续升级与未来发展提供关键技术储备，为公司长期发展奠定坚实基础。

4、项目实施进度安排

本项目预计建设工期为 2 年，项目进度计划内容如下：

序号	实施步骤	T+1年				T+2年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目规划								
2	设备采购								
3	设备安装及调试								
4	人员招聘与培训								

5、投资项目的选址、环保影响及措施

本项目由发行人实施，项目建设地址位于上海市闵行区友东路，拟使用发行人现有场地。

本项目将在生产过程中严格遵守国家和地方的法律法规，严格执行建设项目环境评价和环境管理制度。项目生产过程中产生的废水、废气、固体废弃物、噪声和危险废物均经过相应的环保设施处理，对周围环境不会造成污染，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。

本项目实施主体季丰电子已取得上海市企业投资项目备案证明（上海代码：31011267780827120261D3101001），本项目无需环评。本项目已履行了项目建设所需的审批、核准及备案手续，项目实施不存在障碍。

（四）补充流动资金

报告期内，公司经营规模持续增长，营业收入分别为 44,336.65 万元、58,348.29 万元、66,949.34 万元**及 37,885.76 万元，2023 年至 2025 年**营业收入复合增长率为 22.88%，公司业务规模扩大使公司对日常运营资金的需求不断增加。同时，公司是一家半导体领域检测服务与检测硬件产品的全功能、一站式解决方案提供商，所处行业具有技术驱动、研发先导的特点，公司需要通过持续的技术研发投入以确保具有市场竞争力。报告期内，公司研发投入分别为 4,405.52 万元、4,962.52 万元、5,506.10 万元**及 2,529.95 万元**，合计 **17,404.09** 万元，占**报告期**累计营业收入的比例为 **8.39%**。为了不断提升技术水平，公司未来的技术研发费用将持续增加，公司需要更多资金以应对未来技术研发的资金需求。

因此，为缓解公司营运资金压力，夯实公司发展基础，公司计划使用部分募

集资金补充流动资金。

八、发行人及其子公司拥有的专利

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	专利权人	取得方式	他项权利
1	**一种芯片测试装置和芯片测试方法**	**发明专利**	**ZL202610304809.6**	**2026.03.13**	**季丰电子**	**原始取得**	**无**
2	**一种功率循环测试装置**	**实用新型专利**	**ZL202522052074.6**	**2025.09.24**	**浙江季丰**	**原始取得**	**无**
3	一种集成电路测试设备接口板	实用新型专利	ZL201721263605.5	2017.09.28	季丰电子	原始取得	无
4	一种闪存芯片测试机	实用新型专利	ZL201820210966.1	2018.02.07	季丰电子	原始取得	无
5	一种芯片测试装置	实用新型专利	ZL201820211187.3	2018.02.07	季丰电子	原始取得	无
6	一种芯片测试及老化测试装置	实用新型专利	ZL201820211238.2	2018.02.07	季丰电子	原始取得	无
7	一种 LM2100 崩应可靠度测试机多电源模块	实用新型专利	ZL201820396967.X	2018.03.23	季丰电子	原始取得	无
8	一种芯片老化测试装置	实用新型专利	ZL201820698002.6	2018.05.11	季丰电子	原始取得	无
9	一种芯片的导通测试装置	实用新型专利	ZL201820698024.2	2018.05.11	季丰电子	原始取得	无
10	一种芯片固定安装结构	实用新型专利	ZL201820697952.7	2018.05.11	季丰电子	原始取得	无
11	一种 LM2100 崩应可靠度测试机老化板结构	实用新型专利	ZL201820376921.1	2018.03.20	季丰电子	原始取得	无
12	一种 LM2100 崩应可靠度测试机转接板	实用新型专利	ZL201821233814.X	2018.08.02	季丰电子	原始取得	无
13	用于样品的干燥装置	实用新型专利	ZL201920509332.0	2019.04.16	季丰计量	继受取得	无
14	一种自动进样器	实用新型专利	ZL201920509335.4	2019.04.16	季丰计量	继受取得	无
15	一种实验室用自动滴定仪	实用新型专利	ZL201920509102.4	2019.04.16	季丰计量	继受取得	无
16	一种半导体检测探针平台	实用新型专利	ZL201921397952.6	2019.08.27	季丰精密	继受取得	无
17	一种用于 PCB 对接测试固定的装置	实用新型专利	ZL201921511242.1	2019.09.11	季丰电子	原始取得	无
18	一种检测台底座	实用新型专利	ZL201921853152.0	2019.10.30	季丰电子	原始取得	无
19	一种芯片转接结构	实用新型专利	ZL201922333521.X	2019.12.23	季丰电子	原始取得	无

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	专利权人	取得方式	他项权利
20	一种用于测试的 COB 板	实用新型专利	ZL201921734148.2	2019.10.16	季丰电子	原始取得	无
21	一种印制电路板散热支架及印制电路板	实用新型专利	ZL201922206692.6	2019.12.11	季丰电子	原始取得	无
22	一种真空转移盒自动封闭的真空装置	实用新型专利	ZL201922216857.8	2019.12.05	季丰电子	原始取得	无
23	基于 CPLD 的测试板接口电路	实用新型专利	ZL201922097935.7	2019.11.29	季丰电子	原始取得	无
24	一种节能电路及电子产品	实用新型专利	ZL202021247207.6	2020.07.01	季丰电子	原始取得	无
25	一种具有老化板背面测试功能的老化测试机台	实用新型专利	ZL202021247194.2	2020.07.01	季丰电子	原始取得	无
26	射频信号源	外观设计专利	ZL202030620772.1	2020.10.19	季丰电子	原始取得	无
27	一种用户身份鉴权电路	实用新型专利	ZL202021783873.1	2020.08.24	季丰电子	原始取得	无
28	一种用于老化测试机台的老化板背面测试装置	实用新型专利	ZL202021251773.4	2020.07.01	季丰电子	原始取得	无
29	射频信号放大器	外观设计专利	ZL202030620348.7	2020.10.19	季丰电子	原始取得	无
30	一种可靠性实验室监控电路	实用新型专利	ZL202120412995.8	2021.02.23	季丰电子	原始取得	无
31	飞针测试辅助夹具	实用新型专利	ZL202120469910.X	2021.03.04	季丰电子	原始取得	无
32	测试夹具（Wafer 通用测试夹具）	外观设计专利	ZL202130422323.0	2021.07.05	季丰电子、浙江季丰	原始取得	无
33	PTC 铝合金载具	外观设计专利	ZL202130428882.2	2021.07.07	江山季丰	原始取得	无
34	暴露绝缘体上硅器件有源区的方法、应用和失效分析方法	发明专利	ZL202111237524.9	2021.10.25	江山季丰、季丰电子	原始取得	无
35	一种多通道扩展机箱	实用新型专利	ZL202121587335.X	2021.07.13	江山季丰	原始取得	无
36	一种超声波扫查仪高质量成像装置	实用新型专利	ZL202121690844.5	2021.07.23	季丰电子	原始取得	无
37	一种晶圆测试夹具	实用新型专利	ZL202121515537.3	2021.07.05	季丰电子、浙江季丰	原始取得	无

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	专利权人	取得方式	他项权利
38	一种环境试验装置	实用新型专利	ZL202121542913.8	2021.07.07	江山季丰	原始取得	无
39	验板机	外观设计专利	ZL202130625621.X	2021.09.18	季丰电子、浙江季丰	原始取得	无
40	射频裸晶片测试系统和测试方法	发明专利	ZL202111495073.9	2021.12.09	江山季丰、季丰电子	原始取得	无
41	电压电流监控设备	外观设计专利	ZL202130650774.X	2021.09.29	季丰电子、浙江季丰	原始取得	无
42	数字老化机	外观设计专利	ZL202130691813.0	2021.10.21	季丰电子	原始取得	无
43	一种集成电路晶圆老化测试用散热装置	实用新型专利	ZL202121007606.X	2021.05.12	江山季丰	原始取得	无
44	芯片老化测试的监测方法、电子设备和存储介质	发明专利	ZL202210051803.4	2022.01.18	江山季丰、季丰电子、浙江季丰	原始取得	无
45	多 site ATE 项目的元器件丝印摆放的调整方法	发明专利	ZL202210103621.7	2022.01.28	江山季丰、季丰电子	原始取得	无
46	砷化镓芯片封装结构中取晶粒的方法和应用	发明专利	ZL202111205743.9	2021.10.15	季丰电子	原始取得	无
47	一种高精度的多通道信号校准方法及装置	发明专利	ZL202110419528.2	2021.04.19	季丰电子	原始取得	无
48	一种样品固定装置	实用新型专利	ZL202221260280.6	2022.05.25	浙江季丰	原始取得	无
49	电阻自动测试仪	外观设计专利	ZL202230109936.3	2022.03.04	季丰科技、季丰电子	原始取得	无
50	一种 CSP 芯片测试治具	实用新型专利	ZL202123446281.8	2021.12.30	浙江季丰、季丰电子	原始取得	无
51	采用打线工艺封装的芯片的开封方法、应用和失效分析方法	发明专利	ZL202210477878.9	2022.05.05	江山季丰、季丰电子	原始取得	无
52	一种微小样品夹取装置	实用新型专利	ZL202123420497.7	2021.12.30	浙江季丰、季丰电子	原始取得	无
53	一种电镜多功能载物台	实用新型专利	ZL202220420798.5	2022.02.24	季丰科技、季丰电子	原始取得	无

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	专利权人	取得方式	他项权利
54	植球辅助载具及用于向芯片上的植球孔植入锡球的方法	发明专利	ZL202210199487.5	2022.03.02	季丰电子	原始取得	无
55	一种电压电流监控系统	实用新型专利	ZL202220484804.3	2022.02.28	季丰科技、季丰电子	原始取得	无
56	芯片失效分析的样品制备方法及样品制备设备	发明专利	ZL202111566223.0	2021.12.20	季丰电子、杭州季丰	原始取得	无
57	用于芯片老化测试的驱动电平调节电路及系统	发明专利	ZL202111574533.7	2021.12.21	季丰电子、季丰技术	原始取得	无
58	半导体激光器的故障分析方法、样品的制备方法及系统	发明专利	ZL202210189423.7	2022.03.01	江山季丰、季丰电子、深圳季丰	原始取得	无
59	一种非焊接式的连接器安装夹具	实用新型专利	ZL202221514571.3	2022.06.15	季丰科技、季丰电子	原始取得	无
60	多通道电压电流曲线测试仪	外观设计专利	ZL202230788031.3	2022.11.24	季丰计量、季丰电子	原始取得	无
61	一种回流焊治具	实用新型专利	ZL202222612923.5	2022.09.30	季丰电子	原始取得	无
62	一种适用于多种芯片测试的外壳及其压紧装置	实用新型专利	ZL202320342289.X	2023.02.28	季丰电子	原始取得	无
63	一种气动工装夹具	实用新型专利	ZL202320234352.8	2023.02.16	浙江季丰、季丰电子	原始取得	无
64	背照式 CMOS 传感器中取晶粒的方法和应用	发明专利	ZL202210099442.0	2022.01.27	季丰电子	原始取得	无
65	射频功率放大器	外观设计专利	ZL202330287211.8	2023.05.16	季丰计量	原始取得	无
66	老化机和老化机的接口板	发明专利	ZL202210002880.0	2022.01.04	季丰电子	原始取得	无
67	硫化铜-泡沫镍三维复合材料及其制备方法	发明专利	ZL201911135980.5	2019.11.19	季丰电子	原始取得	无
68	一种快速上下电电路及其控制方法	发明专利	ZL202110359407.3	2021.04.02	季丰电子	原始取得	无
69	信号的频率估计方法、装置、电子设备和介质	发明专利	ZL202210219102.7	2022.03.08	季丰电子	原始取得	无

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	专利权人	取得方式	他项权利
70	大功率芯片的功率温度循环试验方法、装置和电子设备	发明专利	ZL202111645898.4	2021.12.30	季丰电子、季丰精密	原始取得	无
71	焊接辅助工装	发明专利	ZL202211218047.6	2022.09.30	季丰电子	原始取得	无
72	电源设备的控制方法、装置、电子设备及介质	发明专利	ZL202210037154.2	2022.01.13	季丰电子	原始取得	无
73	一种集成电路老化电路板的模块化设计方法及装置	发明专利	ZL202311560557.6	2023.11.22	江山季丰、季丰电子	原始取得	无
74	一种可靠性测试规划系统及方法	发明专利	ZL202311606118.4	2023.11.29	浙江季丰、季丰电子	原始取得	无
75	芯片封装破除装置及方法	发明专利	ZL202310072551.8	2023.01.17	亦庄季峰	原始取得	无
76	一种加工加劲杆的气动工装夹具	实用新型专利	ZL202322326148.1	2023.08.29	浙江季丰	原始取得	无
77	一种热阻加热槽专用夹具	实用新型专利	ZL202322657422.3	2023.09.28	浙江季丰	原始取得	无
78	一种自动记录老化板使用时间的方法、装置和电子设备	发明专利	ZL202310347995.8	2023.04.03	季丰电子	原始取得	无
79	抬升锁止结构及探针台设备	实用新型专利	ZL202322433876.2	2023.09.07	季丰精密	原始取得	无
80	抬升定位结构及探针台设备	实用新型专利	ZL202322434076.2	2023.09.07	季丰精密	原始取得	无
81	一种 PCB 板压接夹具及压接机	实用新型专利	ZL202322852319.4	2023.10.24	季丰电子	原始取得	无
82	一种电源分配网络的优化结构	发明专利	ZL202210080836.1	2022.01.24	季丰电子	原始取得	无
83	一种灵活的温控 Socket 散热装置	实用新型专利	ZL202323257927.7	2023.11.30	季丰电子	原始取得	无
84	气体制冷机柜	外观设计专利	ZL202330795858.1	2023.12.04	季丰精密	原始取得	无
85	一种芯片测试座中自适应芯片尺寸的限位结构	实用新型专利	ZL202322754743.5	2023.10.13	季丰精密	原始取得	无
86	一种滑台结构和探针台	实用新型专利	ZL202323476222.4	2023.12.19	季丰精密	原始取得	无
87	基于 ATE 项目多 site 的布线检测方法及装置	发明专利	ZL202210512099.8	2022.05.12	江山季丰、季丰电子	原始取得	无

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	专利权人	取得方式	他项权利
88	激光三角测距传感器	发明专利	ZL201110004063.0	2011.01.11	季丰精密	继受取得	无
89	一种基于计算机视觉的线缆角度检测方法	发明专利	ZL201611211234.6	2016.12.24	季丰精密	继受取得	无
90	基于结构光的轴承油沟自动测量方法	发明专利	ZL201611259785.X	2016.12.30	季丰精密	继受取得	无
91	一种小型激光位移传感器	实用新型专利	ZL202120926183.5	2021.04.30	季丰精密	继受取得	无
92	长距型激光位移传感器	实用新型专利	ZL202121195474.8	2021.05.31	季丰精密	继受取得	无
93	一种基于双反射结构的紧凑型大量程激光三角位移传感器	实用新型专利	ZL202123110079.8	2021.12.10	季丰精密	继受取得	无
94	一种电路板和电子器件	实用新型专利	ZL202421065984.7	2024.05.15	季丰技术	原始取得	无
95	芯片可焊性实验夹持工装及焊接实验设备	实用新型专利	ZL202420240238.0	2024.01.31	季丰电子	原始取得	无
96	一种集成式升降装置及晶圆探针测试台	实用新型专利	ZL202421417599.4	2024.06.20	季丰精密	原始取得	无
97	一种丝印结构及电路板	实用新型专利	ZL202421120577.1	2024.05.21	季丰技术	原始取得	无
98	测试样品台及检测设备	实用新型专利	ZL202421426073.2	2024.06.20	深圳季丰	原始取得	无
99	一种老化测试机台、改造方法及老化测试方法	发明专利	ZL202010616705.1	2020.07.01	季丰电子	原始取得	无
100	PCB 数据中丝印数据的处理方法、装置以及电子设备	发明专利	ZL202111536840.6	2021.12.15	季丰电子	原始取得	无
101	一种降低引脚焊接短路风险的电路板、半导体组件	实用新型专利	ZL202421420584.3	2024.06.20	季丰技术	原始取得	无
102	一种印刷电路板的仿真方法及装置	发明专利	ZL202210199919.2	2022.03.02	季丰电子	原始取得	无
103	印刷电路板的仿真方法及装置	发明专利	ZL202210050392.7	2022.01.17	季丰电子	原始取得	无
104	一种节能电路、电子产品及使用方法	发明专利	ZL202010616699.X	2020.07.01	季丰电子	原始取得	无
105	SRP 样品的制备方法、研磨装置及检测方法	发明专利	ZL202210328336.5	2022.03.30	季丰电子	原始取得	无
106	元器件丝印位号的调整方法及装置	发明专利	ZL202210608793.X	2022.05.31	季丰电子	原始取得	无

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	专利权人	取得方式	他项权利
107	一种温控模块及可拼接的模块式独立温控系统	实用新型专利	ZL202422263087.3	2024.09.14	季丰精密	原始取得	无
108	离子抛光底座及离子抛光机	实用新型专利	ZL202421441142.7	2024.06.21	深圳季丰	原始取得	无
109	显微物镜的优化方法及电子设备	发明专利	ZL202510450383.0	2025.04.11	季丰电子	原始取得	无
110	PCIE 差分信号链路的多梯度衰减测试系统、方法和电子设备	发明专利	ZL202210295130.7	2022.03.23	季丰电子	原始取得	无
111	一种 PCB 板	实用新型专利	ZL202421128114.X	2024.05.22	季丰技术	原始取得	无
112	一种晶圆接受测试探针卡测试治具、测试机台	实用新型专利	ZL202422387624.5	2024.09.29	季丰精密	原始取得	无
113	芯片测试方法、装置、系统、可读存储介质及程序产品	发明专利	ZL202510926783.4	2025.07.07	亦庄季峰	原始取得	无
114	洁净空气污染检测方法、装置、终端设备及存储介质	发明专利	ZL202510990147.8	2025.07.18	季丰电子	原始取得	无
115	芯片测试设备	发明专利	ZL202511030252.3	2025.07.25	季丰电子	原始取得	无
116	一种芯片测试插座	实用新型专利	ZL202422694885.1	2024.11.06	季丰精密	原始取得	无
117	一种提供量产测试平台选型的方法	发明专利	ZL202210051415.6	2022.01.17	季丰电子	原始取得	无
118	一种二极管引脚处理装置	实用新型专利	ZL202422318173.X	2024.09.23	季丰技术	原始取得	无
119	芯片测试仪	外观设计专利	ZL202530300660.0	2025.05.27	季丰电子	原始取得	无
120	芯片测试夹具及芯片测试组件	发明专利	ZL202511384599.8	2025.09.26	季丰电子	原始取得	无
121	一种测量样件孔洞的方法	发明专利	ZL202511621802.9	2025.11.07	季丰技术、亦庄季峰	原始取得	无
122	一种测量栅氧化层厚度的方法	发明专利	ZL202511622831.7	2025.11.07	季丰技术、深圳季丰	原始取得	无
123	一种扫描电子显微镜的放大倍率校准方法	发明专利	ZL202511651848.5	2025.11.12	季丰电子、深圳季丰	原始取得	无

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	专利权人	取得方式	他项权利
124	一种 UV 箱升降放置台面	实用新型专利	ZL202520430007.0	2025.03.12	衢州季丰	原始取得	无
125	一种半导体器件的 VF-TLP 测试系统及其校准方法	发明专利	ZL202511949471.1	2025.12.23	季丰电子	原始取得	无
126	负载板边缘连接器的保护装置	发明专利	ZL202511596200.2	2025.11.04	季丰电子	原始取得	无
127	芯片失效分析方法、装置、电子设备及介质	发明专利	ZL202210132348.0	2022.02.14	季丰电子	原始取得	无
128	图像传感器处理方法和分析方法	发明专利	ZL202510711339.0	2025.05.29	季丰电子	原始取得	无
129	一种功率循环测试专用夹具	实用新型专利	ZL202423087026.2	2024.12.13	浙江季丰	原始取得	无
130	一种光伏组件表面缺陷检测装置	实用新型专利	ZL202422802224.6	2024.11.18	衢州季丰	原始取得	无
131	悬臂探针卡、悬臂探针卡的处理方法、装置及电子设备	发明专利	ZL202310524053.2	2023.05.10	季丰电子	原始取得	无
132	一种芯片失效分析去层方法	发明专利	ZL202511769616.X	2025.11.28	季丰技术、亦庄季峰	原始取得	无
133	一种微型针座及微型针台	发明专利	ZL202610188971.6	2026.02.10	季丰技术、季丰精密	原始取得	无
134	半导体测试板的通道分配检查方法、装置、设备、介质和程序产品	发明专利	CN202610537977.X	2026.04.22	季丰电子	原始取得	无
135	**高加速应力测试载板的器件布局方法、装置及电子设备**	**发明专利**	**ZL202610453945.1**	**2026.04.08**	**江山季丰**	**原始取得**	**无**
136	**显微物镜以及显微物镜架构**	**发明专利**	**ZL202310411376.0**	**2023.04.17**	**季丰电子**	**原始取得**	**无**
137	**MEMS 晶圆键合开封装置以及方法**	**发明专利**	**ZL202211539674.X**	**2022.12.02**	**季丰电子**	**原始取得**	**无**
138	**一种伸缩承载机构及高低温探针台**	**实用新型专利**	**ZL202522119943.2**	**2025.09.30**	**季丰精密**	**原始取得**	**无**
139	**芯片失效定位方法、电子设备和存储介质**	**发明专利**	**ZL202410064377.7**	**2024.01.16**	**季丰电子**	**原始取得**	**无**
140	**一种芯片失效分析夹具**	**实用新型专利**	**ZL202522118876.2**	**2025.09.30**	**亦庄季峰**	**原始取得**	**无**

九、发行人及其子公司拥有的注册商标

序号	商标	商标权人	注册号	类别	取得方式	有效期限	他项权利
1	季丰	季丰电子	42485559	9	原始取得	2021.08.21-2031.08.20	无
2	GIGA FORCE	季丰电子	38893938	35	原始取得	2020.02.28-2030.02.27	无
3		季丰电子	38888851	42	原始取得	2020.05.28-2030.05.27	无
4	GIGA FORCE	季丰电子	38886919	40	原始取得	2020.02.28-2030.02.27	无
5		季丰电子	38878848	40	原始取得	2020.07.07-2030.07.06	无
6	GIGA FORCE	季丰电子	38878843	7	原始取得	2020.02.28-2030.02.27	无
7	GIGA FORCE	季丰电子	38868792	42	原始取得	2020.02.28-2030.02.27	无

序号	商标	商标权人	注册号	类别	取得方式	有效期限	他项权利
8	季丰	季丰电子	37425854	7	原始取得	2020.01.07-2030.01.06	无
9	季丰	季丰电子	37415942	40	原始取得	2020.01.14-2030.01.13	无
10	季丰	季丰电子	37412219	42	原始取得	2020.01.07-2030.01.06	无
11	季丰	季丰电子	37403007	9	原始取得	2020.03.28-2030.03.27	无
12	GJ	季丰电子	17771589	9	原始取得	2017.02.14-2037.02.13	无
13	GIGA FORCE	季丰电子	17771580	9	原始取得	2016.10.14-2036.10.13	无
14	ProbeChip	季丰精密	33732555	9	继受取得	2019.06.14-2029.06.13	无

序号	商标	商标权人	注册号	类别	取得方式	有效期限	他项权利
15	ProbeChip	季丰精密	33740397	35	继受取得	2019.06.14-2029.06.13	无
16	IV Beast	季丰电子	70270097	9/42	原始取得	2023.09.21-2033.09.20	无
17	IV Beast	季丰电子	70259295	35	原始取得	2023.09.28-2033.09.27	无
18	StrongBoard	季丰电子	70257762	35	原始取得	2023.10.07-2033.10.06	无
19	StrongBoard	季丰电子	70273683	9/42	原始取得	2023.10.07-2033.10.06	无
20	IV Master	季丰电子	70259213	9/42	原始取得	2023.12.14-2033.12.13	无
21	PowerMaster	季丰电子	70259097	42	原始取得	2024.02.07-2034.02.06	无

序号	商标	商标权人	注册号	类别	取得方式	有效期限	他项权利
22	LabMaster	季丰电子	70256297	35/9	原始取得	2024.02.14-2034.02.13	无
23	季丰电子	季丰电子	73397247	7	原始取得	2024.03.07-2034.03.06	无
24	季丰电子	季丰电子	73390634	9	原始取得	2024.03.07-2034.03.06	无
25	季丰电子	季丰电子	73383805	40	原始取得	2024.03.07-2034.03.06	无
26	季丰电子	季丰电子	73383833	42	原始取得	2024.03.07-2034.03.06	无
27	GIGA-FORCE	季丰电子	73395474	7	原始取得	2024.03.07-2034.03.06	无
28	GIGA-FORCE	季丰电子	73433141	9	原始取得	2024.03.07-2034.03.06	无

序号	商标	商标权人	注册号	类别	取得方式	有效期限	他项权利
29	GIGA-FORCE	季丰电子	73392889	35	原始取得	2024.03.07-2034.03.06	无
30	GIGA-FORCE	季丰电子	73404156	40	原始取得	2024.03.07-2034.03.06	无
31	GIGA-FORCE	季丰电子	73386366	42	原始取得	2024.03.07-2034.03.06	无
32	GigaForce	季丰电子	74949457	7	原始取得	2024.04.28-2034.04.27	无
33	GigaForce	季丰电子	74952254	9	原始取得	2024.04.28-2034.04.27	无
34	GigaForce	季丰电子	74934885	40	原始取得	2024.04.28-2034.04.27	无
35	GigaForce	季丰电子	74936360	42	原始取得	2024.04.28-2034.04.27	无

序号	商标	商标权人	注册号	类别	取得方式	有效期限	他项权利
36	GigaForce	季丰电子	74942880	35	原始取得	2024.04.28-2034.04.27	无

十、发行人及其子公司拥有的计算机软件著作权

序号	权利人	软件名称	登记号	开发完成日	首次发表日	登记日期	取得方式	他项权利
1	季丰电子	基于 HP93000 SOC 测试平台的 GFTE01 测试软件	2016SR112991	2015.09.15	未发表	2016.05.20	原始取得	无
2	季丰电子	GFTE04 高端集成电路老化测试系统	2016SR210925	2016.01.06	2016.02.08	2016.08.09	原始取得	无
3	季丰电子	基于 D10 测试平台的 GFTE06 测试软件系统	2016SR211190	2015.12.15	2015.12.20	2016.08.09	原始取得	无
4	季丰电子	基于 J750 测试平台的 GFTE02 测试软件系统	2016SR211183	2015.05.15	2015.05.20	2016.08.09	原始取得	无
5	季丰电子	季丰 GFTE03 老化电路监控管理系统	2016SR210979	2016.02.10	2016.02.15	2016.08.09	原始取得	无
6	季丰电子	基于 V50 SOC 测试平台的 GFTE07 测试软件系统	2017SR056046	2015.07.15	2015.09.20	2017.02.27	原始取得	无
7	季丰电子	季丰电力芯片开发系统	2017SR632123	2017.06.08	2017.08.18	2017.11.17	原始取得	无
8	季丰电子	季丰 CDM Waveform 自动检测系统	2017SR634319	2017.05.19	2017.07.28	2017.11.20	原始取得	无
9	季丰电子	季丰 CB2100 Flash 芯片可靠性测试系统	2017SR635780	2017.05.12	2017.07.20	2017.11.20	原始取得	无
10	季丰电子	季丰 CB2100 崩应可靠度测试系统的 LM2100 测试软件系统	2018SR068436	2017.10.15	2017.11.20	2018.01.29	原始取得	无
11	季丰电子	微知健康指标分组软件（Andriod 版）	2019SR0451854	2015.12.21	未发表	2019.05.10	继受取得	无
12	季丰电子	微知健康指标分组软件（IOS 版）	2019SR0451850	2015.12.21	未发表	2019.05.10	继受取得	无
13	季丰电子	微知健康软件（Andriod 版）	2019SR0451863	2015.12.21	未发表	2019.05.10	继受取得	无
14	季丰电子	微知健康软件（IOS 版）	2019SR0451859	2015.12.21	未发表	2019.05.10	继受取得	无

序号	权利人	软件名称	登记号	开发完成日	首次发表日	登记日期	取得方式	他项权利
15	季丰电子	微知健康图象识别软件（Andriod 版）	2019SR0451847	2015.12.21	未发表	2019.05.10	继受取得	无
16	季丰电子	微知健康图象识别软件（IOS 版本）	2019SR0458926	2015.12.21	未发表	2019.05.13	继受取得	无
17	季丰电子	季丰老化监控系统	2021SR0695359	2019.08.16	未发表	2021.05.14	原始取得	无
18	季丰电子	PowerMaster 电源管理软件	2021SR1070155	2020.10.08	未发表	2021.07.20	原始取得	无
19	季丰电子	销售报价系统	2022SR0029216	2021.05.13	未发表	2022.01.06	原始取得	无
20	季丰电子	MonitorMaster 电压电流监控系统	2022SR0297548	2021.10.08	未发表	2022.03.02	原始取得	无
21	季丰电子	季丰文件发布系统	2022SR0404897	2021.12.03	未发表	2022.03.29	原始取得	无
22	浙江季丰	季丰 ESD Report	2022SR0982355	2021.07.26	未发表	2022.08.01	原始取得	无
23	浙江季丰	季丰寄存器访问指令转 Pattern 软件	2022SR1097627	2022.06.10	未发表	2022.08.11	原始取得	无
24	杭州季丰	PowerMaster 电源管理软件	2022SR1345225	2022.05.19	未发表	2022.09.06	原始取得	无
25	浙江季丰	季丰老化监控系统	2022SR1360984	2022.03.02	未发表	2022.09.16	原始取得	无
26	杭州季丰	季丰电子收发件系统	2022SR1363969	2022.05.22	未发表	2022.09.20	原始取得	无
27	季丰电子	季丰 PM 项目管理系统	2022SR1401592	2022.06.01	未发表	2022.10.13	原始取得	无
28	季丰电子	季丰 ATE 机时预约系统	2023SR0185783	2022.11.08	未发表	2023.02.01	原始取得	无
29	季丰电子	季丰 IV Master 测试软件	2023SR0185784	2022.05.19	未发表	2023.02.01	原始取得	无
30	季丰电子	季丰 H160 上位机软件	2023SR0191118	2022.09.30	未发表	2023.02.02	原始取得	无
31	季丰电子	季丰 TagsMaster 标签生成软件	2023SR0829705	2022.06.09	未发表	2023.07.13	原始取得	无
32	杭州季丰	术语规范性检查软件	2023SR1207296	2023.07.17	未发表	2023.10.10	原始取得	无
33	季丰电子	季丰测试设备管理系统	2023SR1246162	2023.06.09	未发表	2023.10.17	原始取得	无
34	季丰电子	季丰研发项目时间管理软件	2023SR1253186	2023.04.06	未发表	2023.10.18	原始取得	无
35	杭州季丰	季丰老化监控系统	2023SR1783420	2023.02.27	未发表	2023.12.27	原始取得	无
36	杭州季丰	PowerMaster 电源管理软件	2024SR0044352	2023.11.01	未发表	2024.01.08	原始取得	无
37	杭州季丰	HTOL 电压电流巡检工具软件	2024SR0075530	2023.08.10	未发表	2024.01.11	原始取得	无
38	杭州季丰	UHF 测试终端实时监听软件	2024SR0097957	2023.05.15	未发表	2024.01.15	原始取得	无

序号	权利人	软件名称	登记号	开发完成日	首次发表日	登记日期	取得方式	他项权利
39	杭州季丰	MonitorMaster 电压电流监控系统	2024SR0105170	2023.11.22	未发表	2024.01.16	原始取得	无
40	杭州季丰	季丰测试项目管理系统	2024SR0110267	2023.11.17	未发表	2024.01.16	原始取得	无
41	杭州季丰	季丰 IV Master 测试软件	2024SR0122451	2023.03.25	未发表	2024.01.18	原始取得	无
42	杭州季丰	季丰 ESD Report 软件	2024SR0142677	2023.10.15	未发表	2024.01.22	原始取得	无
43	杭州季丰	新型嵌入式温度控制系统	2024SR0155401	2023.11.20	未发表	2024.01.23	原始取得	无
44	杭州季丰	季丰温控仪上位机软件	2024SR0266764	2023.10.30	未发表	2024.02.09	原始取得	无
45	成都季丰	季丰图像显示与测量软件	2024SR0269580	2023.10.01	未发表	2024.02.18	原始取得	无
46	杭州季丰	季丰 H160 上位机软件	2024SR0303427	2023.10.31	未发表	2024.02.23	原始取得	无
47	季丰物业	季丰健身场地预约系统	2024SR0334174	2022.07.07	未发表	2024.02.29	继受取得	无
48	深圳季丰	高速位移激光传感器控制软件	2024SR0378819	2023.10.10	未发表	2024.03.12	原始取得	无
49	成都季丰	自动载入测试文件的工具软件	2024SR0502025	2022.11.30	未发表	2024.04.12	原始取得	无
50	成都季丰	基于 MES 交互的自动化测试工具软件	2024SR0503046	2023.02.20	未发表	2024.04.15	原始取得	无
51	深圳季丰	季丰 ESD 伴侣系统	2024SR0664623	/	未发表	2024.05.16	原始取得	无
52	成都季丰	电压电流日志查看工具软件	2024SR0765254	/	未发表	2024.06.05	原始取得	无
53	成都季丰	PTC 上位机测试工具软件	2024SR0774916	/	未发表	2024.06.06	原始取得	无
54	江山季丰	季丰 ATE 多 site 项目的资源检查软件	2024SR0801433	/	未发表	2024.06.13	原始取得	无
55	深圳季丰	测试数据提取与分析工具软件	2024SR0887565	/	未发表	2024.06.28	原始取得	无
56	浙江季丰	晶圆测试数据提取与分析工具软件	2024SR0894275	/	未发表	2024.06.28	原始取得	无
57	浙江季丰	晶圆测试数据转换与分析工具软件	2024SR0894791	/	未发表	2024.06.28	原始取得	无
58	浙江季丰	Channel Map 转换工具软件	2024SR0911884	/	未发表	2024.07.02	原始取得	无
59	浙江季丰	季丰 F160 Pattern 生成工具软件	2024SR0911241	/	未发表	2024.07.02	原始取得	无
60	深圳季丰	季丰测试服务应付台账管理系统	2024SR1022334	/	未发表	2024.07.18	原始取得	无
61	季丰技术	ATE 数据筛选提取工具软件	2024SR1036378	/	未发表	2024.07.22	原始取得	无

序号	权利人	软件名称	登记号	开发完成日	首次发表日	登记日期	取得方式	他项权利
62	季丰技术	季丰图库管理软件	2024SR1091993	/	未发表	2024.07.31	原始取得	无
63	季丰技术	测试数据可视化工具软件	2024SR1134457	/	未发表	2024.08.06	原始取得	无
64	季丰技术	季丰 PCB 缺陷识别系统	2024SR1189877	/	未发表	2024.08.15	原始取得	无
65	季丰技术	季丰测试文件管理系统	2024SR1212688	/	未发表	2024.08.20	原始取得	无
66	季丰电子	季丰测试设备管理系统	2024SR1303657	/	未发表	2024.09.04	原始取得	无
67	季丰精密	探针台上位机控制软件	2024SR1453483	/	未发表	2024.09.29	原始取得	无
68	季丰精密	射频信号功率的实时监控软件	2024SR1471266	/	未发表	2024.10.08	原始取得	无
69	季丰精密	季丰 usb 相机调节控制软件	2024SR1471762	/	未发表	2024.10.08	原始取得	无
70	季丰精密	基于 FPGA 的 DDR4 控制器软件	2024SR1473016	/	未发表	2024.10.08	原始取得	无
71	季丰精密	基于 FPGA 的采样设置软件	2024SR1474111	/	未发表	2024.10.08	原始取得	无
72	深圳季丰	多用途的测试接口扩展控制软件	2024SR1479460	/	未发表	2024.10.09	原始取得	无
73	深圳季丰	步进电机的高精度控制系统	2024SR1480766	/	未发表	2024.10.09	原始取得	无
74	成都季丰	用于测试业务的消息认证服务中间件软件	2024SR1497256	/	未发表	2024.10.11	原始取得	无
75	成都季丰	测试数据的云端自动传输软件	2024SR1529345	/	未发表	2024.10.15	原始取得	无
76	季丰技术	季丰 PCB Release 系统	2024SR1541122	/	未发表	2024.10.16	原始取得	无
77	成都季丰	季丰 FT 数据处理工具软件	2024SR1569352	/	未发表	2024.10.21	原始取得	无
78	成都季丰	季丰测试业务费用归集系统	2024SR1573356	/	未发表	2024.10.21	原始取得	无
79	深圳季丰	季丰测试工具领用系统用户端软件	2024SR1712010	/	未发表	2024.11.06	原始取得	无
80	深圳季丰	季丰 LabMaster 配置中心软件	2024SR1720605	/	未发表	2024.11.07	原始取得	无
81	深圳季丰	Pattern 文件修改及分析软件（Linux 版）	2024SR1721070	/	未发表	2024.11.07	原始取得	无
82	深圳季丰	季丰测试工具领用系统管理端软件	2024SR1723262	/	未发表	2024.11.07	原始取得	无
83	成都季丰	LabMaster 案件档案导出工具	2024SR1754451	/	未发表	2024.11.12	原始取得	无
84	成都季丰	ESD 测试结果自动处理系统	2024SR1760915	/	未发表	2024.11.12	原始取得	无

序号	权利人	软件名称	登记号	开发完成日	首次发表日	登记日期	取得方式	他项权利
85	成都季丰	季丰低高温控制系统的远程控制软件	2024SR1762296	/	未发表	2024.11.12	原始取得	无
86	亦庄季峰	测试单数据推送工具	2024SR1791614	/	未发表	2024.11.14	原始取得	无
87	亦庄季峰	季丰失效分析结果自动处理系统	2024SR1792715	/	未发表	2024.11.14	原始取得	无
88	亦庄季峰	季丰 DataSheet 自动识别工具	2024SR1792719	/	未发表	2024.11.14	原始取得	无
89	亦庄季峰	季丰串口工具	2024SR1793872	/	未发表	2024.11.14	原始取得	无
90	亦庄季峰	季丰 Pattern 编辑工具	2024SR1793876	/	未发表	2024.11.14	原始取得	无
91	成都季丰	多通道可调电阻 PXIE 板卡应用软件	2024SR1823050	/	未发表	2024.11.18	原始取得	无
92	成都季丰	多通道可调电阻 PXIE 板卡嵌入式软件	2024SR1831311	/	未发表	2024.11.19	原始取得	无
93	成都季丰	季丰测试流程优化系统	2024SR1957901	/	未发表	2024.12.03	原始取得	无
94	衢州季丰	光伏组件热斑效应测试软件	2024SR2107919	/	未发表	2024.12.17	原始取得	无
95	亦庄季峰	季丰失效分析图片的降噪软件	2024SR2112767	/	未发表	2024.12.18	原始取得	无
96	亦庄季峰	外部负载驱动电压实时调整软件	2024SR2115183	/	未发表	2024.12.18	原始取得	无
97	亦庄季峰	射频信号设备的高温可靠性测试软件	2024SR2121655	/	未发表	2024.12.18	原始取得	无
98	季丰技术	季丰测试信号的数据设置软件	2025SR0577030	/	未发表	2025.04.07	原始取得	无
99	季丰技术	Linux 与 PL 端数据传输程序	2025SR0577015	/	未发表	2025.04.07	原始取得	无
100	衢州季丰	户外实证数据可靠性验证系统	2025SR0660156	/	未发表	2025.04.22	原始取得	无
101	亦庄季峰	实验室图像数据报告自动化生成工具	2025SR0676039	/	未发表	2025.04.24	原始取得	无
102	亦庄季峰	LabMaster-PR 实验室报告生成工具	2025SR0673259	/	未发表	2025.04.24	原始取得	无
103	季丰技术	ECN 工程变更管理系统	2025SR0920263	/	未发表	2025.06.03	原始取得	无
104	季丰电子	SER 软错误率测试软件	2025SR1120437	/	未发表	2025.06.30	原始取得	无
105	季丰电子	超景深显微镜测量控制软件	2025SR1120478	/	未发表	2025.06.30	原始取得	无
106	深圳季丰	芯片自动化测试管理软件	2025SR1124050	/	未发表	2025.06.30	原始取得	无

序号	权利人	软件名称	登记号	开发完成日	首次发表日	登记日期	取得方式	他项权利
107	深圳季丰	PDA 端芯片测试分析的工时管理系统	2025SR1227083	/	未发表	2025.07.11	原始取得	无
108	深圳季丰	PDA 端芯片测试设备的工时管理系统	2025SR1470618	/	未发表	2025.08.06	原始取得	无
109	深圳季丰	web 端芯片测试设备的工时管理系统	2025SR1227688	/	未发表	2025.07.11	原始取得	无
110	深圳季丰	物料清单查询管理系统	2025SR1227099	/	未发表	2025.07.11	原始取得	无
111	亦庄季峰	测试数据收集及汇总系统	2025SR1380566	/	未发表	2025.08.07	原始取得	无
112	季丰电子	季丰 EMS 邮件提醒辅助工具软件	2024SR1305562	/	未发表	2024.09.04	原始取得	无
113	浙江季丰	晶圆自动化测试设备数据中台	2025SR2007755	/	未发表	2025.10.17	原始取得	无
114	浙江季丰	晶圆自动化测试设备管理系统	2025SR2017934	/	未发表	2025.10.20	原始取得	无
115	浙江季丰	晶圆自动化测试设备数据管理系统	2025SR2054761	/	未发表	2025.10.23	原始取得	无
116	浙江季丰	晶圆自动化测试设备参数配置管理系统	2025SR2039191	/	未发表	2025.10.22	原始取得	无
117	浙江季丰	芯片自动化测试设备管理系统	2025SR2096582	/	未发表	2025.10.29	原始取得	无
118	季丰电子	芯片电迁移测试系统	2026SR0312361	/	未发表	2026.02.24	原始取得	无
119	季丰电子	芯片电迁移测试校准系统	2026SR0312423	/	未发表	2026.02.24	原始取得	无
120	浙江季丰	芯片自动化测试设备参数配置管理系统	2026SR0444606	/	未发表	2026.03.17	原始取得	无
121	浙江季丰	芯片自动化测试设备数据管理系统	2026SR0436214	/	未发表	2026.03.16	原始取得	无
122	浙江季丰	芯片自动化测试设备数据平台	2026SR0540983	/	未发表	2026.04.08	原始取得	无
123	季丰电子	晶圆快速封装标签打印软件	2026SR0431138	/	未发表	2026.03.13	原始取得	无
124	季丰电子	晶圆快速封装打印软件	2026SR0440606	/	未发表	2026.03.16	原始取得	无
125	亦庄季峰	LIMS-FA 标签打印系统	2026SR0578408	/	未发表	2026.04.23	原始取得	无
126	亦庄季峰	LIMS_FA_PDA 系统	2026SR0475634	/	未发表	2026.03.23	原始取得	无
127	亦庄季峰	LIMS-FA 系统	2026SR0464981	/	未发表	2026.03.20	原始取得	无
128	浙江季丰	晶圆挑粒 MAP 处理软件	2026SR0556340	/	未发表	2026.04.13	原始取得	无

序号	权利人	软件名称	登记号	开发完成日	首次发表日	登记日期	取得方式	他项权利
129	季丰电子	众芯盛网表提取软件	2026SR0889865	/	/	2026.4.30	继受取得	
130	季丰电子	众芯盛电路原理图编辑软件	2026SR0889869	/	/	2026.4.30	继受取得	
131	季丰电子	众芯盛光学显微镜图像采集软件	2026SR0889868	/	/	2026.4.30	继受取得	
132	季丰电子	众芯盛图像自动拼接对准软件	2026SR0889866	/	/	2026.4.30	继受取得	
133	浙江季丰	季丰半导体量产测试设备物联网安全认证管理系统	2026SR0867845	/	未发表	2026.8.25	原始取得	